

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Montage Technology Co., Ltd.

瀾起科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6809)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列瀾起科技股份有限公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《2025年年度報告》《2025年年度報告摘要》，僅供參閱。

承董事會命
瀾起科技股份有限公司
董事長
楊崇和博士

香港，2026年3月30日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事楊崇和博士及Stephen Kuong-Io Tai先生；(ii)非執行董事Wang Rui博士及方周婕女士；及(iii)獨立非執行董事李若山博士、高秉強教授、Yuhua Cheng博士及單海玲博士。

公司代码：688008

公司简称：澜起科技

澜起科技股份有限公司 2025 年年度报告



董事长致辞

时光流转，岁序更新。当人工智能的浪潮以磅礴之势重塑全球科技格局，澜起科技在 2026 年初迎来了发展的重要里程碑——在香港联合交易所主板成功挂牌上市。立足国际资本市场的新起点，我们回望 2025 年：澜起人全面拥抱人工智能时代的到来，继续以技术创新夯实产品的根基。在为客户持续创造卓越价值的同时，我们笃行不怠，以期行稳致远。

战略引领：在 AI 浪潮中构筑运力护城河

人工智能的演进正将数据传输的“运力”提升至与算力、存力并重的战略高度，澜起也同时从内存互连芯片的全球领导者，进入更广阔的高速互连蓝海，稳步迈向我们的愿景：成为国际领先的全互连芯片设计公司。

我们精准把握 DDR5 迭代升级与 AI 产业爆发的双重机遇，持续推进产品创新与升级。报告期内，我们的内存互连芯片出货量大幅增长，DDR5 第五子代 RCD 芯片、第二子代 MRCD/MDR 芯片、新一代 CKD 芯片等新产品相继推出，我们持续在 JEDEC 牵头制定相关产品国际标准，引领内存互连技术的创新，进一步巩固在内存互连芯片领域的市场领先地位。

在 PCIe 高速互连领域，澜起的产品版图不断拓展。以自研高速 SerDes 技术为支撑，继 PCIe 5.0 Retimer 芯片实现产业化之后，我们新发布了 PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer 芯片以及相应的 AEC 解决方案。同时，PCIe 7.0 Retimer 以及 PCIe Switch 芯片的研发正在有序推进，我们将为客户提供更全面、更具竞争力的 PCIe 互连芯片解决方案。

CXL 技术生态蓬勃发展。作为全球首发内存扩展控制器（MXC）芯片的企业，我们与合作伙伴共同推动 CXL 技术的成熟及商用。报告期内，我们推出了符合 CXL 3.1 标准的 MXC 芯片，并已向主要客户送样。我们欣喜地看到，CXL 内存池化与扩展应用正在加速落地，而 AI 推理应用的到来将成为其规模部署的关键催化剂。

以太网及光互连是高速互连的关键环节，也是我们战略拓展的重要方向。目前，我们正在研发以太网 Phy Retimer 芯片，加快在该领域的产品布局。基于在高速 SerDes 技术领域的长期积累与成熟的产业化经验，我们有信心在该领域实现新的技术与市场突破。

创新是澜起科技发展的根基。过去一年，清晰的产品战略、高效的研发执行以及精准的市场洞察，共同凝聚成推动公司业绩新高的核心引擎。2025 年，公司营收 54.56 亿元，同比增长 49.9%，归母净利润 22.36 亿元，同比增长 58.4%，实现了跨越式发展。

人本为先：凝聚国际一流的硬科技团队

作为一家以研发为核心的硬科技企业，人才是我们最宝贵的财富。我们始终面向全球技术前沿，持续吸引并汇聚高水平研发与管理人才，打造具备国际视野与系统工程能力的卓越团队。

我们坚持“人本为先”，营造多元和包容的职场环境，推动人才与公司共同成长。我们持续推进“以事业吸引人才，以文化凝聚人才，以机制激励人才”的立体人才战略，构建具有市场竞争力的薪酬体系与多层次福利保障，推动全员持股计划，强化员工、企业与股东之间的利益共享。我们关注员工职业发展与身心健康，并通过系统化的人才培养机制激发个体潜能与集体动能，为公司在全球竞争中保持长期韧性与可持续增长提供坚实的人才保障。

2025 年，我们的全球研发技术团队持续扩大，总人数达 583 人，占员工总数的 74.4%，其中硕士及以上学历的占比 64%。

治理筑基：以透明合规护航长期价值

公司治理是企业可持续发展的基石。我们以 H 股上市为契机，持续优化董事会结构、完善内控体系、强化商业道德与合规管理，进一步构建权责清晰、运行高效的治理机制。我们的董事会新增一名独立董事，独立董事占比提升至 50%，结构更趋于多元与平衡。我们坚持负责任运营，积极参照国际电子行业负责商业联盟的标准管理自身和供应链，致力于打造诚信、透明、可持续的商业生态。我们的信息披露工作已连续三年被上交所评定为 A 级（优秀），并首次入选上证 50 指数成分股，资本市场影响力进一步提升。

我们高度重视股东回报，通过持续的分红与回购，与投资者共享发展成果。报告期内，公司派发现金红利 6.70 亿元，回购股份 4.20 亿元；自 2019 年 7 月 A 股上市以来至 2025 年末，我们已累计派发现金红利 23.67 亿元，累计回购股份 14.30 亿元。公司已连续四年将市值纳入高管考核体系，引导管理层聚焦长期价值创造。

绿色运营：低碳发展，践行环境责任

澜起将绿色理念融入产品研发与企业运营。在产品源头，我们坚持“低功耗”的研发理念，我们的 DDR5 第五子代 RCD 芯片，在同等速率下相较第一子代产品功耗下降近 40%，以技术创新助力数据中心能效提升。在供应链管理中，我们携手合作伙伴共建责任供应链体系，严格执行无冲突矿产政策。在自身运营过程中，我们持续推进节能减排，优化废弃物回收与资源循环利用机制，并逐步扩大范围三碳排放的核算与披露，以更透明的姿态践行环境责任。

回馈社会：公益担当，传递企业温度

企业的成长源于社会，也应当回馈社会。报告期内，我们积极参与行业生态共建与社会公益事业，通过支持教育、关爱社区等公益行动，履行企业公民责任，让科技发展的温度触达更多角落。

2026 年初登陆国际资本市场，是澜起科技发展的新起点。我们心怀感恩，亦知责任在肩。展望前路，我们将继续秉持“专注、创新、跨越”的企业精神，以技术驱动产业进步，以治理保障基业长青，以绿色运营守护生态，以真诚回馈社会。我们期待与所有利益相关方携手，在人工智能时代波澜壮阔的征程中，互连无限可能，赋能美好未来。

董事长：杨崇和

澜起科技股份有限公司

2026 年 3 月 30 日

重要提示

一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人杨崇和、主管会计工作负责人苏琳及会计机构负责人（会计主管人员）苏琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每10股派发现金红利人民币3.90元（含税）。截至2025年2月28日，公司的总股本1,222,200,021股，其中A股回购专用账户的股数为12,533,000股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为1,209,667,021股，以此计算合计拟派发现金红利471,770,138.19元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

公司2025年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。该分配方案经公司第三届董事会第十次会议审议通过，实际派发现金红利226,856,066.00元（含税）。2025年中期利润分配方案已于2025年10月实施完毕。此外，2025年度公司以现金为对价，通过集中竞价方式回购股份金额为420,723,405.89元（不含佣金、过户费等交易费用）。

综上，本年度公司现金分红（含回购）的合计为1,119,349,610.08元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为50.07%。

母公司存在未弥补亏损适用 不适用**八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项**适用 不适用**九、前瞻性陈述的风险声明**适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他适用 不适用

目录

第一节	释义.....	8
第二节	公司简介和主要财务指标.....	13
第三节	管理层讨论与分析.....	18
第四节	公司治理、环境和社会.....	87
第五节	重要事项.....	118
第六节	股份变动及股东情况.....	135
第七节	债券相关情况.....	143
第八节	财务报告.....	144

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的公司年度财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司原件的正本及公告原件。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、澜起科技	指	澜起科技股份有限公司
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
芯片、集成电路、IC	指	一种微型电子器件或部件，采用一定的半导体制作工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件通过一定的布线方法连接在一起，组合成完整的电子电路，并制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。IC 是集成电路（Integrated Circuit）的英文缩写
晶圆	指	又称 Wafer、圆片、晶片，是半导体集成电路制作所用的圆形硅晶片，在硅晶片上可加工制作各种电路元件结构，成为有特定电性功能的集成电路产品
集成电路设计	指	包括电路功能定义、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制及验证，以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程
流片	指	为了验证集成电路设计是否成功，必须进行流片，即从一个电路图到一块芯片，检验每一个工艺步骤是否可行，检验电路是否具备所需要的性能和功能。如果流片成功，就可以大规模地制造芯片；反之，则需找出其中的原因，并进行相应的优化设计。上述过程一般称之为工程流片，在工程流片成功后进行的大规模批量生产则称之为量产流片
工程样片	指	提供给客户用来进行前期工程验证和评估的芯片
量产版本芯片	指	通过客户评估及认证，用于量产和销售的最终版本芯片
数据中心	指	数据中心是一整套复杂的设施，不仅包括计算机系统和其它与之配套的设备（例如通信和存储系统），还包含冗余的数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置，它为互联网内容提供商、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽等业务
时钟芯片	指	Clock Chip，是指为电子系统提供其所需的时钟脉冲的芯片，其主要种类包括时钟发生器、去抖时钟芯片、时钟缓冲芯片等
时钟发生器芯片	指	Clock Generator，是指根据参考时钟来合成多个不同频率时钟的芯片
去抖时钟芯片	指	Jitter Attenuator，是指为其他芯片提供低抖动低噪声的参考时钟的芯片
时钟缓冲芯片	指	Clock Buffer，是指用于时钟脉冲复制/分配、格式转换、电平转化等功能的芯片
实时时钟芯片	指	Real-time clock（RTC），大多采用精度较高的晶体振荡器作为时钟源，可以提供精确的实时时间，或者为电子系统提供精确的时间基准。
插损、插损预算	指	“插损”是指信号通过某个组件（如连接器、电缆、滤波器等）后的功率损失，通常以分贝（dB）为单位；“插损预算”指在设计 and 构建传输链路时，根据系统要求预先分配给各组件的最大允许的插损总和，以确保最终信号强度在可接受范围内，满足传输标准
以太网	指	局域网（LAN）中最主流的通信技术标准，凭借高可靠性、可

		扩展性和持续演进的标准，成为有线网络的核心技术，随着 AI、物联网和自动驾驶的发展，其在高速互联、实时控制等领域的创新将加速推进
光互连	指	利用光信号进行数据传输的互连技术，通过采用光纤或集成光波导替代传统铜缆，解决电互连在带宽、传输距离和能效方面的瓶颈，是数据中心、5G 通信及云计算的核心技术
AI/人工智能	指	Artificial Intelligence 的缩写，指利用计算机系统模拟和扩展人类智能的技术和方法，涵盖机器学习、深度学习、自然语言处理等，旨在实现自动化决策和任务执行
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuit 的缩写，中文名称为专用集成电路，是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路，与通用集成电路相比具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点
AEC	指	Active Electrical Cable 的缩写，中文称为有源线缆，是一种内置电子元件的线缆，通过实时调整信号波形、补偿衰减或抑制噪声等，有效提升信号的传输距离和质量。
CPU	指	Central Processing Unit 的缩写，中文称为中央处理器，是一块超大规模的集成电路，是电子产品的运算核心和控制核心
CXL [®]	指	Compute Express Link [®] 的缩写，是一种开放性的互联协议标准，该标准于 2019 年推出，旨在提供 CPU 和专用加速器、高性能存储系统之间的高效、高速、低延时接口，以满足资源共享、内存池化和高效运算调度的需求
CXL [®] 联盟	指	Compute Express Link [®] Consortium，成立于 2019 年，是一个专注于推动高速互连技术标准化的国际行业组织，致力于制定和推广 Compute Express Link (CXL) 协议，以满足数据中心、云计算及人工智能等领域对高效、低延迟互连的需求
CSP	指	Cloud Service Provider 的缩写，中文称为云计算服务商，指为企业和个人提供云计算服务的第三方公司，通过互联网按需交付计算资源、存储、网络及软件服务
CKD	指	Clock Driver 的缩写，中文名称为时钟驱动器，根据 JEDEC 固态技术协会规范，当 DDR5 数据速率达到 6400MT/s 及以上时，台式机及笔记本电脑所使用的内存模组，需配备一颗专用的时钟驱动器，其核心功能是对来自 CPU 的高速内存时钟信号进行缓冲处理后，输出到内存模组（如 CUDIMM、CSODIMM）上的多个内存颗粒，以确保高频率下的时序一致性和信号完整性
CUDIMM	指	Clocked Unbuffered Dual In-Line Memory Module 的缩写，指搭配一颗 CKD 芯片的 UDIMM，此类内存模组主要应用于台式机
CSODIMM	指	Clocked Small Outline Dual In-Line Memory Module 的缩写，指搭配一颗 CKD 芯片的 SODIMM，此类内存模组主要应用于笔记本电脑
CAMM	指	Compression Attached Memory Module 的缩写，一种新型内存模组标准，采用 DDR5 内存颗粒，通过优化模组布局和使用更紧凑的连接器的实现更轻薄尺寸、更高容量、更低功耗和更优散热性能，未来主要用于笔记本电脑、移动工作站。
DDR	指	Double Data Rate 的缩写，意指双倍速率，是内存模块中用于使输出增加一倍的技术
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory 的缩写，中文名称为动态随机存取存储器，是一种半导体存储器
DIMM	指	Dual Inline Memory Module 的缩写，中文名称为双列直插内存

		模组，俗称“内存条”
DB	指	Data Buffer 的缩写，中文名称为数据缓冲器，用来缓冲来自内存控制器或内存颗粒的数据信号，主要用于服务器 LRDIMM
EDSFF	指	Enterprise & Data Center SSD Form Factor 的缩写，一种专为企业级存储系统及数据中心设计的固态硬盘外形规格标准，旨在提供更高密度、更优散热和更强扩展性的存储解决方案。
FPGA	指	Field Programmable Gate Array 的缩写，中文名称为现场可编程逻辑门阵列，属于专用集成电路中的一种半定制电路，是可编程的逻辑阵列，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
Fabless	指	没有晶圆厂的集成电路设计企业，只从事集成电路研发设计和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成，有时也代指此种商业模式
GPU	指	Graphics Processing Unit 的缩写，中文名称为图形处理器，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备上做图像和图形相关运算工作的微处理器
PC/I3C 总线	指	一种串行接口总线，用于多个主从设备之间的低速通信
I/O 集线器 (IOH) 芯片	指	是一款应用于英特尔新一代 Birch Stream 平台的芯片，旨在为云计算、大数据、企业存储等应用场景提供高集成度且灵活易用的 I/O 扩展解决方案
JEDEC	指	Joint Electron Device Engineering Council 的缩写，即 JEDEC 固态技术协会，成立于 1958 年，是全球微电子产业的权威标准化机构
津逮®产品线	指	公司往期定期报告中的津逮®服务器平台产品线
净利润率	指	归属于上市公司股东的净利润除以同期营业收入的比率
LPDDR	指	Low Power Double Data Rate，中文含义是低功耗双倍数据速率内存，指一种专为移动设备和功耗敏感型应用设计的低功耗 DRAM，具备较低电压和出色的能效表现，同时保持较高的数据传输速率。
LRDIMM	指	Load Reduced DIMM，中文名称为减载双列直插内存模组，采用了 RCD 和 DB 套片对地址、命令、控制信号及数据信号进行缓冲的服务器内存模组，主要用于服务器
LPCAMM	指	Low Power Compression Attached Memory Module 的缩写，是一种新型的内存模组标准，结合了 LPDDR 内存的低功耗特性与 CAMM 模组的紧凑设计，旨在为轻薄笔记本、移动工作站等设备提供高性能、低功耗且可升级的内存解决方案
MRDIMM	指	Multiplexed Rank DIMM 的缩写，中文名称为多路复用双列直插内存模组，是一种更高带宽的服务器内存模组，基于 DDR5 LRDIMM 架构，MRDIMM 采用“1+10”设计方案（即搭配 1 颗 MRCD 芯片和 10 颗 MDB 芯片），与 RDIMM/LRDIMM 相比，MRDIMM 可以同时访问内存模组上的两个阵列，实现双倍带宽。部分厂家将第一子代产品称为 MCRDIMM。
MRCD	指	Multiplexed Rank Registering Clock Driver 的缩写，用于 MRDIMM，与用于 RDIMM/LRDIMM 的 RCD 芯片相比，MRCD 芯片设计更为复杂、支持速率更高
MDB	指	Multiplexed Rank Data Buffer 的缩写，用于 MRDIMM，与用于 LRDIMM 的 DB 芯片相比，MDB 芯片设计更为复杂、支持速率更高
MXC	指	Memory Expander Controller 的缩写，中文名称为内存扩展控制器，是基于 CXL 协议的高带宽大容量内存扩展模组的芯片，同时通过 CXL 接口和主机相连，为服务器系统提供高带宽低延迟的内存访问性能，并且支持丰富的 RAS 功能，MXC

		主要应用于大数据、AI、云服务的内存扩展和池化
NVDIMM	指	Non-volatile DIMM 的缩写，中文名称为非易失性双列直插内存模组，使用非易失性的 flash 存储介质来保存数据，设备掉电关机后，NVDIMM 模组上面的实时数据不会丢失
NVMe SSD	指	Non-Volatile Memory express Solid State Disk，指支持非易失性内存主机控制器接口规范的固态硬盘
NRZ	指	Non-Return-to-Zero 的缩写，中文名称为不归零编码，是一种基础的数字信号编码方式，采用两种电平来表示二进制 1/0，逻辑 0 是低电平，逻辑 1 是高电平，每个时钟周期可传输 1 bit 信息
OEM	指	Original Equipment Manufacturer 的缩写，是指根据客户提供的设计和规格进行生产制造的公司，OEM 厂商负责生产，由客户提供设计方案，OEM 厂商通常不参与产品的设计过程
ODM	指	Original Design Manufacturer 的缩写，是指同时具备产品设计和生产制造能力的公司，ODM 厂商通常拥有独立的产品设计能力和自主知识产权，并可以根据客户的需求对原有设计进行灵活定制
PCI-SIG	指	Peripheral Component Interconnect Special Interest Group，成立于 1991 年，是一个专注于制定和管理计算机总线标准的国际性行业联盟，其核心职责是推动 PCI（外设组件互连）、PCI-X（PCI 扩展）和 PCI Express®（PCIe®）等技术的标准化与应用
PCIe®	指	Peripheral Component Interconnect Express 的缩写，是一种高速串行计算机扩展总线标准，可实现高速串行点对点双通道高带宽传输。是全球应用最广泛的高性能外设接口之一，提供了高速传输带宽的解决方案，已经在多个领域中得到广泛采用，其中包括云计算、服务器、存储、网络、检测仪表和消费类电子产品等
PCIe® Retimer	指	适用于 PCIe 协议的超高速时序整合芯片，主要解决数据中心数据高速、远距离传输时，信号时序不齐、损耗大、完整性差等问题
PCIe Switch	指	PCIe 交换芯片，是数据中心、AI 加速及存储系统的核心互连组件，通过扩展 PCIe 拓扑，实现多设备高效通信，解决主机与外围设备间的带宽瓶颈问题
PMIC	指	Power Management IC 的缩写，中文名称为电源管理芯片，本报告特指在 DDR5 内存模组上为各个器件提供多路电源的芯片
PAM4	指	4-Level Pulse Amplitude Modulation 的缩写，中文名称为四电平脉冲幅度调制，是一种高速数字信号调制技术，通过使用四个电压电平对数据进行编码，实现每个符号周期传输 2 bit 信息（如 00、01、10、11），相比 NRZ 技术，PAM4 能在相同带宽下实现传输速率翻倍，从而成为 PCIe 6.0 及其他高速信号互连的核心技术
RCD	指	Registering Clock Driver 的缩写，中文名称为寄存时钟驱动器，用来缓冲来自内存控制器的地址/命令/控制信号，用于 RDIMM 和 LRDIMM
RDIMM	指	Registered DIMM，中文名称为寄存式双列直插内存模组，采用了 RCD 芯片对地址、命令、控制信号进行缓冲的内存模组，主要应用于服务器
SPD	指	Serial Presence Detect 的缩写，中文名称为串行检测，本报告特指串行检测集线器，是专用于 DDR5 内存模组的 EEPROM（带电可擦可编程只读存储器）芯片，用来存储内存模组的相关

		键配置信息
SerDes	指	SER ializer（串行器）/ DE Serializer（解串器）的缩写，是一种主流的时分多路复用、点对点的串行通信技术，即在发送端将多路低速并行信号转换成高速串行信号，经过传输媒体（光缆或铜线），最后在接收端将高速串行信号重新转换成低速并行信号。作为一种重要的底层技术，SerDes 通常作为一些重要协议（比如 PCIe、USB、以太网等）的物理层，广泛应用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速互连
SODIMM	指	S mall O utline D IMM，中文名称为小型双列直插内存模组，主要应用于笔记本电脑
TS	指	T emperature S ensor 的缩写，中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器
UDIMM	指	U nbuffered D IMM，中文名称为无缓冲双列直插内存模组，指地址和控制信号不经缓冲器，无需做任何时序调整的内存模组，主要应用于台式机
UA Link	指	U ltra A ccelerator L ink 的缩写，是由 AMD、Intel、博通、思科、谷歌、HPE、Meta 和微软等八家厂商于 2024 年发起设立的一项新的开放互连技术标准，旨在为云计算和人工智能加速器提供高效、低延迟的数据传输和计算资源共享
VMware ESXi 7.0 U3	指	VMware 公司开发的一款服务器虚拟化操作系统，能够在单台物理服务器上同时运行多个虚拟机，每个虚拟机都可以独立运行操作系统和应用程序，其对硬件配置要求低，稳定性高，是业界领先的虚拟化平台。
展频振荡器	指	S pread S pectrum O scillator，一种基于扩展频谱技术的晶体振荡器，通过动态调制时钟频率分散电磁干扰能量，从而降低 EMI 辐射并提高系统稳定性。
瑞萨电子	指	R enesas E lectronic C orporation，知名半导体企业，日本东京证券交易所上市公司
IDT	指	I ntegrated D evice T echnology, I nc. 于 2019 年被瑞萨电子收购
Rambus	指	R ambus I nc.，美国纳斯达克上市公司
英特尔	指	I ntel C orporation，世界知名的半导体企业，美国纳斯达克上市公司
三星电子	指	世界知名的半导体及电子企业
海力士	指	世界知名的 DRAM 制造商
美光科技	指	世界知名的半导体解决方案供应商
中电投控	指	中国电子投资控股有限公司
嘉兴芯电	指	嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）
上海融迎	指	上海融迎投资合伙企业（有限合伙）
上海临理	指	上海临理投资合伙企业（有限合伙）
上海临丰	指	上海临丰投资合伙企业（有限合伙）
上海临骥	指	上海临骥投资合伙企业（有限合伙）
上海临利	指	上海临利投资合伙企业（有限合伙）
上海临国	指	上海临国投资合伙企业（有限合伙）
临桐建发	指	上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）
上海临齐	指	上海临齐投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴宏越	指	嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴莫奈	指	嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）
WLT	指	W LT P artners, L.P.
Xinyun I	指	X inyun C apital F und I , L.P.
Xinyun	指	X inyun C apital F und, L.P.
Xinyun III	指	X inyun C apital F und III , L.P.

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《澜起科技股份有限公司章程》
弗若斯特沙利文	指	弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司，是一家于 1961 年在纽约成立的独立全球咨询公司，提供行业研究及市场策略
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司，为香港交易及结算所有限公司的全资附属公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	澜起科技股份有限公司
公司的中文简称	澜起科技
公司的外文名称	Montage Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Montage Technology
公司的法定代表人	杨崇和
公司注册地址	上海市徐汇区漕宝路 181 号 1 幢 15 层
公司注册地址的历史变更情况	2021 年度，公司注册地址发生变更，变更前注册地址为：上海市徐汇区宜山路 900 号 1 幢 A6；变更后注册地址为：上海市徐汇区漕宝路 181 号 1 幢 15 层
公司办公地址	上海市徐汇区漕宝路 181 号和光天地 16 层
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	https://www.montage-tech.com/cn
电子信箱	ir@montage-tech.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅晓	孔旭
联系地址	上海市徐汇区漕宝路 181 号和光天地 16 层	上海市徐汇区漕宝路 181 号和光天地 16 层
电话	021-5467 9039	021-5467 9039
传真	021-5426 3132	021-5426 3132
电子信箱	ir@montage-tech.com	ir@montage-tech.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报（ www.cnstock.com ）、证券时报（ www.stcn.com ）、中国证券报（ www.cs.com.cn ）
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市徐汇区漕宝路 181 号和光天地 16 层

四、公司股票/存托凭证简况

（一）公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	澜起科技	688008	/
H股	香港联合交易所主板	澜起科技	6809	/

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
	签字会计师姓名	施瑾、方舟

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	5,456,316,783.63	3,638,911,068.29	49.94	2,285,738,498.23
利润总额	2,320,568,053.46	1,412,617,850.07	64.27	472,218,810.54
归属于上市公司股东的净利润	2,235,569,970.18	1,411,778,923.59	58.35	450,909,813.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,021,628,734.94	1,248,290,398.82	61.95	369,932,113.14
经营活动产生的现金流量净额	2,022,020,556.92	1,691,321,506.14	19.55	731,249,699.11
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	12,923,722,372.46	11,403,438,067.08	13.33	10,191,406,155.95
总资产	13,748,147,352.18	12,218,911,386.38	12.52	10,697,540,981.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
基本每股收益（元/股）	1.97	1.25	57.60	0.40
稀释每股收益（元/股）	1.96	1.25	56.80	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.78	1.10	61.82	0.33
加权平均净资产收益率（%）	18.25	13.41	增加4.84个百分点	4.44
扣除非经常性损益后的加权平均	16.50	11.85	增加4.65个百分点	3.64

净资产收益率 (%)				
研发投入占营业收入的比例 (%)	16.77	20.98	减少4.21个百分点	29.83

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2025 年度，公司营业收入 54.56 亿元，较上年度增长 49.94%，主要原因为：受益于 AI 产业趋势，行业需求旺盛，公司的互连类芯片出货量显著增加，推动公司相关产品销售收入较上年度大幅增长。

2025 年度，公司利润总额较上年度增长 64.27%，归属于母公司股东的净利润较上年度增长 58.35%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年度增长 61.95%，基本每股收益较上年度增长 57.60%。相关财务数据大幅增长主要原因包括：（1）营业收入较上年度增长 49.94%；（2）毛利率较上年度提升 4.10 个百分点。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2025 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,222,209,473.93	1,411,247,007.15	1,424,232,009.73	1,398,628,292.82
归属于上市公司股东的净利润	525,326,047.97	633,744,331.75	473,213,606.21	603,285,984.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	502,602,549.26	588,783,209.44	376,038,130.77	554,204,845.47
经营活动产生的现金流量净额	188,245,990.36	870,443,028.97	541,982,422.33	421,349,115.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2025 年金额	附注（如适用）	2024 年金额	2023 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	199,825.84	第八节 七、68、75		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	114,143,915.11	第八节 七、67	89,848,166.32	83,091,738.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	112,863,009.41	第八节 七、68、70	33,241,365.83	-40,127,881.26
委托他人投资或管理资产的损益	2,440,924.39	第八节 七、68	2,228,863.83	5,461,996.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443,490.48	第八节 七、74、75	-275,322.50	183,029.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,991,325.28	主要为结构性存款收益	45,294,374.04	43,297,069.32
减：所得税影响额	30,213,409.24		6,605,780.92	10,690,822.26
少数股东权益影响额（税后）	8,040,865.07		243,141.83	237,430.19
合计	213,941,235.24		163,488,524.77	80,977,699.99

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
扣除股份支付影响后的净利润	2,647,204,523.42	1,462,703,211.35	80.98	556,904,126.29

注：“扣除股份支付影响后的净利润”为公司剔除股份支付影响后归属于上市公司股东的净利润。

十一、非企业会计准则财务指标情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	本期数	上期数
会计指标：归属于上市公司股东的净利	2,235,569,970.18	1,411,778,923.59

润		
调整项目：股权支付费用（税后）	411,634,553.24	50,924,287.76
调整项目：港股上市费用（税后）	2,923,264.76	
非企业会计准则财务指标：归属于上市公司股东的净利润	2,650,127,788.18	1,462,703,211.35

选取该非企业会计准则财务指标的原因

股份支付费用指因公司股权激励而产生的费用，主要是以权益结算的股份支付费用（第二类限制性股票）。公司选取剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润作为非企业会计准则业绩指标，主要基于以下考虑：（1）股份支付费用可能因行权条件、估值模型变化产生波动，其本质属于管理工具而非经营结果，通过剔除这类费用，能够更客观地反映公司的实际经营成果，有助于投资者更准确地评估公司的核心业务盈利能力和经营效率，以进行横向比较同行业公司业绩表现，及纵向分析公司不同期间的经营成果；（2）以权益结算的股份支付费用是一种非现金性费用，不会导致公司实际的现金流出，虽然按照企业会计准则须在一定期限内进行摊销，但该费用并不直接影响公司的经营性现金流状况；因此剔除该费用影响，有利于还原公司主营业务盈利情况，为投资者评估公司的长期发展态势提供更可靠的数据支持。

选取的非企业会计准则财务指标或调整项目较上一年度发生变化的说明

适用 不适用

本年度，公司选取的非企业会计准则财务指标较上年度增加港股上市费用。

该非企业会计准则财务指标本期增减变化的原因

2025 年度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年度增长 58.35%，同时股份支付费用较上年度大幅增长，故剔除股份支付费用及上市费用后的归属于上市公司股东的净利润较上年度增长 81.18%，增幅大于归属于上市公司股东净利润的增长。

十二、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,783,494,750.68	823,304,333.04	-960,190,417.64	109,164,969.68
其他权益工具投资	22,270,908.60	27,755,580.30	5,484,671.70	1,449,504.20
其他非流动金融资产	575,243,925.97	583,514,277.41	8,270,351.44	25,870,909.32
合计	2,381,009,585.25	1,434,574,190.75	-946,435,394.50	136,485,383.20

十三、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

澜起科技是一家全球领先的无晶圆厂集成电路设计公司，致力于为云计算及 AI 基础设施提供创新、可靠及高能效的互连解决方案。目前我们拥有两大产品线，互连类芯片和津逮®产品。我们的互连类芯片主要包括内存接口芯片、内存模组配套芯片、PCIe Retimer 芯片、CXL MXC 芯片及时钟芯片等。津逮®产品主要包括津逮®CPU 及数据保护和可信计算加速芯片等。下图列示我们产品的功能及主要应用。

	主要产品	功能介绍	主要应用
互连类芯片			
内存互连芯片	RCD、DB、MRCD、MDB、CKD	<ul style="list-style-type: none"> 作为服务器CPU存取内存数据的通路，提升内存数据访问的速度及可靠性 	服务器及PC内存模组
	SPD、PMIC、TS	<ul style="list-style-type: none"> 内存模组配套芯片，用于实现系统主控设备与内存模组上组件之间的通信管理、内存模组上其他芯片的电源管理、内存模组温度监控等功能 	
PCIe/CXL互连芯片	PCIe Retimer	<ul style="list-style-type: none"> 主要用于解决在高速、远距离传输场景中时序不齐、衰减、完整性差等信号问题 	服务器
	CXL MXC	<ul style="list-style-type: none"> 用于内存池化及内存扩展 	服务器
时钟芯片	时钟发生器芯片、时钟缓冲芯片、展频振荡器	<ul style="list-style-type: none"> 用于为系统中的各类设备提供精准的时钟脉冲信号，确保系统正常运行 	广泛应用于各类电子系统
津逮®产品			
津逮®产品	津逮®CPU	<ul style="list-style-type: none"> 津逮®CPU是具有PrC（预检测）或DSC（动态安全检查）功能的x86架构CPU 	服务器
	数据保护和可信计算加速芯片	<ul style="list-style-type: none"> 用于解决数据中心等高并发数据加解密运算的需求 	服务器

➤ 互连类芯片产品线

一、内存互连芯片

(1) 内存接口芯片（RCD/DB、MRCD/MDB 及 CKD）

内存接口芯片是服务器内存模组（又称“内存条”）的核心逻辑器件，作为服务器 CPU 存取内存数据的必由通路，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。内存接口芯片需与内存厂商生产的各种内存颗粒和内存模组进行配套，并通过服务器 CPU、内存和 OEM 厂商针对其功能和性能（如稳定性、运行速度和功耗等）的全方位严格认证，才能进入大规模商用阶段。因此，研发此类产品不仅要攻克内存接口的核心技术难关，还要跨越服务器生态系统的高准入门槛。

- **RCD/DB 芯片**

DDR4 及 DDR5 内存接口芯片按功能可分为两类：一是寄存时钟缓冲器（RCD），用来缓冲来自内存控制器的地址、命令、时钟、控制信号；二是数据缓冲器（DB），用来缓冲来自内存控制器或内存颗粒的数据信号。RCD 与 DB 组成套片，可实现对地址、命令、时钟、控制信号和数据信号的全缓冲。仅采用了 RCD 芯片对地址、命令、时钟、控制信号进行缓冲的内存模组通常称为 RDIMM（寄存双列直插内存模组），而采用了 RCD 和 DB 套片对地址、命令、时钟、控制信号及数据信号进行缓冲的内存模组称为 LRDIMM（减载双列直插内存模组）。

澜起科技凭借其自主知识产权的高速、低功耗技术，长期致力于为新一代服务器平台提供符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案。随着 JEDEC 标准和内存技术的发展演变，我们先后推出了 DDR2-DDR5 系列内存接口芯片，可应用于各种缓冲式内存模组，包括 RDIMM 及 LRDIMM 等，满足高性能服务器对高速、大容量的内存系统的需求。我们的 DDR4 及 DDR5 内存接口芯片广泛应用于国际主流内存、服务器和云计算领域，并占据全球市场的重要份额。



图：RCD/DB 芯片及含 RCD/DB 芯片的 DDR5 LRDIMM 内存模组示意图

我们的 DDR4 内存接口芯片子代产品及其主要应用情况如下：

DDR4 内存接口芯片	主要应用
Gen1.0 DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2133
Gen1.0 DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2133
Gen1.5 DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2400
Gen1.5 DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2400
Gen2 DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2666
Gen2 DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2666
Gen2 Plus DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM、LRDIMM 和 NVDIMM，支持速率达 DDR4-3200
Gen2 Plus DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM，支持速率达 DDR4-3200

当前，DDR5 内存模组已取代 DDR4 成为市场主流产品。DDR5 是 JEDEC 标准定义的第 5 代双倍速率同步动态随机存取存储器标准。与 DDR4 相比，DDR5 采用了更低的工作电压（1.1V），同时在传输有效性和可靠性上又迈进了一步，最新推出的 DDR5 第五子代 RCD 芯片支持速率可达 8000MT/s，是 DDR4 最高速率（3200MT/s）的 2.5 倍。

我们的 DDR5 内存接口芯片子代产品及其主要应用情况如下：

DDR5 内存接口芯片	主要应用
Gen1.0 DDR5 RCD 芯片	DDR5 RDIMM 和 LRDIMM，支持速率达 DDR5-4800
Gen1.0 DDR5 DB 芯片	DDR5 LRDIMM，支持速率达 DDR5-4800
Gen2.0 DDR5 RCD 芯片	DDR5 RDIMM，支持速率达 DDR5-5600
Gen3.0 DDR5 RCD 芯片	DDR5 RDIMM，支持速率达 DDR5-6400
Gen4.0 DDR5 RCD 芯片	DDR5 RDIMM，支持速率达 DDR5-7200
Gen5.0 DDR5 RCD 芯片	DDR5 RDIMM，支持速率达 DDR5-8000

① DDR5 第一子代 RCD 芯片支持双通道内存架构，命令、地址、时钟和控制信号 1:2 缓冲，并提供奇偶校验功能。该芯片符合 JEDEC 标准，支持 DDR5-4800 速率，采用 1.1V 工作电压，更为节能。该款芯片除了可作为中央缓冲器单独用于 RDIMM 之外，还可以与 DDR5 DB 芯片组成套片，用于 LRDIMM，以提供更高容量、更低功耗的内存解决方案。

② DDR5 第一子代 DB 芯片是一款 8 位双向数据缓冲芯片，该芯片与 DDR5 RCD 芯片一起组成套片，用于 DDR5 LRDIMM。该芯片符合 JEDEC 标准，支持 DDR5-4800 速率，采用 1.1V 工作电压。在 DDR5 LRDIMM 应用中，一颗 DDR5 RCD 芯片需搭配十颗 DDR5 DB 芯片，即每个子通道配置五颗 DB 芯片，以支持片上数据校正，并可将数据预取提升至最高 16 位，从而为高端多核服务器提供更大容量、更高带宽和更强性能的内存解决方案。

③ 2022 年 5 月，公司在业界率先试产 DDR5 第二子代 RCD 芯片。DDR5 第二子代 RCD 芯片支持双通道内存架构，命令、地址、时钟和控制信号 1:2 缓冲，并提供奇偶校验功能。该芯片符合 JEDEC 标准，支持数据速率为 5600MT/s，采用 1.1V 工作电压，更为节能。

④ 2023 年 10 月，公司在业界率先试产 DDR5 第三子代 RCD 芯片。DDR5 第三子代 RCD 芯片支持的数据速率高达 6400MT/s，较第二子代 RCD 速率提升 14.3%，较第一子代 RCD 速率提升 33.3%。

⑤ 2024 年 1 月，公司推出 DDR5 第四子代 RCD 芯片。DDR5 第四子代 RCD 芯片支持的数据速率高达 7200MT/s，较第三子代 RCD 速率提升 12.5%，较第一子代 RCD 速率提升 50%。

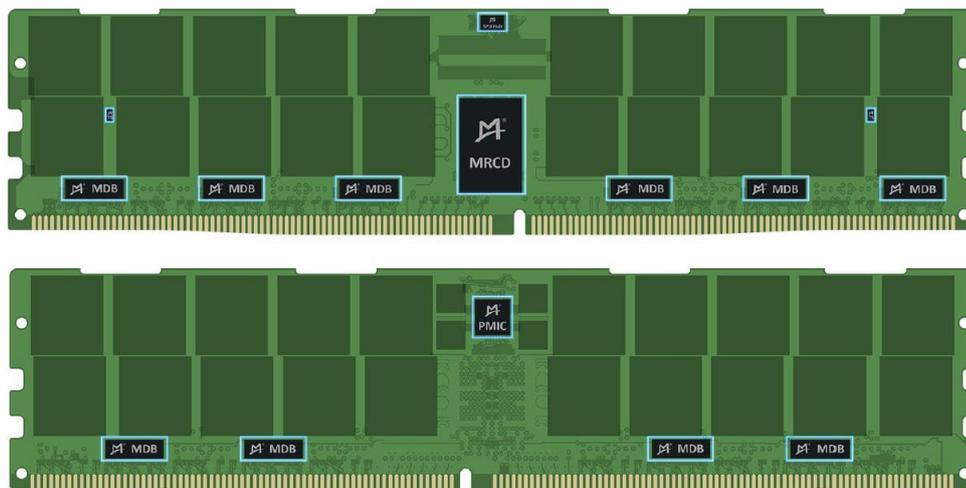
⑥ 2024 年第四季度，公司推出 DDR5 第五子代 RCD 芯片。DDR5 第五子代 RCD 芯片支持的数据速率高达 8000MT/s，较第四子代 RCD 速率提升 11.1%，较第一子代 RCD 速率提升 66.7%。

• **MRCO/MDB 芯片**

MRCO/MDB 芯片是服务器高带宽内存模组 MRDIMM 的核心逻辑器件。随着 AI 及大数据应用的发展以及相关技术的演进，服务器 CPU 的内核数量快速增加，对内存系统带宽的需求也日益迫切，以满足多核 CPU 中各个内核的数据吞吐要求，MRDIMM 正是基于这种应用需求而开发的。作为一种更高带宽的内存模组，第一子代 MRDIMM 支持 8800MT/s 速率，第二子代产品支持 12800MT/s 速率，每根 MRDIMM 模组均需要搭配 1 颗 MRCO、10 颗 MDB、1 颗 SPD、2 颗 TS 以及 1 颗 PMIC 芯片。

MRDIMM 的工作原理如下：MDB 芯片用来缓冲来自内存控制器或 DRAM 内存颗粒的数据信号，在标准速率下，通过 MDB 芯片可以同时访问两个 DRAM 内存阵列（而传统 RDIMM 只能访问一个阵列），从而实现双倍带宽。MRCO 则用来缓冲来自内存控制器的地址、命令、时钟、控制信号。MRDIMM 的特点和优势包括：①使用常规的 DRAM 颗粒；②与现有 DDR5 生态系统有良好的适配性；③能够大幅提升内存模组的带宽。

我们的 DDR5 第一子代 MRCO/MDB 芯片于 2024 年开始在行业规模试用。我们的第二子代 MRCO/MDB 芯片已成功向全球主要内存厂商送样，该芯片最高支持 12800MT/s 传输速率，旨在为下一代计算平台提供卓越的内存性能，满足云计算和人工智能等应用场景对内存带宽的迫切需求。



图：MRCO/MDB 芯片及含 MRCO/MDB 芯片的 MRDIMM 内存模组示意图

我们的 DDR5 高带宽内存接口芯片（MRCO/MDB）及其主要应用情况如下：

DDR5 高带宽内存接口芯片	主要应用
Gen1.0 DDR5 MRCD 芯片	DDR5 MRDIMM/MCRDIMM，支持速率达 DDR5-8800
Gen1.0 DDR5 MDB 芯片	DDR5 MRDIMM/MCRDIMM，支持速率达 DDR5-8800
Gen2.0 DDR5 MRCD 芯片	DDR5 MRDIMM，支持速率达 DDR5-12800
Gen2.0 DDR5 MDB 芯片	DDR5 MRDIMM，支持速率达 DDR5-12800

从下游应用来看，预计 MRDIMM 将在云计算、AI 等对内存带宽敏感的应用领域有较大的需求。随着 MRDIMM 未来渗透率的提升，MRCD/MDB（尤其是 MDB）芯片的需求也将大幅增长。

• CKD 芯片

在 DDR4 世代及 DDR5 世代初期，时钟驱动功能集成在 RCD 芯片中，用于服务器内存模组，尚未在 PC 端内存模组（如台式机和笔记本电脑）部署。随着 DDR5 传输速率持续提升，时钟信号频率越来越高，信号完整性问题愈发显著。根据 JEDEC 定义，当 DDR5 数据速率达到 6400MT/s 及以上时，PC 端内存模组需引入专用的时钟驱动器（CKD，即“Clock Driver”）芯片，对时钟信号进行缓冲和重新驱动，以满足高速时钟信号的完整性和可靠性要求。

我们的 DDR5 第一子代 CKD 芯片最高支持 7200MT/s 速率，旨在提高 PC 端内存模组的数据访问速度和稳定性，以匹配不断增长的 CPU 运行速度和性能需求。该芯片符合最新的 JEDEC 标准，支持双边带总线地址访问及 I²C、I³C 接口。通过配置寄存器控制字，该芯片可改变其输出信号特性以匹配不同 DIMM 的网络拓扑，并可通过禁用未使用的输出信号以降低功耗。报告期内，我们推出新一代 CKD 芯片，最高支持 9200MT/s 速率，可有效优化客户端内存子系统性能，为下一代高性能 PC、笔记本电脑及工作站提供关键技术支撑。



图：CKD 芯片及含 CKD 芯片的 CUDIMM 内存模组示意图

公司 DDR5 时钟驱动器芯片及其主要应用情况如下：

DDR5 时钟驱动器芯片	主要应用
Gen1.0 DDR5 CKD 芯片	DDR5 UDIMM/CUDIMM/CAMM，最高支持速率达 DDR5-7200
Gen1.0 Plus DDR5 CKD 芯片	DDR5 UDIMM/CUDIMM/CAMM，最高支持速率达 DDR5-9200

由于 AI PC 需要更高内存带宽以提升整体运算性能，AI PC 渗透率的提升预计将加速 DDR5 的子代迭代，并推动对更高速率 DDR5 内存的需求。因此，AI PC 应用的普及将助推 CKD 芯片的需求提升。

(2) 内存模组配套芯片 (SPD、TS、PMIC)

根据 JEDEC 标准,DDR5 内存模组上除了内存颗粒及内存接口芯片外,还需要三种配套芯片,分别是串行检测集线器 (SPD)、温度传感器 (TS) 以及电源管理芯片 (PMIC)。

我们的内存模组配套芯片产品及其主要应用情况如下:

内存模组配套芯片	主要应用
DDR5 SPD	DDR5 RDIMM、LRDIMM、MRDIMM/MCRDIMM、UDIMM、SODIMM、CUDIMM、CSODIMM、CAMM 和 LPCAMM
DDR5 TS	DDR5 RDIMM、LRDIMM 和 MRDIMM/MCRDIMM
DDR5 PMIC	DDR5 RDIMM 和 LRDIMM

• 串行检测集线器 (SPD)

我们与合作伙伴共同研发了 DDR5 串行检测集线器 (SPD), 芯片内部集成了 8Kbit EEPROM、I²C/I³C 总线集线器 (Hub) 和温度传感器 (TS), 适用于 DDR5 系列内存模组 (如 LRDIMM、RDIMM、MRDIMM、UDIMM、SODIMM、CUDIMM、CSODIMM、CAMM 和 LPCAMM 等), 应用范围包括服务器、台式机及笔记本内存模组。SPD 是 DDR5 内存模组不可或缺的组件, 也是内存管理系统的关键组成部分, 其包含如下几项功能:

第一, 其内置的 SPD EEPROM 是一个非易失性存储器, 用于存储内存模组的相关信息以及模组上内存颗粒和相关器件的所有配置参数。根据 JEDEC 的内存规范, 每个内存模组都需配置一个 SPD 器件, 并按照 JEDEC 规范的数据结构编写 SPD EEPROM 的内容。主板 BIOS 在开机后会读取 SPD 内存储的信息, 并根据读取到的信息来配置内存控制器和内存模组。DDR5 SPD 数据可通过 I²C/I³C 总线访问, 并可按存储区块 (block) 进行写保护, 以满足 DDR5 内存模组的高速率和安全要求。

第二, 该芯片还可以作为 I²C/I³C 总线集线器, 一端连接系统主控设备 (如 CPU 或基板管理控制器 (BMC)), 另一端连接内存模组上的本地组件, 包括 RCD、PMIC 和 TS, 是系统主控设备与内存模组上组件之间的通信中心。在 DDR5 规范中, 一个 I²C/I³C 总线上最多可连接 8 个集线器 (8 个内存模组), 每个集线器和该集线器管理下的每个内存模组上的本地组件都被指定了一个特定的地址代码, 支持唯一地址固定寻址。

第三, 该芯片还内置了温度传感器 (TS), 可连续监测 SPD 所在位置的温度。主控设备可通过 I²C/I³C 总线从 SPD 中的相关寄存器读取传感器检测到的温度, 以便于进行内存模组的温度管理, 提高系统工作的稳定性。

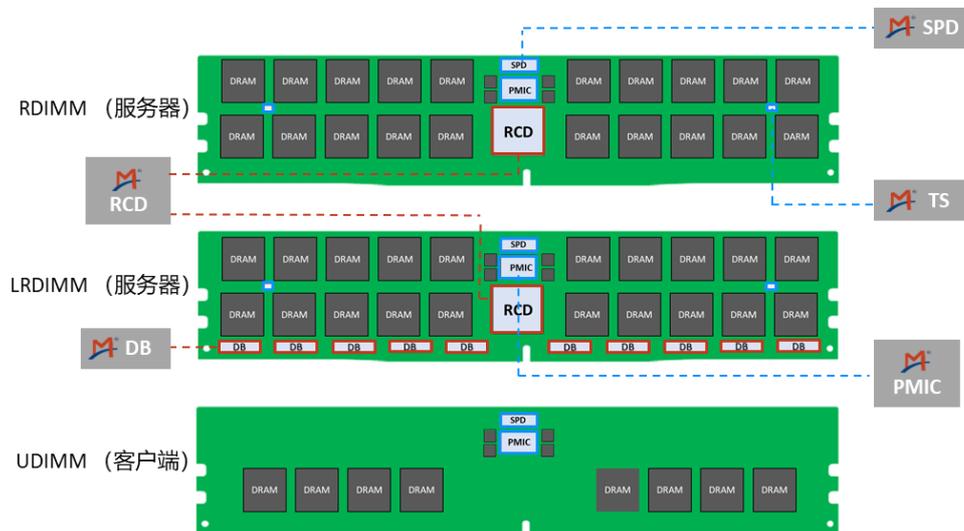
• 温度传感器 (TS)

我们与合作伙伴共同研发了 DDR5 高精度温度传感器 (TS) 芯片, 该芯片符合 JEDEC 规范, 支持 I²C 和 I3C 串行总线, 适用于 DDR5 服务器内存模组 (如 RDIMM、LRDIMM 和 MRDIMM)。TS 作为 SPD 芯片的从设备, 可以工作在时钟频率分别高达 1MHz I²C 和 12.5MHz I3C 总线上; CPU 可经由 SPD 芯片与之进行通讯, 从而实现对内存模组的温度管理。TS 是 DDR5 服务器内存模组上重要组件, 通常一条内存模组配置 2 颗 TS。

• 电源管理芯片 (PMIC)

我们的 DDR5 电源管理芯片 (PMIC) 符合 JEDEC 规范, 其作用主要是为内存模组上的其他芯片 (如 DRAM、RCD、DB、SPD 和 TS 等) 提供电源支持, CPU 可经由 SPD 芯片与之进行通讯, 从而实现电源管理。

我们的 DDR5 SPD、TS、PMIC 芯片在内存模组中的位置示意图如下:



2. PCIe/CXL 互连芯片

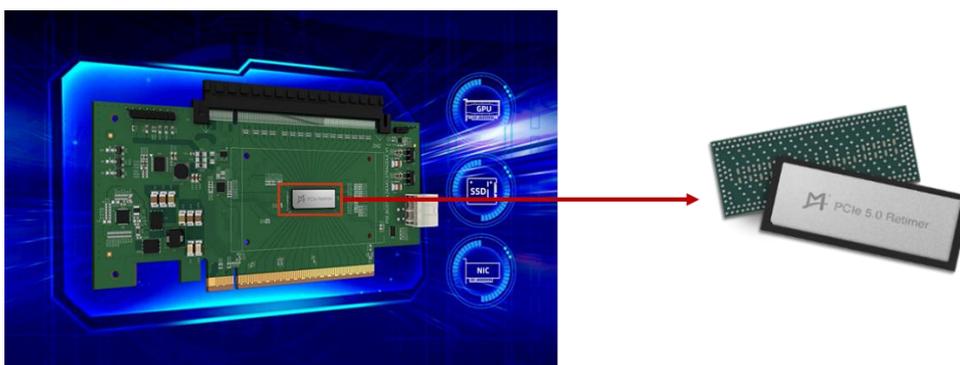
(1) PCIe Retimer 芯片

PCIe Retimer 芯片是适用于 PCIe 高速数据传输协议的超高速时序整合芯片。近年来, 随着 PCIe 协议从 3.0 (8 GT/s) 发展至 4.0 (16 GT/s)、5.0 (32 GT/s), 并逐步迈向 6.0 (64 GT/s) 和 7.0 (128 GT/s), 数据传输速率的不断翻倍带来了显著的信号衰减和参考时钟时序重整问题, 这些问题极大地限制了 PCIe 协议在下一代计算平台的应用范围, 促使行业加大对高速电路与系统互连设计的优化需求, 同时也推动了在超高速传输环境下保持信号完整性的研发工作。

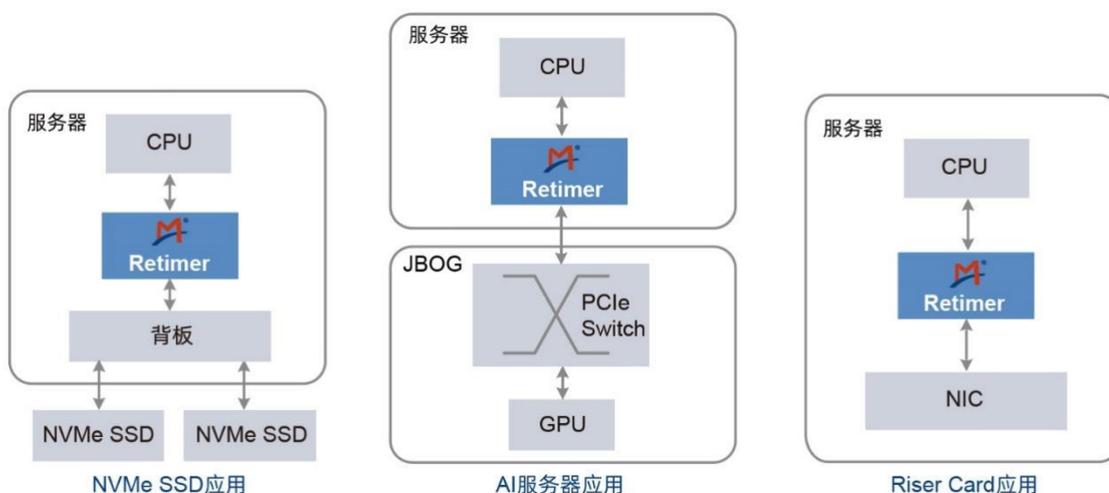
为了补偿高速信号的损耗、提升信号质量，超高速时序整合芯片（Retimer）应用而生。目前，PCIe Retimer 芯片已成为高速电路中不可或缺的重要器件，尤其在数据中心的数据高速、远距离传输场景中，可有效解决信号时序不齐、损耗严重、完整性差等问题。

PCIe Retimer 芯片采用先进的信号调理技术，能够补偿信道损耗并消除各种抖动源的影响，从而提升信号完整性，增加高速信号的有效传输距离，为服务器、存储设备及硬件加速器等应用场景提供可扩展的高性能 PCIe 互连解决方案。我们量产的 PCIe Retimer 产品组合包括 PCIe 4.0 Retimer 及 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer。其中，PCIe 4.0 Retimer 芯片符合 PCIe 4.0 基本规范，支持 16 GT/s 的传输速率，可补偿高达 28 dB 的信道损耗；PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 符合 PCIe 5.0 和 CXL 2.0 基本规范，支持 32 GT/s 的传输速率，可补偿高达 36 dB 的信道损耗，支持业界主流封装，其功耗、传输延时等关键性能指标达到国际先进水平，并已与 CPU、PCIe 交换芯片、固态硬盘、GPU 及网卡等进行了广泛的互操作测试。报告期内，我们推出了 PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer 芯片，支持 64 GT/s 的传输速率，采用 PAM4 SerDes 技术，支持高达 43 dB 的链路预算，可用于通用及 AI 服务器、有源线缆（AEC）和存储系统等典型应用场景。

我们的 PCIe Retimer 芯片及其对应板卡的示意图如下：



PCIe Retimer 芯片的典型应用场景图示如下：



我们的 PCIe Retimer 芯片及其主要应用情况如下：

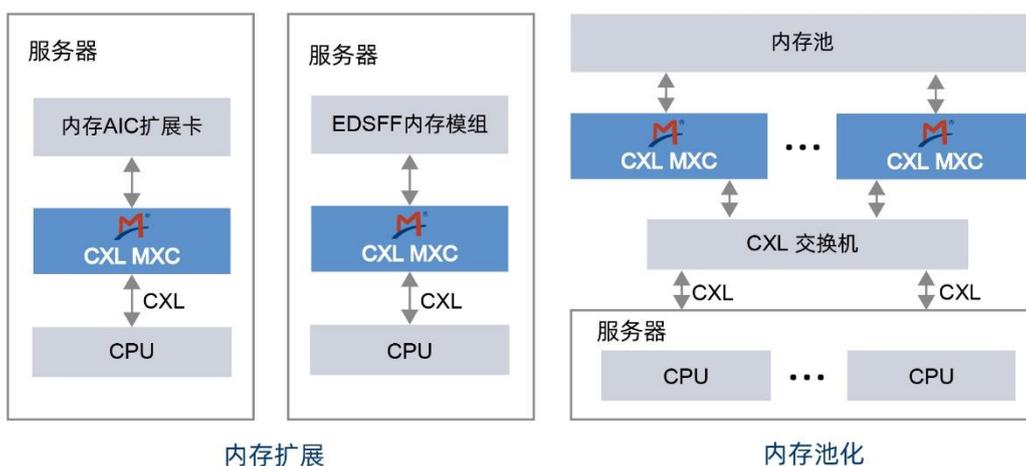
PCIe Retimer 芯片	主要应用场景
8 通道 PCIe 4.0 Retimer	服务器、存储设备和硬件加速器
16 通道 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer	服务器、存储设备和硬件加速器
16 通道 PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer	服务器、存储设备和硬件加速器

在人工智能时代，AI 服务器需求迅猛增长，PCIe Retimer 芯片的重要性日益突出。以配置 8 块 GPU 的典型 AI 服务器为例，通常需要 8 至 16 颗 PCIe Retimer 芯片；部分国产 AI 服务器为满足扩展的需求，配置了 24 颗 PCIe Retimer 芯片。随着 AI 服务器需求量持续攀升，以及 PCIe 协议传输速率不断升级，PCIe Retimer 芯片的市场空间也将进一步扩大。

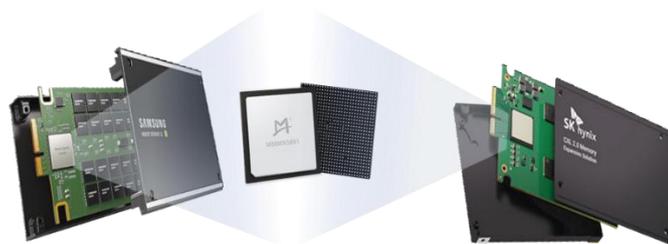
(2) CXL MXC 芯片

MXC 芯片是一款 CXL 内存扩展控制器芯片，属于 CXL 协议所定义的第三种设备类型。该芯片可为 CPU 及基于 CXL 协议的设备提供高带宽、低延迟的高速互连解决方案，实现 CPU 与各 CXL 设备间的内存共享，在大幅提升系统性能的同时，显著降低软件堆栈复杂性和数据中心总体拥有成本（TCO）。

MXC 芯片主要应用于内存扩展及内存池化领域，为内存 AIC 扩展卡、背板及 EDSFF 内存模组而设计，可大幅扩展内存容量和带宽，满足云计算、人工智能等数据密集型应用日益增长的需求，典型应用场景如下：



MXC 芯片目前的产品应用形态主要有两种：EDSFF 模组、AIC(Add In Card)连接标准 DDR5/4 内存模组。



产品应用形态一：EDSFF 模组



产品应用形态二：AIC（Add In Card）连接标准 DDR5/4 内存模组

2022 年 5 月，我们发布了全球首款 CXL MXC 芯片，并支持三星电子、SK 海力士等内存厂商推出相关 CXL 内存产品，加速下一代存储器解决方案的商用化进程。目前，我们的 MXC 芯片已顺利通过 CXL 联盟的数十项严苛测试，列入 CXL 1.1 和 CXL 2.0 的合规供应商清单，保持在该领域的领先地位。报告期内，我们推出了 CXL 3.1 MXC 芯片，采用自研的 PCIe® 6.2 物理层接口，支持最高 64 GT/s 的传输速率（x8 通道），内置双通道 DDR5 内存控制器，支持速率高达 8000 MT/s。我们与 CPU/GPU 厂商、DRAM 内存厂商、云服务提供商（CSP）、服务器 OEM/ODM 厂商等生态伙伴共同合作，以推动 CXL 技术获得更广泛的应用。

人工智能、云计算的快速发展，对突破内存瓶颈提出了迫切需求，推动业界加快部署内存扩展、内存池化等 CXL 技术的典型应用。在人工智能领域，CXL 技术通过支持 GPU 和 FPGA 等加速器与 CPU 的高效协作，可显著提升 AI 训练和推理效率，并提供低延迟、高带宽的数据传输；同时，CXL 技术支持内存扩展和内存共享，为 AI 应用提供更大容量、更灵活调配的内存资源。因此，CXL 内存将成为人工智能时代最具前景的内存解决方案之一。

3. 时钟芯片

时钟芯片是为电子系统提供其必要的时钟脉冲的芯片。在数字系统中，时钟脉冲是集成电路运转的节拍器，在电子系统中扮演着“心脏”的重要角色。时钟芯片为不同的芯片和功能模块提供统一的时序基准，确保系统各部件的协调、稳定运行。对于数据处理速率与准确度需求较高的

应用场景，时钟系统通常以独立芯片或模块的形式存在。时钟芯片主要包括时钟发生器芯片、时钟缓冲芯片、去抖时钟芯片、振荡器及实时时钟芯片（RTC）等。

我们推出了时钟发生器芯片、时钟缓冲芯片和展频振荡器（即支持展频功能的差分振荡器）。其中时钟发生器产品支持最高 4 路独立差分输出，提供高精度时钟源；时钟缓冲器具备 4 至 10 路可扩展输出，实现信号无损分配；展频振荡器在提供高精度时钟源的同时，可通过展频功能有效抑制电磁干扰（EMI），提升系统稳定性。我们的时钟芯片采用先进的数模混合架构，实现业界领先的超低输出相位噪声，每个输出通道均支持独立配置 I/O 类型、驱动能力、电压值、输出频率及展频参数，可精准匹配不同接收端的需求，显著提升信号完整性，同时降低系统功耗与设计复杂度。

随着 AI 算力的迅猛增长、5G 通信的持续升级及工业自动化的不断深化，市场对时钟信号的精度与稳定性要求日益严格。我们的时钟芯片产品凭借高可靠性、低抖动和广泛适配能力，已成功通过多家头部客户的测试验证，未来将广泛应用于 AI 服务器与数据中心、通信基础设施、工业控制设备、消费电子及汽车电子等领域。



图：澜起科技时钟芯片示意图

➤ 津逮®产品线

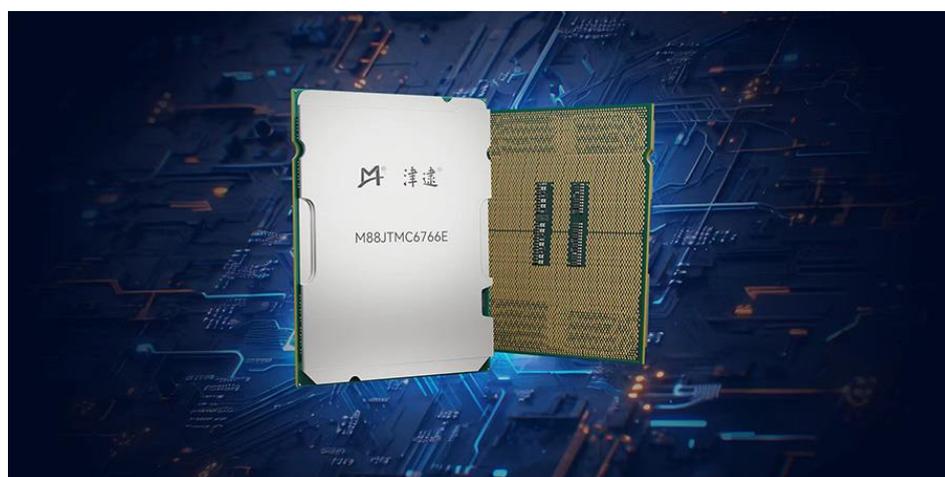
我们的津逮®产品线主要包括津逮®CPU 及数据保护和可信计算加速芯片等。该产品线具备芯片级实时安全监控功能，可在信息安全领域发挥重要作用，为云计算数据中心提供更为安全、可靠的运算平台。此外，该产品线还融合了先进的异构计算与互联技术，可为大数据及云计算时代的各种应用提供强大的综合数据处理及计算力支撑。

1. 津逮®CPU

津逮®CPU 是一系列具有预检测、动态安全监控功能的 x86 架构处理器，适用于津逮®或其他通用的服务器平台。我们先后推出了第一代至第六代津逮®CPU，以更好满足用户对安全可靠算力日益提升的需求。

2019 年 5 月，公司发布第一代津逮®CPU；2020 年 8 月，公司发布第二代津逮®CPU；2021 年 4 月，公司发布第三代津逮®CPU。2022 年 10 月，公司第三代津逮®CPU 系列产品通过了 VMware 公司的产品兼容性认证，达到 VMware ESXi 7.0 U3 虚拟化平台的通用兼容性及性能、可靠性要求，满足用户的关键应用需求。2023 年 1 月 12 日，公司发布第四代津逮®CPU。2023 年 12 月 18 日，公司发布第五代津逮®CPU。2024 年 6 月，公司发布全新第六代津逮®能效核 CPU。

2025 年 8 月，我们发布了第六代津逮®性能核 CPU，单颗 CPU 最高支持 86 个高性能核心和 172 个线程，最大三级缓存容量达 336MB，内存子系统采用 8 通道 DDR5 架构，最高支持 6400MT/s 的 RDIMM 或 8000MT/s 的 MRDIMM，显著提升内存带宽与扩展能力，在 I/O 方面，提供 88 条 PCIe® 5.0 通道，并兼容 CXL® 2.0 协议，为 GPU、FPGA 等加速器提供卓越的连接带宽。



图：第六代津逮®能效核 CPU

2. 数据保护和可信计算加速芯片

我们的数据保护和可信计算加速芯片采用公司自主创新的 Mont-TSSE®可信安全系统扩展架构和技术，将硬件级数据加解密和平台可信度量两大核心功能融合于单一芯片之上。芯片内部集成了高速加解密、安全 SoC 和硬件信任根（HRoT）三个子系统。

该芯片硬件支持 SM2/3/4、SHA-256/384/512、AES、RSA、ECC 等商密算法和国际主流加解密算法加速，可广泛应用于对数据保密性、完整性要求极高的场景，如 AI 训练和推理、分布式数据存储、零信任架构等。芯片内置多个真随机数发生器(TRNG)，搭配 PCIe 5.0 ×8 高速接口，可提供高达 160Gbps 的吞吐量，多颗芯片集成可实现加密处理能力倍增，从而为数据中心提供高性能加解密算力支持，助力商密算法在数据中心落地应用。

该芯片广泛兼容多项可信计算标准，具备出色的泛在可信优势。芯片符合 TPM、TCM 和 TPCM 等可信计算标准，遵从商密 GM/T 0008-2012、GM/T 0012-2020、GM/T 0028-2014 等多项设计、测试、接口标准，并兼顾 FIPS-140 设计要求和 NIST SP 800-193 固件安全标准，支持 MCTP/SPDM

等协议。芯片可作为硬件信任根(HRoT)使用，满足可信平台 3.0 规范的需求，保障服务器、台式机、嵌入式终端、加速卡（AI 卡）等各类设备启动运行期间的平台安全。

该芯片可用于解决数据中心等高并发数据加解密运算的需求，同时因为其具有低功耗特点，也适用于端侧、边缘侧、嵌入式系统中对数据和平台安全有需求的场景。



图：澜起科技数据保护和可信计算加速芯片

津逮®产品主要针对中国本土市场，截至目前，已有多家服务器厂商采用津逮®产品，开发出了系列高性能且具有独特安全功能的服务器机型。这些机型已应用到政务、交通等领域及高科技企业中，为用户实现了计算资源池的无缝升级和扩容，在保障强劲运算性能的同时，更为用户的数据、信息安全保驾护航。

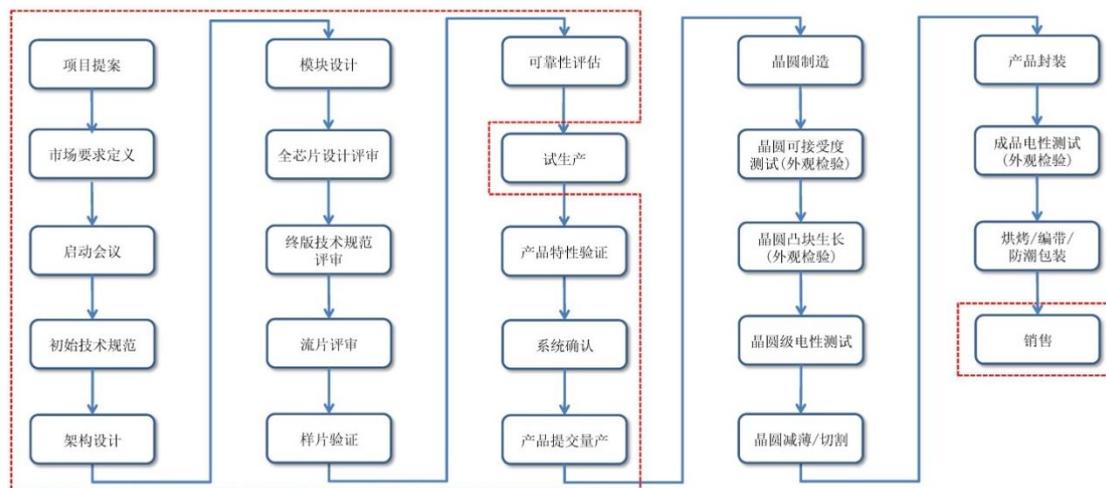
新增重要非主营业务情况

适用 不适用

（二） 主要经营模式

我们是一家集成电路设计企业，自成立以来公司经营模式均为行业里的 Fabless 模式，该模式下，我们专注于从事产业链中的集成电路设计和营销环节，其余环节委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成，由公司取得测试后芯片成品销售给客户。

在 Fabless 模式下，产品设计与研发环节属于我们经营的核心，由多个部门参与执行。芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成，因此公司需要向晶圆制造厂采购晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务。我们产品的业务流程示意图如下：



注：红色框线标注为公司自主完成，其余由委外厂商完成。

上述流程图中项目提案、市场要求定义、启动会议、初始技术规范、架构设计、模块设计、全芯片设计评审、终版技术规范审议、流片评审、样片验证、可靠性评估、产品特性验证、系统确认、产品提交量产、销售等环节主要由公司完成，其余环节主要由委外厂商完成。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

我们是一家集成电路设计企业，集成电路行业作为全球信息产业的基础，是世界电子信息技术创新的基石。集成电路行业派生出诸如 PC、互联网、智能手机、云计算、大数据、人工智能等诸多具有划时代意义的创新应用，成为现代日常生活中必不可少的组成部分。移动互联时代后，云计算、AI 计算、智能汽车等应用领域的快速发展和技术迭代，正推动集成电路产业进入新的成长周期。

我们的内存接口及模组配套芯片、PCIe Retimer 芯片、MXC 芯片、CKD 芯片等属于高速互连芯片领域。高速互连芯片是支撑数据中心、服务器及计算机实现高速数据交互的必备芯片，主要解决智能算力系统持续升级背景下各类数据传输的瓶颈。高速互连芯片适配多种标准化通信协议，通过信号处理、架构优化等方式，保障数据在各系统间高效、可靠传输。

按技术类别区分，高速互连芯片主要分为三大类：内存互连芯片、PCIe/CXL 互连芯片和以太网及光互连芯片等。其中，内存互连芯片包括内存接口及模组配套芯片，主要用于提升内存数据访问的速度及可靠性；PCIe/CXL 互连芯片包括 PCIe Retimer、PCIe Switch、CXL MXC、CXL Switch 等芯片，主要用于数据中心和服务器单机多卡连接、内存池化、内存扩展等；以太网及光互连芯片包括 Ethernet Retimer/Switch、oDSP、NIC、硅光芯片等，主要用于数据中心集群组网等长距离、高带宽的互连方案。

(1) 全球服务器及 PC 市场行业情况

高速互连芯片以服务器领域为主要应用场景，在 PC 领域亦有部份应用。

AI 服务器对高速互连的需求与日俱增，成为驱动高速互连芯片市场扩容的关键动力。根据行业相关数据，全球 AI 服务器出货量从 2020 年的 50 万台激增至 2024 年的 200 万台，年均复合增长率为 45.2%；展望未来，其出货量将进一步从 2025 年的 250 万台增长至 2030 年的 650 万台，年均复合增长率为 21.2%。AI 服务器需求的增长主要由大模型训练、推理等需求驱动，多芯片集群架构需高带宽、低延时互连支撑海量数据交互，直接拉动 PCIe/CXL 互连芯片、以太网及光互连芯片的需求，同时推动对更大容量及更高带宽系统主内存的需求。随着 AI 服务器向“多卡互连+高速协议”架构升级，支持 PCIe 6.0、CXL 3.0 等新一代标准的高速互连芯片需求将持续攀升。通用服务器市场需求较为平稳，但同时也需要高速互连芯片来提升数据访问稳定性，其增速虽不及 AI 服务器，仍是相关市场的重要支撑。

复合年增长率	2020年至2024年	2025年至2030年（预估）
AI服务器	45.2%	21.2%
通用服务器	1.6%	-1.2%
总计	4.2%	3.6%



图：全球服务器出货量，按服务器类型（AI、通用）拆分

资料来源：弗若斯特沙利文¹

全球 PC 出货量总体呈平稳增长趋势，2024 年出货量为 2.59 亿台，未来预计出货量将从 2025 年的 2.63 亿台增长至 2030 年的 2.98 亿台，年均复合增长率 2.5%。

¹ 本年度报告引用了来自弗若斯特沙利文的多项行业数据，均来自于弗若斯特沙利文为公司发行 H 股股票并在香港联交所上市的招股章程编制的独立市场研究报告，相关详情请参阅公司于香港联交所网站披露的招股章程（链接：<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0130/2026013000007.pdf>）。相关数据仅作为行业背景参考，既不代表公司的业务预测，也不构成对业绩达成或投资回报的任何明示或暗示保证，请投资者注意识别相关风险并理性决策。

（2）内存模组行业情况

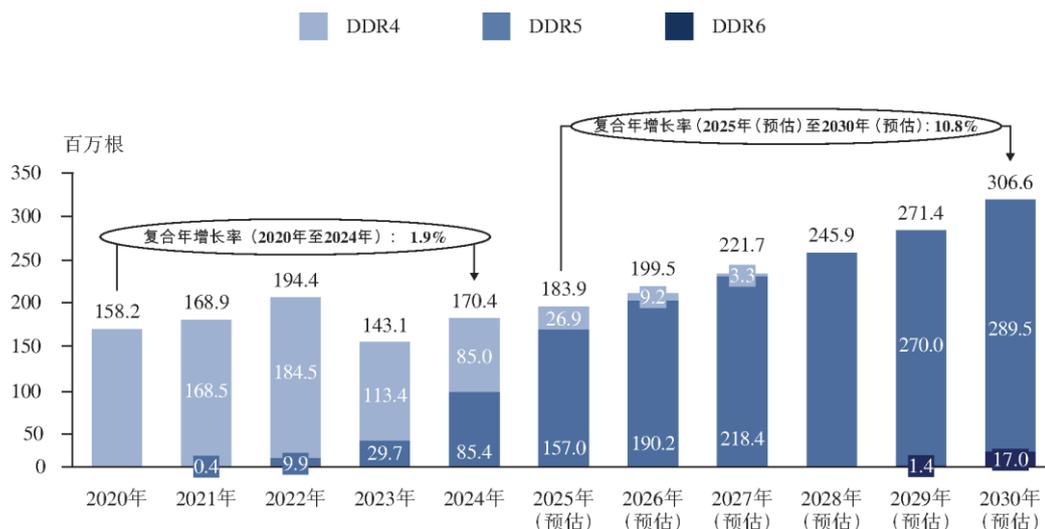
内存模组是计算机架构的核心组成部分之一，主要作为 CPU 与硬盘的数据中转站，用于临时存储数据，其存储和读取速度远高于硬盘。根据应用领域不同，内存模组可分为以下几类：①服务器内存模组，目前主要包括 RDIMM 和 LRDIMM 等类型，随着服务器数据存储和处理负载的不断增加，对服务器内存模组的稳定性、纠错能力以及低功耗的要求也日益提高；②普通台式机、笔记本内存模组，主要类型为 UDIMM、SODIMM 等。全球 DRAM 市场中，90% 左右的市场份额由三星电子、海力士及美光科技占据，这三家公司也是公司内存接口芯片及内存模组配套芯片的主要下游客户。

内存模组的发展遵循清晰的技术升级路径，相关标准由 JEDEC 组织定义，涵盖内存模组的组成构件、性能指标和具体参数等。近年来，服务器内存模组行业正经历从 DDR4 世代向 DDR5 世代的切换，目前 DDR5 第一、第二、第三子代内存产品已实现量产，JEDEC 已完成 DDR5 第四、第五子代标准制定，并正在推进第六子代产品标准的制定。为满足传输速率提升及新的产业需求，JEDEC 还陆续定义了多种新型内存模组架构，例如用于服务器的 MRDIMM，以及用于台式机/笔记本电脑的 CUDIMM、CSODIMM、CAMP、LPCAMP 等。目前，JEDEC 正在开展对 DDR6 相关标准的讨论。

内存模组与 CPU 是计算机的两个核心部件，是计算机生态系统的重要组成部分。随着支持更高速率 DDR5 的 CPU 的持续迭代，DDR5 内存模组的渗透率将提升，同时其子代的更新迭代也将持续推进。

根据弗若斯特沙利文的数据，2020 年至 2024 年，服务器内存模组出货量从 1.58 亿根增长至 1.7 亿根；到 2030 年预计将攀升至 3.07 亿根，2025 年至 2030 年间的年均复合增长率约为 10.8%，呈现良好增长态势。从市场结构上看，服务器内存模组正加速向 DDR5 世代迈进：DDR5 从 2021 年开始在下游应用，到 2024 年渗透率已超过 50%，预计在 2025 年将超过 85%。同时，DDR6 内存模组有望在 2029 年前后实现商业化应用，为市场注入新的增长动力。

驱动服务器内存模组需求量增长的核心因素，在于全球服务器出货量的增长，以及单台服务器内存模组配置数量的增加。AI 服务器的崛起，进一步推动了市场需求。由于 AI 服务器对内存容量的需求显著增加，须配置更多的内存模组，通常一台典型 AI 服务器配置的内存模组数量是通用服务器的 2 倍左右，因此，随着 AI 技术在各行业的广泛应用，AI 服务器渗透率持续提升，将直接推动服务器内存模组整体需求增速高于服务器增速，进而为内存互连芯片市场带来广阔的发展空间。



图：全球服务器内存模组出货量

资料来源：弗若斯特沙利文

(3) 内存互连芯片行业情况

内存互连芯片包括内存接口芯片、内存模组配套芯片等。内存接口芯片是服务器内存模组的核心逻辑器件，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。

内存接口芯片的发展演变情况如下：

内存接口芯片世代	技术特点	主要厂商	研发时间跨度
DDR2	最低可支持 1.5V 工作电压	TI (德州仪器)、英特尔、西门子、Inphi、澜起科技、IDT 等	2004 年-2008 年
DDR3	最低可支持 1.25V 工作电压，最高可支持 1866MT/s 的运行速率	Inphi、IDT、澜起科技、Rambus、TI (德州仪器) 等	2008 年-2014 年
DDR4	最低可支持 1.2V 工作电压，最高可支持 3200MT/s 的运行速率	澜起科技、IDT、Rambus	2013 年-2017 年
DDR5	最低可支持 1.1V 工作电压，RDIMM 预计可实现 9200MT/s 的运行速率；MRDIMM 预计可实现 16000MT/s 的运行速率	澜起科技、瑞萨电子 (原 IDT)、Rambus	2017 年至今

从 2016 年开始，DDR4 技术进入成熟期并成为内存市场的主流技术。为了实现更高的传输速率和支持更大的内存容量，JEDEC 进一步完善了 DDR4 内存接口芯片的技术规格，增加了多种功能以支持更高速率和更大容量的内存。在 DDR4 世代一共有四个子代产品，每一子代内存接口芯片的最高传输速率不断提升，其中最后一个子代产品支持的最高传输速率达到 3200MT/s。随着

DDR5 内存技术的成熟和商用，DDR5 已经取代 DDR4 成为市场主流产品。相比 DDR4 最后一个子代产品，DDR5 内存接口芯片采用了更低的工作电压（1.1V），并在传输效率和可靠性上进一步提升。根据 JEDEC 公布的信息，DDR5 内存接口芯片已经规划了六个子代，前五个子代产品支持速率分别是 4800MT/s、5600MT/s、6400MT/s、7200MT/s、8000MT/s，最后一个子代支持速率预计将达到 9200MT/s。通过持续的技术创新，以实现更高的传输速率和支持更大的内存容量，将是内存接口芯片行业未来发展的趋势和动力。

在 DDR5 世代，根据 JEDEC 定义，服务器内存模组除了需要内存接口芯片之外，还需要配置三种配套芯片：一颗 SPD 芯片、一颗 PMIC 芯片和两颗 TS 芯片；普通台式机和笔记本电脑的内存模组（UDIMM、SODIMM）则需要配置两种配套芯片：一颗 SPD 芯片和一颗 PMIC 芯片。

随着技术的发展，内存互连领域衍生出新的接口芯片种类，包括用于服务器新型高带宽内存模组 MRDIMM 的 MRCD/MDB 芯片，以及用于 PC 端内存模组的 CKD 芯片：

在服务器端，随着人工智能和大数据分析等应用快速发展，处理器内核数量日益增多，对内存带宽的需求急剧增长，JEDEC 制定了新型高带宽内存模组多路复用双列直插内存模组 MRDIMM（Multiplexed Rank DIMM）的相关技术标准。根据 JEDEC 公布的信息，DDR5 MRDIMM 通过创新设计提高了数据传输速率和整体系统性能。多路复用允许将多个数据信号组合并通过单个通道传输，从而在不增加额外物理连接的情况下提升带宽，实现无缝带宽升级，使数据速率超过同期的 DDR5 RDIMM。其特性包括：①平台与 RDIMM 兼容，提供灵活的用户带宽配置；②采用标准的 DDR5 DIMM 组件（包括 DRAM、外形尺寸、引脚分布、SPD、PMIC 和 TS），便于推广；③利用 RCD/DB 逻辑处理能力实现高效的 I/O 扩展；④借助现有的 LRDIMM 生态系统进行设计和测试。MRDIMM 未来将持续迭代升级，第一子代 MRDIMM 支持 8800MT/s 速率，第二子代 MRDIMM 支持 12800MT/s 速率，正在定义的第三子代 MRDIMM 支持的速率预计实现 16000MT/s。MRDIMM 需要搭配 1 颗 MRCD 和 10 颗 MDB 芯片，其设计复杂度和速率要求高于普通的 RCD 和 DB 芯片。

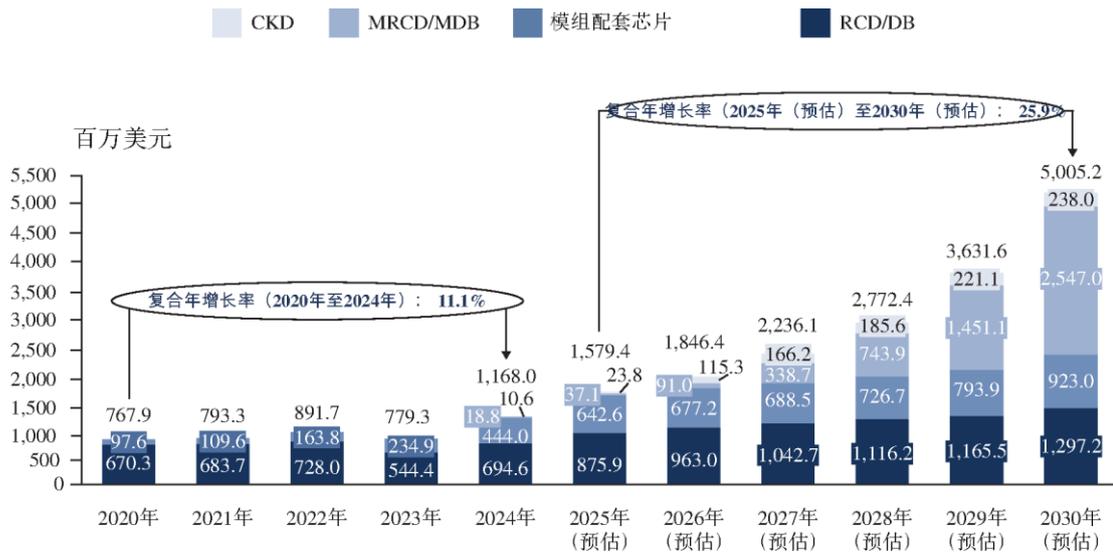
在 PC 端，随着 DDR5 传输速率持续提升，到 DDR5 中期，原本无需信号缓冲的 UDIMM、SODIMM（主要用于台式机和笔记本电脑），将需要配备一颗 CKD 芯片，对内存模组的时钟信号进行缓冲和重新驱动，从而提高时钟信号的完整性和可靠性。JEDEC 已制定了 CUDIMM 和 CSODIMM 内存模组相关标准，包括 CKD 芯片标准，将应用于支持 6400MT/s 及以上内存速率的台式机和笔记本电脑。

内存模组		RCD	DB	SPD	TS	PMIC	MRC	MD	CKD
服务器	RDIMM (DDR4)	1	-	1	-	-	-	-	-
	LRDIMM (DDR4)	1	9	1	-	-	-	-	-
	RDIMM (DDR5)	1	-	1	2	1	-	-	-
	LRDIMM (DDR5)	1	10	1	2	1	-	-	-
	MRDIMM (DDR5)	-	-	1	2	1	1	10	-
PC端	UDIMM/SODIMM (DDR4)	-	-	1	-	-	-	-	-
	UDIMM/SODIMM (DDR5)	-	-	1	-	1	-	-	-
	CUDIMM/CSODIMM/CAMM (DDR5)	-	-	1	-	1	-	-	1
	LPCAMM (DDR5)	-	-	1	-	1	-	-	-

图：内存互连芯片在不同类型的内存模组中的应用及配比数量

附注：(1)UDIMM(Unbuffered Dual In-line Memory Module):无缓冲双列直插内存模块；(2)CUDIMM(Clocked Unbuffered Dual In-line Memory Module):时钟无缓冲双列直插内存模块；(3)SODIMM(Small Outline Dual In-line Memory Module):小型双列直插内存模块；(4)CSODIMM(Clocked Small Outline Dual In-line Memory Module):时钟小型双列直插内存模块；(5)CAMM(Compression Attached Memory Module):压缩附加内存模块；(6)LPCAMM(Low Power Compression Attached Memory Module):低功耗压缩附加内存模块。

根据弗若斯特沙利文的数据，内存互连芯片市场规模从 2020 年的 7.68 亿美元增长至 2024 年的 11.68 亿美元，预计未来将进一步从 2025 年的 15.79 亿美元增长至 2030 年的 50.05 亿美元，期间年均复合增长率高达 25.9%。2024 年，中国占全球市场 20% 的份额，预计到 2030 年将占约 30%。



图：全球内存互连芯片市场规模

资料来源：弗若斯特沙利文

（4）PCIe 互连行业情况

PCIe 协议是一种高速串行计算机扩展总线标准，自 2003 年诞生以来，其互连技术在近几年发展迅猛，传输速率基本每 3-4 年翻倍增长，并保持良好的向后兼容特性。从 PCIe 4.0 到 PCIe 5.0，传输速率已从 16GT/s 提升至 32GT/s；到 PCIe 6.0 和 PCIe 7.0，传输速率将进一步提升至 64GT/s 和 128GT/s。凭借强大的生态系统，平台厂商、芯片厂商、终端设备厂商和测试设备厂商深度合作，PCIe 已成为主流互连接口，全面覆盖了 PC 机、服务器、存储系统等各种计算平台，广泛服务于云计算、企业级计算、人工智能和物联网等应用场景。

① PCIe Retimer 芯片

PCIe Retimer 芯片是在 PCIe 协议升级迭代背景下应运而生的，它主要解决数据中心和服务器在通过 PCIe 协议进行高速、远距离传输时，面临的信号时序不齐、损耗大、完整性差等问题。

随着应用的快速发展，PCIe 协议持续迭代更新，传输速率不断翻倍，但服务器的物理尺寸受限于工业标准，变化不大。这导致整个链路的插损预算从 PCIe 3.0 时代的 22dB 增加到 PCIe 4.0 时代的 28dB，并进一步增长到 PCIe 5.0 时代的 36dB。业界亟待解决 PCIe 信号链路的插损问题，以提高信号传输距离。

一种解决方案是选用低损 PCB，但其成本高昂且难以有效覆盖多连接器应用场景；另一种解决方案是引入链路扩展器件，如 PCIe Retimer 芯片，通过采用模拟信号和数字信号调理技术及重定时技术，Retimer 芯片能够补偿信道损耗并消除抖动影响，从而提升 PCIe 信号的完整性，增加高速信号的有效传输距离。相较于其他技术解决方案，Retimer 芯片在性能、标准化和生态系统支持等方面具有明显优势，可用于 CPU 与高速外设（如 GPU、AI 芯片、SSD 卡及网卡等）的互连，适应多连接器应用场景，未来还可以根据系统配置灵活切换至 PCIe 或 CXL 模式，更受用户青睐。

因此，随着传输速率从 PCIe 4.0 的 16GT/s 翻倍至 PCIe 5.0 的 32GT/s，Retimer 芯片的技术优势愈发显著。根据行业发展趋势，到 PCIe 5.0 时代，PCIe Retimer 芯片已成为行业主流解决方案。近两年，随着 AI 服务器需求快速增长，PCIe Retimer 芯片已成为 AI 服务器中的关键部件，其市场规模也随之迅速扩大。

② PCIe Switch 芯片

PCIe Switch 芯片是一种用于扩展和连接多个 PCIe 设备的关键组件，可以将有限的 PCIe 通道分配给更多设备，同时优化带宽分配。

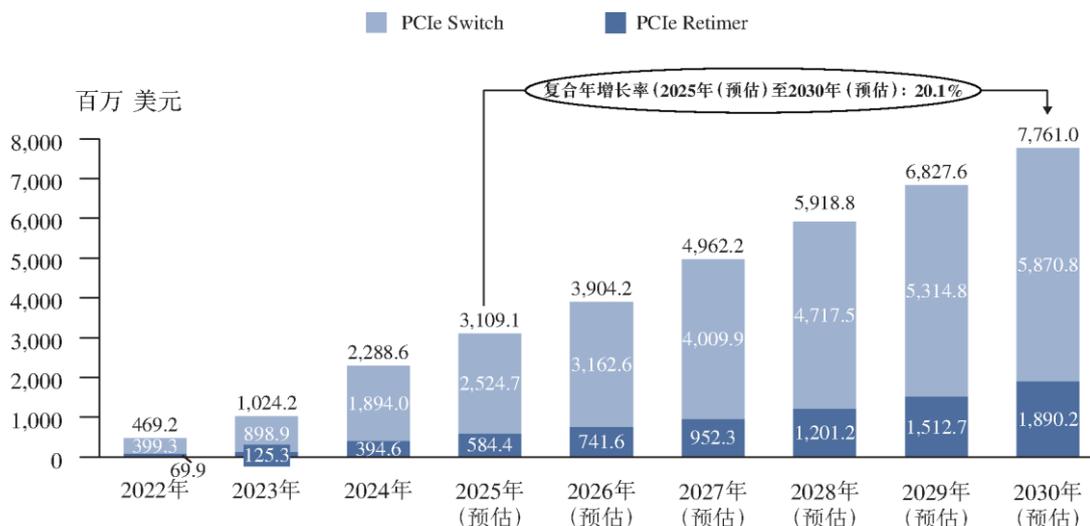
PCIe Switch 芯片是用于实现高速、低延迟的设备互连的关键组件，其主要功能为：a. 扩展接口：可增加 PCI Express 接口数量，让更多设备通过 PCIe 总线高速通信。如服务器中，当 CPU 的 PCIe 通道不足时，PCIe Switch 芯片可连接多个设备，例如 SSD、网卡、GPU 等；b. 数据转发：在点到点（P2P）工作模式下，为连接的多个设备进行数据转发，将多个 PCIe 通道连接到芯片上，

实现设备高速连接；c. 实现分区功能：相当于以太网 Switch 里的虚拟局域网（Vlan），可将多台机器连接到同一片 PCIe Switch，并进行分区配置，把某些端点设备分配给特定服务器，实现统一管理和灵活分配，避免多个操作系统枚举同一堆 PCIe 总线内的角色时出现访问地址冲突；d. 支持 NTB（Non-Transparent Bridge）技术：通过地址翻译实现不同分区或系统中的设备通信。例如传统存储系统中的多个控制器，可利用 NTB 技术通过 PCIe 链路直接通信，实现数据和控制信息的同步。

PCIe Switch 芯片可以突破主机有限 PCIe 接口的制约，实现更多设备的高密度 PCIe 互连，显著提升系统扩展性和资源利用率，在数据中心、云计算、存储系统、网络设备中有广泛的应用，尤其适用于对带宽和延迟敏感的场景。比如在数据中心和云计算中，PCIe Switch 芯片可以连接多块 GPU/AI 加速卡进行并行计算，也可以构建 GPU/AI 加速卡集群进行超大规模计算；在存储系统中，PCIe Switch 芯片可以连接大量 NVMe SSD，构建高速存储池；在网络设备中，PCIe Switch 芯片可以连接多块 100G/400G 网卡，管理高速端口的数据转发。

AI 服务器的快速增长显著拉动了 PCIe Retimer 芯片和 PCIe Switch 芯片的需求。以配置 8 块 GPU 的典型 AI 服务器为例，通常需配备 2 至 4 个 PCIe Switch 实现拓扑扩展，同时需要 8 至 16 个 Retimer，以延长 CPU 与外设间的有效传输距离。目前，根据部分国内 8 卡 GPU 服务器的方案，需要 24 个 Retimer 芯片。因此，PCIe 互连芯片已成为 AI 服务器中不可或缺的核心器件，其需求量与 AI 服务器出货量呈正相关。

根据弗若斯特沙利文的数据，PCIe 互连芯片市场规模从 2022 年的 4.69 亿美元快速增长至 2024 年的 22.89 亿美元。行业预测显示，未来该市场将持续高速增长，预计 2030 年市场规模将达到 77.61 亿美元，2025 至 2030 年间的年复合增长率高达 20.1%。2024 年，中国占全球市场 25% 以上的份额，预计到 2030 年将占 30% 以上。



图：全球 PCIe 互连芯片市场规模

资料来源：弗若斯特沙利文

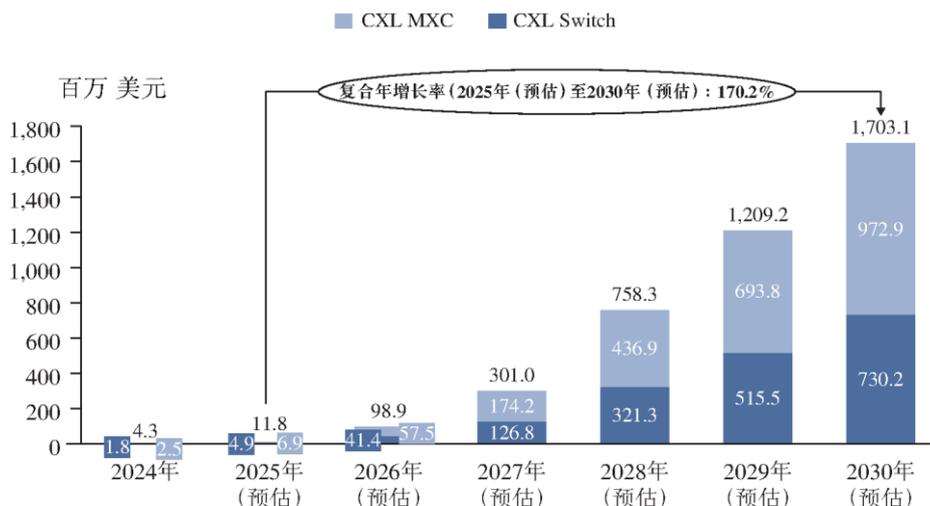
（5）CXL 互连行业情况

作为一种新兴的高速互连技术，CXL 自推出以来就备受业界关注。随着人工智能、云计算等领域的高速发展，内存扩展、内存池化等 CXL 技术的典型应用正在受到越来越多厂商的积极部署，以打破内存瓶颈。

近年来，CXL 技术在数据中心和人工智能领域展现出巨大的应用潜力。在数据中心领域，CXL 技术通过高带宽、低延迟的特性，将不同的计算和存储资源进行互连，形成庞大的资源池，可以显著提升数据处理和分析效率，满足现代数据中心对大规模数据处理和分析的需求。在人工智能领域，CXL 技术通过支持 GPU 和 FPGA 等加速器与主处理器的高效协作，可显著提升 AI 模型训练和推理的速度，实现低延迟、高速的数据传输，从而大幅提高计算效率；同时 CXL 技术支持内存扩展和内存共享，为 AI 应用提供更大的内存空间和更灵活的资源分配方式。根据相关服务器厂商测评，CXL 内存池化方案在 AI 推理、向量数据库和内存数据库三个最重要的大内存应用场景中，均有卓越性能表现；CXL 内存池化方案为运行更大参数 AI 模型提供了更高容量和性能的内存支持。

CXL 协会 2024 年发布了 CXL3.2 标准，2025 年又继续推出了 CXL4.0 标准，CXL 技术的相关生态也在不断完善：（I）从主流 CPU 厂商来看，英特尔发布了两款支持 CXL 2.0 协议的 CPU（Granite Rapids 和 Sierra Forest），AMD 发布了支持 CXL 2.0 协议的第五代 EPYC 处理器，上述 CPU 平台能支持更多的 CXL 设备类型，提供更好的安全性和可靠性，适配更多的应用场景；2025 年主流 CPU 厂商也继续推进 CXL3.0 新平台的内部验证，未来几年数据中心支持 CXL 技术的服务器平台比例将进一步提升。（II）从内存模组厂商来看，SK 海力士和三星电子正在积极研发并量产 CXL 兼容的内存模块，如三星电子展示了 CMM-D 2.0 模组，并于联想一起完成了 128GB CMM-D CXL 内存模块的验证，而且计划在 2026 年推出 CMM-D 3.0 模组。（III）从服务器平台来看，CXL Switch 也开始应用于服务器平台，支持 CXL 协议的数据传输，可以实现多个节点间的内存和其他设备资源的共享。未来，越来越多的服务器 CPU 和 GPU 都将支持 CXL 接口，这一趋势将显著推动 CXL 市场的发展，尤其是在数据中心、人工智能和云计算等领域的广泛应用。

根据弗若斯特沙利文的数据，2024 年 CXL 互连芯片市场尚处于商业化初期，市场规模约为 430 万美元，行业预测未来几年该市场将迎来爆发式增长，预计至 2030 年市场规模将达到 17.03 亿美元，2025 至 2030 年期间的年均复合增长率高达 170.2%。2024 年，中国占全球市场 25% 以上的份额，预计到 2030 年将占 30% 以上。



图：全球 CXL 互连芯片市场规模

资料来源：弗若斯特沙利文

(6) 时钟芯片行业情况

时钟芯片是为电子系统提供其必要的时钟脉冲的芯片。在数字系统中，时钟脉冲是集成电路运转的节拍器，在电子系统中扮演着“心脏”的重要角色。高频/高性能数字模块的正确运行需要时钟芯片提供精准的时钟脉冲（节拍）来同步运算操作和数据传输交互。时钟脉冲的性能决定了系统是否能运行到目标速度，时钟芯片不达标有可能导致模块或设备无法运作。因此，时钟芯片提供的输出时钟需要具备极高的可靠性、宽广的输出频率范围、优良的抖动特性以及扩频功能。

目前，时钟芯片主要包括时钟发生器、去抖时钟芯片、时钟缓冲芯片和展频振荡器等产品子类。时钟发生器是根据参考时钟来合成多个不同频率时钟的芯片，它是时钟芯片的一个重要类别，是数据中心、工业控制、新能源汽车等领域的基础芯片；去抖时钟芯片是为其他芯片提供低抖动低噪声的参考时钟的芯片；时钟缓冲芯片是用于时钟脉冲复制、格式转换、电平转化等功能的芯片；展频振荡器是基于扩展频谱技术的晶体振荡器，通过调制原始时钟信号的频率分布，将能量分散到更宽的频带内，从而降低电磁干扰（EMI）峰值并提升系统稳定性。

从市场规模来看，时钟芯片是一个相对成熟、空间较大的市场。根据弗若斯特沙利文的数据，全球时钟芯片市场已进入稳定增长阶段，市场规模从 2020 年的 17 亿美元增长至 2024 年的 22 亿美元，期间年均复合增长率为 5.7%。展望未来，随着 AI 服务器、高速通信、智能驾驶与工业边缘计算等对高精度时钟的需求持续增长，时钟芯片在系统架构中的价值量将稳步提升。预计至 2030 年，全球时钟芯片市场规模预计将扩大至 30 亿美元，2025 至 2030 年间年均复合增长率为 5.3%。根据 Market Data Forecast 的数据，2022 年全球时钟芯片的市场规模合计为 20.3 亿美元，预计到 2027 年可达到 30.2 亿美元。

目前，高性能时钟芯片国产化程度较低，主要市场份额被少数几家海外厂商占据，国产替代空间广阔。比如单台服务器内一般需要 10 颗左右的时钟芯片，平均每台中高端仪器仪表使用约 4 颗时钟芯片。

AI 已成为服务器技术升级的核心驱动力：一方面，推动互连标准向 PCIe 5.0 及 112G 切换；另一方面，AEC/AOC 等技术的应用也对时钟芯片性能提出了新要求。这两大趋势，共同构成了对高性能时钟芯片的强劲需求。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1) 内存互连芯片

内存接口芯片和内存模组配套芯片是 JEDEC 固态技术协会定义的行业标准产品。我们在该领域深耕二十年，拥有自主知识产权的高速、低功耗技术，可为新一代服务器平台提供符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案，是全球可提供从 DDR2 到 DDR5 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，产品获得市场和用户的广泛认可。

在产品标准制定方面，我们是全球微电子行业标准制定机构 JEDEC 固态技术协会的董事会成员之一，在 JEDEC 下属的若干个委员会及分会中安排员工担任主席或副主席职位，深度参与 JEDEC 相关产品的标准制定，在该领域拥有重要话语权。我们牵头制定 DDR5 RCD、MDB 及 CKD 芯片的国际标准，并积极参与 DDR5 内存模组配套芯片的标准制定。

在技术实力方面，我们处于国际领先水平。我们发明的 DDR4 全缓冲“1+9”架构被 JEDEC 国际标准采纳，并在 DDR5 世代演化为“1+10”框架，继续作为 LRDIMM 的国际标准，同时衍生出 MRDIMM 国际标准。在 DDR5 世代，我们进一步巩固了技术领先优势。2025 年 1 月，我们推出 DDR5 第二子代 MRCD/MDB 芯片，支持速率为 12800MT/s；2025 年 10 月，我们的 DDR5 第四子代 RCD 芯片成功量产，支持速率为 7200MT/s；2025 年 11 月，我们推出新一代用于客户端的 DDR5 CKD 芯片，支持速率为 9200MT/s。

在市场份额方面，我们在 DDR4 世代逐步确立了行业领先地位，是全球可提供 DDR4 内存接口芯片的三家主要厂商之一，占据全球市场的重要份额。在 DDR5 世代，我们牵头制定相关产品国际标准，并提供完整的内存接口及模组配套芯片解决方案，继续保持行业领先地位。根据弗若斯特沙利文的数据，2024 年内存互连市场整体呈现高度集中的市场格局，前三家企业合计占据 93.4% 的市场份额：其中，我们以 36.8% 的市场份额，排名全球第一。

(2) PCIe Retimer 芯片

PCIe Retimer 芯片是适用于 PCIe 协议的超高速时序整合芯片，其技术实现和协议交互均需符合 PCI-SIG 联盟制定的标准体系。

在 PCIe 4.0 时代，我们是全球量产 PCIe 4.0 Retimer 芯片的三家厂商之一；进入 PCIe5.0 时代，我们成为全球主要供货 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片的两家厂商之一。2025 年 1 月，我们推

出了 PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer 芯片并向客户送样，并于 2026 年 1 月发布 PCIe 6.x/CXL 3.x AEC 解决方案，同时正在积极推进 PCIe 7.0 Retimer 芯片的研发。

作为全球领先的 PCIe Retimer 芯片供应商之一，我们自研的 PCIe SerDes IP 已成功应用于 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 和 PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer 芯片中。自研 IP 带来了良好的整合性，使公司的产品在信道适应能力、传输时延等关键性能指标上处于行业领先水平，此外，我们的 PCIe Retimer 芯片还提供全方位的遥测功能，能够实现更全面的链路监控和故障诊断，为高可靠性的 AI 集群应用提供了坚实保障。

基于领先的技术实力及优异的产品性能，我们的 PCIe Retimer 芯片从 2024 年开始出货快速增长，呈现良好成长态势。根据弗若斯特沙利文的数据，2024 年全球 PCIe Retimer 芯片市场呈现出极高的市场集中度，前两家企业合计占据 96.9% 的市场份额；其中，我们作为市场的新进入者，以 10.9% 的市场份额，排名全球第二。

(3) CXL MXC 芯片

CXL MXC 芯片是遵循 CXL 行业标准规范的产品，其设计、功能及互操作性均需通过 CXL 联盟的严格认证，属于 CXL 协议所定义的第三种设备类型，主要用于内存扩展和内存池化。

2022 年 5 月，我们全球首发 MXC 芯片，并与多家全球顶级云计算厂商及内存龙头企业开展合作；同年，全球领先内存厂商三星电子及 SK 海力士先后推出其最新的 CXL 内存产品，均采用了我们的 MXC 芯片。2023 年 8 月，我们的 MXC 芯片顺利通过了 CXL 联盟的数十项严苛测试，成为全球首家通过 CXL1.1 测试的内存扩展控制器产品，与国际知名 CPU 和存储器厂商的产品在 CXL 官网并列展示，彰显了我们的技术实力。2025 年 1 月，我们的 MXC 芯片入选 CXL 联盟公布的首批 CXL 2.0 合规供应商清单，同期入选还包括三星电子和 SK 海力士，其受测产品均采用了我们的 MXC 芯片。2025 年 9 月，我们推出基于 CXL[®]3.1 标准的 MXC 芯片，并已开始向主要客户送样测试。

我们将继续深化与 CPU/GPU 厂商、DRAM 内存厂商、云服务提供商(CSP)、服务器 OEM/ODM 厂商等生态伙伴的交流与合作，紧跟技术前沿，不断推进产品更新迭代，致力于推动 CXL 生态的成熟完善和 CXL 技术的广泛应用，并保持公司在的行业领先地位。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 报告期内与公司及行业相关的新政策

2025 年 8 月，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，以科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等领域为重点，深入实施“人工智能+”行动，涌现一批新基础设施、新技术体系、新产业生态、新就业岗位等，加快培育发展新质生产力。

2025 年 9 月，工业和信息化部、市场监督管理总局发布《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》，方案明确，电子信息制造业 2025 至 2026 年主要预期目标包括，规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速在 7% 左右，到 2026 年，预期实现营收规模和出口比例在 41 个工业大类中保持首位，5 个省份的电子信息制造业营收过万亿，服务器产业规模超过 4000 亿元。

（2）报告期内行业的新技术及未来发展趋势

➤ 内存互连技术

内存互连技术主要跟随主流 CPU 及内存模组生态系统的发展而演进。报告期内，DDR5 内存模组已取代 DDR4 成为市场主流产品，其内部子代持续迭代升级，同时，行业正在开展对 DDR6 内存互连技术相关标准的讨论和制定。

① 服务器内存互连技术

服务器内存互连技术的演进路径及发展趋势如下：

在传统内存模组 RDIMM 方面，内存互连技术遵循 JEDEC 标准持续演进，各子代产品支持的数据速率在持续提升。例如，DDR5 第一子代内存接口芯片支持速率为 4800MT/s，到了 DDR5 第五子代产品，支持速率提升至 8000MT/s，而 DDR5 第六子代产品将达到 9200MT/s 的速率。

在新型高带宽内存模组 MRDIMM 方面，基于 CPU 多核化的技术演进，以及 AI 和高性能计算应用对内存带宽日益增长的迫切需求，高带宽内存互连技术也在迭代升级，新一子代产品支持的数据速率提升显著。其中，第一子代 MRDIMM 最高支持 8800MT/s 速率，第二子代产品最高支持 12800MT/s 速率，预计第三子代产品支持速率将达到 16000MT/s。MRDIMM 采用 LRDIMM “1+10” 的基础架构，需要搭配 1 颗 MRCD 芯片和 10 颗 MDB 芯片，这些新型高带宽内存接口芯片与 CPU 的数据连接仍为单组内存信号，但是通过采用双倍数据传输速率和时分数据复用技术，能够将两个标准速率的内存数据通道合并后进行倍频传输，其与 DRAM 的数据连接则扩展为两组独立内存信号，可以在标准速率下对 MRDIMM 上面两个内存阵列同时操作，实现双倍速率读写。因此，与普通的 RCD/DB 芯片相比，MRCD/MDB 芯片设计难度更高，构造也更为复杂。随着 MRDIMM 技术逐步成熟以及相关生态日益完善，未来将有更多的服务器 CPU 支持第二子代 MRDIMM，其将为下游应用提供更具性价比的高带宽内存解决方案。

② 客户端内存互连技术

在 DDR4 世代及 DDR5 初期，内存接口芯片只用于服务器内存模组，其核心功能是缓冲来自内存控制器的地址、命令及控制信号，从而提升内存数据访问的速度及稳定性，以满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。由于台式机和笔记本电脑 CPU 及内存模组之间数据传输量相对较小，因此在这类设备中尚未需要对信号进行缓冲。

然而,随着 DDR5 传输速率持续提升,时钟信号频率越来越高,信号完整性面临瓶颈。当 DDR5 数据速率达到 6400MT/s 及以上时,原本无需信号缓冲的 UDIMM、SODIMM (主要用于台式机和笔记本电脑),也需要引入时钟驱动器 (CKD),对内存模组的时钟信号进行缓冲和重新驱动,以提高信号完整性和可靠性。DDR5 第一子代 CKD 芯片已于 2024 年开始在行业规模试用,支持速率可达 7200MT/s,主流 CPU 厂商也发布了支持该产品的客户端 CPU。目前,JEDEC 已经制定了新一代 CKD 芯片(支持速率为 9200MT/S)的标准,同时积极推动配备该 CKD 芯片的 CUDIMM 和 CSODIMM 标准的进程。

此外,JEDEC 还制定了尺寸更加紧凑的 CAMM 和 LPCAMM 内存模组的相关标准,以满足笔记本电脑等设备的需求。其中 CAMM 内存模组采用 DDR5 DRAM 颗粒,需配合 CKD、SPD 和 PMIC 芯片使用;而 LPCAMM 内存模组采用 LPDDR5 DRAM 颗粒,需配合 SPD 和 PMIC 芯片使用。

目前,DDR5 相关技术已日臻成熟,相关产品已实现规模商用。为了应对服务器和客户端等应用对高速、大容量、低功耗内存子系统的持续需求,JEDEC 组织已经开始对 DDR6 内存互连技术进行技术讨论和标准制定。公司正深度参与相关技术标准的讨论和制定,并为 DDR6 内存接口芯片和相关模组配套芯片的研发做好准备。行业预计,DDR6 内存模组有望在 2029 年前后开始规模商用。

►PCIe 互连技术

PCIe 作为业界广泛采用的高速串行点对点互连标准,已成为 CPU、GPU、FPGA 和 SSD 等关键计算设备之间不可或缺的连接桥梁。PCI-SIG 持续推动 PCIe 标准的演进,以满足不断增长的互连需求。

AI 服务器的快速发展带动 PCIe Retimer 拓展至高速铜缆领域。高速铜缆主要用于数据中心内部服务器与交换机之间、交换机与交换机之间等短距离互联传输场景,铜缆方案不仅有助于提升数据传输速度和可靠性,还在散热效率、信号传输及成本方面有显著的优势。高速铜缆可以分为无源铜缆 (DAC)、有源铜缆 (ACC) 与有源线缆 (AEC) 三大类,其中 AEC 通过在线缆两端加入 Retimer 芯片实现对信号的放大和再生,相比传统的无源直连铜缆 DAC 的传输距离更长,同时大幅优化了信号质量。据行业分析,AEC 领域既有以太网 Retimer,也有 PCIe Retimer,目前的应用是以太网 Retimer 为主。相比以太网 Retimer,PCIe Retimer 带宽相对较低,但时延相对较小,在推理服务器上可能具备一定优势。

PCIe 6.0 协议将数据传输速率提高了一倍,达到 64GT/s,以支持人工智能和机器学习等计算密集型应用,同时保持了向后兼容性。行业预计 PCIe 6.0 在 GPU、SSD、CXL 领域的应用将快速增长,并进一步扩展到以太网、工业智能化、无人驾驶汽车和物联网(IoT)等新兴领域。

2025 年，PCI-SIG 发布 PCIe 7.0 规范最终版本，新规范将传输速率提升至 128GT/s，其主要特点包括：1.通过 x16 配置可实现高达 512GB/s 的双向带宽；2.采用 PAM4 信号和基于 Flit 的编码技术；3.提高了能效比；4.保持向后兼容性。PCIe 7.0 标准为下一代 AI、机器学习、800 以太网、云计算和量子计算等数据驱动型应用提供了强大的支持。

► CXL 互连技术

CXL 互连技术可以提升系统间各模块的数据交换效率，解决缓存一致性问题，显著改善多路 CPU、CPU 与加速器之间的通信能力，降低延迟，实现数据中心 CPU 和加速器芯片之间的超高速互连，从而提高数据密集型应用程序的性能。

作为当前数据中心领域重要标准之一，CXL 互连技术其有望催生诸多创新应用，改变现有数据中心的基本架构，从而提升其运行效率并降低运行成本。CXL 标准使用 PCIe 协议作为物理接口，增强了兼容性，通过三种基础协议（CXL.io、CXL cache 和 CXL.memory）支持具体应用。在 CXL 1.1 规范的初期，有三种应用模式：其一，调用 CXL.io 和 CXL cache，可以使得一些内存不足的智能设备（比如智能网卡）与 CPU 内存进行交互；其二，调用 CXL.io、CXL cache 和 CXL.memory，可以实现 CPU、GPU、ASIC 和 FPGA 等设备间内存的共享，同时解决缓存一致性问题；其三，调用 CXL.io 和 CXL.memory 协议，可实现内存扩展及内存池化。

2023 年 11 月，CXL 联盟发布了 CXL3.1 规范。该规范对横向扩展 CXL 进行了结构优化，新增了可信执行环境功能，并改进了内存扩展器。CXL 3.1 的一项新功能是支持使用全局集成内存（GIM）通过 CXL 结构进行主机之间的通信，提升系统性能，通过 CXL 对内存访问直接点对点支持，提高 GPU 内存使用效率，有利于处理大规模数据集和 AI 工作负载。此外，CXL 3.1 还定义了基于端口的路由 CXL 交换机 Fabric Manager API，使结构管理器成为 CXL 生态系统的关键，同时，其可信安全协议（TSP）对云服务提供商的多租户虚拟机环境的安全性至关重要。随着 CXL 技术的发展，未来数据中心的计算节点和内存节点将实现更加快速、高效和灵活的互连。

2025 年 11 月，CXL 联盟推出了最新的 CXL 4.0 规范。该规范在 CXL 3.x 的基础上将传输速度翻倍，达到 PCIe 7.0 的 128GT/s；同时扩展了连接距离，能够最多支持 4 级 Retimer 芯片来显著增强信号传输，支持跨机架部署；通过引入捆绑端口的概念允许将多个物理 CXL 端口聚合成一个逻辑实体，提升总带宽。针对当前 AI/HPC 工作负载的极端带宽需求，跨机架远距离传输的痛点，以及不断提升的 CXL 内存 RAS 的要求，CXL 4.0 都提供了相应的解决方案，成为未来数据中心互连技术的重要选择之一。

二、 经营情况讨论与分析

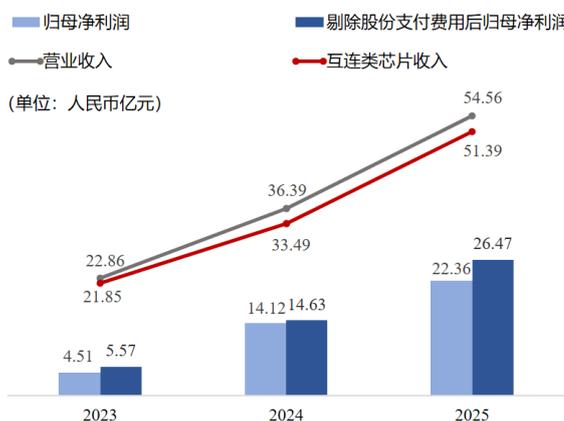
我们是一家全球领先的无晶圆厂集成电路设计公司，致力于为云计算及 AI 基础设施提供创新、可靠及高能效的互连解决方案。2025 年，受益于 AI 产业趋势，行业需求旺盛，我们的互连类芯片出货量显著增加，推动公司 2025 年度经营业绩较上年度实现大幅增长，多项财务指标再创历史新高。报告期内公司具体经营情况如下：

（一）经营业绩大幅增长，发展质量持续提升

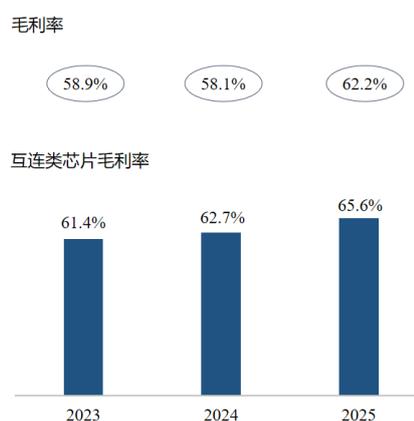
报告期内，我们积极把握 AI 产业趋势带来的行业机遇，加大研发创新与市场拓展，凭借核心技术优势实现经营业绩大幅增长，发展质量持续提升。2025 年度，公司实现营业收入 54.56 亿元，较上年度增长 49.9%，毛利率为 62.2%，较上年度提升 4.1 个百分点；实现归属于母公司股东的净利润 22.36 亿元，较上年度增长 58.4%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20.22 亿元，较上年度增长 62.0%。公司的净利润率为 41.0%，较上年度提升 2.2 个百分点；经营活动产生的现金流量净额为 20.22 亿元，连续四年增长，彰显公司强劲的盈利能力与稳健的经营质量。

2025 年度，我们的互连类芯片产品线实现销售收入 51.39 亿元，较上年度增长 53.4%，产品线毛利率为 65.6%，较上年度提升 2.9 个百分点，主要原因是毛利率较高的产品销售收入占比增加；津逮®产品线实现销售收入 3.08 亿元，较上年度增长 10.2%。

2025 年度，我们的营业收入、互连类芯片销售收入、归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额均创公司年度历史新高。



图：公司 2023-2025 年度主要财务数据



图：公司 2023-2025 年度毛利率情况

2025 年度，公司股份支付费用为 4.31 亿元，该费用计入经常性损益，对归属于母公司股东的净利润影响为 4.12 亿元（已考虑相关所得税费用的影响）。因此，2025 年度剔除股份支付费用影响后的归属于母公司股东的净利润为 26.47 亿元，较上年度增长 81.0%；剔除股份支付费用影响后的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 24.33 亿元，较上年度增长 87.3%。

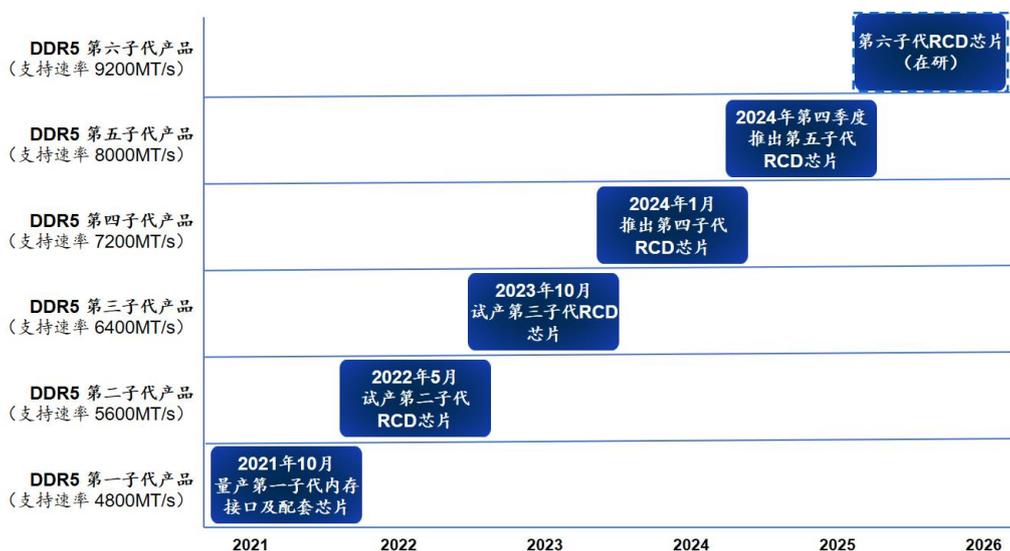
2025 年第四季度，我们实现营业收入 13.99 亿元，同比增长 31.0%，其中：互连类芯片产品线销售收入 13.06 亿元，同比增长 34.4%，产品线毛利率为 67.8%，较第三季度提升 2.1 个百分点；实现归属于母公司股东的净利润 6.03 亿元，同比增长 39.1%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.54 亿元，同比增长 48.0%。

(二) DDR5 快速渗透及新品逐步应用，保持内存互连领域领先地位

1. 持续推进 DDR5 下游渗透及子代升级迭代

2025 年全球 AI 产业快速发展，带动服务器市场需求持续高涨，DDR5 在下游的渗透率快速提升，内部子代持续迭代。我们作为内存互连芯片行业的领跑者和 DDR5 RCD 芯片国际标准的牵头制定者，在 DDR5 世代的竞争中持续保持全球领先地位。

报告期内，我们精准把握 DDR5 迭代升级与 AI 驱动的产业机遇，持续推进产品创新与升级。我们的 DDR5 RCD 芯片出货量在报告期内大幅增长。在 DDR5 内部子代迭代进程中，我们的第三子代 RCD 芯片规模出货，同时已量产支持 7200MT/s 速率的第四子代 RCD 芯片。2025 年下半年，我们的 DDR5 第三子代 RCD 芯片销售收入已超过第二子代产品，在新子代产品的商业化进程方面行业领先。凭借卓越的技术实力以及产品出色的稳定性和可靠性，我们精准把握 DDR5 迭代升级的产业机遇，进一步巩固行业领先优势。在 DDR5 相关产品强劲增长的推动下，报告期内我们的互连类芯片产品线实现销售收入 51.39 亿元，较上年度增长 53.4%，毛利率为 65.6%，较上年度提升 2.9 个百分点，产品竞争力持续增强。



图：公司 DDR5 内存接口芯片研发持续领先

2. 引领 DDR 接口技术创新，加速内存互连新品商业化落地

基于我们的核心技术——内存接口技术，我们创新研发的内存互连新产品 MRCD/MDB 芯片以及 CKD 芯片持续迭代升级，并在报告期内实现规模应用。

(1) MRCD/MDB 芯片是服务器新型高带宽内存模组 MRDIMM 的核心逻辑器件，旨在满足 AI 及云计算等应用场景对内存带宽的高要求。根据 JEDEC 定义，一根 MRDIMM 需要标配 1 颗 MRCD 芯片和 10 颗 MDB 芯片。我们作为全球唯二可以提供 DDR5 第一子代 MRCD/MDB 芯片的供应商，于 2025 年 1 月推出了第二子代产品，支持速率提升至 12800MT/s，较第一子代产品提升 45%。从 2025 年第四季度开始，我们的第二子代 MRCD/MDB 芯片出货量显著提升，并凭借优异的性能和出色的稳定性获得客户认可，为后续产业规模放量奠定了基础。

(2) CKD 芯片是 PC 端内存模组 CUDIMM 和 CSODIMM 的关键器件。根据 JEDEC 定义，当 DDR5 数据速率达到 6400MT/s 及以上时，PC 端内存模组需采用一颗专用的 CKD 芯片对时钟信号进行缓冲和重新驱动，以满足高速时钟信号的完整性和可靠性要求。我们继 2024 年在业界率先试产 DDR5 CKD 芯片（支持速率为 7200MT/s）之后，于报告期内推出新一代 CKD 芯片，支持速率高达 9200MT/s，可为下一代高性能 PC 提供关键技术支撑。2025 年 CKD 芯片的行业渗透率进一步提升，我们的产品量出货快速增长。

作为 DDR5 RCD、MDB 及 CKD 芯片国际标准的牵头制定者，我们引领内存互连相关技术的创新，并通过优异的产品质量和技术支持，持续保持行业领先地位。

(三) 依托扎实技术积累拓展产品矩阵，提升 PCIe/CXL 互连领域综合竞争力

1. PCIe Retimer 芯片呈现良好成长态势

PCIe Retimer 芯片是 AI 服务器的核心高速互连组件，主要用于 AI 服务器、有源线缆(AEC)、NVMe SSD、Riser 卡等场景。以配置 8 块 GPU 的典型 AI 服务器为例，通常需要 8 至 16 颗 PCIe Retimer 芯片，部分国产 AI 服务器为满足扩展的需求，配置了 24 颗 PCIe Retimer 芯片，因此 AI 服务器出货量的增长将直接驱动该芯片需求攀升。

报告期内，我们持续深化市场拓展，凭借领先的技术实力及优异的产品性能，我们的 PCIe Retimer 芯片呈现良好成长态势。作为全球主要供货 PCIe 5.0 Retimer 芯片的两家厂商之一，我们自主研发的 SerDes 技术为产品的持续迭代提供了坚实支撑。2025 年 1 月，我们推出 PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer 芯片并向客户送样，2026 年 1 月，我们发布了 PCIe 6.x/CXL 3.x AEC 解决方案。目前我们正在积极推进 PCIe 7.0 Retimer 芯片的研发。

展望未来，随着 AI 服务器需求持续增长以及 PCIe 协议传输速率的不断提升，PCIe Retimer 芯片的重要性愈发凸显，其应用场景也将进一步拓展，推动市场规模持续扩大。

2. 稳步推进 PCIe Switch 芯片产品研发

PCIe Switch 芯片是数据中心、AI 加速及存储系统的核心互连组件，通过扩展 PCIe 拓扑，实现多设备高效通信，解决主机与外围设备间的带宽瓶颈问题。PCIe Switch 芯片与 PCIe Retimer 芯片的核心底层技术均包括高速 SerDes 技术，并且两者的客户群体高度重合，直接客户主要包括服

务器 OEM/ODM 厂商,终端用户主要为云计算服务商。在成功自研 SerDes 技术并实现 PCIe Retimer 芯片产业化的过程中,我们已积累了深厚的 SerDes 技术储备与广泛的客户资源,为布局 PCIe Switch 芯片奠定了坚实的基础。报告期内,我们正在稳步推进 PCIe Switch 芯片工程研发。

3. 加快 CXL MXC 芯片产品升级与市场化应用

CXL MXC 芯片作为 CXL 协议所定义的第三种设备类型,主要用于内存扩展和内存池化,可有效提升内存容量和带宽,以满足云计算和人工智能等数据密集型应用的需求。报告期内,我们与合作伙伴持续推进 CXL 技术的商用化进程,已有更多服务器厂商推出基于澜起 MXC 芯片的 CXL 内存扩展方案,CXL 相关生态正逐步走向成熟。2025 年 1 月,我们的 MXC 芯片成功入选 CXL 联盟公布的首批 CXL 2.0 合规供应商清单,同期入选的内存厂商三星电子和 SK 海力士,其受测产品均采用了我们的 MXC 芯片,2025 年 9 月,我们推出基于 CXL 3.1 标准的 MXC 芯片,并已开始向主要客户送样测试。

CXL 技术作为行业前沿技术,目前正处于蓬勃发展初期。展望未来,随着 CXL 生态的不断成熟和技术的广泛普及,MXC 芯片市场将迎来广阔的发展空间。

(四) 坚持创新驱动发展,持续强化研发投入与技术实力

作为科技创新型企业,我们始终坚持创新驱动发展,持续加大研发投入,以增强公司的核心竞争力。2025 年度,我们的研发费用为 9.15 亿元,同比增长 19.9%,占营业收入的比例为 16.8%。我们的研发费用自 2019 年 A 股上市以来逐年增加。我们的研发技术团队具备国际化视野和卓越的专业能力,截至 2025 年末,公司研发技术人员为 583 人,占总人数的比例约为 74.4%,其中,具有硕士及以上学历的研发技术人员占比约 64%。



图: 公司 2019-2025 年研发投入情况

报告期内,我们取得的研发成果如下:

1. 互连类芯片产品线: (1) 内存互连芯片: DDR5 第四子代 RCD 芯片成功量产,完成 DDR5 第五子代 RCD 芯片、第二子代 MRCD/MDB 芯片、新一代 CKD 芯片量产版本的研发。(2) PCIe

互连芯片：推进 PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer 芯片量产版本的研发，并将其应用于 PCIe 6.x/CXL 3.x AEC 解决方案，同时积极开展 PCIe 7.0 Retimer 芯片及 PCIe Switch 芯片的工程研发。（3）CXL 互连芯片：完成 CXL 2.0 MXC 芯片量产版本的研发，完成 CXL 3.x MXC 芯片的工程研发。（4）时钟芯片：完成首批时钟缓冲芯片（Clock Buffer）及展频振荡器的工程研发。

2. 津逮®产品线：发布第六代津逮®性能核 CPU。

3. 在知识产权领域，我们新申请 40 项发明专利，共获得 36 项授权发明专利；新提交 19 项集成电路布图设计登记申请，共获得 24 项布图登记证书。截至 2025 年末，我们累计获授权发明专利 224 项、实用新型专利 1 项、集成电路布图设计登记证书 103 项以及计算机软件著作权登记证书 13 项。

（五）构建长效回报机制，与股东共享发展成果

我们始终秉持“以投资者为本”的发展理念，在兼顾业绩增长和高质量可持续发展的同时，致力于构建长效回报机制，与股东分享企业的成长与发展成果。报告期内，我们实施了 2024 年度及 2025 年中期利润分配方案，合计派发现金股利约 6.70 亿元；2025 年度我们的分红预案为每 10 股派发现金红利人民币 3.90 元（含税），预计将派发现金股利 4.72 亿元。除现金分红之外，在报告期内我们还推出两期股份回购计划，其中第一期回购股份用途为员工持股计划/股权激励，该计划已实施完毕，回购金额为 2.00 亿元；第二期回购股份用途为减少公司注册资本，回购计划的资金总额为 2-4 亿元，截至 2025 年末公司已回购 2.20 亿元。自 2019 年 7 月 A 股上市以来至 2025 年末，我们累计派发现金红利 23.67 亿元，累计回购股份金额为 14.30 亿元。此外，公司不断完善市值管理机制，连续四年将市值纳入高管年度绩效考核体系，进一步引导管理层聚焦公司价值创造与股东利益。

我们高度重视投资者关系，致力于构建透明、畅通的沟通机制，促进公司价值的有效传递。凭借在投资者关系方面的优良表现，报告期内我们收获了资本市场多个奖项，包括证券时报“最受机构青睐（科创板）上市公司 TOP5 榜单”、“投资者关系管理天马奖”，以及中国上市公司协会评定的“上市公司投资者关系管理最佳实践（2024）”、“上市公司 2024 年报业绩说明会最佳实践”等荣誉。

报告期内，我们荣获“2025 年福布斯中国创新力企业 50 强”、“《财富》中国科技 50 强”。我们首度入选上证 50 指数成分股，资本市场关注度显著提升。

（六）深化国际化战略布局，成功实现 H 股上市

为深化公司国际化战略布局，持续吸引并集聚优秀研发与管理人才，增强境外融资能力，进一步提升全球影响力与核心竞争力，我们依据发展战略与经营需要，在报告期内稳步推进 H 股发行并在香港联交所上市的相关工作。

2025 年 7 月，公司向香港联交所递交 H 股发行上市申请材料；2025 年 12 月，顺利完成中国证监会境外发行上市备案并通过香港联交所上市聆讯。2026 年 2 月，公司于香港联交所主板正式挂牌上市（股票代码：6809.HK），搭建起 A+H 股双资本平台，为公司全球化布局与长期可持续发展奠定坚实基础。本次公司 H 股全球发售获得国际投资者积极认购：在基石投资者方面，我们引入了多家顶级国际长线机构、战略投资人及知名科技专项基金，基石认购比例占公司 H 股基础发行规模的 50%；在锚定投资者方面，我们收到的国际配售订单数量超过 500 条，订单金额超 300 亿美元，覆盖倍数超过锚定投资者实际获配金额的 60 倍，充分体现了全球资本市场对公司发展战略与投资价值的高度认可。

非企业会计准则财务指标的变动情况及展望

适用 不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1. 持续的创新研发能力与领先的技术优势

公司自成立以来，持续专注于技术研发和产品创新。我们拥有自主的集成电路设计平台，覆盖数字信号处理技术、内存管理与数据缓冲技术、模拟电路设计技术、高速逻辑与接口电路设计技术、低抖动时钟设计技术以及低功耗设计技术，方案集成度高，可有效提高系统能效和产品性能。

(1) 在内存互连技术领域，我们以技术创新为基础，发明了 DDR4 全缓冲“1+9”架构，最终被 JEDEC 国际标准采纳，该架构在 DDR5 世代演化为“1+10”框架，继续作为 LRDIMM 的国际标准，并在此基础上衍生出 MRDIMM 的国际标准。在 DDR5 世代，我们凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术，为新一代服务器平台提供完全符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案，是全球可提供从 DDR2 到 DDR5 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，在该领域拥有重要话语权。经过持续不断的技术创新与积累，我们的核心技术在 DDR4 系列产品原有的基础上，建立了新一代 DDR5 高速内存接口产品所需的关键设计技术，研发出高速高精度自动化测试技术与测试平台。在 DDR5 世代，我们继续全球领跑，进一步巩固了我们的技术领先优势。在新技术方面，我们引领行业创新，推出了用于服务器高带宽内存模组的 MRCD/MDB 芯片，以及用于 PC 端内存模组的 CKD 芯片，这两款新产品将在未来几年带来广阔的市场增量空间。

(2) 在 PCIe 互连技术领域，我们是全球量产 PCIe 4.0 Retimer 芯片的三家厂商之一，也是全球主要供货 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片的两家厂商之一。我们自研的 PCIe SerDes 技术已成功应用于相关产品，自研 IP 带来了良好的整合性，在产品的时延、信道适应能力方面，我们的产品具有竞争优势。2025 年 1 月，我们推出 PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer 芯片，并向客户成功送样，该芯

片采用了我们自主研发的 PAM4 SerDes IP，支持低传输时延及高达 43dB 的链路预算。针对通用及 AI 服务器、有源线缆（AEC）和存储系统等典型应用场景，我们可提供基于该芯片的参考设计方案、评估板及配套软件等全套技术支持服务。

（3）在 CXL 互连技术领域，我们于 2022 年 5 月发布全球首款 CXL 内存扩展控制器芯片（MXC），相关技术处于国际领先水平，并与全球多家顶级云计算厂商及内存龙头企业开展合作。2023 年 5 月，三星电子推出其首款支持 CXL 2.0 的 128GB DRAM，加速下一代存储器解决方案的商用化，我们的 MXC 芯片被用于该解决方案，是其中的核心控制芯片。2023 年 8 月，我们的 MXC 芯片顺利通过了 CXL 联盟的几十项严苛测试，成为全球首家通过测试的内存扩展控制器产品，与国际知名 CPU、存储器厂商的产品在 CXL 官网并列展示。2025 年 1 月，凭借优异的产品性能和良好的互操作性，我们的 MXC 芯片上榜首批 CXL 2.0 合规供应商清单，同期入选的还包括内存厂商三星电子和 SK 海力士，其受测产品均采用了公司的 MXC 芯片。2025 年 9 月，我们推出基于 CXL[®] 3.1 标准的 MXC 芯片，并已开始向主要客户送样测试。我们在 CXL 互连技术领域保持行业领先地位，与 CPU/GPU 厂商、DRAM 内存厂商、云服务提供商（CSP）、服务器 OEM/ODM 厂商等生态伙伴保持密切的交流与合作，推动 CXL 技术获得更广泛的应用，并在最终客户端顺利部署 CXL 方案。

我们的核心技术基于自主知识产权，并形成了有规划、有策略的专利布局。截至报告期末，我们已获授权的国内外发明专利达 224 项。

2. 行业标准制定先行者

作为 JEDEC 董事会成员并担任若干个委员会主席或副主席职位，我们在制定及建立内存互连国际标准方面发挥着关键作用。我们是 DDR5 RCD、MDB、CKD 三款芯片国际标准的牵头制定者。在该领域，我们通过制定及引领行业标准，已获得了关键的先发优势。内存互连芯片在研发能力与技术专业知识的高准入壁垒，新进入者需要多年的高强度研发才能跟上最新的行业标准、产品迭代升级节奏，同时完成严格的产品验证及资格认证。我们凭借深厚的技术积淀，能够以高规格完成每一代产品解决方案交付，这使我们能够持续占领市场份额，巩固我们在行业中的领先地位。

凭借在内存互连方面的深厚技术水平，我们已成功拓展到 PCIe/CXL 等其他高速互连领域，成为 PCI-SIG、CXL、UALink 等国际行业联盟的成员，并在新领域实现市场突破。

3. 领先的市场地位和品牌优势

经过 20 余年的发展和积淀，我们已成为国际知名的芯片设计公司，我们的内存互连芯片和 PCIe Retimer 芯片已广泛应用于各类服务器和计算机，在行业竞争中处于领先地位。根据弗若斯特沙利文的数据：按收入计算，2024 年全球内存互连芯片市场整体呈现高度集中的市场格局，前三家企业合计占据 93.4% 的市场份额，我们的市场份额约为 36.8%，排名全球第一；2024 年全球

PCIe Retimer 芯片市场中，前两家企业合计占据 96.9% 的市场份额，我们作为市场的新进入者，2024 年产品出货快速增长，市场份额约为 10.9%，排名全球第二。

我们成立至今获得了多项荣誉，形成了独特的品牌优势。2016 年 6 月，中国电子学会认定公司“低功耗 DDR 系列内存缓冲控制器芯片设计技术整体技术达到国际领先水平”；同年 12 月，该项技术及产业化项目荣获“中国电子学会科学技术奖一等奖”；2017 年，公司荣获三星电子颁发的“最佳供应商奖”；2018 年，公司产品“第二代 DDR4 内存缓冲控制器芯片”荣获中国芯“年度重大创新突破产品”奖；2018 年 11 月，津逮®CPU 及其平台采用的“动态安全监控技术”获评第五届世界互联网大会“世界互联网领先科技成果”；2019 年 5 月，公司“高性能 DDR 内存缓冲控制器芯片设计技术项目”荣获上海市人民政府颁发的“上海市技术发明一等奖”；2020 年 10 月，公司荣获“上海知识产权创新奖”，公司的津逮®CPU 荣获“中国芯年度重大创新突破产品奖”。2022 年 4 月，公司荣获“第二十三届中国专利优秀奖”。2022 年 11 月，公司获得全球领先的内存和存储厂商美光科技的肯定，荣膺美光科技“杰出性能奖（半导体元器件）”和“杰出质量奖（封装&测试材料半导体元器件）”。2023 年 1 月，公司荣获“国家知识产权优势企业”。2023 年 11 月，澜起科技 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片荣获第十八届中国芯“年度重大创新突破产品”，并再次斩获美光科技“杰出供应商表现奖”。2023 年 12 月，公司荣获 SK 海力士“最佳供应商奖”；凭借在数据中心高速互连芯片领域的持续创新与市场领先地位，我们继 2023 年首次入选福布斯“2023 中国创新力企业 50 强”榜单，于 2025 年再度成功入选该权威榜单。2025 年，公司被认定为“上海市创新型企业总部”；入选《财富》中国科技 50 强。这一系列荣誉的获得，充分显示出市场对于澜起科技品牌的认可。

4. 富有远见且经验丰富的管理及研发团队

我们的管理及核心研发团队由经验丰富、富有远见的领导者组成，在互连解决方案的创新及研发方面拥有深厚的专业知识。

我们的创始人杨崇和博士及 Stephen Tai 先生在集成电路设计及研发方面拥有丰富经验，各自拥有逾 30 年行业经验。杨崇和博士曾在美国国家半导体公司等企业任职，并于 1997 年与同仁共同创建硅谷模式的集成电路设计公司新涛科技。杨崇和博士于 2010 年当选美国电气和电子工程师协会院士（IEEE Fellow），积累了丰富的设计、研发和管理经验，于 2015 年入选全球半导体联盟亚太领袖。杨博士在 2019 年成为全球微电子行业标准制定机构 JEDEC “杰出管理领袖奖”首位获奖者，该奖为 JEDEC 组织新设立奖项，用于表彰推动和支持 JEDEC 标准发展的电子行业最杰出的高级管理人员。2022 年 11 月，杨博士被授予 IEEE 终身院士（IEEE Life Fellow）称号，以表彰他多年来在集成电路设计领域做出的杰出贡献。2023 年 12 月，杨博士荣获“安永企业家奖 2023 中国内地大奖”。2024 年 10 月，杨博士以其在全球芯片设计领域的杰出贡献荣登俄勒冈州立大学工程名人堂，表彰其在工程领域持续、卓越的专业成就和领导力。2025 年 7 月，杨博士凭借其在技术创新与企业治理方面的卓越领导力，荣登福布斯中国最佳 CEO 榜单。我们的总经理

Stephen Kuong-Lo Tai 先生曾参与创建 Marvell 科技集团并就任该公司的工程研发总监，拥有逾 25 年的半导体架构、设计和工程管理经验，因其在科技创新和国际合作方面的杰出贡献，于 2025 年荣膺上海市“白玉兰荣誉奖”。

我们的核心技术人员、研发部负责人常仲元博士曾在 IEEE 学术期刊和国际会议上发表了论文逾 20 篇，其中 3 篇发表于 ISSCC 会议，并作为第一作者出版了《Low Noise Wideband Amplifiers in Bipolar and CMOS Technology》。我们核心团队多毕业于国内外著名高校，在技术研发、市场销售、工程管理等领域均有着丰富的阅历和实战经验。公司自成立以来就十分注重人才的培养和 innovation，目前已培养了数百名在高速、低功耗和数模混合电路设计领域的专业技术人才。目前我们的员工中约 74% 为研发技术人员，且研发技术人员中约 64% 拥有硕士及以上学位，为公司持续开展技术创新提供了重要的人才基础。

5. 显著的行业生态优势与全球化产业化布局

凭借在互连解决方案领域二十余年的深耕积累，我们在行业内建立了良好声誉，与 AI 基础设施生态体系内全球知名企业建立并保持战略合作关系，合作对象涵盖内存模组厂商、服务器 OEM/ODM 厂商、CPU 及 GPU 厂商、云计算服务提供商等。

我们的产品已被主流服务器 OEM/ODM 厂商广泛采用，其下游客户覆盖云计算及其他云服务提供商。我们的产品获得客户高度认可，多年来持续获得三星电子、SK 海力士、美光科技等主要客户颁发的优秀供应商奖项，长期稳定的客户合作关系进一步巩固了我们的行业地位。互连解决方案的性能与可靠性对服务器及 AI 基础设施至关重要。因此，我们与全球行业头部企业长期稳定、经过验证的合作关系，已成为客户选择供应商的重要考量因素。我们在产品高性能、低功耗、高良率及高品质交付方面的优异表现，获得客户高度认可。根据客户调研结果，2022 年至 2024 年，我们的客户满意度评分连续超过 90 分（满分 100 分）。

我们与全球领先的 CPU 及 GPU 厂商建立长期合作伙伴关系，围绕云计算及 AI 基础设施，紧密合作开发新一代互连产品。在全球供应链体系内，我们与全球领先的集成电路晶圆制造企业、封装和测试企业深度合作，确保生产并交付满足客户高品质标准的产品。

我们不仅扎根中国，还在美国、韩国等地建立了分支机构或办事处，形成全球化布局。我们派驻工程师及销售人员直接对接众多产业巨头，深入了解行业发展所带来的客户需求变化及技术创新趋势。我们通过与全球市场客户及合作伙伴的深度互动，引领行业创新，保持行业领先地位。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

(三) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

(1) 核心技术及其先进性

我们具备自有的集成电路设计平台，包括数字信号处理技术、内存管理与数据缓冲技术、模拟电路设计技术、高速逻辑与接口电路设计技术、低抖动时钟设计技术以及低功耗设计技术，方案集成度高，可有效提高系统能效和产品性能。

① 内存接口相关技术

历经二十余年的专注研发和持续投入，我们成为全球少数能够提供从 DDR2 到 DDR5 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一。公司的核心技术完全基于自主知识产权，突破了一系列关键技术壁垒。在 DDR4 世代，由公司发明的“1+9”分布式缓冲内存子系统框架，突破了 DDR2、DDR3 的集中式架构设计，创新性采用 1 颗寄存缓冲控制器为核心、9 颗数据缓冲控制器芯片的分布结构布局，大幅减少了 CPU 与 DRAM 颗粒间的负载效应，降低了信号传输损耗，解决了内存子系统大容量与高速度之间的矛盾。该技术架构最终被 JEDEC 采纳，成为 DDR4 LRDIMM 的国际标准，显著提升了公司的国际话语权。进入 DDR5 世代，“1+9”架构演化为“1+10”，继续作为 LRDIMM 的国际标准，并进一步衍生出新型高带宽内存模组 MRDIMM 的国际标准。

公司提出了一系列创新电路和算法，有效改善了 DDR5 内存高速并行总线的信号完整性问题。在电路上，公司发明了高速低噪声收发器，并通过多抽头判决反馈均衡（Decision Feedback Equalization，以下简称 DFE），补偿远端串扰和均衡码间干扰；在算法上，公司提出面向复杂电磁环境的偏差校准和自适应算法，通过均衡系数自适应的 DFE 训练算法，增加眼图的电压和时序裕度。此外，公司还提出了自适应电源管理和动态时钟分配等创新技术，显著降低了相关内存接口芯片的功耗。公司的内存接口相关技术已达到国际领先水平，最新发布的 DDR5 第五子代内存接口芯片可支持的数据速率高达 8000MT/s，同时，公司发布的 DDR5 第二子代高带宽内存接口芯片（MRCD/MDB）可支持的数据速率高达 12800MT/s，研发水平保持全球领先。

公司经过 DDR 系列产品的持续不断创新与积累，掌握了 DDR5 高速内存接口所需的关键设计技术，并开发了高速高精度自动化测试技术与平台，加快了产品设计、全面评估与迭代速度，为 DDR5 新一子代产品的研发奠定了坚实的基础。

② SerDes 高速串行接口技术

SerDes 是高速互连领域的重要基础技术，是 SERializer（串行器）/DESerializer（解串器）的简称。它是一种主流的时分多路复用、点对点的串行通信技术，能够在发送端将多路低速并行信号转换成高速串行信号，并通过传输介质（光缆或铜缆）传输，最终在接收端将高速串行信号重

新转换成低速并行信号。作为多种重要高速传输技术（如 PCIe、USB、以太网等）的物理层基础，SerDes 广泛应用于服务器、异构计算、汽车电子和通信等领域的高速互连。

从 PCIe 5.0 到 PCIe 6.0，其底层技术 SerDes IP 的技术框架发生了质的变化，其中最核心的是编码方式由 NRZ 改变为 PAM4。NRZ 只有信号振幅高低两个状态表示 0 和 1；而 PAM4 利用四种不同振幅电平表示 00、01、10 和 11 四种状态，因此 PCIe 6.0 SerDes 同样的波特率能够让传输速度翻倍（由 32GT/s 提升至 64GT/s）。但是相对 NRZ，PAM4 在相同的幅度范围内需要容纳四个电平，信号幅度只有 NRZ 的三分之一，同时信噪比也只有 NRZ 三分之一。小的信号幅度和低的信噪比会对串扰和电路本身的噪声更加的敏感。因此 PCIe 6.0 相关的 SerDes IP 难度大幅提升。

近年来，我们持续投入 SerDes 技术的研发并不断取得新突破，为相关新产品的开发提供了技术保障。我们已成功研发数据速率为 32GT/s 的 SerDes IP,并应用于 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer，该产品于 2024 年获得下游客户规模采购；在此基础上，我们进一步攻克了难度更大的数据速率为 64GT/s 的 SerDes IP，并应用于 PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer 产品。未来，我们将继续推进 SerDes 技术的迭代升级，目前在研的 PCIe 7.0 SerDes IP 支持速率高达 128GT/s。

(2) 核心技术在报告期内的变化情况

①内存接口相关技术

报告期内，我们持续投入 DDR5 内存接口芯片技术的研发及迭代升级，进一步巩固在该领域的行业领先地位。在服务器端，我们完成了 DDR5 第五子代 RCD 芯片（支持速率 8000MT/s）以及第二子代 MRCD/MDB 芯片（支持速率 12800MT/s）量产版本的研发；在 PC 端，我们推出了支持 9200 MT/s 速率的 DDR5 CKD 芯片，展现了我们在内存接口技术领域的强大技术实力和快速迭代能力。

②SerDes 高速串行接口技术

报告期内，我们自研的 64GT/s 的 SerDes 技术成功应用于 PCIe6.x/CXL3.x Retimer 芯片，该产品已于 2025 年 1 月向客户送样。SerDes 技术作为 PCIe Retimer 芯片的关键底层技术，其研发成功不仅体现了公司在高速串行接口技术领域的深厚积累，也为我们的 PCIe Switch 等相关新产品的开发筑牢了技术根基。目前，公司正在研发 128GT/s 的 SerDes 技术，并开展 PCIe 7.0 Retimer 芯片及高速以太网 PHY Retimer 芯片等新产品的研发。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
澜起科技股份有限公司	单项冠军企业	2024-2026 年	DDR 系列内存接口芯片

2. 报告期内获得的研发成果

(1) 互连类芯片产品线

- 内存互连芯片：DDR5 第四子代 RCD 芯片成功量产，完成 DDR5 第五子代 RCD 芯片、第二子代 MRCD/MDB 芯片、新一代 CKD 芯片量产版本的研发。
- PCIe 互连芯片：推进 PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer 芯片量产版本的研发，并将其应用于 PCIe 6.x/CXL 3.x AEC 解决方案，同时积极开展 PCIe 7.0 Retimer 芯片及 PCIe Switch 芯片的工程研发。
- CXL 互连芯片：完成 CXL 2.0 MXC 芯片量产版本的研发，完成 CXL 3.x MXC 芯片的工程研发。
- 时钟芯片：完成首批时钟缓冲芯片（Clock Buffer）及展频振荡器的工程研发。

(2) 津逮®产品线：发布第六代津逮®性能核 CPU。

公司在 2025 年获得的各项知识产权情况如下：

A、专利

2025 年度，公司已获授权的发明专利共 36 项，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	授权公告日	国家或地区
1	用于对神经网络中卷积层进行剪枝的方法和装置	发明专利	ZL202010171150.4	2020/3/12	2025/1/28	中国
2	MEMORY CONTROLLER AND A METHOD FOR CONTROLLING ACCESS TO A MEMORY MODULE	发明专利	US12190996B2	2021/5/21	2025/1/7	美国
3	用于在候选向量集中查询相似向量的方法和装置	发明专利	ZL202110393852.1	2021/4/13	2025/12/16	中国
4	METHOD AND APPARATUS FOR QUERYING SIMILAR VECTORS IN A CANDIDATE VECTOR SET	发明专利	US12346321B2	2022/4/12	2025/7/1	美国
5	用于压缩神经网络的方法和装置	发明专利	ZL202011308961.0	2020/11/20	2025/10/24	中国
6	用于压缩神经网络的方法和装置	发明专利	ZL202110425076.9	2021/4/20	2025/12/16	中国
7	用于选择最值的装置和方法	发明专利	ZL202110400296.6	2021/4/14	2025/12/12	中国
8	具有分离的电源供给能力的存储设备	发明专利	ZL202111121365.6	2021/9/24	2025/12/12	中国
9	METHOD FOR PROCESSING DATA USING A NEURAL NETWORK	发明专利	US12505330B2	2022/12/12	2025/12/23	美国
10	DEVICE AND METHOD FOR SELECTING TOP VALUES FROM A SET OF RAW VALUES	发明专利	US12271709B2	2022/12/27	2025/4/8	美国

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	授权公告日	国家或地区
11	SIGNAL PROCESSING METHOD AND DEVICE FOR A MEMORY SYSTEM INTERFACE CIRCUIT	发明专利	US12407548B2	2024/3/27	2025/9/2	美国
12	模拟数字转换器, 及用于检测其中缺陷的方法和电路	发明专利	ZL202311745847.8	2023/12/19	2025/10/17	中国
13	一种基于锁相环的供电电路、方法、芯片及电子设备	发明专利	ZL202011594506.1	2020/12/29	2025/7/22	中国
14	连续系统地址解析方法、装置、电子设备及存储介质	发明专利	ZL202110003420.5	2021/1/4	2025/5/2	中国
15	基于串联端接匹配的驱动输出电路、芯片及驱动输出方法	发明专利	ZL202110443837.3	2021/4/23	2025/9/23	中国
16	LOW LATENCY RETIMER AND LOW LATENCY CONTROL METHOD	发明专利	US12470319B2	2022/9/22	2025/11/11	美国
17	一种获得印刷电路板板材参数的方法	发明专利	ZL202110802152.3	2021/7/15	2025/7/18	中国
18	DATA SECURITY METHOD AND DATA SECURITY SYSTEM	发明专利	US12493516B2	2023/9/4	2025/12/9	美国
19	DELAY DEVICE AND DELAY CONTROL METHOD	发明专利	US12206418B2	2023/5/19	2025/1/21	美国
20	DELAY DEVICE AND CONTROL METHOD OF TRANSMISSION DELAY	发明专利	US12191929B2	2023/6/28	2025/1/7	美国
21	基于伽罗瓦哈希验证的电路	发明专利	ZL202311244378.1	2023/9/25	2025/12/26	中国
22	CODE EXECUTION METHOD AND DATA PROCESSING DEVICE AND SYSTEM	发明专利	US12474897B2	2023/11/6	2025/11/18	美国
23	TEST CIRCUIT AND TEST APPARATUS COMPRISING THE TEST CIRCUIT	发明专利	US12504472B2	2023/5/3	2025/12/23	美国
24	MULTI-MODE FREQUENCY DIVISION CIRCUIT	发明专利	US12451889B2	2024/8/1	2025/10/21	美国
25	ZERO-CROSSING DETECTION CIRCUIT	发明专利	US12399198B1	2024/4/2	2025/8/26	美国
26	电压转换电路	发明专利	ZL202311733218.3	2023/12/15	2025/6/27	中国
27	虚拟机热迁移的方法及其装置	发明专利	ZL202110204159.5	2021/2/23	2025/9/16	中国
28	片上帕尔贴制冷器件及其制作方法	发明专利	ZL202110642608.4	2021/6/9	2025/8/19	中国
29	自制冷半导体电阻器及其制作方法	发明专利	ZL202110644408.2	2021/6/9	2025/11/7	中国
30	SELF-COOLING SEMICONDUCTOR RESISTOR AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	发明专利	US12205863B2	2022/6/9	2025/1/21	美国

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	授权公告日	国家或地区
31	基于帕尔贴效应的集成制冷装置及其制作方法	发明专利	ZL202110644412.9	2021/6/9	2025/12/2	中国
32	DATA ENCRYPTION AND DECRYPTION SYSTEM AND METHOD	发明专利	US12306962B2	2022/12/30	2025/5/20	美国
33	静电放电和电过载的探测电路	发明专利	ZL202111442023.4	2021/11/30	2025/10/31	中国
34	DUTY CYCLE CALIBRATION CIRCUIT AND METHOD	发明专利	US12388424B2	2023/9/15	2025/8/12	美国
35	DUTY CYCLE CALIBRATION CIRCUIT AND METHOD	发明专利	US12323152B2	2023/9/1	2025/6/3	美国
36	DATA COMPRESSION AND DECOMPRESSION METHODS AND SYSTEMS	发明专利	US12341539B2	2023/7/20	2025/6/24	美国

B、集成电路布图设计

2025 年度，公司共获得 24 项集成电路布图设计证书，具体情况如下：

序号	布图设计名称	登记号	申请日	创作完成日	颁证日
1	KS-P5100-CB	BS.245583610	2024/10/23	2024/4/19	2025/2/13
2	ZH-MXC2-AB	BS.245583637	2024/10/23	2024/4/19	2025/2/13
3	KS-LC-RCD04-AB	BS.245583394	2024/10/23	2024/4/10	2025/2/13
4	KS-LC-RCD05-AA	BS.245583408	2024/10/23	2024/7/19	2025/2/13
5	LG-JP-MRCD02-AA	BS.245583661	2024/10/23	2024/7/19	2025/2/13
6	LG-JP-MDB02-AA	BS.245583556	2024/10/23	2024/7/19	2025/3/10
7	MT-CK01-BD	BS.255517203	2025/3/20	2025/1/8	2025/7/16
8	KS-TC-RCD02P-A2	BS.25550814X	2025/2/10	2024/12/9	2025/5/23
9	KS-TC-DB02P-A5A	BS.255508255	2025/2/10	2024/11/5	2025/5/23
10	KS-LC-RCD01-C51	BS.255508344	2025/2/11	2024/12/16	2025/5/23
11	KS-LC-RCD02-GA1	BS.255508190	2025/2/10	2024/12/12	2025/5/23
12	KS-LC-RCD03-IA1	BS.255508220	2025/2/10	2024/12/19	2025/5/23
13	MT-JP-MDB01-BC	BS.255517262	2025/3/20	2024/3/15	2025/7/16
14	KS-RT5x16-DC	BS.255517319	2025/3/20	2024/5/30	2025/7/28
15	LG-RT6x16-AB	BS.255517335	2025/3/20	2025/3/3	2025/7/16
16	LG-RT5x16-DC	BS.255562144	2025/8/5	2025/3/30	2025/11/27
17	KS-Gen5RT-DC	BS.255562187	2025/8/5	2025/4/5	2025/11/27
18	MT-MRCD02-BA	BS.255562578	2025/8/6	2025/5/27	2025/11/25

序号	布图设计名称	登记号	申请日	创作完成日	颁证日
19	MT-MDB02-BA	BS.255562586	2025/8/6	2025/5/30	2025/11/25
20	KS-LC-RCD03-IX	BS.255562594	2025/8/6	2025/8/1	2025/11/27
21	MT-CK01P-D0	BS.255574606	2025/9/15	2025/6/11	2025/12/29
22	KS-P5200-AC	BS.255574622	2025/9/15	2025/7/28	2025/12/29
23	KS-P5030-AC	BS.255574630	2025/9/15	2025/8/8	2025/12/29
24	ZH-MXC3-AA	BS.255574649	2025/9/15	2025/2/26	2025/12/25

C、软件著作权

2025 年度，公司共获得 1 项软件著作权，具体情况如下：

序号	软件著作名称	登记号	受理日	开发完成日	颁证日
1	时钟芯片 OTP 烧录软件 V1.1	2025SR1941697	2025/8/29	2025/8/5	2025/10/10

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	40	36	145	224
实用新型专利	0	0	0	1
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	1	1	13	13
布图设计权	19	24	104	103
合计	60	61	262	341

注：上表所列是公司独家拥有的知识产权数据，除此之外，公司还与多家合作伙伴共同申请了 10 项中国专利（其中 6 项已授权）

3. 研发投入情况表

单位：元 币种：人民币

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	915,030,216.00	763,469,994.44	19.85
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	915,030,216.00	763,469,994.44	19.85
研发投入总额占营业收入比例 (%)	16.77	20.98	减少 4.21 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	互连类芯片研发项目	180,000.00	83,100.72	179,227.90	<p>(1) 内存互连芯片：DDR5 第四子代 RCD 芯片成功量产，完成 DDR5 第五子代 RCD 芯片、第二子代 MRCD/MDB 芯片、新一代 CKD 芯片量产版本的研发。</p> <p>(2) PCIe 互连芯片：推进 PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer 芯片量产版本的研发，并将其应用于 PCIe 6.x/CXL 3.x AEC 解决方案，同时积极开展 PCIe 7.0 Retimer 芯片及 PCIe Switch 芯片的工程研发。(3) CXL 互连芯片：完成 CXL 2.0 MXC 芯片量产版本的研发，完成 CXL 3.x</p>	互连类芯片各子产品技术保持领先、持续迭代。	国际领先	<p>(1) 内存互连相关芯片主要用于服务器及 PC 端内存模组，是实现内存数据高速传输与可靠访问的核心组件；</p> <p>(2) MXC 芯片应用于大数据、云服务的内存扩展和池化；</p> <p>(3) PCIe Retimer 和 PCIe Switch 芯片应用于数据中心服务器运算、存储间高速互连解决方案；(4) 时钟芯片主要用于生成、分配和管理电子系统中的时钟信</p>

					MXC 芯片的工程研发。(4)时钟芯片:完成首批时钟缓冲芯片 (Clock Buffer) 及展频振荡器的工程研发。			号,以实现各个模块间的数据传输与处理同步。
2	津逮®产品研发项目	60,000.00	8,402.30	32,499.03	发布第六代津逮®性能核 CPU。	提供符合市场需求的数据保护与可信加速芯片、I/O 集线器 (IOH) 芯片等产品。	行业领先	集成了芯片级安全监控、硬件加速、可信计算、I/O 扩展等功能,旨在信息安全领域发挥关键作用,为云计算数据中心和数据应用提供安全可靠的服务环境。
合计	/	240,000.00	91,503.02	211,726.93	/	/	/	/

情况说明

- 注: 1. “互连类芯片研发项目”的子产品包括内存接口芯片、内存模组配套芯片、MXC 芯片、CKD 芯片、MRCD/MDB 芯片、PCIe Retimer 芯片、PCIe Switch 芯片、时钟芯片等。
2. “互连类芯片研发项目”及“津逮®产品研发项目”的“预计总投资规模”为 2023 年至 2025 年累计对各个项目投入的预估(包括研发投入及其他投入),本期投入金额和累计投入金额均指研发投入金额,累计投入金额从 2023 年 1 月 1 日起算。

5. 研发人员情况

单位: 万元 币种: 人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	583	536
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	74.36	74.65
研发人员薪酬合计	62,698.21	53,320.43

研发人员平均薪酬	107.54	99.48
----------	--------	-------

说明：（1）研发人员薪酬合计与“第十节 财务报告”之“七、65、研发费用-职工薪酬”口径一致，包括公司支付的工资、奖金、津贴、补贴、福利、社会保险、公积金以及承担的股份支付费用；

（2）研发人员平均薪酬指研发人员薪酬合计除以报告期末研发人员人数。

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	15
硕士研究生	359
本科	206
专科及以下	3
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	167
30-40岁（含30岁，不含40岁）	242
40-50岁（含40岁，不含50岁）	131
50-60岁（含50岁，不含60岁）	38
60岁及以上	5

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

四、 风险因素

（一）尚未盈利的风险

适用 不适用

（二）业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

（三）核心竞争力风险

适用 不适用

1. 产品研发风险

集成电路产业发展日新月异，技术及产品迭代速度较快。芯片设计公司需要不断地进行创新，同时对市场进行精确的把握与判断，不断推出适应市场需求的新技术、新产品以跟上市场变化，赢得和巩固公司的竞争优势和市场地位。

公司新产品的开发风险主要来自以下几个方面：（1）公司新产品的开发存在周期较长、资金投入较大的特点，在产品规划阶段，存在对市场需求判断失误的风险，可能导致公司产品定位错

误；（2）由于公司产品技术含量较高，公司存在对企业自身实力判断失误的风险，主要是对公司技术开发能力的判断错误，导致公司研发项目无法实现或周期延长；（3）由于先发性对于公司产品占据市场份额起到较大的作用，若产品迭代期间，竞争对手优先于公司设计生产出新一代产品，公司有可能丢失较大的市场份额，从而影响公司后续的发展。

针对上述潜在风险，一方面，公司将加强对行业新技术、新需求的动态跟踪，加强对市场需求的研判能力；另一方面，公司积极参与各类行业标准组织，参与甚至主导相关新产品标准的制定，从而降低后续产品研发风险。

2. 人才流失风险

芯片设计行业属于技术密集型产业，对技术人员的依赖度较高。凭借公司研发团队多年来的持续努力钻研，公司技术人员的自主开发能力不断增强。公司针对优秀人才实施了多项激励措施，对稳定公司核心技术团队起到了积极作用。但同行业竞争对手仍可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，或公司受其他因素影响导致公司技术人才流失，将对公司新产品的研发以及技术能力的储备造成影响，进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

针对上述潜在风险，一方面，公司为员工提供丰富的职业发展机会，让员工在企业中获得成长；另一方面，伴随着企业的发展壮大，合理提升员工待遇，实施股权激励在内的多种激励手段，从而吸引和留住优秀人才。

3. 技术泄密风险

通过持续技术创新，公司研发技术平台处于行业内较高水平。自成立以来，公司就十分重视对核心技术的保密，及时将研发成果申请专利，并制定了严格完善的内控制度，保障核心技术的保密性。但存在由于核心技术人员流动、技术泄密，或专利保护措施不力等原因，导致公司核心技术流失的风险。如前述情况发生，将在一定程度上削弱公司的技术优势，对公司的竞争力产生不利影响。

公司将持续加强核心技术的保密，及时处理潜在的泄密事件，有效防范技术泄密风险，维护公司的核心技术安全。

(四) 经营风险

适用 不适用

1. 客户集中风险

互连类芯片产品是公司目前主要的利润来源，其中内存接口及模组配套芯片的下游为 DRAM 市场，直接客户为内存模组厂商。根据行业资料，目前三星电子、海力士、美光科技合计占全球 DRAM 市场 90% 以上份额，这导致公司在该产品线的客户集中度也相对较高。如果公司产品开发策略不符合市场变化或不符合客户需求，则公司将存在不能持续、稳定地开拓新客户和维系老客

户新增业务的可能，从而面临业绩下滑的风险。同时，由于客户相对集中度高，如果发生客户要求大规模降价、竞争对手恶性竞争等竞争环境变化的情形，公司将面临市场份额波动、收入下滑的风险。

为应对客户集中风险，公司坚持以研发创新为核心，持续优化产品结构。公司前期布局的 PCIe Retimer、MRCD/MDB、CKD 芯片等多款高性能运力芯片，凭借稳定可靠的性能和较高的市场认可度，市场份额显著提升，销售收入快速增长，展现出强劲的市场活力和良好的盈利态势，其中 PCIe Retimer 芯片的直接客户为服务器 OEM/ODM 厂商，其收入占比提升将在一定程度上降低客户集中风险。

此外，基于公司的战略目标，公司依托自主研发 SerDes 技术的核心优势，正在积极布局 PCIe Switch 等新产品，为客户提供更全面的 PCIe/CXL 互连芯片解决方案，稳步拓宽公司在该领域的市场空间，进一步提升公司的综合竞争力和市场影响力。

2. 供应商风险

公司为最大程度优化自身产能资源配置，同时考虑经济性原则，采取 Fabless 模式，将芯片生产及封测等工序交给外协厂商负责。自公司成立以来，公司已与外协加工厂商建立了稳定、良好的协作关系，外协加工厂商严格按照公司的设计图纸及具体要求进行部分工序的作业。采用外协加工的模式有利于公司将资源投入到核心工序、核心技术研发和产品研发中去，以增强核心竞争力。但是公司存在因外协工厂生产排期导致供应量不足、供应延期或外协工厂生产工艺存在不符合公司要求的潜在风险。

此外，晶圆制造、封装测试均为资本及技术密集型产业，因此相关行业集中度较高，是行业普遍现象。公司供应商集中度较高。如果上述供应商发生不可抗力的突发事件，或因集成电路市场需求旺盛出现产能紧张等因素，晶圆代工和封装测试产能可能无法满足公司需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。如果市场环境及供求关系发生变化，造成原材料价格上涨等情形，公司将面临成本上升、毛利率下降等相关经营风险。

针对上述风险，公司将进一步加强与供应商的合作与沟通，建立应急处理机制，以降低供应量不足或供应延期的风险；此外，公司将进一步完善供应商备份机制，持续进行市场分析，及时了解原材料价格波动，优化采购策略，降低潜在经营风险。

3. 产品质量风险

公司采用 Fabless 的运营模式，专注于芯片的设计及研发环节，而芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成。公司的产品质量一方面取决于公司的研发设计水平，一方面取决于委外厂商的生产管理水平。如果公司产品设计出现缺陷，或委外厂商生产管理水平不足导致发生产品质量事故，将给公司造成直接经济损失，存在赔偿客户以及造成公司订单减少、收入下滑、盈利下

降等风险。

针对上述风险，公司将持续提升研发设计水平，通过严格的设计验证和测试流程，减少设计缺陷，降低设计相关质量风险。同时，公司将继续执行严格的供应商管理制度，明确产品质量责任划分与承担机制，制定晶圆和封装委外厂商的质量要求和认证制度，加强对其产品质量的规范管理，降低制造相关质量风险。

4. 存货跌价风险

集成电路行业具有周期性，若未来市场环境发生变化、竞争加剧或技术更新导致存货过时，使得产品滞销、存货积压，会对公司的盈利能力产生不利影响。公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品构成。公司定期对存货进行资产减值测试，截至 2025 年 12 月 31 日，公司的存货账面价值为人民币 8.96 亿元。

公司将定期进行市场分析和竞争态势评估，及时了解市场需求变化，以调整存货采购和生产计划；同时，公司也将进一步加强与客户的合作与沟通，提升存货周转率，并结合行业周期特点优化库存结构，降低存货跌价风险。

5. 知识产权风险

芯片设计属于技术密集型行业，该行业知识产权众多。在产品开发过程中，涉及到较多专利及集成电路布图等知识产权的授权与许可，因此公司出于长期发展的战略考虑，一直坚持自主创新的研发战略，做好自身的知识产权的申报和保护，并在需要时购买必须的第三方知识产权，避免侵犯他人知识产权。但未来不能排除竞争对手或第三方采取恶意诉讼的策略，阻滞公司市场拓展的可能性。同时，也不能排除竞争对手窃取公司知识产权非法获利的可能性。公司将定期进行知识产权风险评估，制订应急预案，以应对潜在的知识产权争议和侵权风险。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

(三) 财务风险

汇兑损益风险

公司日常经营的销售采购业务大部分以美元结算，且发生的外币交易在初始确认时，按交易日的上一月的期末汇率折算为记账本位币金额，但在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金额，导致公司汇兑损益金额较大。

2025年，公司外汇汇兑损失为人民币4,074.94万元。由于人民币对美元汇率的持续波动，公司存在汇兑损失的风险。

在所有其他变量保持不变的假设下，人民币兑美元汇率发生合理、可能的变动时，将对公司 2025 年净损益（由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化）产生的影响如下：

单位：元

假设	净损益增加/（减少）
人民币对美元贬值 5%	93,590,330.11
人民币对美元升值 5%	(93,590,330.11)

针对上述潜在风险，公司将持续完善外汇风险管理政策，保持财务灵活性并加强财务监控以降低汇兑风险对公司的影响。

(六) 行业风险

适用 不适用

公司是集成电路设计企业，主要从事集成电路芯片产品的设计、研发及销售，属于集成电路行业的上游环节。集成电路行业是资本及技术密集型行业，随着技术的更迭，行业本身呈现周期性波动的特点，并且行业周期的波动与经济周期关系紧密。如果宏观经济发生剧烈波动或存在下行趋势，将导致行业发生波动或需求减少，使包括公司在内的集成电路企业面临一定的行业波动风险，对经营情况造成一定的不利影响。公司将密切关注行业及市场动态，适时调整经营策略，提高经营质量，增强公司的竞争力和抗风险能力，以降低行业波动对公司经营造成的不利影响。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

1. 全球贸易摩擦风险

报告期内，公司的主要客户、供应商、EDA 工具授权厂商大多为境外企业。近年来，全球贸易摩擦频发，虽然目前未对公司的经营情况产生重大不利影响，但鉴于集成电路产业是典型的全球化分工合作行业，如果全球贸易摩擦进一步升级，有可能造成产业链上下游交易成本增加，下游需求受限，上游供给不畅，从而将对公司的经营造成不利影响。假如相关半导体出口管制政策进一步升级，不排除未来对公司业务及相关人员产生不利影响。公司将持续关注相关规则的更新并积极做好应对措施。

2. 税收优惠政策风险

根据相关规定，报告期内公司及其相关子公司享受多项税收优惠政策，包括国家鼓励的重点集成电路设计企业税收优惠、高新技术企业税收优惠等。若未来上述税收优惠政策发生调整，或者公司无法持续享受企业所得税减免优惠政策，则将对公司的经营业绩和利润产生一定程度的影

响。公司将持续关注并研究上述税收优惠政策，与相关主管部门保持良好沟通，以有效管理和应对上述潜在风险。

3. 其他合规风险

公司业务面向全球市场，经营活动受到多个国家和地区法律管辖，不同司法辖区在出口管制、贸易合规、反垄断等领域的监管要求存在差异。如果未来相关法律法规发生变化或更新，或公司对境外监管规则理解、执行存在偏差，可能对公司业务开展、市场布局及经营业绩带来一定程度的影响或风险。公司将持续健全合规管理体系，密切跟踪、研究主要业务所在地法律法规及监管政策变化，加强对员工、合作伙伴的合规培训与宣导，强化出口管制、贸易合规、反垄断等重点领域的风险识别与管控，积极主动防范和化解相关合规风险，保障公司业务持续稳健运行。

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

适用 不适用

五、 报告期内主要经营情况

2025 年，受益于 AI 产业趋势，行业需求旺盛，公司的互连类芯片出货量显著增加，推动公司 2025 年度经营业绩较上年同期实现大幅增长。因此，报告期内公司实现营业收入 54.56 亿元，较上年度增长 49.94%；实现归属于母公司股东的净利润 22.36 亿元，较上年度增长 58.35%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,456,316,783.63	3,638,911,068.29	49.94
营业成本	2,060,961,088.35	1,523,614,938.54	35.27
销售费用	120,228,658.51	96,006,550.08	25.23
管理费用	526,287,844.89	196,262,500.24	168.16
财务费用	-228,316,436.63	-240,504,105.54	不适用
研发费用	915,030,216.00	763,469,994.44	19.85
经营活动产生的现金流量净额	2,022,020,556.92	1,691,321,506.14	19.55
投资活动产生的现金流量净额	850,312,118.68	-443,474,435.73	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,029,063,587.76	-276,938,001.46	不适用

营业收入变动原因说明：受益于 AI 产业趋势，行业需求旺盛，公司的互连类芯片出货量显著增加，推动公司相关产品销售收入较上年度大幅增长。

营业成本变动原因说明：主要是由于营业收入增长导致其相应的营业成本上升。

管理费用变动原因说明：主要是由于实施核心高管激励计划导致股份支付费用增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于报告期内收回投资收到的现金超过投资支付的现金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于（1）报告期内实施中期分红导致分配股利支付的现金增加；（2）上年同期因出售库存股实施员工持股计划收到现金导致筹资活动现金流入较高。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 54.56 亿元，较上年度增长 49.94%，其中互连类芯片产品线实现销售收入 51.39 亿元，较上年度增长 53.43%，产品线毛利率为 65.57%，较上年度提升 2.91 个百分点；津逮®产品线实现销售收入 3.08 亿元，较上年度增长 10.25%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
集成电路产品	544,675.96	205,447.76	62.28	50.10	35.45	增加 4.08 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
互连类芯片	513,852.63	176,911.09	65.57	53.43	41.47	增加 2.91 个百分点
津逮®产品	30,823.33	28,536.67	7.42	10.25	7.16	增加 2.67 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
境内	154,602.72	72,981.77	52.79	47.04	30.65	增加 5.92 个百分点
境外	390,073.24	132,465.99	66.04	51.35	38.24	增加 3.22 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
直销	461,894.65	163,940.96	64.51	49.57	30.64	增加 5.14 个百分点

						个百分点
代销	82,781.31	41,506.80	49.86	53.13	58.45	减少 1.68 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

- 2025 年，公司销售主要以直销为主，互连类芯片产品线销售区域主要在境外；津逮®产品线销售区域在境内。
- 2025 年度公司营业收入大幅增长的主要原因是受益于 AI 产业趋势，行业需求旺盛，公司的互连类芯片出货量显著增加，推动公司相关产品销售收入较上年度大幅增长。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
互连类芯片	万颗	40,107.73	38,213.58	13,412.63	66.28	53.04	184.09
津逮®产品	万片	4.75	4.13	4.92	144.93	35.46	14.81

产销量情况说明

- 互连类芯片期末库存量包含了所有存货的数量，即库存商品数量及原材料、委托加工物资模拟转换为库存商品的数量，其中库存商品数量为 2,495.78 万颗。
- 由于客户需求及销售订单增长，2025 年度公司增加备货，期末互连类芯片库存量较上年末增长 184.09%。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：万元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
集成电路产品	原材料	136,577.41	66.48	106,793.97	70.41	27.89	-
集成电路产品	加工成本	68,870.35	33.52	44,887.16	29.59	53.43	-
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

互连类芯片	原材料	108,184.90	61.15	80,326.15	64.23	34.68	-
互连类芯片	加工成本	68,726.19	38.85	44,724.59	35.77	53.67	-
津逮®产品	原材料	28,392.51	99.49	26,467.82	99.39	7.27	-
津逮®产品	加工成本	144.16	0.51	162.57	0.61	-11.32	-

成本分析其他情况说明

原材料及加工成本占比未发生重大变动。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明

A.公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 421,428.43 万元，占年度销售总额 77.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

适用 不适用

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%的贸易业务前五名销售客户

适用 不适用

B.公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 229,903.89 万元，占年度采购总额 79.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%的贸易业务前五名供应商

适用 不适用

C. 报告期内公司存在贸易业务收入

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

2025 年度管理费用增加主要是由于实施核心高管激励计划导致股份支付费用增加所致。

4. 现金流

适用 不适用

投资活动产生的现金流量净额增加主要是由于报告期内收回投资收到的现金超过投资支付的现金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动主要是由于（1）报告期内实施中期分红导致分配股利支付的现金增加；（2）上年同期因转让出售回购股份实施员工持股计划库存股收到现金导致筹资活动现金流入较高。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	82,330.43	5.99	178,349.48	14.60	-53.84	主要系由于结构性存款减少所致
应收账款	56,753.22	4.13	38,779.19	3.17	46.35	主要系本期销售收入增长所致
预付款项	13,289.04	0.97	439.42	0.04	2,924.25	主要系预付采购款增加

						所致
存货	89,613.55	6.52	35,219.64	2.88	154.44	主要系为满足客户需求及销售订单增加备货所致
其他流动资产	13,097.37	0.95	8,598.61	0.70	52.32	主要系公司进项税额增加以及港股上市费用增加所致
递延所得税资产	4,329.93	0.31	8,309.74	0.68	-47.89	主要系股份支付产生的递延所得税资产减少所致
合同负债	4.57	0.00	2,208.79	0.18	-99.79	主要系预收客户款项减少所致
应交税费	11,208.15	0.82	6,388.42	0.52	75.44	主要系应付企业所得税增加所致
租赁负债	1,936.27	0.14	2,879.87	0.24	-32.77	主要系报告期内按照租赁合同履行了付款义务所致
长期应付职工薪酬			1,959.30	0.16	-100.00	主要系核心高管激励工具变更,相关负债终止确认所致
递延所得税负债	909.94	0.07	211.30	0.02	330.63	主要系金融资产公允价值变动产生的递延所得税负债增加所致

其他说明

无

公司尚未盈利的成因及对公司的影响

适用 不适用

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1). 资产规模

其中：境外资产 66.41（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 48.30%。

(2). 境外资产占比较高的相关说明√适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期 营业收入	本报告期 净利润
Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited	同一控制下企业合并	芯片研发及销售	535,082.87	76,629.95

3. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 不适用

截至本报告期末，公司使用权受到限制的资产为货币资金人民币 820.40 万元，为银行保函保证金。详见第八节、七、31。

4. 其他说明适用 不适用**(四) 行业经营性信息分析**√适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
72,621,168.49	45,059,357.37	61.17%

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	176,402,753.81	13,053,923.85	439,690.15		49,021,168.49	109,877,478.96	-713,864.02	128,326,193.32
私募基金	43,448,364.95	30,643,443.66			3,600,000.00	10,880,000.00		66,811,808.61
其他	2,161,158,466.49	-17,803,306.37			20,000,000.00	919,701,912.34	-4,217,058.96	1,239,436,188.82
其中：结构性存款	1,629,362,905.47	-1,927,273.11				904,701,912.34		722,733,720.02
非上市股权投资	531,795,561.02	-15,876,033.26			20,000,000.00	15,000,000.00	-4,217,058.96	516,702,468.80
合计	2,381,009,585.25	25,894,061.14	439,690.15		72,621,168.49	1,040,459,391.30	-4,930,922.98	1,434,574,190.75

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	处置损益	期末账面价值	会计核算科目
境内外股票	688381	帝奥微	4,281,375.80	自有资金	11,189,996.32	-6,908,620.52			15,240,209.54	10,958,833.74		交易性金融资产
境内外股票	688206	概伦电子	20,000,000.00	自有资金	18,657,872.97	15,707,738.64					34,365,611.61	交易性金融资产
境内外股票	688347	华虹公司	99,999,952.00	自有资金	89,365,341.72	16,230,761.44			171,106,217.69	65,510,114.53		交易性金融资产
境内外股票	其他	其他	37,406,690.35	自有资金	34,918,634.20	-11,975,955.71		43,976,186.94			66,205,001.41	交易性金融资产
境内外股票	其他	其他	19,365,157.16	自有资金	22,270,908.60		439,690.15	5,044,981.55			27,755,580.30	其他权益工具投资
合计	/	/	181,053,175.31	/	176,402,753.81	13,053,923.85	439,690.15	49,021,168.49	186,346,427.23	76,468,948.27	128,326,193.32	/

衍生品投资情况

√适用 □不适用

(1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

□适用 √不适用

(2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用 √不适用

其他说明

公司于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及其子公司根据实际业务发展情况，自董事会审议通过之日起 12 个月，使用不超过 2,500 万美元（或等值人民币）的自有资金与相关金融机构开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。报告期内，公司未开展外汇衍生品交易。

4. 私募股权投资基金投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	投资目的	拟投资总额	报告期内投资金额	截至报告期末已投资金额	参与身份	报告期末出资比例(%)	是否控制该基金或施加重大影响	会计核算科目	是否存在关联关系	基金底层资产情况	报告期利润影响	累计利润影响
上海木澜一期私募基金合伙企业(有限合伙)	2021年9月	获取投资回报及产业链投资布局	20,000.00	360.00	5,790.00	有限合伙人	20	否	其他非流动金融资产	否	未上市公司股权	3,090.14	2,911.90
合计	/	/	20,000.00	360.00	5,790.00	/	20	/	/	/	/	3,090.14	2,911.90

其他说明
无

5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
澜起电子科技（昆山）有限公司	子公司	芯片研发及销售	50,000.00	320,192.13	300,541.13	112,663.30	93,871.40	93,869.76
Montage Technology Holdings Company Limited	子公司	投资控股	5万美元	352,841.92	352,837.56		11,636.86	11,636.86
Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited	子公司	芯片研发及销售	50万澳门元	430,846.66	198,146.73	535,082.87	87,574.34	76,629.95

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

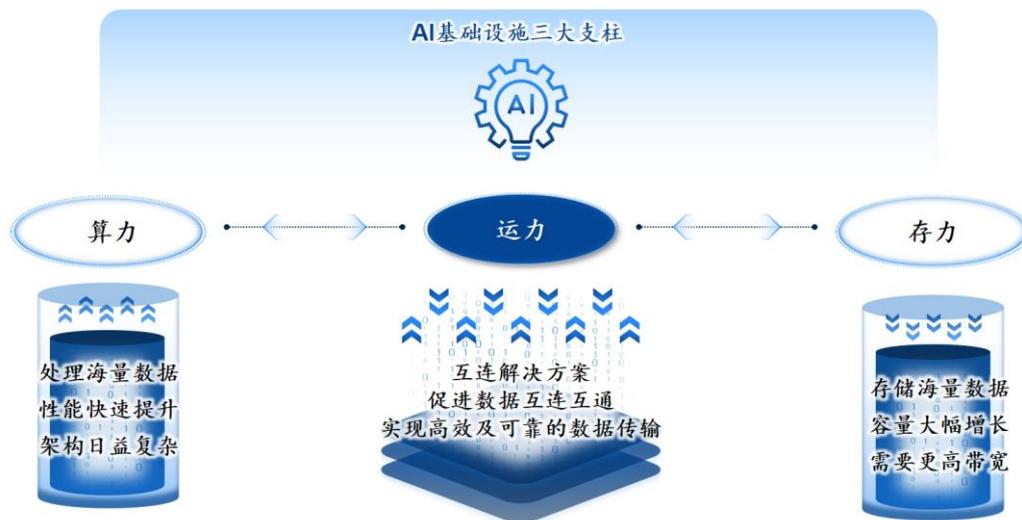
六、 公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

当前，随着人工智能相关技术的快速进步，业界正经历从“计算”向“智算”演进的深刻变革，生成式人工智能（AI）和大语言模型（LLM）未来将重塑科技行业，并深刻影响人们生活的诸多方面。生成式人工智能的快速发展将带动 AI 服务器市场的高速增长，根据 TrendForce 预测，2025 年预计 AI 服务器相关的行业价值将增长至 3000 亿美元，同比增长 46.1%，AI 服务器将占整个服务器行业总价值的 72% 以上。

在 AI 产业蓬勃发展的浪潮中，相关基础设施将持续获得强劲动力。AI 基础设施主要由三大支柱构成：（1）算力：以 GPU、CPU 及各类 AI 加速卡为代表，是执行复杂计算任务的核心，通常构成系统中最关键且成本较高的部分；（2）运力：包括 DRAM、NVMe SSD、HBM 等各类存储介质，为算力提供高效、可靠的数据存取支持，是 AI 模型训练与推理的数据基石；（3）运力：指贯穿芯片间、服务器间、集群间乃至数据中心间的多层次互连与通信能力。随着 AI 基础设施架构日益复杂，运力的作用愈发关键——它需要各类高速互连芯片以确保各组件间高效、稳定、低延迟的协同与数据流动，从而全面提升数据中心的整体效率、可靠性与可扩展性。



我们在高速互连芯片领域拥有深厚的技术积累。基于开放的行业标准，我们已成为内存互连领域的市场领跑者，并持续深耕和创新；我们通过自研高速 SerDes 等关键技术，将优势延伸至 PCIe/CXL 互连领域。我们的产品致力于突破互连瓶颈，显著提高数据传输速率/带宽、可靠性及系统能效。

1. 内存互连领域

内存互连芯片市场的发展趋势呈现以下两个特点：

(1) 算力爆发驱动内存容量及带宽需求增长：大模型训练与推理对算力的迫切需求，正持续推高内存容量和带宽升级。以 GPT、Deepseek 为代表的大模型，参数规模突破万亿级，推动 AI 服务器内存配置显著升级——单台典型 AI 服务器通常需部署超过 20 条 DDR5 内存模组，内存容量和数量远超通用服务器。同时，算力的爆发也对内存带宽提出了更高的要求，DDR5 第一子代 RDIMM 支持速率为 4800MT/s，第六子代预计突破 9200MT/s，而第三子代 MRDIMM 支持速率将达到 16000MT/s。随着技术成熟及生态逐步完善，MRDIMM 凭借更高带宽与综合性能，有望取代 RDIMM 成为 AI 服务器系统主内存的优选方案，带动 MRCD/MDB 芯片需求激增。在 PC 领域同样呈现高速发展态势，DDR5 在游戏本和 AI PC 等高阶终端加速渗透，模组速率逐步迭代至 6400 MT/s 及以上。为了保障高速运行下的信号完整性，预计到 2029 年至 2030 年几乎所有的 PC 内存模组都将标配 CKD 芯片。

(2) 技术迭代周期缩短：内存互连芯片技术正沿“协议升级迭代—传输速率提升—芯片功能复杂化”路径加速演进，高速信号处理与低功耗设计等技术成为核心竞争点，内存互连芯片的价值量将持续提升。在服务器领域，DDR4 仅经历四个子代迭代，每个子代的迭代周期约为 18~24 个月；而 DDR5 预计有六个子代，当前子代迭代周期已逐步缩短至 12-18 个月，技术迭代节奏较 DDR4 世代明显提速。

我们在内存互连芯片市场的竞争格局及重点发展方向：

一方面，我们持续推进 DDR5 内存接口芯片的升级迭代。当前，DDR5 内存以其更高容量和更快数据传输速率的优势，已取代 DDR4 内存成为市场主流，并持续推进子代迭代。我们的 DDR5 内存接口及模组配套芯片占据全球市场重要份额。报告期内，我们不仅成功推出 DDR5 第五子代 RCD 芯片，还实现了第三子代产品的规模出货以及第四子代产品量产。随着 DDR5 的持续渗透与子代迭代，我们在传统内存接口芯片领域的行业领先地位将进一步稳固。

另一方面，我们正引领内存互连技术的创新并推动新产品落地。随着行业对更高带宽和更快的传输速率内存需求的不断增长，内存互连领域的新技术和新产品应运而生，其中包括用于服务器高带宽内存模组的 MRCD/MDB 芯片，以及用于客户端内存模组的 CKD 芯片。报告期内，这两款新产品已于 2025 年开始在下游规模应用，同时，我们持续推进产品的升级，成功推出了第二子代 MRCD/MDB 芯片，并发布了新一代支持更高速率的 CKD 芯片。凭借领先的技术水平和优异的产品性能，我们将充分受益于内存互连行业新技术的快速发展和新产品的广泛应用。

我们是 DDR5 RCD、MDB、CKD 三款芯片国际标准的牵头制定者，也是全球内存互连芯片的三家主要供应商之一。因此，在内存互连领域，我们不仅引领了行业创新的方向，还将持续强化在该领域的领先地位。目前，JEDEC 组织已经开始对下一代 DDR6 DRAM 及其配套的内存互连技术进行早期技术讨论和标准制定，我们正在深度参与。

2. PCIe 互连领域

PCIe 作为现代计算机的核心总线标准，凭借其灵活的拓扑结构、低延迟的架构设计以及出色的兼容性，已成为主机与高速外设之间高速数据传输的基石。PCIe 互连芯片市场未来发展的主要驱动因素包括以下几个方面：

(1) AI 服务器出货量激增，拉动芯片需求放量：随着 GPU/AI 芯片数量持续攀升、模型规模迅速扩大，对系统带宽及高速互连需求大幅增长，PCIe 互连芯片已成为高速设备间互连的关键器件。PCIe Switch 提供扩展或聚合能力，并允许更多的设备连接到一个 PCIe 端口，而 PCIe Retimer 则用于保障系统的信号完整性与稳定性，提升高速信号的有效传输距离。以配置 8 块 GPU 的典型 AI 服务器为例，通常需配备 2 至 4 个 PCIe Switch 实现拓扑扩展，同时需要 8 至 16 个 Retimer，以延长 CPU 与外设间的有效传输距离。因此，PCIe 互连芯片的需求量与该等 AI 服务器出货量呈正相关。

(2) PCIe 协议持续迭代升级，拓展应用场景边界：目前 PCIe 5.0 正在逐步成为市场主流，未来还将进一步向 PCIe 6.0 及 PCIe 7.0 演进，PCIe 协议每次迭代将带来数据传输速率翻倍，由此驱动两大增长逻辑：一方面，更高速率带来更复杂的信号完整性问题，PCIe Retimer 的应用场景从当前的 CPU 及 GPU/AI 加速卡/SSD/网卡互连，将延伸至有源线缆（AEC）、边缘计算设备、智能汽车等连接密集型场景；另一方面，协议迭代推动服务器集群组网需求，PCIe Switch 需承担多设备带宽优化与拓扑架构升级任务，在 AI 推理服务、数据中心高密度部署等场景中重要性持续提升。

我们在 PCIe 互连芯片市场的竞争格局及重点发展方向：

(1) PCIe Retimer 芯片：我们是全球三家能够提供 PCIe 4.0 Retimer 芯片的主要厂商之一，并且在 PCIe 5.0 时代成为全球第二家量产 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 的厂商，同时在该产品中成功应用了自研的 SerDes IP。随着 AI 服务器需求的快速增长以及 PCIe 5.0 生态的逐步完善，全球 PCIe Retimer 芯片市场迎来了爆发式增长。我们凭借其产品在时延和信道灵活性方面的优异表现，抓住市场机遇，于近两年实现 PCIe Retimer 出货量的快速增长，市场份额显著提升，成为全球主要供货 PCIe Retimer 芯片的两家厂商之一。

2025 年 1 月，我们推出了 PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer 芯片，其最高数据传输速率提升至 64GT/s，支持低传输时延及高达 43dB 的链路预算。相较于 PCIe 5.0，PCIe 6.0 编码方式由 NRZ 改变为 PAM4，这使得 SerDes IP 的设计难度显著增加。我们通过持续的技术创新，成功攻克了 PCIe 6.0 SerDes 技术，并将其应用到新一代产品中，进一步展现了我们在 PCIe 互连技术领域的研发实力。2026 年，我们推出了 PCIe 6.x/CXL 3.x AEC 解决方案，旨在应对数据中心架构从机架内到更复杂的机架间架构的演变，为超大规模数据中心和高性能服务器平台提供高带宽、低延迟的互连。目前，我们正在研发 PCIe 7.0 Retimer 芯片，将为 PCIe 互连性能带来进一步提升，最高数据传输速

率将提升至 128GT/s。展望未来，我们将持续关注 PCIe 互连技术的迭代演进，通过不断的技术创新和产品优化，为客户提供更优质、更全面的 PCIe 互连芯片解决方案，进一步提升在该领域的核心竞争力和市场占有率，为公司在全球市场竞争中奠定坚实基础。

(2) PCIe Switch 芯片：除 PCIe Retimer 芯片之外，AI 服务器还需要 PCIe Switch 芯片以实现无阻塞、高吞吐率和低延时交换，满足 CPU 与 GPU 之间以及 GPU 与网卡和 NVME SSD 等外设间的高性能互连需求。基于在 PCIe Retimer 芯片积累的技术基础及客户资源，我们正在稳步推进 PCIe Switch 芯片的研发，并计划于 2026 年完成工程样片的流片。

3. CXL 互连领域

在人工智能和云计算快速发展的背景下，市场对计算性能和存储容量的需求持续攀升，CXL 互连技术凭借其在缓存一致性、低延迟和扩展性方面的优势，正成为支撑大规模算力应用的关键。基于 CXL 的新型内存解决方案，能够提供高速接口与弹性扩展能力，已展现出显著的市场潜力。CXL 互连芯片市场未来成长主要受两大因素驱动：

(1) AI 领域深度融合，拉动芯片需求：在 AI 训练和推理中，CXL 技术支持 GPU 和 FPGA 等加速器与 CPU 高效协作，实现低延迟、高带宽数据传输，大幅提升计算效率；同时 CXL 技术支持内存扩展和共享机制，为 AI 应用提供更大的内存容量和更灵活的资源调配，有效缓解内存带宽瓶颈。作为 AI 存储与异构计算的关键演进方向，CXL 吸引了全球芯片企业加大投入。而 CXL 互连芯片作为该技术落地的重要载体，在 AI 领域的需求将持续攀升。

(2) 系统架构演进及连接复杂度提升，拓宽应用场景：AIGC 推动数据中心向万卡级集群演进，芯片、服务器与数据中心间的互连复杂度呈指数级上升，传统互连方案难以满足 TB 级带宽与百纳秒级延迟的要求，CXL 通过内存池化与高速互连实现架构升级：CXL MXC 在内存扩展及内存池化方面能显著提升容量和带宽，适应云计算和 AI 等数据密集型应用；CXL Switch 逐步应用于服务器平台，支持多节点设备的内存和资源共享，优化集群拓扑与资源利用率。在 AI 推理场景中，HBM 因容量限制难以有效支撑持续增大的模型和 KV 缓存，而 CXL 的内存扩展和池化能力可以有效弥补这一缺口，提升 GPU 利用率和整体推理性能。目前，国际主流云服务商已在新型服务器集群中部署 CXL 内存资源池，单个内存池通常配置 16-32 颗 CXL MXC 和 2-4 颗 CXL Switch 芯片。随着此类架构的普及，CXL 互连芯片市场将有望迎来爆发式增长。

综上，CXL 技术通过内存池化实现高效的内存扩展与共享，不仅显著提升 GPU 集群的算力效率，也有助于降低总体拥有成本，成为下一代数据中心和 AI 基础设施的关键支撑。

我们是 CXL 互连技术的先行者。2022 年，我们全球首发 CXL MXC 芯片，携手多家内存厂商共同推动 CXL 内存商业化进程。2023 年，我们成为全球首家进入 CXL 合规供应商清单的 MXC 芯片厂商。2025 年 1 月，我们再次凭借技术实力进入首批 CXL 2.0 合规供应商清单，同期上榜的三星电子和 SK 海力士，其受测产品均搭载了我们的 MXC 芯片；同年 9 月，我们推出 CXL 3.0

MXC 芯片，并已开始向主要客户送样测试。我们凭借深厚的技术积累和持续创新，在产品研发上保持相对领先地位，并通过与产业链伙伴的紧密合作，助力 CXL 生态系统的完善。2025 年 11 月，CXL 联盟发布最新的 CXL4.0 规范，在 CXL3.x 的基础上实现传输速度翻倍，达到与 PCIe 7.0 对应的 128GT/s。

当前，基于 CXL 的内存扩展应用正日趋成熟，CXL 内存池化及共享的相关生态和应用预计将在未来一至两年进一步完善。我们将继续投入 CXL 互连技术的创新研发，利用先发优势在 MXC 芯片市场竞争中抢占先机，为 AI 和数据中心提供更高效、可靠的 CXL 内存解决方案。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

我们的战略目标是逐步成长为国际领先的全互连芯片设计公司，重点聚焦于运力芯片领域，通过持续的研发创新，为用户提供丰富多样、具有组合竞争力的高速互连芯片解决方案，助力云计算和人工智能基础设施领域实现更高效与更稳定的数据互连。我们的发展战略包括以下四个方面：

1. 聚焦研发创新，丰富产品矩阵并拓展业务布局

我们将继续通过持续研发创新，专注于开发行业领先的互连解决方案。我们寻求进一步丰富产品矩阵并拓展业务布局，使我们能够提供丰富多样、具有组合竞争力的创新互连类芯片解决方案。该等解决方案将为云计算及 AI 基础设施提供更高效及稳定的数据传输，为在 AI 时代下持续拓展我们的业务奠定坚实的基础。为实现上述战略目标，我们将主要从以下三个维度拓展业务布局：

(1) 内存互连领域：我们将持续投入于 DDR 内存接口产品的迭代升级，优化产品性能和质量，引领 MRCD/MDB、CKD 芯片等行业新产品的技术创新，满足市场对数据传送更快、可靠度更高、能效更高的内存互连芯片解决方案的需求，进一步巩固我们在内存互连领域的技术和市场领先地位。

(2) PCIe/CXL 互连领域：我们将加强 SerDes 等核心底层技术的研发投入，积极推动 PCIe/CXL Retimer、CXL MXC 产品的迭代升级和市场拓展，并将持续深化与云服务提供商（CSP）、服务器 OEM/ODM 厂商、CPU/GPU 厂商、DRAM 内存厂商的战略合作关系。依托自主研发 SerDes 技术的核心优势，我们积极布局 PCIe Switch 等新产品，为客户提供更全面的 PCIe/CXL 互连芯片解决方案，稳步拓宽公司在该领域的市场空间，进一步提升我们的综合竞争力和市场影响力。

(3) 以太网及光互连领域：以太网及光互连是高速互连领域的重要环节，具有广阔的成长空间。我们将充分借助在内存互连及 PCIe/CXL 互连领域长期积累的技术和资源储备，积极探索适

合我们战略布局的新市场，灵活运用自研、合作及/或投资等多种方式，循序渐进、稳步推进我们在以太网及光互连领域的产品布局，为我们的可持续发展注入新的动力。

2. 坚持以人才为核心，驱动战略发展与管理效能提升

我们致力于吸引高水平的研发与管理人才，打造具备国际视野与强大系统工程能力的卓越团队。这一人才战略不仅是我们持续保持技术领先、增强全球竞争力的关键支撑，更是驱动我们长期可持续发展的根本动力。随着我们业务的持续拓展，我们愈发重视人才战略价值。一方面，我们将聚焦高精尖人才引进，重点强化研发团队，通过拓展专家推荐网络及校园招聘，多渠道精准触达顶尖人才。另一方面，我们将持续推进人才激励计划，激发员工的潜力，构建高效、活力充沛的工作环境，培养具有科技创造力和团队精神的研发人才，为我们的长远发展打造坚实的人才护城河。

3. 保持技术和市场领先地位，推动互连芯片产业合作发展

我们将继续推动高速互连芯片行业技术标准和生态系统的建设与完善。我们的高速互连芯片属于国际标准化组织定义的行业标准品，及/或符合产业联盟的标准规范及标准体系。我们将持续积极参加各类国际标准化组织与产业联盟，并与全球产业伙伴携手合作，深度参与相关产品行业标准的制定，积极探索高速互连技术的发展与创新方向，推动行业技术创新和行业生态完善。基于这些新技术标准和技术方向，我们将持续研发一系列在数据传输速度、可靠性和能效方面表现更优的创新互连芯片，这些产品将在 AI 时代发挥重要作用，为系统提供更高效可靠的数据传输，助力保持我们的技术和市场领先地位。

同时，我们还将携手产业合作伙伴，加速前沿技术与新产品的应用。我们将持续深化与 CPU/GPU 厂商、DRAM 内存厂商、云服务提供商（CSP）、服务器 OEM/ODM 厂商等行业伙伴的战略合作，以加速我们新产品的客户验证与导入，拓宽业务领域和客户覆盖广度，进一步巩固我们的市场领先地位。通过产品全生命周期的质量管理体系，以及完善的客户服务管理流程，我们将为客户持续提供优质产品和服务。此外，我们将继续加强与供应商的合作，提升我们供应链的稳定性和可靠性。

4. 探寻投资合作和并购机会，战略性提升外延发展能力

我们计划通过研发推动内生高质量增长，同时利用我们的资源积极探索符合战略目标的投资、合作及并购机会。我们将重点围绕互连相关领域各细分赛道中具有深厚技术实力和独特竞争优势的优质目标，通过战略性投资和收购，进一步提升我们的技术实力及拓展产品组合，扩大我们可触达的市场，从而加速我们的增长。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2026 年，公司的经营计划和重点工作主要围绕以下几方面展开：

1. 巩固内存互连领先优势，把握新产品渗透机遇

我们将紧密跟踪内存互连芯片市场需求与技术趋势，持续优化产品性能和质量，以巩固我们的市场领先地位。在 AI 产业浪潮的推动下，全球内存互连芯片市场前景广阔。我们将持续推进 DDR5 RCD 芯片子代迭代，提升第三、第四子代产品出货规模；重点把握 MRCD/MDB、CKD 芯片等新产品的市场渗透机遇，以卓越的产品表现快速响应客户需求，进一步强化竞争优势。

2. 拓展 PCIe/CXL 业务布局，驱动收入持续增长

我们将深化与云计算服务商、服务器 OEM/ODM 厂商以及 GPU/CPU 厂商的战略合作，加快新一代 PCIe Retimer、CXL MXC 芯片在更多客户供应链的导入，为后续规模放量奠定基础；同时，我们将进一步加强市场拓展，推动相关产品收入持续增长。我们始终坚持技术驱动，通过为客户提供全面、领先的 PCIe/CXL 互连解决方案，不断提升公司的综合竞争力和行业影响力。

3. 深耕高速互连核心技术，不断丰富产品矩阵

(1) 内存互连领域：作为 DDR5 RCD、MDB 及 CKD 芯片国际标准的牵头制定者，我们将继续引领并投入内存接口技术的迭代与创新，巩固技术领先优势，具体计划包括：完成 DDR5 第六子代 RCD、第三子代 MRCD/MDB 芯片的工程研发；积极参与 JEDEC 组织对 DDR6 内存接口芯片标准的制定，并启动 DDR6 第一子代内存互连产品的工程研发。

(2) PCIe/CXL 互连领域：我们将加强高速 SerDes 等核心底层技术的研发投入，积极推动 PCIe/CXL 互连芯片的迭代和新产品研发，具体计划包括：完成 PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer、CXL 3.x MXC 芯片量产版本的研发；完成 PCIe 7.0 Retimer、PCIe Switch 芯片工程样片的流片。

(3) 以太网互连领域：依托自研的高速 SerDes 技术与长期积累的客户资源，我们将积极推进高速以太网 PHY Retimer 芯片的研发，并计划完成工程样片的流片。

(4) 时钟芯片领域：计划完成首批及第二批时钟缓冲芯片量产版本的研发。

4. 强化人才体系建设，筑牢创新发展根基

2026 年 2 月，我们成功于香港联合交易所主板挂牌上市，成为 A+H 双平台上市企业，全球化布局与品牌影响力迈上新台阶。未来，我们将依托境内外双资本市场优势，进一步汇聚海内外优秀复合型人才，持续夯实核心人才竞争力。

面对技术快速迭代、业务需求日益复杂的发展环境，我们坚持以人才为核心，建立从新人到专家的全周期成长路径，通过体系化课程、重点项目与关键技术攻关，全面提升工程师技术能力

与项目管理素养。同时，我们将运用 AI 工具搭建智能知识库与个性化学习平台，提升人才培养效率与学习体验；通过项目复盘、专题研讨、技术分享与激励机制激发团队创新，打造持续进化的学习型组织。我们将以人才培养、技术赋能与团队建设协同发力，形成人才成长、技术革新、企业发展的良性循环，为公司战略落地与高质量可持续发展提供坚实的人才保障与创新动力。

5. 深化 ESG 管理，赋能可持续发展

以 H 股上市为契机，我们将进一步完善 ESG 管治架构，以满足 A+H 两地监管合规要求。同时，对标全球报告标准及优秀管理实践范例，逐步提升 ESG 数据管理规范化水平，持续推进对财务重要性影响议题的量化分析工作，将 ESG 相关工作进一步融入至公司日常运营中，以可持续发展驱动长期价值增长。

(四) 其他

适用 不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由股东会、董事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司股东会、董事会及高级管理人员均根据《公司法》《公司章程》行使职权和履行义务。

（一）股东会的运行情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东会议事规则》，切实保证股东会依法规范地行使职权。

2025 年，公司共计召开了 3 次股东（大）会，股东（大）会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生损害中小股东权益的情况。股东会机构和制度的建立及执行，对公司完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

（二）董事会的运行情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策的水平。

2025 年，公司共计召开了 9 次董事会会议，报告期内历次董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与 ESG 委员会 4 个专门委员会，各专门委员会对董事会负责。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员是会计专业人士。2025 年公司共计召开 6 次审计委员会会议，7 次薪酬与考核委员会会议，1 次提名委员会会议，2 次战略与 ESG 委员会。各专门委员会均严格按照相应议事规则开展工作，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

（三）信息披露及透明度

公司严格按照有关法律、法规，《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司《信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，让所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。报告期内，公司披露了 78 份临时公告、4 份定期报告。

2025 年 10 月,上海证券交易所公布了沪市上市公司 2024-2025 年度信息披露工作评价结果,公司连续三年荣获最高等级 A 级。

(四) 内幕信息知情人管理

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,并按照相关要求,努力将内幕信息的知情者控制在最小范围内,对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记,并将按照监管要求将相关内幕信息知情人名单报送备案。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

三、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

四、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

五、董事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及薪酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前薪酬总额(万元)	是否在公司关联方获取薪酬
杨崇和	董事长、执行董事兼首席执行官、核心技术人员	男	68	2018-10-28	2027-6-20	2,180,000	2,180,000	0	不适用	1,311.40	否
Stephen Kuong-lo Tai	执行董事、总经理	男	55	2018-10-28	2027-6-20	2,180,000	2,180,000	0	不适用	1,312.17	否
Wang Rui	非执行董事	女	65	2024-01-26	2027-6-20	0	0	0	不适用	0	否
方周婕	非执行董事	女	30	2024-6-21	2027-6-20	1,066	1,066	0	不适用	40.06	否
李若山	独立非执行董事	男	77	2024-6-21	2027-6-20	0	0	0	不适用	36.00	否
高秉强	独立非执行董事	男	75	2026-2-9	2027-6-20	0	0	0	不适用	0	否
YUHUA CHENG	独立非执行董事	男	67	2024-6-21	2027-6-20	0	0	0	不适用	36.00	否
单海玲	独立非执行董事	女	66	2024-6-21	2027-6-20	0	0	0	不适用	36.00	否
苏琳	副总经理、财务负责人	女	53	2018-10-28	2027-6-20	1,068,707	1,068,707	0	不适用	429.42	否
傅晓	董事会秘书	女	40	2021-09-28	2027-6-20	72,240	72,240	0	不适用	234.70	否

山岗 ^{注1}	核心技术人员	男	50	2015-12-01		110,000	110,000	0	不适用	-	否
常仲元	核心技术人员	男	66	2013-07-01		100,000	100,000	0	不适用	-	否
史刚	核心技术人员	男	56	2017-08-01		280,548	280,548	0	不适用	-	否
合计	/	/	/	/	/	5,992,561	5,992,561	0	/	3,435.74	/

Stephen Kuong-Io Tai 先生与方周婕女士为公司职工代表大会选举的第三届董事会职工董事。

姓名	主要工作经历
杨崇和	曾就职于美国国家半导体、上海贝岭等公司；1997 年与同仁共同创建了新涛科技；2004 年同 Stephen Kuong-Io Tai 共同创立澜起科技，自创立至今任公司董事长、执行董事兼首席执行官。
Stephen Kuong-Io Tai	曾任 Sigmax Technology 公司资深设计工程师、Marvell 科技集团工程研发总监。自 2004 年澜起科技创立至今任公司执行董事兼总经理。
Wang Rui	曾在美国铿腾电子科技有限公司（Cadence）和 AMD 半导体公司工作；1994 年加入英特尔公司，历任英特尔平台工程事业部副总裁兼混合信号 IP 解决方案事业部总经理、英特尔技术支持事业部（TEG）总经理、英特尔公司副总裁、市场营销集团中国区总经理、英特尔公司高级副总裁、英特尔中国区董事长等职务。2024 年 1 月起任澜起科技非执行董事。
方周婕	2018 年 7 月加入澜起科技，曾任澜起科技职工监事，现任董事会办公室综合事务主管。2024 年 6 月起任澜起科技非执行董事。
李若山	曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院副院长、金融系主任、会计系教授及博士生导师，并于退休后继续担任返聘教授。李教授现任中国上市公司协会第三届独立董事专业委员会主任委员、春秋航空（601021.SH）独立董事、从麟科技（688370.SH）独立董事。2024 年 6 月起任公司独立非执行董事。
高秉强	曾先后担任美国贝尔实验室研究员，加州大学伯克利分校副主任、教授、微电子制造所主任，香港科技大学电子及计算机工程系客座教授、工程学院院长，2005 年至今任香港科技大学荣休教授。高教授现任恒基兆业发展有限公司、恒基兆业地产有限公司、伟易达集团有限公司的独立非执行董事及卧安机器人（深圳）股份有限公司的非执行董事；同时，还担任思特威（上海）科技股份有限公司、固高科技股份有限公司的董事。2026 年 2 月起任澜起科技独立非执行董事。
YUHUA CHENG	曾在美国铿腾电子科技有限公司（Cadence）、罗克韦尔自动化（Rockwell）、科胜讯公司（Conexant）及思佳讯解决方案公司（Skyworks）工作，并创立电路设计技术服务公司 Siliconlinx。现任北京大学上海微电子研究院院长。2024 年 6 月起任澜起科技独立非执行董事。
单海玲	曾任国际法协会会员（International Law Association, ILA）、国际保护知识产权协会会员（International Association for the Protection of Intellectual Property, AIPPI）、中国国际法学会理事、中国国际私法学会常务理事、《武大国际法评论》学术顾问委员会委员、华东政法大学副教授及上海财经大学法学院教授、博士生导师。2024 年 6 月起任澜起科技独立非执行董事。
苏琳	曾任普华永道会计师事务所审计经理，道康宁有机硅贸易（上海）有限公司财务总监，道康宁（张家港）有限公司财务总监。2007 年 9

	月加入澜起科技，历任财务总监、行政与财务副总裁，副总经理兼财务负责人。2018 年 10 月起任澜起科技副总经理兼财务负责人。
傅晓	曾任上海金桥信息股份有限公司证券事务代表兼法务，新焦点集团董事会办公室助理兼法务。2016 年 4 月加入澜起科技，历任公司证券事务经理、证券事务高级经理、证券事务代表。2021 年 9 月起任澜起科技董事会秘书。
山岗 ^{注1}	曾任中兴通讯上海研究所、新涛科技工程师，IDT-新涛科技设计经理。2005 年 8 月加入澜起科技，历任设计总监、应用总监、市场副总裁。2015 年 12 月起任澜起科技市场应用技术部负责人。
常仲元	曾任 Alcatel Bell Belgium 高级 IC 设计工程师；新涛科技，IDT 副总裁，上海贝岭首席技术官。2013 年 7 月起任澜起科技研发部负责人。
史刚	曾任上海先进半导体公司质量工程师及质量部经理，新涛科技营运副总经理，IDT-新涛科技营运副总经理，上海新进半导体制造有限公司营运副总裁、第一产品事业群总经理，Diodes Inc 分立器件事业群保护类产品事业部总经理兼分立器件事业群中国市场总监。2017 年 8 月起任澜起科技运营部负责人。

其它情况说明

√适用 □不适用

注 1：公司核心技术人员山岗先生于 2026 年 3 月因病逝世。

(二) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨崇和	澜至电子科技(成都)有限公司	董事	2019年11月	至今
Wang Rui	Intel Corporation	高级副总裁、英特尔中国区董事长	1994年4月	2025年9月
李若山	中国二十冶集团有限公司	董事	2020年7月	至今
李若山	湖南远泰生物技术有限公司	董事	2019年12月	至今
李若山	沪创医疗科技(上海)有限公司	董事	2021年9月	至今
李若山	上海祥腾投资有限公司	董事	2020年12月	至今
李若山	复旦大学	管理学院会计系教授	1997年9月	至今
李若山	春秋航空股份有限公司	独立董事	2023年6月	至今
李若山	上海从麟环保科技股份有限公司	独立董事	2020年11月	至今
李若山	陕西鼓风机(集团)有限公司	董事	2023年6月	至今
高秉强	上海固高欧辰智能科技有限公司	董事	2016年10月	至今
高秉强	固高发展有限公司(Googol Development Limited)	董事		至今
高秉强	固高科技股份有限公司	董事	2021年6月	至今
高秉强	固高科技(香港)有限公司	董事	1999年7月	至今
高秉强	Clear Water Bay Startup Fund GP	董事		至今
高秉强	清水湾香港盈瓴有限公司(CWB SPV HK Limited)	董事		至今
高秉强	东莞松山湖机器人产业发展有限公司	副董事长	2017年3月	至今
高秉强	东莞松山湖国际机器人研究院有限公司	董事	2016年2月	至今
高秉强	亚洲创投服务有限公司	董事		至今

	司 (AEfolio Limited)			
高秉强	InvestChina Global Limited	董事		至今
高秉强	Brizan Ventures LP	普通合伙人		至今
高秉强	Goldtank Limited	董事		至今
高秉强	Goldtank Investment Limited	董事		至今
高秉强	iFlight Technology Company Limited (智翔科技有限公司)	董事		至今
高秉强	芯联集成电路(上海)有限公司	董事长	2003 年 12 月	至今
高秉强	灵铄电子科技(上海)有限公司	董事长	2007 年 2 月	至今
高秉强	启攀微电子(上海)有限公司	董事	2021 年 12 月	至今
高秉强	东莞远铸智能科技有限公司	副董事长	2016 年 11 月	至今
高秉强	睿魔创新科技(深圳)有限公司	副董事长	2017 年 5 月	至今
高秉强	芯联电科技(苏州)有限公司	董事兼总经理	2006 年 9 月	至今
高秉强	博通集成电路(上海)股份有限公司	董事	2017 年 2 月	至今
高秉强	奇航(深圳)信息科技有限公司	董事	2018 年 9 月	至今
高秉强	深圳博升光电科技有限公司	董事	2019 年 4 月	至今
高秉强	深圳市声扬科技有限公司	董事	2019 年 1 月	至今
高秉强	鼎晟开元(深圳)智能科技有限公司	董事	2019 年 3 月	至今
高秉强	辉芒微电子(深圳)股份有限公司	董事	2018 年 5 月	至今
高秉强	思特威(上海)电子科技股份有限公司	董事	2020 年 12 月	至今
高秉强	埃游科技(深圳)有限公司	董事	2020 年 9 月	至今
高秉强	深圳市螺旋星系科技有限公司	董事	2020 年 11 月	至今
高秉强	深圳思派力科技有限公司	执行董事	2021 年 1 月	至今
高秉强	东莞思派力科技有限公司	执行董事	2021 年 1 月	至今
高秉强	深圳市不停科技有限公司	董事	2023 年 7 月	至今
高秉强	深圳跃然创新科技有限公司	董事	2023 年 11 月	至今
高秉强	安迪威数码有限公司 (Actywell Digital	董事		至今

	Limited)			
高秉强	亚洲数码联盟有限公司 (Asia Cyber Republic Limited)	董事		至今
高秉强	智活研发有限公司 (Mindvidid Limited)	董事		至今
高秉强	华硅有限公司 (Sinomodel Limited)	董事		至今
高秉强	胡桃科技有限公司	董事		至今
高秉强	磊明(香港)有限公司	董事		至今
高秉强	卫保数码有限公司	董事		至今
高秉强	Sensethink Technology Limited	董事		至今
高秉强	Sensethink Holdings limited	董事		至今
高秉强	Brizan Investment Limited	董事		至今
高秉强	GoPeak Capital Limited	董事		至今
高秉强	GeneSense Technology Limited	董事		至今
高秉强	骏创科技有限公司 (CYC Motor Limited)	董事		至今
高秉强	旋智电子科技(上海)有限公司	董事	2021年8月	至今
高秉强	Brizan II	董事		至今
高秉强	Miscato Limited	董事		至今
高秉强	New Paradise Ltd.	董事		至今
高秉强	深圳市一晤未来科技有限公司	董事	2021年11月	至今
高秉强	Brizan Investment Adviser Limited	董事	2021年11月	至今
高秉强	启皓科技(开曼)有限公司 CHIPHOMER TECHNOLOGY (CAYMAN) LIM	董事		至今
高秉强	奇力士技术有限公司	董事		至今
高秉强	Brizan Investment Adviser II Limited	董事		至今
高秉强	广东逸动科技有限公司	董事	2021年2月	至今
高秉强	进迭时空(杭州)科技有限公司	董事	2024年11月	至今
高秉强	深圳市玖治科技有限公司	董事	2024年6月	至今
高秉强	深圳思派天缘餐饮管理有限公司	执行董事	2023年11月	至今
高秉强	音科思(深圳)技术	董事	2021年8月	至今

	有限公司			
高秉强	上海概伦电子股份有限公司	独立董事	2023 年 10 月	2025 年 2 月
高秉强	宁波安建半导体有限公司	董事	2022 年 1 月	至今
高秉强	丘钛科技（集团）有限公司	独立非执行董事	2017 年 5 月	2025 年 9 月
高秉强	Henderson Investment Limited	独立非执行董事	2004 年 9 月	至今
高秉强	Henderson Land Development Company Limited	独立非执行董事	2004 年 9 月	至今
高秉强	VTech Holdings Limited	独立非执行董事	2018 年 1 月	至今
高秉强	卧安机器人（深圳）股份有限公司	非执行董事	2018 年 10 月	至今
YUHUA CHENG	北京大学上海微电子学院	院长	2007 年 7 月	至今
YUHUA CHENG	上海盛英科技发展有限公司	执行董事	2011 年 12 月	至今
YUHUA CHENG	上海卓弘微系统科技有限公司	董事长	2013 年 7 月	至今
YUHUA CHENG	上海芯感微电子科技有限公司	执行董事	2016 年 6 月	至今
YUHUA CHENG	上海佑壳尔科技有限公司	执行董事	2015 年 8 月	至今
YUHUA CHENG	上海矽润科技有限公司	董事长	2012 年 8 月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员薪酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、高级管理人员薪酬的决策程序	公司董事的薪酬根据《公司章程》等相关规定由公司股东（大）会批准，公司高级管理人员的薪酬根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《公司董事会聘用人员薪酬管理办法》等相关规定由董事会及董事会薪酬与考核委员会确定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况	薪酬与考核委员会对报告期内相关人员的报酬事项发表了同意意见。
董事、高级管理人员薪酬确定依据	公司董事薪酬方案由公司股东（大）会批准，具体如下：1. 独立董事津贴由股东（大）会批准；2. 在公司日常任职的非独立董事按其各自所任职务的薪酬制度领取报酬，兼任高级管理人员的，其高级管理人员薪酬方案由董事会确定，并由薪酬与考核委员会进行绩效评估，不再另外领取董事职务报酬；3. 未在公司日常任职的非独立董事不领取报酬。

董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况	详见“现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及薪酬情况”。截至本报告日，高级管理人员的绩效薪酬尚未支付，将于年度报告披露之后支付。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计	3,435.74
报告期末核心技术人员实际获得的薪酬合计	2,766.88
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况	公司董事实际获得津贴与股东（大）会批准的方案一致；公司高级管理人员实际获得年度基本薪酬与董事会批准的方案一致，实际获得绩效薪酬的考核方案经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议批准，并经第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议评估确认。 2025 年度公司高级管理人员的考核指标包括营业收入、归母净利润、平均市值及合规运作等。薪酬与考核委员会根据高级管理人员的岗位和职责分别设定考核指标及权重。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	无
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	无

(四) 公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
高秉强	独立董事	选举	

注：高秉强教授的任期自 H 股股票上市之日（2026 年 2 月 9 日）起正式生效。

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
杨崇和	否	9	9	2	0	0	否	3
Stephen Kuong-Io Tai	否	9	9	2	0	0	否	3
Wang	否	9	9	9	0	0	否	3

Rui								
方周婕	否	9	9	2	0	0	否	3
李若山	是	9	9	4	0	0	否	3
YUHUA CHENG	是	9	9	3	0	0	否	3
单海玲	是	9	9	5	0	0	否	3

注：因高秉强教授于 2026 年 2 月 9 日起担任公司独立董事，因此 2025 年参会情况对其不适用。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	李若山（主任委员）、YUHUA CHENG、方周婕
提名委员会	单海玲（主任委员）、李若山、杨崇和
薪酬与考核委员会	YUHUA CHENG（主任委员）、单海玲、方周婕
战略与 ESG 委员会	杨崇和（主任委员）、Stephen Kuong-Io Tai、Wang Rui

注：以上为报告期内董事会专门委员会成员构成情况。

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	李若山（主任委员）、YUHUA CHENG、单海玲
提名委员会	单海玲（主任委员）、李若山、杨崇和
薪酬与考核委员会	YUHUA CHENG（主任委员）、高秉强、单海玲、方周婕
战略与 ESG 委员会	杨崇和（主任委员）、Stephen Kuong-Io Tai、Wang Rui、高秉强

注：2026 年 2 月 9 日，公司于香港联交所主板上市，上表为 H 股上市后董事会专门委员会成员构成情况。

(二) 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 3 月 31 日	审议通过： 《公司 2024 年度财务决算报告》《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 《公司 2024 年度审计报告》《公司 2024 年度内部审计工作报告》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《关于 2024 年度会计	与会委员重点关注了金融资产估值、信息系统内部审计流程、关联关系认定等。	无

	师事务所履职情况评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》		
2025 年 4 月 23 日	审议通过： 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》	与会委员重点关注了公司具体产品需求提升与营收增长之间的关系、一季度经营活动现金流量净额减少的原因、公司应收账款及应付账款的周转周期等。	无
2025 年 6 月 13 日	审议通过： 《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》《关于修订公司<内部审计工作制度>的议案》《关于就公司发行 H 股股票并上市修订公司<内部审计工作制度（草案）>的议案》	与会委员重点关注了公司 H 股发行及上市项目的时间安排，并建议公司及审计机构就关键审计事项进行了讨论。	无
2025 年 8 月 29 日	审议通过： 《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 会议听取： 2025 年半年度内审工作汇报	与会委员重点关注了公司金融资产公允价值变动情况，光罩模具摊销期限，知识产权权属情况等。同时，建议公司细化内审工作报告，并对存货盘点方式提出了优化要求。	无
2025 年 10 月 30 日	审议通过： 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 会议听取： 1.2025 年第三季度内部审计工作汇报； 2.审计机构出具的《2024 年度管理层建议书》及续聘 2025 年财务及内控审计机构事宜预沟通。	与会委员对审计机构出具的《2024 年度管理层建议书》进行了讨论，同时关注了内审工作中发现的问题整改、优化审计机构服务，并就续聘事项进行了讨论。	无
2025 年 11 月 9 日	审议通过： 《关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》 会议听取： 《2025 年度审计工作计划》	与会委员会重点关注了公司税务合规管理、现场审计覆盖率、研发费用资本化与费用化的界定、	无

		临港项目进展等情况。	
--	--	------------	--

(三) 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 6 月 13 日	《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》《关于确定公司董事角色的议案》	与会委员对高秉强先生的履历、专业性及独立性进行了探讨，并同意增补其为公司独立董事候选人。	无

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 7 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 3 月 31 日	审议通过： 《关于董事会聘用人员 2024 年度绩效考核结果的议案》《公司 2024 年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》	与会委员一致同意董事会聘用人员 2024 年度绩效考核结果。	无
2025 年 4 月 10 日	审议通过： 《关于董事会聘用人员 2025 年度绩效考核指标及评分标准的议案》	与会委员会结合相关人员岗位职责及 2025 年度工作重点，讨论并通过了相关人员 2025 年考核指标。	无
2025 年 6 月 13 日	审议通过： 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予（行权）价格的议案》	与会委员重点关注了激励计划员工个人层面业绩考核周期及考核结果情况。	无
2025 年 7 月 2 日	审议通过： 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2025 年 10 月 30 日	审议通过： 《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予（行权）价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》	与会委员重点关注了激励对象自愿放弃相关股票归属的具体原因。	无
2025 年 12 月 8 日	审议通过： 《关于公司<第三届董事会核心高管激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2025 年 12 月 26 日	审议通过： 《关于向第三届董事会核心高管激励计划激励对象授予限制性股票的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

(五) 报告期内战略与 ESG 委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 4 月 10 日	审议通过： 《关于公司发展战略的议案》《公司 2024 年环境、社会及公司治理报告》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2025 年 6 月 20 日	审议通过： 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

(六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、审计委员会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	202
主要子公司在职员工的数量	582
在职员工的数量合计	784
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	-
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
研发技术人员	583
市场销售人员	80
管理支持人员	121
合计	784
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	16
硕士研究生	409
本科	334
专科及以下	25
合计	784

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际情况，建立了符合公司发展要求的薪酬体系。

公司薪酬体系包括基本薪酬、绩效薪酬、股权激励、专项奖励、福利性收入等，将企业文化、价值观及工作环境、职业发展机会等与具有竞争力的薪酬福利相结合，激励绩效优秀的员工，以吸引人才、留住人才，实现员工与公司的共同成长和发展。

在国家法定的社会保险、住房公积金、带薪休假等福利之外，公司为员工提供年节福利、补充商业保险、公司福利假期、团队活动补贴、年度旅游、优秀员工人才引进落户、租房补贴申请，各种兴趣俱乐部等多项福利，以激励员工不断提升自我并与公司共同成长。

(三) 培训计划

适用 不适用

2025 年，澜起科技聚焦“高精尖人才引进与系统化培养”核心方向，持续完善和优化公司的人才发展体系。公司充分发挥多矩阵培养渠道的优势，结合企业文化建设、管理能力提升、技术销售能力提升、数字化学习平台建设、岗位专业技术能力提升等多人才项目举措。构建了覆盖新员工、应届生、管理层及核心技术骨干的全方位人才培养体系。

除了持续打磨“四位一体”的培训体系外，今年重点开展研发管理者赋能及数字化学习平台建设和运营。已落实项目有：澜星计划-为期 6 个月的横琴专项人才校招生培养项目；澜新计划-针对新员工的培养项目；青澜计划-数字化学习平台建设和内容运营项目；澜芯计划-针对研发中层管理者的培养项目；以及内部在岗员工的个性化岗位需求等培训项目。采用面授培训，线上教学，导师制，虚拟项目及案例教学，行动学习，项目研讨，座谈交流，实验室演示等多种形式。报告期内公司共计开展各类型培训 13080.5 小时，人均培训 16.68 小时，员工培训覆盖率 100%。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

➤ 现金分红政策

《公司章程》明确了公司利润分配政策，具体内容如下：

1. 公司利润分配政策的基本原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

2. 利润分配的方式及比例

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之八十；

（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之四十；

（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之二十；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第（三）项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

3. 利润分配的条件及期间间隔

在满足下列条件时，可以进行利润分配：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（3）公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

当公司存在以下情形时，可以不进行利润分配：（1）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；（2）当年末资产负债率高于 70%；（3）当年经营性现金流为负。公司利润分配不得损害公司持续经营能力。

公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

4. 现金分红的条件及比例

在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体年度的分配比例由董事会根据公司当年经营情况制定方案。

5. 利润分配的决策程序和机制

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

股东会对现金分红具体预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，如通过投资者关系电子邮箱、电话方式，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

6. 利润分配政策调整的条件、决策程序和机制

公司应当严格执行本章程确定的分红政策以及股东会审议批准的分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者公司外部经营环境发生重大变化，确需调整本章程规定的现金分红政策时，董事会需就调整或者变更利润分配政策的可行性进行充分论证，形成专项决议后，提交公司股东会批准，公司提出调整利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对股东利益的保护，并在提交股东会的议案中详细说明调整的原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

➤ 公司 2024 年度利润分配方案的执行情况

公司于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案具体执行情况如下：以实施权益分派股权登记日的公司总股本 1,144,789,273 股为基数，扣除回购专用账户的股数为 8,532,000 股，实际发放现金红利的股本基数为 1,136,257,273 股，每股派发现金红利人民币 0.39 元（含税），共计派发现金红利 443,140,336.47 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.39%。前述现金分红事项已于 2025 年 5 月派发完毕。

➤ 公司 2025 年中期利润分配方案的执行情况

公司于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会

制定 2025 年度中期分红的议案》，同意授权董事会在符合利润分配的条件下制定 2025 年中期利润分配方案。根据前述授权，公司 2025 年中期利润分配方案经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过。本次利润分配方案具体执行情况如下：以实施权益分派股权登记日的公司总股本 1,145,151,330 股为基数，扣除回购专用账户的股数为 10,871,000 股，实际发放现金红利的股本基数为 1,134,280,330 股，每股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），共计派发现金红利 226,856,066.00 元（含税），占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 10.15%。前述现金分红已于 2025 年 10 月派发完毕。

➤ 公司 2025 年度利润分配预案

公司 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每股派发现金红利人民币 0.39 元（含税）。截至 2026 年 2 月 28 日，公司的总股本 1,222,200,021 股，其中回购专用账户的股数为 12,533,000 股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为 1,209,667,021 股，以此计算合计拟派发现金红利 471,770,138.19 元（含税），占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 21.10%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

此外，2025 年度公司以现金为对价，通过集中竞价方式回购股份金额为 420,723,405.89 元（不含佣金、过户费等交易费用）。

➤ 2025 年度累计分红总额

综上，本年度公司分红（含 2025 年中期现金分红金额、2025 年股份回购金额及 2025 年度拟派发的现金分红总额）合计金额为 1,119,349,610.08 元（含税），占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 50.07%。

➤ 对公司现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序合规，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.90
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	698,626,204.19
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	2,235,569,970.18
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	31.25
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	420,723,405.89
合计分红金额（含税）	1,119,349,610.08
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	50.07

注：“每 10 股派息数（元）（含税）”包含 2025 年中期利润分配方案为每 10 股派息 2 元（含税）及 2025 年年度利润分配预案为每 10 股派息 3.90 元（含税）。

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	2,235,569,970.18
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	534,289,147.28
最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	1,479,959,878.46
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	0
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	1,479,959,878.46
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	1,366,086,235.63
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	108.34
最近三个会计年度累计研发投入金额	2,360,312,645.80
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	20.74

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格(元/股)
2023 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	1,973,000	0.1721%	187	23.85	18.81
2024 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	4,541,000	0.3961%	454	57.91	26.01
第三届董事会核心高管激励计划	第二类限制性股票	22,800,000	1.9888%	2	0.26	45.91

注：1. 2023 年及 2024 年限制性股票激励计划股份数量及激励对象人数为首次授予与预留授予的合计情况。

2. 因分红派息的原因，2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）调整为 18.81 元/股；2024 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）调整为 26.01 元/股；第三届董事会核心高管激励计划授予价格调整为 45.91 元/股。

3. 激励对象人数占比的计算公式分母为报告期末公司总人数 784 人。

4. 标的股票数量占比的分母为公司 2025 年期末总股本。

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位：万股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格(元)	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
2023 年限制性股票激励计划	197.30	0	46.6967	46.6967	18.81	197.30	99.9418
2024 年限制性股票激励计划	363.28	90.82	117.2591	117.0281	26.01	454.10	117.0281
第三届董事会核心高管激励计划	1,140	1,140	0	0	45.91	2,280	0

注 1：上述限制性股票激励计划，报告期内可归属数量与报告期内已归属数量不一致系部分激励对象放弃认购所致；

注 2：因分红派息的原因，对上述激励计划相应归属期授予价格进行了调整。

3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2023 年限制性股票激励计划	首次及预留授予第二个归属期均已达到目标值，归属 100%	1,355.97
2024 年限制性股票激励计划	首次授予第一个归属期已达到	9,680.33

	目标值，归属 100%	
2024 年董事会核心高管激励计划	-	32,043.38
合计	/	43,079.68

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2025 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予（行权）价格的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。	相关事项详见公司于 2025 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2025-025、2025-026）
2025 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》；公司董事会薪酬与考核委员会对 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单发表了核查意见。	相关事项详见公司于 2025 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告（公告编号：2025-040）及相关文件。
2025 年 8 月 6 日，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属完成，相关股份于 2025 年 8 月 12 日上市流通。	相关事项详见公司于 2025 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2025-045）
2025 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予（行权）价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。	相关事项详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2025-058、2025-059）
2025 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<第三届董事会核心高管激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。	相关事项详见公司于 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2025-069、2025-070）
2025 年 12 月 22 日，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期第二次归属、2023 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期、2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属完成，相关股份于 2025 年 12 月 29 日上市流通。	相关事项详见公司于 2025 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2025-074）
2025 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向第三届董事会核心高管激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；公司董事会薪酬与考核委员会对公司第三届董事会核心高管激励计划（修订稿）授予限制性股票的激励对象名单发表了核查意见。	相关事项详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2025-077）

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

√适用 □不适用

《2023 年员工持股计划》：2025 年 11 月 29 日，公司公告 2023 年员工持股计划出售完毕暨终止，同时将对相关资产进行清算和分配等工作。相关事项详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2025-065）

其他激励措施

□适用 √不适用

（三）董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

□适用 √不适用

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价（元）
杨崇和	董事长、执行董事兼首席执行官、核心技术人员	570	570	45.91	0	0	1,140	117.80
Stephen Kuong-IoTai	执行董事、总经理	570	570	45.91	0	0	1,140	117.80
合计	/	1,140	1,140	/	0	0	2,280	/

（四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内，根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《公司董事会聘用人员薪酬管理办法》，第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于董事会聘用人员 2025 年度绩效考核指标及评分标准的议案》，对董事会聘用人员 2025 年度绩效考核指标及评分标准进行了设定。第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议已审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度绩效考核结果的议案》，按照设定的考核指标对高级管理人员进行了 2025 年度绩效评估，相关议案经第三届董事会第十五次会议审议通过。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 不适用

公司已制定了《内部审计工作制度》《内部控制制度》，建立了较为完善内部审计体系。董事会为内部审计体系的牵头部门。董事会下设审计委员会负责监督公司的外部审计工作，并指导公司内部审计工作。公司内审部负责具体审计事宜，促进公司经营管理工作有效开展并帮助董事会和审计委员会履行其责任，包括对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估，对公司组织机构、系统和程序是否恰当进行审查和评估；对资产的安全和完整进行审查和评估；了解和评价公司出现重大风险的可能性，帮助公司改进风险管理等工作。公司内部审计工作有详细的工作流程。

2025 年度，内审部依据公司《内部审计工作制度》《内部控制制度》及 2025 年内审工作计划，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项内部审计任务。

具体情况详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《澜起科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 不适用

公司对控股子公司采用总部统一管理的模式，建立统一的制度和内控流程，提升子公司的管理水平以及与总部的协同效应。

对子公司的管理控制存在异常的风险提示

适用 不适用

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 不适用

内容详见于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《澜起科技股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司不存在上市公司治理专项行动自查问题整改情况。

十六、董事会有关 ESG 情况的声明

董事会作为 ESG 治理的最高决策机构，全面负责 ESG 相关事务的监督、指导与审核工作，并确保 ESG 战略在公司日常运营中得到有效执行。

董事会负责制定并监督 ESG 战略与目标，听取战略与 ESG 委员会关于 ESG 工作的汇报与建议，定期评估 ESG 目标的实施进展及达成情况，并结合公司实际情况进行必要的优化和调整。

董事会下设战略与 ESG 委员会，负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；审议公司可持续发展、ESG 相关战略规划，并指导相关工作的实施；关注对公司业务有重大影响的 ESG 相关风险及机遇，并提出相应建议；审议公司年度 ESG 报告。

十七、ESG 整体工作成果

适用 不适用

(一)本年度具有行业特色的 ESG 实践做法

适用 不适用

我们是一家全球领先的无晶圆厂集成电路设计公司，致力于为云计算及 AI 基础设施提供创新、可靠及高能效的互连解决方案。公司高度重视 ESG 实践活动，积极推动 ESG 要素融入企业发展战略和日常运营管理，以实现可持续、高质量发展。

1. 针对环境相关议题，公司致力于打造绿色低碳企业，将清洁技术机遇视为公司可持续发展的重要议题之一，“低能耗”理念已融入整体发展战略。我们研发的 DDR5 第五子代 RCD 芯片，在同等速率下相较第一子代产品功耗下降约 35%-40%。公司产品符合 ROHS、REACH 等环保要求。同时，公司提倡绿色办公，强化能源管理，积极推广可再生能源的使用。

2. 针对社会相关议题，公司积极履行员工责任、社区责任、产品责任和伙伴责任。公司重视员工权益保障、福利及员工发展，股权激励综合覆盖率超过 90%；员工培训覆盖率为 100%，并为员工打造清晰灵活的成长路径。公司积极参加教育相关的社会公益。公司承诺不使用冲突矿产，致力于构建可持续的供应链。同时，公司还积极参与相关产品行业标准制定、推动产业生态建设，致力于推动行业创新。

3. 针对公司治理议题，公司注重多元化管理架构、高质量的信息披露、有效的风险管控和通畅的投资者交流。公司制定了董事会多元化政策，目前公司女性董事成员占比为 37.5%，女性高级管理人员占比为 50%，彰显女性领导力。公司积极实施现金分红及回购，本年度公司共派发现金股利 6.70 亿元，股份回购金额达 4.21 亿元，彰显公司对股东长期价值的积极回馈。我们连续三年获得上海证券交易所信息披露工作评价最高级别 A 级（优秀），公司治理及信息披露质量保持较高水平。

(二)本年度 ESG 评级表现

适用 不适用

ESG 评级体系	ESG 评级机构	公司本年度的评级结果
MSCI ESG 评级	MSCI	BB
Wind ESG 评级	万得信息技术股份有限公司	A
中证指数 ESG 评级	中证指数有限公司	AA
华证 ESG 评级	上海华证指数信息服务有限公司	A

(三) 本年度被 ESG 主题指数基金跟踪情况

适用 不适用

本年度，跟踪公司的 ESG 主题指数基金包括跟踪中证 180ESG 指数、沪深 300ESG 基准指数、中证 ESG120 策略指数、中证 800ESG 领先指数、华证 ESG 领先指数、MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数的相关基金。

十八、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司主要业务为集成电路芯片设计及销售，不属于国家规定的重污染行业，公司主要采购原材料为晶圆，公司及其子公司均不直接从事生产制造业务，生产经营活动不涉及环境污染情形。

十九、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

2025 年，我们积极把握 AI 产业趋势带来的行业机遇，加大研发创新与市场拓展，凭借核心技术优势实现经营业绩大幅增长，发展质量持续提升。2025 年度，公司实现营业收入 54.56 亿元，较上年度增长 49.9%，毛利率为 62.2%，较上年度提升 4.1 个百分点；实现归属于母公司股东的净利润 22.36 亿元，较上年度增长 58.4%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20.22 亿元，较上年度增长 62.0%。公司的净利润率为 41.0%，较上年度提升 2.2 个百分点；经营活动产生的现金流量净额为 20.22 亿元，连续四年增长，彰显公司强劲的盈利能力与稳健的经营质量。

2025 年度，我们的研发费用为 9.15 亿元，同比增长 19.9%，占营业收入的比例为 16.8%。我们的研发费用自 2019 年 A 股上市以来逐年增加。我们的研发技术团队具备国际化视野和卓越的专业能力，截至 2025 年末，公司研发技术人员为 583 人，占总人数的比例约为 74.4%，其中，具有硕士及以上学历的研发技术人员占比约 64%。

(二) 推动科技创新情况

公司与行业伙伴携手，在标准制定、交流合作等方面共同推进高速互连技术的创新与升级，以持续的技术进步驱动产业生态繁荣发展。

公司是行业标准的制定者，作为 JEDEC 董事会成员并担任若干个委员会主席或副主席职位，公司在制定内存互连国际标准方面发挥着关键作用，是 DDR5 RCD、MDB、CKD 三款芯片国际标准的牵头制定者，技术水平及产品迭代能力行业领先。凭借在内存互连方面的深厚技术水平，我们已成功拓展到 PCIe/CXL 等其他高速互连领域，成为 PCI-SIG、CXL、UALink 等国际行业联盟的成员，并在新领域实现市场突破。

在内存互连技术领域，公司继续全球领跑 DDR5 内存互连的迭代升级，进一步巩固了技术领先优势，并引领行业创新，推出了用于服务器高带宽内存模组的 MRCD/MDB 芯片，以及用于 PC 端内存模组的 CKD 芯片。

在 PCIe 互连技术领域，公司自研的 PCIe SerDes 技术已成功应用于 PCIe Retimer 芯片并实现产业化。2025 年 1 月，公司推出 PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer 芯片，并向客户成功送样。

在 CXL 互连技术领域，公司自 2022 年全球首发 CXL MXC 芯片后，继续保持行业领先地位，2025 年 9 月，我们推出基于 CXL[®] 3.1 标准的 MXC 芯片，并已开始向主要客户送样测试。

公司的核心技术基于自主知识产权，并形成了有规划、有策略的专利布局。截至报告期末，公司已获授权的国内外发明专利达 224 项。

2025 年，公司累计参与行业展会 5 场、参与合作伙伴联合市场活动 17 场，有效推动了相关产业生态的融合发展，促进了前沿技术成果与创新产品的应用与推广。

除此之外，公司与上海交通大学聚焦模拟射频和混合信号集成电路设计技术，在高速数据接口系统等领域已有一系列成果。

(三) 遵守科技伦理情况

公司目前业务不涉及科技伦理相关内容。

(四) 数据安全与隐私保护情况

公司严格遵守《中华人民共和国网络安全法》等各运营地有关隐私保护与信息安全的法律法规要求，制定《网络划分管理》《高安全等级数据访问策略》《文档访问控制策略》等隐私与信息安全管理制制度，明确相关管理要求与控制措施。

公司已建立以最高管理层领导的信息安全委员会，明确了委员会中各层级的管理职责，确保内部以及客户的信息安全得到妥善管理。2025 年，公司顺利通过 ISO27001 信息安全管理体系的跟踪审核与认证。

在报告期内，公司围绕信息系统安全、数据保护、业务连续性及商业秘密保护等重点领域推进信息安全能力建设，完善网络与邮件系统安全防护机制，强化权限管理与安全评估，并健全数

据备份与存储管理措施，进一步提升信息安全管理的过程化水平。公司开展信息安全相关演练 4 次，通过信息安全相关培训、宣贯，提升员工对信息安全与合规风险的识别与防范意识。

2025 年，公司未发生重大信息安全泄露事件。

(五) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
公益项目		
其中：资金（万元）	44.20	主要用于支持教育事业
救助人数（人）		
乡村振兴		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

2025 年，公司持续关注并积极投身公益事业。我们进一步推进云南凤山小学“公益慈善项目”，我们捐赠电脑、打印机及校园广播设备改善凤山小学的硬件设施，同时开设人工智能科普课程，激发学生们探索人工智能的科学梦想。除此之外，公司通过设立“爱心清凉站”为户外工作者提供便利、赞助“家幸福”项目助力和谐家庭关系构建、组织员工无偿献血等形式，向社会传递澜起温度。

2025 年，公司荣获“2024-2025 年度徐汇区妇女儿童事业发展贡献奖”。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

(六) 股东和债权人权益保护情况

公司依据《公司法》《证券法》及《公司章程》，建立了较为完善的现代企业管理制度，形成了股东会、董事会、总经理办公会议的三级决策体系，相关会议的召集、召开、表决程序均符合法律规定。报告期内，公司根据相关法律法规的要求，加强信息披露事务管理，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，保护股东合法权益。同时，基于公司的长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制。本年度公司共派发现金股利 6.70 亿元，股份回购金额达 4.20 亿元，彰显公司对股东长期价值的积极回馈。

(七) 职工权益保护情况

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《禁止童工使用规定》等相关劳动法律法规，以及业务运营所在地的劳动政策法规，制定并持续完善《员工手册》《招聘制度》等人力资源管理规章制度。公司深知员工是推动企业实现可持续发展的不竭动力，人才成长更是业务发展的动力源泉。公司坚持“以人为本”的管理理念，高度重视员工权益保障。同时，公司积极打造清晰灵活的成长路径，以组织体系推动人才成长，帮助员工实现个人价值的最大化，致力于实现员工与企业共同成长。

员工持股情况

员工持股人数（人）	481
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	61.35
员工持股数量（万股）	725.5248
员工持股数量占总股本比例（%）	0.63

注：因公司不掌握截至报告期内所有员工持股情况，故上述持股情况指报告期内公司员工限制性股票累计归属及员工持股计划持股情况。

(八) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司持续优化《供应商管理制度》等内部政策，完善供应商管理体系与管理流程，对供应商从准入到淘汰/退出环节全流程严格把控，并定期开展供应商审核，推动建立公平竞争、廉洁透明、可追溯性强的供应链环境。2025 年度，我们的客户满意度达 90 分以上（满分为 100 分）。

(九) 产品安全保障情况

公司严格遵守国内外各运营地产品质量相关法律法规以及 ISO9001 质量管理体系要求，制定了《质量手册》《新产品开发流程》以及《可靠性认证要求》等内部质量管理体系，系统规定了集成电路设计、开发、外包、制造和销售等环节的质量管控工作要求。公司制定了质量与可靠性管理目标，2025 年度公司达成前述目标。

公司采用 Fabless 的运营模式，专注于芯片的设计及研发环节，而芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成。公司在芯片的全生命周期包括立项、设计、生产、验证、交付等阶段建立了完善的产品质量保障措施，执行全流程质量管控，分析潜在质量风险，提高质量管理水平。

公司已制定完善的产品召回流程，主要包括问题识别与风险评估、召回决策与计划制定、内部沟通与客户通知、供应链溯源与产品回收/隔离、缺陷分析与纠正措施、召回验证与记录。

公司的产品召回流程强调快速响应、精准追溯与妥善处理。为提高各环节相关员工的质量管控意识，培养质量保障能力，构建质量文化，报告期内，公司面向研发、运营、质量等关键部门所有员工开展了共 5 次质量相关培训。2025 年度，公司未发生任何重大质量事故。

(十) 知识产权保护情况

公司高度重视知识产权的保护工作，已建立了职责清晰的知识产权管理架构。公司总经理负责制定知识产权战略方向，知识产权管理部门负责知识产权日常管理和战略执行。此外，公司还成立了由研发部门负责人及各技术领域专家组成的知识产权委员会，主要负责审核专利申请提案，指导专利布局规划，并协助制定和落实年度申请计划。知识产权管理部门中，知识产权总监负责指导并统筹管理知识产权事务，专利经理负责知识产权的申请与维护。

公司建立了全面的知识产权管理体系，制定了《知识产权保护管理办法》《专利申请流程》《论文发表申请流程》《商业秘密管理办法》《知识产权奖励办法》《知识产权培训办法》《专利申请年度计划制定及考核办法》等内部管理制度。公司定期审查并更新这些制度，为知识产权保护提供了明确、切实可行的执行框架。

面对潜在的知识产权侵权风险与泄露风险，澜起科技采取了多项防范措施构建了一个全面、高效的知识产权保护体系。同时，公司开展知识产权相关培训，增强员工的知识产权管理能力。

报告期内，公司未发生与知识产权相关的违法违规事件，没有上述事项引起的诉讼案件发生。

(十一) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

二十、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	公司于 2025 年 5 月 21 日以视频方式召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会；于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年半年度业绩说明会；于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第三季度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	5	公司在 2024 年年度报告、2024 年度 ESG 报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告披露后，通过长图文的形式开展投资者关系管理活动。
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	具体内容详见公司投资者服务专栏： https://www.montage-tech.com/cn/Investor_Service

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

我们高度重视投资者关系，致力于构建透明、畅通的沟通机制，促进公司价值的有效传递。

报告期内，公司信息披露的指定网站为上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公司信息披露的指定报刊为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。

为了使投资者更好地了解公司经营状况，公司通过接待投资者线下调研、接听投资者热线、回复 IR 邮箱及上证 e 互动、举办业绩说明会等渠道回复投资者关心的问题，公司于公开平台定期披露《投资者关系活动记录表》，汇总各个渠道投资者与公司互动的情况。针对定期报告中的专业性术语，公司尽可能使用通俗易懂的方式表达，使投资者更容易理解公司的业务。

2025 年度，公司举办 3 场业绩说明会；累计接待投资者 109 场次，其中接待外资 63 场次；累计披露 15 份投资者关系活动记录表；累计回复 104 个上证 e 互动问题。

凭借在投资者关系方面的优良表现，2025 年公司荣获证券时报“最受机构青睐（科创板）上市公司 TOP5 榜单”、“投资者关系管理杰出董秘奖”和“投资者关系管理天马奖”、以及中国上市公司协会评定的“上市公司投资者关系管理最佳实践（2024）”、“上市公司 2024 年报业绩说明会最佳实践”等荣誉。此外，公司还首度入选上证 50 指数成分股。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《澜起科技股份有限公司章程》等有关规定，制定并完善《信息披露制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度文件，明确信息披露程序，规范及细化信息披露相关要求。

公司秉承“真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂”等原则，通过指定信息披露媒体进行信息披露，确保公司所有利益相关方能够公平地获取公司信息。

2025 年 10 月，上海证券交易所公布了沪市上市公司 2024-2025 年度信息披露工作评价结果，澜起科技连续三年荣获最高等级 A 级。

(四) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

公司在接受机构投资者调研过程中，机构投资者表达了对公司治理的关注，并建议公司采取措施提升公司 ESG 治理能力，公司根据自身实际情况，对其中一些建议予以采纳。

(五) 反商业贿赂及反贪污机制运行情况

适用 不适用

公司严格遵守《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律法规及相关规定，董事会制定了《商业道德行为准则》，该准则定义了贿赂和舞弊、歧视、泄露秘密信息、利益冲突、垄断、不正当竞争行为、洗钱和内幕交易等违反商业道德的行为，引导公司员工与管理人员开展符合澜起科技企业价值观的合法、合规商业活动。准则明确了公司总经理办公室是商业道德行为的管理机构，公司董事会是监督机构，并规定了相应的举报方式、调查程序及处理措施。同时，为保护举报人，该准则设置了举报人保护机制。2025 年，公司未收到商业贿赂相关举报。

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

二十一、其他

适用 不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员	1. 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份（如有），也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。2. 上述规定的锁定期满后，在本人担任公司董事、高级管理人员期间每年转让所持有的公司股份数量不超过直接或间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接所持有的公司股份。3. 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定股份锁定期长于本承诺，则本人所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定执行。	2019 年 7 月 22 日	是	上市之日起 12 个月；担任公司董事及高级管理人员期间；离职后半年	是	不适用	不适用
	股份限售	直接或间接持有公司股份的核心技	1. 自公司股票上市之日起 12 个月内和本人离职后 6 个月内不得转让本公司首发前股份；2. 自本人所持首发前股份限	2019 年 7 月 22 日	是	上市之日起 12 个月；本人离职后 6	是	不适用	不适用

		术人员杨崇和、山岗、常仲元、史刚	售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；3. 本人将遵守法律法规、证监会规章以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。			个月；股份限售期满 4 年内			
	股份限售	间接持有公司股份的董事和高级管理人员的亲亲属杨崇颐、Tai kuai Lap	1. 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份（如有），也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。2. 上述规定的锁定期满后，在本人近亲属担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让所持有的公司股份数量不超过直接或间接所持有公司股份总数的百分之二十五；在本人近亲属离职后半年内，不转让直接或间接所持有的公司股份。3. 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定股份锁定期长于本承诺，则本人所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定执行。	2019 年 7 月 22 日	是	上市之日起 12 个月；本人近亲属担任公司董事、高级管理人员期间；本人近亲属离职后半年内	是	不适用	不适用
	其他	股东中电投控、嘉兴芯电、WLT、上海融迎、上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、	1. 本单位及本单位控制或影响的其他企业组织（包括除澜起科技及其下属子公司外其他所有全资子公司、控股子公司及其他拥有实际控制权或重大决策影响的企业组织，下同）将尽量避免或减少与公司（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行。本单位及	2019 年 7 月 22 日	否	长期	是	不适用	不适用

		临桐建发、上海临齐、嘉兴宏越、嘉兴莫奈、XinyunI、Xinyun、XinyunIII	<p>本单位控制或影响的其他企业将严格避免向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金。2. 对于本单位及本单位控制或影响的其他企业与公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3. 本单位及本单位控制或影响的其他企业与公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，本单位在公司权力机构审议有关关联交易事项时将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予以执行。4. 本单位保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司损失或利用关联交易侵占公司利益的，公司有权单方终止关联交易。</p>						
	其他	公司董事和高级管理人员	<p>1. 本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与公司（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行。本人</p>	2019年7月22日	否	长期	是	不适用	不适用

			<p>及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款、代偿债务等方式占用公司资金。2. 对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3. 本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。</p> <p>4. 本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司损失或利用关联交易侵占公司利益的，公司有权单方终止该等关联交易。</p>						
	其他	间接持有公司股权的董事和高级管理人员的亲	<p>1. 本人及本人所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与澜起科技（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于澜起科技能够通过市场与独立</p>	2019年7月22日	否	长期	是	不适用	不适用

		属杨崇颐、 Tai kuai Lap	<p>第三方之间发生的交易，将由澜起科技与独立第三方进行。本人及本人所控制的其他企业组织将严格避免向澜起科技拆借、占用澜起科技资金或采取由澜起科技代垫款、代偿债务等方式占用澜起科技资金。2. 对于本人及本人所控制的其他企业组织与澜起科技之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3. 本人及本人所控制的其他企业组织与澜起科技之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守澜起科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在澜起科技权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。4. 本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使澜起科技承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致澜起科技损失或利用关联交易侵占澜起科技利益的，澜起科技有权单方终止该等关联交易。</p>						
	其他	公司	<p>关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施：1. 公司承诺：若公司本次公开发行股票招股说</p>	2019 年 7 月 22 日	否	长期	是	不适用	不适用

			<p>说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行上市的全部新股。公司董事会将在证券监管部门或司法机关出具有关违法违规事实的认定结果之日起三十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。公司将自股份回购方案经股东大会批准或经相关监管部门批准或备案之日起（以较晚完成日期为准）六个月内完成回购。公司承诺，将按照市场价格且不低于首次公开发行上市时的价格进行回购。公司首次公开发行上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，且回购价格将相应进行调整。若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者的直接经济损失。</p> <p>2. 回购新股、赔偿损失义务的触发条件：经证券监管部门或司法机关认定，公司本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司负有承诺的回购新股、赔偿损失等义务。</p> <p>3. 公告程序公司应在本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证券监管部门或司法机关认</p>						
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

			定的当日就该等事项进行公告，并在前述公告后每 5 个交易日定期公告相应的回购新股、赔偿损失的方案的制定和进展情况。						
	其他	股东中电投控、嘉兴芯电、WLT、上海融迎、上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐、嘉兴宏越、嘉兴莫奈、Xinyun 、XinyunIII	关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施：1. 公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本单位将依法购回已转让的原限售股份。2. 公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法赔偿投资者损失。	2019 年 7 月 22 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理人员	关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施：公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2019 年 7 月 22 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司	关于欺诈发行的股份购回承诺：1. 保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。2. 如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5	2019 年 7 月 22 日	否	长期	是	不适用	不适用

			个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。						
	其他	股东中电投控、嘉兴芯电、WLT、上海融迎、上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐、嘉兴宏越、嘉兴莫奈、XinyunI、Xinyun、XinyunIII	关于避免同业竞争的承诺：1. 本单位及本单位直接、间接控制的公司、企业目前不存在从事与澜起科技股份有限公司（以下简称“发行人”）构成同业竞争的业务或经营，与发行人不存在同业竞争。2. 本单位将采取有效措施，保证本单位及本单位直接、间接控制的公司、企业将来也不从事与发行人构成同业竞争的业务或经营。3. 本单位将不在发行人以外的公司、企业增加投资，从事与发行人构成同业竞争的业务或经营。4. 本单位不会向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。5. 本单位不会利用发行人的股东地位或身份损害发行人及发行人其他股东、债权人的正当权益。6. 如本单位违背上述承诺，给发行人造成了直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用，本单位愿承担全部赔偿责任。	2019年7月22日	否	长期	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺情况

适用 不适用

业绩承诺变更情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	164.10
境内会计师事务所审计年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	施瑾、方舟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	2年（施瑾）、1年（方舟）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	50

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司第三届董事会第十二次会议、2025年第二次临时股东会审议通过，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，详情请见公司2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任2025年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-068）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

√适用 □不适用

本报告期，因公司发行H股并上市过程中已开展多次审计工作，审计机构在年度A股审计工作的工作效率提高，因此相应降低了A股年度审计服务费用。

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年上半年日常关联交易额度预计的议案》，预计 2025 年上半年和关联人交易金额累计不超过 3 亿元人民币。	相关事项详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告（公告编号：2025-010）。

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3. 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4. 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3. 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3. 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1. 托管情况

适用 不适用

2. 承包情况

适用 不适用

3. 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：美元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物 (如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保		
公司	公司本部	澜起电子科技（上海）有限公司	全资子公司	360	2023年9月15日	2023年9月15日	2026年9月19日	连带责任担保	否	否	0	否		
公司	公司本部	澜起澳门离岸商业服务有限公司、澜起电子科技（上	控股子公司	7,000	2025年5月21日	2025年5月21日	-	连带责任担保	否	否	0	否 ¹		

¹ 被担保人的少数股东包含公司关联方，该关联方已按其持股比例向公司提供担保。

		海)有限公司、澜起电子科技(珠海横琴)有限公司										
报告期内对子公司担保发生额合计												1,209.05
报告期末对子公司担保余额合计 (B)												260.85
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)												
担保总额 (A+B)												260.85
担保总额占公司净资产的比例(%)												0.14
其中:												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)												0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)												260.85 ¹
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)												0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)												260.85
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												不适用
担保情况说明		<p>1. 澜起电子科技(上海)有限公司向供应商采购相关产品, 供应商要求公司出具担保函, 承诺对债务承担连带责任, 担保金额为360万美元(最高额担保), 担保发生日为2023年9月15日起, 担保到期日为子公司完成付款之日/采购商品使用期限届满之日。截至报告期末, 担保余额为0万美元。</p> <p>2. 澜起澳门离岸商业服务有限公司、澜起电子科技(上海)有限公司、澜起电子科技(珠海横琴)有限公司向供应商采购相关产品, 供应商要求公司出具担保函, 担保金额为7,000万美元(最高额担保), 担保发生日为有延迟给付或有任何不能给付供应商之日起, 担保到期日为供应商全部受偿之日止。截至报告期末, 担保余额为260.85万美元。</p>										

¹ 该金额指报告期末公司为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保余额。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1). 委托理财总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1. 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,144,789,273	100.00	1,637,248				1,637,248	1,146,426,521	100.00
1.人民币普通股	1,144,789,273	100.00	1,637,248				1,637,248	1,146,426,521	100.00
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	1,144,789,273	100.00	1,637,248				1,637,248	1,146,426,521	100.00

2. 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2025年8月6日,公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期第一次归属完成,相关股份36.2057万股于2025年8月12日上市流通,公司总股本由114,478.9273万股变更为114,515.1330万股。相关事项详见公司于2025年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告(公告编号:2025-045)。

2025年12月22日,公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期第二次归属、2023年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期、2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属完成,相关股份127.5191万股于2025年12月29日上市流通,公司总股本由

114,515.1330 万股变更为 114,642.6521 万股。相关事项详见公司于 2025 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告（公告编号：2025-074）。

3. 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，公司共完成 2 次限制性股票归属登记，合计新发 1,637,248 股股份，公司总股本由 1,144,789,273 股增加至 1,146,426,521 股。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产的影响如下：

项目	2025 年（股份变动后）	2025 年（股份变动前）
每股收益（元/股）	1.9500	1.9528
每股净资产（元/股）	11.2730	11.2892

4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2025 年 8 月 6 日	19.01 元 ¹	362,057	2025 年 8 月 12 日	362,057	-
A 股	2025 年 12 月 22 日	18.81 元 / 26.01 元 ²	1,275,191	2025 年 12 月 29 日	1,275,191	-

注 1：2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期第一次归属上市，授予价格为 19.01 元/股。

注 2：2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期第二次归属及 2023 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属上市，授予价格为 18.81 元/股；2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属上市，授予价格为 26.01 元/股。

(二) 报告期后证券发行情况

根据公司 H 股发行方案，公司发行的 65,890,000 股 H 股股票（行使超额配售权之前）于 2026 年 2 月 9 日在香港联交所主板挂牌并上市交易，每股发售价为 106.89 港元。

根据公司 H 股发行方案，公司同意由整体协调人（代表国际包销商）于 2026 年 2 月 10 日悉数行使超额配售权，公司发行的 9,883,500 股 H 股股票于 2026 年 2 月 13 日在香港联交所主板挂牌并上市交易，每股发售价为 106.89 港元。

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

内容详见本节“一、股本变动情况（一）1.股本变动情况表 2.股本变动情况说明”。

(三) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

内容详见本节“一、股本变动情况（一）1.股本变动情况表 2.股本变动情况说明”。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	106,174
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	115,748
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

注：年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 115,748 户，其中：A 股 115,743 户，H 股登记股东 5 户。

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	

香港中央结算有限公司	78,515,472	151,412,538	13.21	0	无	0	境外法人
中国电子投资控股有限公司	-17,117,936	48,045,935	4.19	0	无	0	国有法人
WLT Partners,L.P.	0	45,012,524	3.93	0	无	0	其他
上海融迎企业管理合伙企业（有限合伙）	-22,899,251	37,905,987	3.31	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	-16,308,124	37,238,787	3.25	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	-13,177,598	34,640,959	3.02	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	1,429,028	26,026,042	2.27	0	无	0	其他
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	21,212,320	21,212,320	1.85	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	-639,666	18,881,970	1.65	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	-4,690,957	13,752,675	1.20	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
香港中央结算有限公司	151,412,538		人民币普通股	151,412,538			
中国电子投资控股有限公司	48,045,935		人民币普通股	48,045,935			
WLT Partners,L.P.	45,012,524		人民币普通股	45,012,524			
上海融迎企业管理合伙企业（有限合伙）	37,905,987		人民币普通股	37,905,987			
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	37,238,787		人民币普通股	37,238,787			

中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	34,640,959	人民币普通股	34,640,959
中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	26,026,042	人民币普通股	26,026,042
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	21,212,320	人民币普通股	21,212,320
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	18,881,970	人民币普通股	18,881,970
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	13,752,675	人民币普通股	13,752,675
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. WLT Partners,L.P.的控制人在上海融迎投资合伙企业（有限合伙）享有重要财产权益； 2. 未知上述其余股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

持股 5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件
适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1. 法人

适用 不适用

2. 自然人

适用 不适用

3. 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

公司的股权架构较为分散，任一股东均无法单独控制股东会半数以上表决权，亦无法单独控制董事会半数以上成员，不能单独控制公司。因此，公司不存在控股股东和实际控制人。

4. 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1. 法人

适用 不适用

2. 自然人

适用 不适用

3. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

公司的股权架构较为分散，任一股东均无法单独控制股东会半数以上表决权，亦无法单独控制董事会半数以上成员，不能单独控制公司。因此，公司不存在控股股东和实际控制人。

4. 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

回购股份方案名称	关于 2025 年第一次以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案
回购股份方案披露时间	2025 年 6 月 21 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	拟回购股份数量为 169.49 万股~338.98 万股；占总股本的比例为 0.15%~0.30%
拟回购金额	2 亿元~4 亿元
拟回购期间	自董事会审议通过后 3 个月
回购用途	用于员工持股计划或股权激励
已回购数量(股)	2,339,000
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	-
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

回购股份方案名称	关于 2025 年第二次以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案
回购股份方案披露时间	2025 年 6 月 21 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	拟回购股份数量为 169.49 万股~338.98 万股；占总股本的比例为 0.15%~0.30%
拟回购金额	2 亿元~4 亿元
拟回购期间	自股东大会审议通过后 12 个月内，且自公司 2025 年第一次回购股份方案实施完毕之后开始实施
回购用途	减少注册资本

已回购数量(股)	1,662,000
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	-
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

注：公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2025 年第二次回购股份方案回购价格上限的议案》，同意将 2025 年第二次回购股份方案回购价格上限由不超过人民币 117.80 元/股（含）调整为不超过人民币 200 元/股（含）。本次调整后，公司第二次回购股份方案拟回购数量为 100 万股—200 万股，占公司报告期末总股本的比例为 0.09%—0.17%。

九、优先股相关情况

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

澜起科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了澜起科技股份有限公司的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的澜起科技股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了澜起科技股份有限公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于澜起科技股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
<p>收入确认</p> <p>澜起科技股份有限公司及其子公司（“集团”）主要包括两大产品线，互连类芯片产品线以及津逮®产品线。集团的经营模式为无晶圆厂的集成电路设计企业模式，专注产业链中的集成电路设计和营销环节，并委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成生产制造。封装测试供应商还需要提供成品的仓储和向集团的客户直接发货服务。2025 年度互连类芯片和津逮®产品的销售收入金额为人民币 5,446,759,596.40 元，占合并报表中营业收入的比重为 99.82%。</p> <p>由于营业收入是集团关键业绩指标之一，可能</p>	<p>针对收入确认，我们实施包含但不限于以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 了解和评价与销售及收款相关的内部控制制度的设计和执行； 2) 与管理层访谈，选取样本，检查关键的合同条款，评价收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求； 3) 执行细节测试，根据产品销售贸易条款或研发服务里程碑节点，检查客户订单、发票、仓库发货单、出口报关单、到货签收记录、代销清单等文件； 4) 执行分析性复核程序，评价销售收入和毛利变动的合理性；结合下游行业发展与研发项目

<p>存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>相关政策与披露详见财务报表注释五、34 及注释七、61。</p>	<p>技术特点情况分析收入变动的合理性；</p> <p>5) 根据客户交易的特点与性质，对应收账款和销售收入选取样本执行函证程序；</p> <p>6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，检查销售收入是否计入恰当的会计期间；</p> <p>7) 选取符合特定风险标准的收入确认会计分录，检查相关支持性文件。</p>
<p>存货跌价准备</p>	
<p>截至 2025 年 12 月 31 日，集团合并财务报表中存货账面余额为人民币 1,090,918,862.78 元，存货跌价准备的余额为人民币 194,783,388.51 元。集团的主要存货为互连类芯片及津逮®CPU；由于原材料成本占比高且生产周期较长，互连类芯片与津逮®CPU 存在技术更新和产品过时的风险。</p> <p>管理层根据存货的周转情况及未来销售情况进行判断和估计可变现净值，这涉及管理层运用重大会计估计和判断且具有较大的不确定性，因此我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。</p> <p>相关政策与披露详见财务报表注释五、16 及注释七、10。</p>	<p>针对存货跌价准备，我们实施包含但不限于以下程序：</p> <p>1) 了解和评价管理层关于存货跌价准备的内部控制设计和执行；</p> <p>2) 通过分析存货的历史周转率和对比同行业公司的存货跌价准备计提政策，评价管理层关于存货跌价准备计提方法的合理性；</p> <p>3) 复核存货的库龄及历史周转情况；</p> <p>4) 检查存货的期后销售和使用情况；</p> <p>5) 复核管理层对于可变现净值估计的重要假设；</p> <p>6) 复核管理层存货跌价准备的计算；</p> <p>7) 对存货进行监盘并对存货的存在状况和残次冷背情况做观察和评价。</p>

四、其他信息

澜起科技股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估澜起科技股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督澜起科技股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- （1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- （3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对澜起科技股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致澜起科技股份有限公司不能持续经营。
- （5） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- （6） 就澜起科技股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：施 瑾
（项目合伙人）

中国注册会计师：方 舟

中国 北京

2026 年 3 月 30 日

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 12 月 31 日

编制单位：澜起科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	8,478,984,375.78	6,843,296,852.61
交易性金融资产	七、2	823,304,333.04	1,783,494,750.68
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	567,532,180.51	387,791,885.96
应收款项融资			
预付款项	七、8	132,890,386.00	4,394,165.14
其他应收款	七、9	4,254,922.19	4,143,856.36
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、10	896,135,474.27	352,196,407.33
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	130,973,692.91	85,986,107.30
流动资产合计		11,034,075,364.70	9,461,304,025.38
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	91,960,409.37	109,224,874.65
其他权益工具投资	七、18	27,755,580.30	22,270,908.60
其他非流动金融资产	七、19	583,514,277.41	575,243,925.97
投资性房地产	七、20	376,948,151.74	519,027,667.66
固定资产	七、21	716,066,625.28	582,259,175.21
在建工程	七、22	590,731,464.68	507,416,334.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	33,735,379.81	44,854,350.42
无形资产	七、26	113,432,512.10	133,754,950.96
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	136,628,281.23	180,457,761.37
递延所得税资产	七、29	43,299,305.56	83,097,411.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,714,071,987.48	2,757,607,361.00
资产总计		13,748,147,352.18	12,218,911,386.38

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	208,233,513.35	211,153,859.60
预收款项	七、37	80,412.76	95,412.74
合同负债	七、38	45,729.09	22,087,850.59
应付职工薪酬	七、39	293,937,076.24	241,095,578.48
应交税费	七、40	112,081,459.76	63,884,227.28
其他应付款	七、41	140,489,192.45	125,603,739.18
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	14,775,474.48	15,957,075.03
其他流动负债			
流动负债合计		769,642,858.13	679,877,742.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	19,362,711.49	28,798,720.21
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、49		19,593,000.00
预计负债			
递延收益	七、51	78,886,546.55	92,023,333.33
递延所得税负债	七、29	9,099,385.94	2,113,025.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		107,348,643.98	142,528,078.57
负债合计		876,991,502.11	822,405,821.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,146,426,521.00	1,144,789,273.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	6,114,017,524.66	5,625,969,898.50
减：库存股	七、56	848,359,352.12	427,557,874.81
其他综合收益	七、57	141,120,839.12	255,293,498.30
专项储备			
盈余公积	七、59	351,958,734.25	286,559,941.59
未分配利润	七、60	6,018,558,105.55	4,518,383,330.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,923,722,372.46	11,403,438,067.08
少数股东权益		-52,566,522.39	-6,932,502.17
所有者权益（或股东权益）合计		12,871,155,850.07	11,396,505,564.91

负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,748,147,352.18	12,218,911,386.38
公司负责人：杨崇和		主管会计工作负责人：苏琳	会计机构负责人：苏琳

母公司资产负债表

2025 年 12 月 31 日

编制单位：澜起科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,102,740,733.79	1,380,784,638.63
交易性金融资产		285,907,082.20	792,858,150.68
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	614,601,810.19	222,936,138.65
应收款项融资			
预付款项		21,574,452.99	944,956.74
其他应收款	十九、2	1,655,206,224.00	1,287,570,989.98
其中：应收利息		545,205.48	
应收股利		100,000,000.00	40,000,000.00
存货			
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		69,481,407.85	26,759,766.53
流动资产合计		3,749,511,711.02	3,711,854,641.21
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		100,000,000.00	
长期股权投资	十九、3	3,137,534,636.95	3,075,299,188.13
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			8,042,885.07
投资性房地产		280,474,169.51	313,156,660.60
固定资产		146,097,508.80	127,398,613.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			754,183.99
无形资产		4,412,702.43	13,212,993.75
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		55,387,027.59	127,450,520.81

递延所得税资产		8,112,411.72	10,865,623.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,732,018,457.00	3,676,180,669.87
资产总计		7,481,530,168.02	7,388,035,311.08
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,713,426.07	863,909.28
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		97,171,671.77	62,268,815.72
应交税费		11,589,389.91	8,632,815.79
其他应付款		27,963,660.69	20,210,561.94
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			274,216.88
其他流动负债			
流动负债合计		138,438,148.44	92,250,319.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			504,004.03
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		44,759,444.51	49,823,333.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,759,444.51	50,327,337.36
负债合计		183,197,592.95	142,577,656.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,146,426,521.00	1,144,789,273.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,114,017,524.66	5,625,969,898.50
减：库存股		848,359,352.12	427,557,874.81
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		351,958,734.25	286,559,941.59
未分配利润		534,289,147.28	615,696,415.83
所有者权益（或股东权益）合计		7,298,332,575.07	7,245,457,654.11

负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,481,530,168.02	7,388,035,311.08
公司负责人：杨崇和		主管会计工作负责人：苏琳	会计机构负责人：苏琳

合并利润表

2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入		5,456,316,783.63	3,638,911,068.29
其中：营业收入	七、61	5,456,316,783.63	3,638,911,068.29
二、营业总成本		3,400,837,066.07	2,345,174,927.11
其中：营业成本	七、61	2,060,961,088.35	1,523,614,938.54
税金及附加	七、62	6,645,694.95	6,325,049.35
销售费用	七、63	120,228,658.51	96,006,550.08
管理费用	七、64	526,287,844.89	196,262,500.24
研发费用	七、65	915,030,216.00	763,469,994.44
财务费用	七、66	-228,316,436.63	-240,504,105.54
其中：利息费用	七、66	1,732,176.80	1,512,598.38
利息收入	七、66	271,072,118.66	229,985,802.58
加：其他收益	七、67	115,887,831.13	91,576,969.33
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	97,013,584.17	48,599,096.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	25,894,061.14	23,888,571.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-921,798.92	-464,514.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	28,423,710.47	-44,443,090.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,321,777,105.55	1,412,893,172.57
加：营业外收入	七、74		5,170.00
减：营业外支出	七、75	1,209,052.09	280,492.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,320,568,053.46	1,412,617,850.07
减：所得税费用	七、76	190,932,103.50	71,881,725.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,129,635,949.96	1,340,736,124.50
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,129,635,949.96	1,340,736,124.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,235,569,970.18	1,411,778,923.59

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-105,934,020.22	-71,042,799.09
六、其他综合收益的税后净额		-114,172,659.18	66,341,399.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-114,172,659.18	66,341,399.44
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		329,767.61	2,863,238.40
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		329,767.61	2,863,238.40
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-114,502,426.79	63,478,161.04
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-114,502,426.79	63,478,161.04
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,015,463,290.78	1,407,077,523.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,121,397,311.00	1,478,120,323.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-105,934,020.22	-71,042,799.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.97	1.25
（二）稀释每股收益(元/股)		1.96	1.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

母公司利润表

2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	十九、4	920,470,608.17	557,366,228.07
减：营业成本	十九、4	33,539,932.46	22,973,272.21
税金及附加		2,493,651.43	2,482,476.76
销售费用		13,865,725.23	18,174,919.84
管理费用		123,227,379.86	85,314,023.75
研发费用		248,584,903.09	242,011,079.39
财务费用		-18,286,646.42	-42,877,347.66
其中：利息费用		13,150.70	2,488.81
利息收入		29,897,149.16	39,890,021.63
加：其他收益		55,969,305.04	66,677,997.88
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	110,980,575.83	65,371,397.25

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		7,150,909.47	-6,101,832.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-10,000,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		691,146,452.86	345,235,366.16
加：营业外收入			5,170.00
减：营业外支出		670,035.63	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		690,476,417.23	345,140,536.16
减：所得税费用		36,488,490.65	17,613,596.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		653,987,926.58	327,526,939.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		653,987,926.58	327,526,939.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		653,987,926.58	327,526,939.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

合并现金流量表
2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		5,256,493,776.07	3,576,434,663.11
收到的税费返还		14,306,408.46	17,805,020.80
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	424,288,280.85	295,347,782.24
经营活动现金流入小计		5,695,088,465.38	3,889,587,466.15
购买商品、接受劳务支付的现金		2,684,684,916.17	1,378,915,150.88
支付给职工及为职工支付的现金		677,844,941.00	626,115,370.66
支付的各项税费		113,847,288.78	34,311,484.65
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	196,690,762.51	158,923,953.82
经营活动现金流出小计	七、79	3,673,067,908.46	2,198,265,960.01
经营活动产生的现金流量净额		2,022,020,556.92	1,691,321,506.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,884,125,668.58	5,085,114,806.26
取得投资收益收到的现金		26,390,326.64	45,794,434.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		36,741,410.02	
投资活动现金流入小计		3,947,257,405.24	5,130,909,241.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		265,828,735.88	379,121,899.19
投资支付的现金		2,829,116,550.68	5,160,520,367.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	2,000,000.00	34,741,410.02
投资活动现金流出小计		3,096,945,286.56	5,574,383,676.85
投资活动产生的现金流量净额		850,312,118.68	-443,474,435.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		99,595,069.48	194,344,837.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,300,000.00	49,200,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			297,691,636.52
筹资活动现金流入小计		99,595,069.48	492,036,473.92
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		669,996,402.47	338,496,337.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			303,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	458,662,254.77	430,478,137.58
筹资活动现金流出小计		1,128,658,657.24	768,974,475.38
筹资活动产生的现金流量净额		-1,029,063,587.76	-276,938,001.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-126,127,139.11	62,142,396.44
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	1,717,141,948.73	1,033,051,465.39
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	6,698,931,684.67	5,665,880,219.28
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	8,416,073,633.40	6,698,931,684.67

公司负责人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

母公司现金流量表
2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		507,705,534.15	334,329,099.30
收到的税费返还			2,930,885.24
收到其他与经营活动有关的现金		159,607,903.50	179,796,014.16
经营活动现金流入小计		667,313,437.65	517,055,998.70
购买商品、接受劳务支付的现金		21,302,026.49	124,721,942.32
支付给职工及为职工支付的现金		127,789,996.58	111,217,369.21
支付的各项税费		40,880,014.29	3,460,114.28
支付其他与经营活动有关的现金		111,089,981.56	64,354,847.49
经营活动现金流出小计		301,062,018.92	303,754,273.30
经营活动产生的现金流量净额		366,251,418.73	213,301,725.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,112,000,000.00	2,885,000,000.00
取得投资收益收到的现金		59,125,438.85	25,371,397.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,142,739.73	
投资活动现金流入小计		2,177,268,178.58	2,910,371,397.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,071,504.32	104,478,781.47
投资支付的现金		1,669,200,000.00	2,740,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,705,271,504.32	2,844,558,781.47
投资活动产生的现金流量净额		471,996,674.26	65,812,615.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		39,295,069.48	145,144,837.40
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			297,691,636.52
筹资活动现金流入小计		39,295,069.48	442,836,473.92
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		669,996,402.47	338,193,337.80
支付其他与筹资活动有关的现金		433,353,659.98	409,057,267.16
筹资活动现金流出小计		1,103,350,062.45	747,250,604.96
筹资活动产生的现金流量净额		-1,064,054,992.97	-304,414,131.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-387,061.92	1,817,313.35
五、现金及现金等价物净增加额		-226,193,961.90	-23,482,476.51
加：期初现金及现金等价物余额		1,313,661,828.10	1,337,144,304.61
六、期末现金及现金等价物余额		1,087,467,866.20	1,313,661,828.10

公司负责人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

合并所有者权益变动表
2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年度													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,144,789,273.00				5,625,969,898.50	427,557,874.81	255,293,498.30		286,559,941.59	4,518,383,330.50		11,403,438,067.08	-6,932,502.17	11,396,505,564.91
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,144,789,273.00				5,625,969,898.50	427,557,874.81	255,293,498.30		286,559,941.59	4,518,383,330.50		11,403,438,067.08	-6,932,502.17	11,396,505,564.91
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,637,248.00				488,047,626.16	420,801,477.31	-114,172,659.18		65,398,792.66	1,500,174,775.05		1,520,284,305.38	-45,634,020.22	1,474,650,285.16
（一）综合收益总额							-114,172,659.18			2,235,569,970.18		2,121,397,311.00	-105,934,020.22	2,015,463,290.78
（二）所有者投入和减少资本	1,637,248.00				488,047,626.16	420,801,477.31						68,883,396.85	60,300,000.00	129,183,396.85
1. 所有者投入的普通股	1,637,248.00				37,657,821.48							39,295,069.48	60,300,000.00	99,595,069.48
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					450,389,804.68							450,389,804.68		450,389,804.68
4. 其他						420,801,477.31						-420,801,477.31		-420,801,477.31
（三）利润分配									65,398,792.66	-735,395,195.13		-669,996,402.47		-669,996,402.47

1. 提取盈余公积								65,398,792.66	-65,398,792.66				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-669,996,402.47	-669,996,402.47			-669,996,402.47
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,146,426,521.00				6,114,017,524.66	848,359,352.12	141,120,839.12	351,958,734.25	6,018,558,105.55		12,923,722,372.46	-52,566,522.39	12,871,155,850.07

项目	2024 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他											

一、上年年末余额	1,138,740,286.00			5,432,387,416.86	300,031,332.07	188,448,802.51		253,807,247.64	3,478,053,735.01		10,191,406,155.95	15,213,296.92	10,206,619,452.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,138,740,286.00			5,432,387,416.86	300,031,332.07	188,448,802.51		253,807,247.64	3,478,053,735.01		10,191,406,155.95	15,213,296.92	10,206,619,452.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,048,987.00			193,582,481.64	127,526,542.74	66,844,695.79		32,752,693.95	1,040,329,595.49		1,212,031,911.13	-22,145,799.09	1,189,886,112.04
（一）综合收益总额						66,341,399.44			1,411,778,923.59		1,478,120,323.03	-71,042,799.09	1,407,077,523.94
（二）所有者投入和减少资本	6,048,987.00			193,582,481.64	127,526,542.74						72,104,925.90	49,200,000.00	121,304,925.90
1. 所有者投入的普通股	6,048,987.00			139,095,850.40							145,144,837.40	49,200,000.00	194,344,837.40
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				39,255,996.62							39,255,996.62		39,255,996.62
4. 其他				15,230,634.62	127,526,542.74						-112,295,908.12		-112,295,908.12
（三）利润分配								32,752,693.95	-370,946,031.75		-338,193,337.80	-303,000.00	-338,496,337.80
1. 提取盈余公积								32,752,693.95	-32,752,693.95				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-338,193,337.80		-338,193,337.80	-303,000.00	-338,496,337.80
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转						503,296.35			-503,296.35				
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益						503,296.35			-503,296.35				
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,144,789,273.00				5,625,969,898.50	427,557,874.81	255,293,498.30	286,559,941.59	4,518,383,330.50	11,403,438,067.08	-6,932,502.17	11,396,505,564.91	

公司负责人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

母公司所有者权益变动表
2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,144,789,273.00				5,625,969,898.50	427,557,874.81			286,559,941.59	615,696,415.83	7,245,457,654.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,144,789,273.00				5,625,969,898.50	427,557,874.81			286,559,941.59	615,696,415.83	7,245,457,654.11
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,637,248.00				488,047,626.16	420,801,477.31			65,398,792.66	-81,407,268.55	52,874,920.96
（一）综合收益总额										653,987,926.58	653,987,926.58
（二）所有者投入和减少资本	1,637,248.00				488,047,626.16	420,801,477.31					68,883,396.85
1. 所有者投入的普通股	1,637,248.00				37,657,821.48						39,295,069.48

2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额					450,389,804.68					450,389,804.68
4. 其他						420,801,477.31				-420,801,477.31
(三) 利润分配								65,398,792.66	-735,395,195.13	-669,996,402.47
1. 提取盈余公积								65,398,792.66	-65,398,792.66	
2. 对所有者（或股东）的分配									-669,996,402.47	-669,996,402.47
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,146,426,521.00				6,114,017,524.66	848,359,352.12		351,958,734.25	534,289,147.28	7,298,332,575.07

项目	2024 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,138,740,286.00				5,432,387,416.86	300,031,332.07			253,807,247.64	659,115,508.11	7,184,019,126.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,138,740,286.00				5,432,387,416.86	300,031,332.07			253,807,247.64	659,115,508.11	7,184,019,126.54
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	6,048,987.00				193,582,481.64	127,526,542.74			32,752,693.95	-43,419,092.28	61,438,527.57
(一) 综合收益总额										327,526,939.47	327,526,939.47

(二) 所有者投入和减少资本	6,048,987.00			193,582,481.64	127,526,542.74					72,104,925.90
1. 所有者投入的普通股	6,048,987.00			139,095,850.40						145,144,837.40
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				39,255,996.62						39,255,996.62
4. 其他				15,230,634.62	127,526,542.74					-112,295,908.12
(三) 利润分配								32,752,693.95	-370,946,031.75	-338,193,337.80
1. 提取盈余公积								32,752,693.95	-32,752,693.95	
2. 对所有者(或股东)的分配									-338,193,337.80	-338,193,337.80
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,144,789,273.00			5,625,969,898.50	427,557,874.81			286,559,941.59	615,696,415.83	7,245,457,654.11

公司负责人：杨崇和

主管会计工作负责人：苏琳

会计机构负责人：苏琳

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

澜起科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2004 年 5 月 27 日在上海市成立。本公司的法定代表人为杨崇和，截至 2025 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 1,146,426,521.00 元，住所为上海市徐汇区漕宝路 181 号 1 幢 15 层。2018 年 10 月 29 日，经上海市工商行政管理局批准，本公司整体变更为股份有限公司，并更名为澜起科技股份有限公司，换发了统一社会信用代码为 913100007626333657 的企业法人营业执照，营业期限为 2004 年 5 月 27 日至无固定期限。根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 25 日出具的《关于同意澜起科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1128 号），本公司向社会公开发行人民币普通股 11,298.1389 万股股份，每股面值人民币 1 元。本公司于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。

本公司主要经营范围为：集成电路、线宽 0.25 微米及以下大规模集成电路、软件产品、新型电子元器件的设计、开发、批发、进出口等，属于计算机、通信和其他电子设备制造业。

本公司无实际控制人。

本财务报表业经本公司董事会于 2026 年 3 月 30 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本财务报表还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及子公司（以下统称“本集团”）根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备、存货跌价准备、政府补助、收入确认和计量及递延所得税资产的确认等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司的记账本位币为人民币。本公司之境外子公司，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程	预算数或实际发生数超过上年度经审计总资产 5%
重要的合营企业或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团净资产的 10% 以上且金额大于 1 亿元，或长期股权投资权益法下投资损益占集团合并净利润的 10% 以上
存在重要少数股东权益的子公司	子公司净资产占集团净资产 10% 以上，或单个子公司少数股东权益占集团净资产的 5% 以上且金额大于 1 亿元

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。当且仅当投资方具备下列三要素时，投资方能够控制被投资方：投资方拥有对被投资方的权力；因参与被投资方的相关活动而享有可变回报；有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的上一月的期末汇率将外币金额折算为记账本位币金额，但投资者以外币投入的资本以交易发生日的即期汇率折算。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用初始确认时所采用的汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率的近似汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的上月的月末汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的上月的月末汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

11. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即将之前确认的金融资产从资产负债表中予以转出：

- 收取金融资产现金流量的权利届满；
- 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。以常规方式买卖金融资产，是指按照合同规定购买或出售金融资产，并且该合同条款规定，根据通常由法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）金融工具减值

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十二、1。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

本集团基于组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以客户信用等级分类为基础评估应收账款的预期信用损失。本集团根据开票日期确定账龄。

减值准备的核销

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

12. 应收票据

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

14. 应收款项融资

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

存货包括原材料、委托加工物资、库存商品等。

存货按照标准成本法进行初始计量,通过成本差异分摊结转为实际成本。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。生产加工环节主要由外部专业厂商完成,包括封装和测试等。发出存货采用加权平均法确定其实际成本。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时,原则上按照类别计提。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本）。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产的折旧采用年限平均法计提，使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30-50 年	0%	2.00-3.33%

本集团至少于每年年度终了，对投资性房地产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

21. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
境外土地所有权	年限平均法	永久期限	0%	0%
房屋及建筑物	年限平均法	5-50 年	0%	2.00-20.00%
电子设备	年限平均法	3-5 年	0%	20.00-33.33%
办公设备	年限平均法	3-5 年	0%	20.00-33.33%
交通工具	年限平均法	3-5 年	0%	20.00-33.33%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。境外土地所有权不予折旧，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试；在每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的固定资产的政策进行会计处理。

22. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。标准如下：

类别	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	房屋及建筑物初步验收合格并达到预定可使用状态或合同规定的标准

23. 借款费用

适用 不适用

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，其使用寿命如下：

类别	使用寿命	确定依据
土地使用权	50 年	土地使用权期限
IP 授权	1-5 年	预计可使用年限
软件	1-5 年	预计可使用年限

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本集团进行研究与开发过程中发生的支出主要包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、工程开发费用、工具及许可证费、折旧及摊销费用等相关支出，本集团按照研发项目核算研发费用，归集各项支出。

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

27. 长期资产减值

√适用 □不适用

对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

类别	摊销期
经营租入固定资产改良	3-5 年
光罩模具	3-5 年

绿化工程	5 年
维保费	2-5 年

29. 合同负债

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。

在向客户转让商品或服务之前，已收客户对价或取得无条件收取对价权利而应向客户转让商品或服务的义务，确认为合同负债。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，同时有关金额能够可靠地计量的，本集团将其确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核并进行适当调整以反映当前最佳估计数。

32. 股份支付

适用 不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的

最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

(1) 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品一项履约义务。本集团通常综合考虑下列因素：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品：

- 对于直销模式，根据合同约定分别以出口报关时点或客户签收时点作为收入确认时点；
- 对于委托代销安排，在受托方售出商品时确认销售商品收入。

(2) IP 授权收入

IP 授权销售业务模式主要分为固定费用模式和按计件模式，收入确认的具体方法分别如下：

- 固定费用模式

固定费用模式合同中约定授权许可客户享受技术的使用权，属于在某一时点履行的履约义务，在技术交付客户并验收确认、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

- 按计件模式

按计件模式合同中约定授权许可使用费按照客户产品的出货量为标准进行结算，属于在某一时点履行的履约义务，在收到客户提供的授权许可使用产品的出货量报告（按权责发生制原则确定的归属期间）、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

36. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在满足相关条件且不再具有退回义务时确认相关成本费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

37. 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本集团对租赁期不超过 12 个月的短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益

除了短期租赁和低价值租赁，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额）；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团因租赁付款额变动重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的单项交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下单项交易中产生的：该交易不是企业合并，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣该暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

回购股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行（含再融资）、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

公允价值计量

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面价值进行重大调整。

（1）判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

经营租赁—作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的几乎全部重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异。

（2）估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面价值重大调整。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及过时和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面价值不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

非上市股权投资的公允价值

本集团根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损基于转回时适用的税率确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

40. 重要会计政策和会计估计的变更

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”。

41. 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	集团内一般纳税人按销售额和适用税率计算的销项税额，抵扣准予抵扣的进项税额后的差额；集团内小规模纳税人按照销售额和增值税征收率计算的增值税税额，不得抵扣进项税额	免税、0%、3%减按 1%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
房产税	从价计征：房产原值一次减除 30% 后余值 从租计征：租金收入	从价计征：1.2% 从租计征：12%
土地使用税	实际占用的土地面积	每平方米 6 元和 1.5 元

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	10%
澜起电子科技（昆山）有限公司	0%
昆山澜起半导体有限公司	25%
澜起电子科技（上海）有限公司	15%
澜起投资有限公司	25%
蒙万实业发展（上海）有限公司	25%
上海奚泰实业有限公司	25%
上海华萃置业有限公司	25%
蒙特图实业发展（上海）有限公司	25%
蒙西庐实业发展（上海）有限公司	25%
澜起电子科技（海南）有限公司	20%
澜起创业投资（海南）有限公司	15%
澜起电子科技（珠海横琴）有限公司	25%
西安澜起电子设计有限公司	20%
澜起电子设计（上海）有限公司	20%
Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited	12%，详见注 1
Montage Technology Holdings Company Limited	详见注 2
Montage Hong Kong Holdings Company Limited	8.25% 及 16.5%，详见注 2
Montage Real Estate Holding I Limited (BVI)	详见注 2
Montage Real Estate Holding II Limited (BVI)	详见注 2
Montage Real Estate Holding I (Hong Kong) Limited	8.25% 及 16.5%，详见注 2
Montage Real Estate Holding II (Hong Kong) Limited	8.25% 及 16.5%，详见注 2
Montage Technology Inc.	详见注 3
Mont Acquisition Sub, Inc.	详见注 3
Montage, Inc.	详见注 3
3955 Johns Creek Inc.	详见注 3
Montage Semiconductor Inc.	详见注 3
Montage Technology Holdings Inc.	详见注 3
Montage Technology Holdings II Inc.	详见注 3

注 1：Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited 注册地为澳门。根据澳门特别行政区颁布的第 21/78/M 号所得补充税法律制度，2021 年 1 月 1 日起该子公司符合 A 类纳税人的组别条件，根据其税前利润规模适用税率 12%。

注 2: Montage Technology Holdings Company Limited 注册地为英属开曼群岛, 不征收企业所得税; Montage Real Estate Holding I Limited 和 Montage Real Estate Holding II Limited 注册地为英属维尔京群岛, 不征收企业所得税; Montage Hong Kong Holdings Company Limited、Montage Real Estate Holding I (Hong Kong) Limited 和 Montage Real Estate Holding II (Hong Kong) Limited 注册地为香港特别行政区, 执行香港利得税两级税率制, 针对年不超过 2,000,000 港元的应评税利润实施 8.25% 的税率征收, 应评税利润中超过 2,000,000 港元的部分实施 16.5% 的税率征收。

注 3: Montage Technology Inc.、Mont Acquisition Sub, Inc.、Montage, Inc.、3955 Johns Creek Inc.、Montage Semiconductor Inc.、Montage Technology Holdings Inc. 和 Montage Technology Holdings II Inc. 注册地为美国, 执行美国联邦企业所得税税率 21%。前述子公司在执行美国联邦企业所得税的同时, 需执行其注册地所在州相应的企业所得税政策。

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36 号, 纳税人提供技术转让服务免征增值税。本集团收取特许权使用费免征增值税。

(2) 企业所得税

本公司于 2023 年 12 月 12 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局颁发的高新技术企业证书, 证书编号: GR202331004753, 本公司可于 2023 年至 2025 年按 15% 税率征收企业所得税。同时, 根据《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告 2020 年第 45 号) 及《国家发展改革委等部门关于做好 2025 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》(发改高技〔2025〕385 号), 本公司符合国家鼓励的重点集成电路设计企业条件, 可减按 10% 的税率缴纳企业所得税, 本公司会按照法律法规要求进行各项申报工作。

本公司的子公司澜起电子科技(昆山)有限公司(“澜起昆山”)于 2024 年 12 月 24 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书, 证书编号: GR202432016754, 澜起昆山可于 2024 年至 2026 年按 15% 税率征收企业所得税。同时, 根据《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告 2020 年第 45 号) 及《国家发展改革委等部门关于做好 2025 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》(发改高技〔2025〕385 号), 国家鼓励的重点集成电路设计企业, 可自获利年度起, 第一年至第五年免征企业所得税, 接续年度减按 10% 的税率征收企业所得税。本公司的子公司澜起昆山符合国家鼓励的重点集成电路设计企业的认定标准, 本年度可免征企业所得税, 澜起昆山会按照法律法规的要求进行各项申报工作。

本公司的子公司澜起电子科技(上海)有限公司于 2024 年 12 月 26 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局颁发的高新技术企业证书, 证书编号: GR202431005429, 澜起电子科技(上海)有限公司可于 2024 年至 2026 年按 15% 税率征收企业所得税。

根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号) 的规定, 对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税政策, 延续执行至 2027 年 12 月 31 日。于 2025 年度, 本公司的子公司澜起电子科技(海南)有限公司、西安澜起电子设计有限公司及澜起电子设计(上海)有限公司属于小型微利企业, 可适用小型微利企业的优惠税率。

本公司的子公司澜起创业投资（海南）有限公司注册于海南省三亚市。根据《财政部税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2020〕31号）文件，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15% 的税率征收企业所得税，该规定自 2020 年 1 月 1 日起执行至 2024 年 12 月 31 日。最新的鼓励类产业目录源自国务院审定印发的《海南自由贸易港鼓励类产业目录（2024 年本）》，其中创业投资已被纳入海南省鼓励类产业目录，拥有创业投资资质符合条件的企业可减按 15% 税率征税企业所得税。根据《财政部税务总局关于延续实施海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2025〕3号），《财政部税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2020〕31号）规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2027 年 12 月 31 日。根据《海南省发展和改革委员会创业投资企业备案通知书》（琼发改审批〔2021〕869号）澜起创业投资（海南）有限公司已于 2021 年 11 月 9 日完成创业投资企业备案，本年度按 15% 税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,628.60	5,928.60
银行存款	8,351,281,401.04	6,752,516,164.00
其他货币资金	127,695,346.14	90,774,760.01
合计	8,478,984,375.78	6,843,296,852.61
其中：存放在境外的款项总额	4,985,225,547.98	3,993,373,315.93

其他说明

无

2. 交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	823,304,333.04	1,783,494,750.68	/
其中：			
结构性存款	722,733,720.02	1,629,362,905.47	/
权益工具投资	100,570,613.02	154,131,845.21	/
合计	823,304,333.04	1,783,494,750.68	/

其他说明：

适用 不适用

无

3. 衍生金融资产

适用 不适用

4. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	570,380,702.87	389,736,337.95
合计	570,380,702.87	389,736,337.95

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	570,380,702.87	100.00	2,848,522.36	0.50	567,532,180.51	389,736,337.95	100.00	1,944,451.99	0.50	387,791,885.96
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	570,380,702.87	100.00	2,848,522.36	0.50	567,532,180.51	389,736,337.95	100.00	1,944,451.99	0.50	387,791,885.96
合计	570,380,702.87	/	2,848,522.36	/	567,532,180.51	389,736,337.95	/	1,944,451.99	/	387,791,885.96

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
信用优质客户	570,380,702.87	2,848,522.36	0.50
合计	570,380,702.87	2,848,522.36	0.50

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	1,944,451.99	2,866,250.91	1,944,451.99		17,728.55	2,848,522.36
合计	1,944,451.99	2,866,250.91	1,944,451.99		17,728.55	2,848,522.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	277,341,883.27		277,341,883.27	48.62	1,386,709.42
第二名	138,469,820.08		138,469,820.08	24.28	692,349.10
第三名	29,963,774.40		29,963,774.40	5.25	149,818.87
第四名	29,225,223.24		29,225,223.24	5.12	146,126.12
第五名	18,107,594.56		18,107,594.56	3.17	90,537.97
合计	493,108,295.55		493,108,295.55	86.44	2,465,541.48

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

6. 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7. 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8). 其他说明：

适用 不适用

8. 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	132,890,386.00	100.00	4,394,165.14	100.00
合计	132,890,386.00	100.00	4,394,165.14	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	108,021,557.52	81.29
第二名	21,000,000.00	15.80
第三名	1,305,570.00	0.98
第四名	480,594.20	0.36

第五名	392,485.03	0.30
合计	131,200,206.75	98.73

其他说明：

无

其他说明

适用 不适用

9. 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,254,922.19	4,143,856.36
合计	4,254,922.19	4,143,856.36

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	923,214.41	990,948.99
1 至 2 年	603,207.52	324,224.36
2 至 3 年	324,152.48	2,080.00
3 年以上	2,404,347.78	2,826,603.01
合计	4,254,922.19	4,143,856.36

(14). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	4,254,854.57	4,114,812.47
其他	67.62	29,043.89
合计	4,254,922.19	4,143,856.36

(15). 坏账准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(16). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的 性质	账龄	坏账准备 期末余额
西安腾飞信息技术孵化器 有限公司	893,208.48	20.99	押金	2 年以上	
融科物业投资有限公司	504,900.00	11.87	押金	3 年以上	
Geumdam Co., Ltd.	485,999.98	11.42	押金	1 年以内	
昆山金融产业园投资开发 有限公司	460,000.00	10.81	押金	1-2 年	
上海华昱房地产开发有限 公司静安瑞吉酒店	420,000.00	9.87	押金	3 年以上	
合计	2,764,108.46	64.96	/	/	

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10. 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准 备/合同履约 成本减值准 备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履约 成本减值准 备	账面价值
原材料	101,254,170.87	39,048,652.09	62,205,518.78	58,270,638.08	33,313,414.35	24,957,223.73
委托加工 物资	463,361,201.07	27,473,263.22	435,887,937.85	199,434,288.53	13,182,794.36	186,251,494.17
库存商品	526,303,490.84	128,261,473.20	398,042,017.64	349,270,368.95	208,282,679.52	140,987,689.43
合计	1,090,918,862.78	194,783,388.51	896,135,474.27	606,975,295.56	254,778,888.23	352,196,407.33

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	33,313,414.35	6,243,627.70			508,389.96	39,048,652.09

委托加工物资	13,182,794.36	14,854,640.54		67,212.38	496,959.30	27,473,263.22
库存商品	208,282,679.52	-49,521,978.71		27,174,659.62	3,324,567.99	128,261,473.20
合计	254,778,888.23	-28,423,710.47		27,241,872.00	4,329,917.25	194,783,388.51

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

转销存货跌价准备主要是由于本年实现销售。

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11. 持有待售资产

适用 不适用

12. 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13. 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项税	81,579,188.76	79,456,098.75
待摊费用	18,164,954.42	6,509,171.10
预缴企业所得税	2,735,777.93	20,837.45
港股上市费用	28,493,771.80	
合计	130,973,692.91	85,986,107.30

其他说明

无

14. 债权投资**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15. 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16. 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17. 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
上海木澜投资管理有限公司	2,651,370.28		1,659,612.55	4,009.80					-995,767.53	
深圳博升光电科技有限公司	67,546,224.00			-3,106,237.00						64,439,987.00
晟联科（上海）技术有限公司	39,027,280.37			-11,506,858.00						27,520,422.37
小计	109,224,874.65		1,659,612.55	-14,609,085.20					-995,767.53	91,960,409.37
合计	109,224,874.65		1,659,612.55	-14,609,085.20					-995,767.53	91,960,409.37

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

18. 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的投资	22,270,908.60	5,044,981.55		1,680,971.70	1,241,281.55		27,755,580.30	1,449,504.20	4,566,593.35	1,221,151.76	非交易性
合计	22,270,908.60	5,044,981.55		1,680,971.70	1,241,281.55		27,755,580.30	1,449,504.20	4,566,593.35	1,221,151.76	/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19. 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市股权投资	516,702,468.80	531,795,561.02
私募基金投资	66,811,808.61	43,448,364.95
合计	583,514,277.41	575,243,925.97

其他说明：

□适用 √不适用

20. 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	548,240,531.50	548,240,531.50
2.本期增加金额		
(1) 外购		
3.本期减少金额	138,218,286.13	138,218,286.13
(1) 处置	192,170.97	192,170.97
(2) 其他转出	138,026,115.16	138,026,115.16
4.期末余额	410,022,245.37	410,022,245.37
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	29,212,863.84	29,212,863.84
2.本期增加金额	11,942,351.91	11,942,351.91
(1) 计提或摊销	11,942,351.91	11,942,351.91
3.本期减少金额	8,081,122.12	8,081,122.12
(1) 处置		
(2) 其他转出	8,081,122.12	8,081,122.12
4.期末余额	33,074,093.63	33,074,093.63
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	376,948,151.74	376,948,151.74
2.期初账面价值	519,027,667.66	519,027,667.66

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21. 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	716,066,625.28	582,259,175.21
合计	716,066,625.28	582,259,175.21

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境外土地所有权	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	11,556,374.40	516,878,027.53	2,087,026.59	238,305,887.84	21,473,968.75	790,301,285.11
2.本期增加金额		171,794,751.10		43,374,119.14	7,339,471.14	222,508,341.38
(1) 购置				43,374,119.14	7,339,471.14	50,713,590.28
(2) 在建工程转入		33,768,635.94				33,768,635.94
(3) 其他转入		138,026,115.16				138,026,115.16
3.本期减少金额	256,579.68	1,210,007.76		5,420,085.05	123,022.16	7,009,694.65
(1) 处置或报废		193,525.70		3,967,627.01		4,161,152.71
(2) 外币折算差异	256,579.68	1,016,482.06		1,452,458.04	123,022.16	2,848,541.94
4.期末余额	11,299,794.72	687,462,770.87	2,087,026.59	276,259,921.93	28,690,417.73	1,005,799,931.84
二、累计折旧						
1.期初余额		35,493,027.52	2,087,026.59	155,932,704.19	14,529,351.60	208,042,109.90
2.本期增加金额		30,971,252.17		48,683,063.78	5,941,518.63	85,595,834.58
(1) 计提		22,890,130.05		48,683,063.78	5,941,518.63	77,514,712.46
(2) 其他转入		8,081,122.12				8,081,122.12
3.本期减少金额		30,181.72		3,835,056.60	39,399.60	3,904,637.92
(1) 处置或报废				3,202,065.40		3,202,065.40
(2) 外币折算差异		30,181.72		632,991.20	39,399.60	702,572.52
4.期末余额		66,434,097.97	2,087,026.59	200,780,711.37	20,431,470.63	289,733,306.56
三、减值准备						

1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	11,299,794.72	621,028,672.90	0.00	75,479,210.56	8,258,947.10	716,066,625.28
2.期初账面价值	11,556,374.40	481,385,000.01	0.00	82,373,183.65	6,944,617.15	582,259,175.21

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22. 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	590,731,464.68	507,416,334.80
合计	590,731,464.68	507,416,334.80

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
临港项目	587,690,019.31		587,690,019.31	502,293,904.34		502,293,904.34
其他	3,041,445.37		3,041,445.37	5,122,430.46		5,122,430.46
合计	590,731,464.68		590,731,464.68	507,416,334.80		507,416,334.80

注：“临港项目”指公司在上海自由贸易试验区临港新片区 PDC1-0401 单元 K15-01 地块实施的研发中心建设项目，以下同。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
临港项目	797,460,000.00	502,293,904.34	85,396,114.97			587,690,019.31	73.70	在建				自有及募集资金
合计	797,460,000.00	502,293,904.34	85,396,114.97			587,690,019.31	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

23. 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24. 油气资产

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

25. 使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	56,106,201.31	56,106,201.31
2.本期增加金额	12,596,698.28	12,596,698.28
(1) 增加	12,596,698.28	12,596,698.28
3.本期减少金额	12,938,511.36	12,938,511.36
(1) 到期	12,685,987.97	12,685,987.97
(2) 外币折算差异	252,523.39	252,523.39
4.期末余额	55,764,388.23	55,764,388.23
二、累计折旧		
1.期初余额	11,251,850.89	11,251,850.89
2.本期增加金额	15,692,392.75	15,692,392.75
(1) 计提	15,692,392.75	15,692,392.75
3.本期减少金额	4,915,235.22	4,915,235.22
(1) 处置	4,821,122.36	4,821,122.36
(2) 外币折算差异	94,112.86	94,112.86
4.期末余额	22,029,008.42	22,029,008.42
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	33,735,379.81	33,735,379.81
2.期初账面价值	44,854,350.42	44,854,350.42

(2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

26. 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	IP 授权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	79,918,285.38	11,410,599.19	134,356,909.27	225,685,793.84
2.本期增加金额		1,325,466.73	5,022,586.80	6,348,053.53
(1) 购置		1,325,466.73	5,022,586.80	6,348,053.53
3.本期减少金额		379,391.83	28,643,937.82	29,023,329.65
(1) 处置		379,391.83	28,643,937.82	29,023,329.65
4.期末余额	79,918,285.38	12,356,674.09	110,735,558.25	203,010,517.72
二、累计摊销				
1.期初余额	4,928,294.18	6,665,525.82	80,337,022.88	91,930,842.88
2.本期增加金额	1,598,365.68	1,769,960.81	23,302,165.90	26,670,492.39
(1) 计提	1,598,365.68	1,769,960.81	23,302,165.90	26,670,492.39
3.本期减少金额		379,391.83	28,643,937.82	29,023,329.65
(1) 处置		379,391.83	28,643,937.82	29,023,329.65
4.期末余额	6,526,659.86	8,056,094.80	74,995,250.96	89,578,005.62
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	73,391,625.52	4,300,579.29	35,740,307.29	113,432,512.10
2.期初账面价值	74,989,991.20	4,745,073.37	54,019,886.39	133,754,950.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0

(2). 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(3). 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

27. 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28. 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
光罩模具	174,355,187.64	79,920,030.04	35,828,909.51	90,304,122.97	128,142,185.20
绿化工程	3,110,126.89	923,039.66	1,186,838.01		2,846,328.54
经营租入固定资产改良	2,757,146.31	4,485,619.73	1,784,308.68		5,458,457.36
维保费	235,300.53	120,686.72	174,677.12		181,310.13
合计	180,457,761.37	85,449,376.15	38,974,733.32	90,304,122.97	136,628,281.23

其他说明：
无

29. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	174,165,178.06	22,858,097.09	238,123,615.94	30,671,099.13
可抵扣亏损	26,931,872.80	4,726,573.97	23,883,393.34	4,763,535.58
股份支付	80,413,689.61	10,141,712.34	293,324,955.65	37,119,369.28
递延收益	76,131,444.51	7,806,244.45	88,023,333.33	10,224,833.33
应付职工薪酬	23,433,677.16	2,991,827.54	32,310,779.49	5,467,542.27
固定资产计提折旧的时间性差异	24,565,773.06	3,533,408.52	16,923,177.80	2,245,028.22
租赁负债	34,955,947.25	2,814,381.92	42,189,278.51	2,741,955.01
金融资产公允价值变动			11,710,447.82	1,432,551.77
其他	1,355,648.75	288,622.49	1,870,743.49	342,036.32
合计	441,953,231.20	55,160,868.32	748,359,725.37	95,007,950.91

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	3,345,441.59	836,360.40	2,905,751.44	726,437.86
金融资产公允价值变动	76,741,346.00	11,957,183.80	27,812,237.21	4,644,368.19
使用权资产	33,735,379.81	2,714,744.13	41,469,287.17	2,680,344.42
内部交易未实现利润	7,878,386.78	1,969,596.70	7,878,386.78	1,969,596.70
固定资产计提折旧的时间性差异	16,484,773.34	3,461,803.49	19,061,034.60	4,002,817.41
其他	329,733.69	21,260.18		
合计	138,515,061.21	20,960,948.70	99,126,697.20	14,023,564.58

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	11,861,562.76	43,299,305.56	11,910,539.55	83,097,411.36
递延所得税负债	11,861,562.76	9,099,385.94	11,910,539.55	2,113,025.03

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	338,778,735.86	
可抵扣亏损	1,290,664,249.07	877,225,452.12
合计	1,629,442,984.93	877,225,452.12

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025		179,886.98	
2026	10,862,888.37	10,862,888.37	
2027	6,397,023.73	6,397,023.73	
2028	19,689,442.19	19,704,814.06	
2029	137,189,853.45	194,442,282.50	
2030	464,140,583.84	72,719,491.88	
2031	118,281,855.96	118,281,855.96	
2032	163,907,314.73	163,907,314.73	
2033	279,216,826.02	279,216,826.02	
2034	67,540,851.01	11,513,067.89	
2035	23,437,609.77		
合计	1,290,664,249.07	877,225,452.12	/

其他说明：

√适用 □不适用

2025 年 12 月 31 日确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异金额中含零税率子公司澜起昆山形成的可抵扣暂时性差异金额人民币 11,669,517.74 元(2024 年 12 月 31 日：人民币 46,021,265.91 元)。

本集团以未来期间很可能取得的用于抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损产生的递延所得税资产。

于 2025 年 12 月 31 日，与本公司之境外子公司可分配利润有关的应纳税暂时性差异为人民币 4,117,637,899.00 元(2024 年 12 月 31 日：人民币 3,234,811,417.05 元)。由于本公司预计这些暂时性差异在可预见的未来不会转回，故未就因分配这些暂时性差异而应付的所得税确认递延所得税负债。

30. 其他非流动资产

□适用 √不适用

31. 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资	8,204,000.00	8,204,000.00	其他		42,945,410.02	42,945,410.02	其他	

金								
合计	8,204,000.00	8,204,000.00	/	/	42,945,410.02	42,945,410.02	/	/

其他说明：

于 2025 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 2,000,000.00 元（2024 年 12 月 31 日：人民币 2,000,000.00 元）的履约保函保证金用于项目委托管理担保，质押期限至 2026 年 1 月 1 日。

于 2025 年 12 月 31 日，无履约保函保证金用于工程结算担保（2024 年 12 月 31 日：人民币 34,741,410.02 元）；于 2025 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 3,102,000.00 元（2024 年 12 月 31 日：人民币 3,102,000.00 元）的履约保函保证金用于工程竣工担保，质押期限至 2026 年 11 月 30 日；账面价值为人民币 3,102,000.00 元（2024 年 12 月 31 日：人民币 3,102,000.00 元）的履约保函保证金用于工程投产担保，质押期限至 2027 年 11 月 30 日。

32. 短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33. 交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34. 衍生金融负债

适用 不适用

35. 应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36. 应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	208,233,513.35	211,153,859.60
合计	208,233,513.35	211,153,859.60

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37. 预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	80,412.76	95,412.74
合计	80,412.76	95,412.74

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38. 合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	45,729.09	22,087,850.59
合计	45,729.09	22,087,850.59

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39. 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	238,977,136.70	702,202,739.29	649,549,232.48	291,630,643.51
二、离职后福利-设定提存计划	2,118,441.78	37,213,267.80	37,025,276.85	2,306,432.73
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	241,095,578.48	739,416,007.09	686,574,509.33	293,937,076.24

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	236,659,906.48	628,971,346.14	576,518,411.69	289,112,840.93
二、职工福利费		36,209,326.89	36,209,326.89	
三、社会保险费	1,173,889.60	19,418,864.29	19,303,620.55	1,289,133.34
其中：医疗保险费	1,115,205.79	18,908,649.40	18,798,681.22	1,225,173.97
工伤保险费	58,683.81	510,214.89	504,939.33	63,959.37
生育保险费				
四、住房公积金	1,142,975.00	17,597,166.32	17,511,861.32	1,228,280.00
五、工会经费和职工教育经费	365.62	6,035.65	6,012.03	389.24
合计	238,977,136.70	702,202,739.29	649,549,232.48	291,630,643.51

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,052,695.82	35,970,943.08	35,786,228.75	2,237,410.15
2、失业保险费	65,745.96	1,242,324.72	1,239,048.10	69,022.58
合计	2,118,441.78	37,213,267.80	37,025,276.85	2,306,432.73

其他说明：

√适用 □不适用

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，本集团按该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

40. 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	96,098,786.64	56,012,165.67
个人所得税	14,212,152.02	5,923,833.99
印花税	810,025.91	906,792.95
房产税	940,317.91	1,021,257.39
城镇土地使用税	20,177.28	20,177.28
合计	112,081,459.76	63,884,227.28

其他说明：

无

41. 其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	140,489,192.45	125,603,739.18
合计	140,489,192.45	125,603,739.18

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 应付股利

分类列示

□适用 √不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程建设支出	103,045,335.27	104,154,559.66
专业服务及咨询费	12,773,200.03	3,666,504.73
质保金	8,466,762.59	6,200,056.89
租赁保证金	3,050,680.80	2,727,506.95
销售佣金	2,123,577.89	230,945.68
代收代付政府人才补贴款	1,062,500.00	3,122,163.75
其他	9,967,135.87	5,502,001.52
合计	140,489,192.45	125,603,739.18

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42. 持有待售负债

适用 不适用

43. 1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	14,775,474.48	15,957,075.03
合计	14,775,474.48	15,957,075.03

其他说明：

无

44. 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45. 长期借款**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

46. 应付债券**(1). 应付债券**

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47. 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	19,362,711.49	28,798,720.21
合计	19,362,711.49	28,798,720.21

其他说明：

无

48. 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49. 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
现金结算的股权激励		19,593,000.00
合计		19,593,000.00

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50. 预计负债

适用 不适用

51. 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	92,023,333.33	46,710,000.00	59,846,786.78	78,886,546.55	
合计	92,023,333.33	46,710,000.00	59,846,786.78	78,886,546.55	/

其他说明：

适用 不适用

52. 其他非流动负债

适用 不适用

53. 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,144,789,273.00	1,637,248.00				1,637,248.00	1,146,426,521.00

其他说明：

2025 年，本公司因 1,637,248.00 份限制性股票行权而合计发行了 1,637,248.00 股 A 股普通股，新增股本为人民币 1,637,248.00 元，股本溢价为人民币 37,657,821.48 元。

54. 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55. 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,934,055,038.79	37,657,821.48		4,971,712,860.27
其他资本公积	691,914,859.71	450,389,804.68		1,142,304,664.39
合计	5,625,969,898.50	488,047,626.16		6,114,017,524.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动参见附注七、53 及 56 和股份支付附注十五。

56. 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	427,557,874.81	420,801,477.31		848,359,352.12
合计	427,557,874.81	420,801,477.31		848,359,352.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2025 年增加系实施股份回购计划，回购公司部分股份。

57. 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,179,313.58	439,690.15			109,922.54	329,767.61	2,509,081.19
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	2,179,313.58	439,690.15			109,922.54	329,767.61	2,509,081.19
企业自身信用风险公允价值变动							

二、将重分类进损益的其他综合收益	253,114,184.72	-114,502,426.79				-114,502,426.79		138,611,757.93
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	253,114,184.72	-114,502,426.79				-114,502,426.79		138,611,757.93
其他综合收益合计	255,293,498.30	-114,062,736.64			109,922.54	-114,172,659.18		141,120,839.12

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58. 专项储备

适用 不适用

59. 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	286,559,941.59	65,398,792.66		351,958,734.25
合计	286,559,941.59	65,398,792.66		351,958,734.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

60. 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,518,383,330.50	3,478,053,735.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,518,383,330.50	3,478,053,735.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,235,569,970.18	1,411,778,923.59
减：提取法定盈余公积	65,398,792.66	32,752,693.95
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	669,996,402.47	338,193,337.80
转作股本的普通股股利		

加：其他综合收益结转留存收益		-503,296.35
期末未分配利润	6,018,558,105.55	4,518,383,330.50

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61. 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,446,759,596.40	2,054,477,575.22	3,628,769,555.93	1,516,811,244.12
其他业务	9,557,187.23	6,483,513.13	10,141,512.36	6,803,694.42
合计	5,456,316,783.63	2,060,961,088.35	3,638,911,068.29	1,523,614,938.54

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
与客户之间的合同产生的收入	5,446,759,596.40	2,054,477,575.22	3,628,769,555.93	1,516,811,244.12
租赁收入	9,557,187.23	6,483,513.13	10,141,512.36	6,803,694.42
合计	5,456,316,783.63	2,060,961,088.35	3,638,911,068.29	1,523,614,938.54

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
互连类芯片	5,138,526,265.35	1,769,110,853.48
津逮®产品	308,233,331.05	285,366,721.74
按经营地分类		
境内	1,546,027,213.88	729,817,671.42
境外	3,900,732,382.52	1,324,659,903.80
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	5,446,759,596.40	2,054,477,575.22
合计	5,446,759,596.40	2,054,477,575.22

其他说明

√适用 □不适用

上述表格中“境内”指中国大陆及香港。

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品	交付时	按合同约定支付价款	销售互连类芯片或津逮®产品	是	无	法定质保
合计	/	/	/	/		/

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 45,729.09 元，其中：

45,729.09 元预计将于 2026 年度确认收入

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62. 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	24,928.44	
教育费附加	10,683.62	
房产税	3,761,271.64	4,080,477.80
土地使用税	31,101.12	73,482.90
印花税	2,810,587.72	2,171,088.65
地方教育费附加	7,122.41	
合计	6,645,694.95	6,325,049.35

其他说明：

无

63. 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	99,924,129.17	83,720,519.04
销售佣金	4,206,989.69	1,008,838.62
专业服务及咨询费	3,320,144.96	634,083.14
差旅费	2,952,772.56	2,797,050.12
折旧及摊销费	2,405,273.03	2,228,293.84
市场推广费	1,530,880.39	1,364,987.90
业务招待费	1,163,800.72	1,230,952.42
其他	4,724,667.99	3,021,825.00
合计	120,228,658.51	96,006,550.08

其他说明：

无

64. 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	422,110,031.18	113,609,262.01
折旧及摊销费	46,069,164.21	44,453,092.15
专业服务及咨询费	14,343,520.22	8,009,101.53
租赁费	5,760,056.16	6,853,942.82
办公及会议费	4,295,541.71	3,378,095.65
水电费	3,530,180.35	3,692,774.11
交通与通讯费	3,081,608.94	3,059,984.44
其他	27,097,742.12	13,206,247.53
合计	526,287,844.89	196,262,500.24

其他说明：

无

65. 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	626,982,077.17	533,204,296.99
工程开发费用	168,858,161.19	121,519,507.18
工具及许可证费	52,679,878.20	44,982,643.82
折旧及摊销费	48,458,631.13	44,110,253.08
专业服务及咨询费	4,109,188.63	4,017,584.40
外部服务费	3,261,875.89	6,504,885.21
其他	10,680,403.79	9,130,823.76
合计	915,030,216.00	763,469,994.44

其他说明：

无

66. 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-271,072,118.66	-229,985,802.58
租赁负债利息费用	1,732,176.80	1,512,598.38
汇兑损益	40,749,393.00	-12,311,885.43
其他	274,112.23	280,984.09
合计	-228,316,436.63	-240,504,105.54

其他说明：

无

67. 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	114,143,915.11	89,848,166.32
代扣代缴税金手续费返还	1,743,916.02	1,728,803.01
合计	115,887,831.13	91,576,969.33

其他说明：

无

68. 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-14,609,085.20	-6,548,133.03
处置长期股权投资产生的投资收益	965,387.45	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	321,961.41	89,659.10
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,449,504.20	1,578,173.20
处置交易性金融资产取得的投资收益	76,468,948.27	9,352,794.63
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	10,500,000.00	
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	603,498.92	536,228.24
结构性存款投资收益	21,247,409.26	43,565,571.03
理财产品投资收益	65,959.86	24,803.29
合计	97,013,584.17	48,599,096.46

其他说明：

无

69. 净敞口套期收益

适用 不适用

70. 公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	11,126,650.74	-7,431,002.05
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
其他非流动金融资产	14,767,410.40	31,319,573.25
合计	25,894,061.14	23,888,571.20

其他说明：

无

71. 信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-921,798.92	-464,514.83
合计	-921,798.92	-464,514.83

其他说明：

无

72. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	28,423,710.47	-44,443,090.77
合计	28,423,710.47	-44,443,090.77

其他说明：

无

73. 资产处置收益

□适用 √不适用

74. 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		5,170.00	
合计		5,170.00	

其他说明：

□适用 √不适用

75. 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	765,561.61		765,561.61
其中：固定资产处置损失	765,561.61		765,561.61
对外捐赠	441,972.50	279,692.50	441,972.50
其他	1,517.98	800.00	1,517.98
合计	1,209,052.09	280,492.50	1,209,052.09

其他说明：

无

76. 所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	144,257,559.33	68,575,579.29
递延所得税费用	46,674,544.17	3,306,146.28
合计	190,932,103.50	71,881,725.57

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,320,568,053.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	232,056,805.35
子公司适用不同税率的影响	-110,739,009.74
调整以前期间所得税的影响	628,933.02
非应税收入的影响	-1,221,830.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,020,669.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	153,075,441.99
研发费用加计扣除	-86,888,905.17
所得税费用	190,932,103.50

其他说明：

□适用 √不适用

77. 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78. 现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	317,785,134.20	198,056,474.11
政府补助	101,007,128.33	91,222,302.60
其他	5,496,018.32	6,069,005.53
合计	424,288,280.85	295,347,782.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
日常支出	196,690,762.51	158,923,953.82
合计	196,690,762.51	158,923,953.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回受限保证金	36,741,410.02	
合计	36,741,410.02	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付受限保证金	2,000,000.00	34,741,410.02
合计	2,000,000.00	34,741,410.02

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售库存股		297,691,636.52
合计		297,691,636.52

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购库存股	420,801,477.31	409,057,267.16
支付上市费用	20,983,117.92	
支付新租赁准则下租金	16,877,659.54	21,420,870.42
合计	458,662,254.77	430,478,137.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

79. 现金流量表补充资料

(4). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,129,635,949.96	1,340,736,124.50
加：资产减值准备	-28,423,710.47	44,443,090.77
信用减值损失	921,798.92	464,514.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,457,064.37	83,591,540.88
使用权资产摊销	15,692,392.75	14,777,647.32
无形资产摊销	26,670,492.39	26,061,498.83
长期待摊费用摊销	38,974,733.32	16,354,988.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	765,561.61	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-25,894,061.14	-23,888,571.20
财务费用（收益以“-”号填列）	42,481,569.80	-10,799,287.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-97,013,584.17	-48,599,096.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	39,688,183.26	6,358,655.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,986,360.91	-3,052,509.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-511,185,439.22	82,707,303.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-202,772,231.18	-116,226,221.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,645,671.13	219,542,830.31
股份支付	450,389,804.68	58,848,996.62
经营活动产生的现金流量净额	2,022,020,556.92	1,691,321,506.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,416,073,633.40	6,698,931,684.67
减：现金的期初余额	6,698,931,684.67	5,665,880,219.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,717,141,948.73	1,033,051,465.39

(5). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(6). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(7). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,416,073,633.40	6,698,931,684.67
其中：库存现金	7,628.60	5,928.60
可随时用于支付的银行存款	8,296,574,658.66	6,651,096,406.08
可随时用于支付的其他货币资金	119,491,346.14	47,829,349.99
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	8,416,073,633.40	6,698,931,684.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(8). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(9). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
应收利息	54,706,742.38	101,419,757.92	未实际收到
受限货币资金	8,204,000.00	42,945,410.02	保证金
合计	62,910,742.38	144,365,167.94	/

其他说明：

□适用 √不适用

80. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81. 外币货币性项目**(4). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	767,832,232.14	7.0288	5,396,939,193.27
港币	30,539,712.42	0.9032	27,583,468.26
韩元	529,204,858.00	0.0049	2,571,935.69
澳门元	1,486,934.80	0.8763	1,303,000.97
应收账款	-	-	

其中：美元	79,703,303.79	7.0288	560,218,581.68
其他应收款	-	-	
其中：美元	150,611.58	7.0288	1,058,618.67
应付账款	-	-	
其中：美元	27,480,495.85	7.0288	193,154,909.23
其他应付款	-	-	
其中：美元	2,587,232.27	7.0288	18,185,138.18

其他说明：

无

(5). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币
Montage Technology Holdings Company Limited	开曼群岛	美元
Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited	澳门	美元

82. 租赁

(1). 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 7,591,371.69 元

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 24,469,031.23(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
自用房产出租	9,557,187.23	
合计	9,557,187.23	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	7,146,559.05	9,703,307.47
第二年	7,572,093.47	9,030,379.77
第三年	6,596,396.94	7,949,536.33
第四年	4,672,897.50	6,716,674.18
第五年	3,408,290.04	4,914,408.40
五年后未折现租赁收款额总额	3,333,074.97	6,987,750.71

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明

无

83. 数据资源

□适用 √不适用

84. 其他

□适用 √不适用

八、研发支出

1. 按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	626,982,077.17	533,204,296.99
工程开发费用	168,858,161.19	121,519,507.18
工具及许可证费	52,679,878.20	44,982,643.82
折旧及摊销费	48,458,631.13	44,110,253.08
专业服务及咨询费	4,109,188.63	4,017,584.40
外部服务费	3,261,875.89	6,504,885.21
其他	10,680,403.79	9,130,823.76
合计	915,030,216.00	763,469,994.44
其中：费用化研发支出	915,030,216.00	763,469,994.44
资本化研发支出		

其他说明：

无

2. 符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

3. 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2. 同一控制下企业合并

适用 不适用

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	

澜起电子科技（昆山）有限公司	昆山	50,000.00	昆山	芯片研发及销售	100.00		设立
Montage Technology Holdings Company Limited	开曼群岛	5 万美元	开曼群岛	投资控股	100.00		同一控制下企业合并
澜起电子科技（上海）有限公司	上海	35,000.00	上海	芯片研发及销售	49.00	51.00	设立
澜起投资有限公司	上海	30,000.00	上海	股权投资及资产管理	100.00		设立
澜起电子科技（海南）有限公司	海南	1,000.00	海南	芯片研发及销售	100.00		设立
澜起创业投资（海南）有限公司	海南	20,000.00	海南	创业投资	100.00		设立
昆山澜起半导体有限公司	昆山	100.00	昆山	芯片研发及销售		100.00	设立
Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited	澳门	50 万澳门元	澳门	芯片研发及销售		100.00	同一控制下企业合并
Montage Hong Kong Holdings Company Limited	香港	1 港元	香港	投资控股		100.00	同一控制下企业合并
Montage Technology, Inc.	美国	-	美国	芯片研发及销售		100.00	同一控制下企业合并
MONT Acquisition Sub, Inc.	美国	10 美元	美国	投资控股		100.00	同一控制下企业合并
Montage, Inc.	美国	1 美元	美国	芯片研发及销售		100.00	设立
Montage Real Estate Holding I Limited (BVI)	英属维尔京群岛	1 美元	英属维尔京群岛	投资控股		100.00	设立
Montage Real Estate Holding I (Hong Kong) Limited	香港	1 港元	香港	投资控股		100.00	设立
蒙万实业发展（上海）有限公司	上海	1,500.00	上海	投资控股		100.00	设立
上海奚泰实业有限公司	上海	1,000.00	上海	自有物业管理		100.00	非同一控制下企业合并
上海华萃置业有限公司	上海	1,000.00	上海	自有物业管理		100.00	非同一控制下企业合并
Montage Real Estate Holding II Limited (BVI)	英属维尔京群岛	1 美元	英属维尔京群岛	投资控股		100.00	设立
Montage Real Estate Holding II (Hong Kong) Limited	香港	1 港元	香港	投资控股		100.00	设立
蒙特图实业发展（上海）有限公司	上海	40,000.00	上海	投资控股		100.00	设立
蒙西庐实业发展（上海）有限公司	上海	40,000.00	上海	自有物业管理		100.00	设立
上海木澜金思企业管理合伙企业（有限合伙）	上海	8,375.00	上海	股权投资		70.00	设立
Montage Semiconductor, Inc.	美国	-	美国	芯片研发及销售		100.00	设立
3955 Johns Creek Inc.	美国	-	美国	自有物业管理		100.00	设立

Montage Technology Holdings Inc.	美国	1 美元	美国	投资控股		100.00	设立
Montage Technology Holdings II Inc.	美国	1 美元	美国	投资控股		100.00	设立
上海澜起红利企业管理合伙企业（有限合伙）	上海	50,000.00	上海	股权投资	9.00	91.00	设立
澜起电子科技（珠海横琴）有限公司	珠海	13,350.00	珠海	芯片研发及销售	48.24		设立
西安澜起电子设计有限公司	西安	500.00	西安	芯片研发及销售		48.24	设立
澜起电子设计（上海）有限公司	上海	500.00	上海	芯片研发及销售		48.24	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

于 2025 年 12 月 31 日，本公司对澜起电子科技（珠海横琴）有限公司（以下简称“澜起横琴”）的持股比例为 48.24%，持有的表决权低于 50%，但基于本公司为澜起横琴最大单一股东，且能够决定澜起横琴董事会半数以上成员的当选，本公司管理层认为本公司能够对澜起横琴及其控股子公司西安澜起电子设计有限公司及澜起电子设计（上海）有限公司实施控制，并将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，本公司控股子公司澜起横琴进行增资扩股。澜起横琴注册资本由人民币 10,000 万元增加至人民币 13,350 万元，新增注册资本额为人民币 3,350 万元，本轮增资方合计增资人民币 10,050 万元。其中，本公司出资人民币 4,020 万元，认购澜起横琴新增注册资本人民币 1,340 万元。本次增资扩股完成后，公司对澜起横琴的持股比例由 51.00% 变更为 48.24%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	91,960,409.37	109,224,874.65
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-14,609,085.20	-6,548,133.03
--其他综合收益		
--综合收益总额	-14,609,085.20	-6,548,133.03

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

十一、 政府补助

1. 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2. 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	62,280,000.00	20,910,000.00		39,850,000.00		43,340,000.00	与收益相关
递延收益	29,743,333.33	25,800,000.00		19,996,786.78		35,546,546.55	与资产相关
合计	92,023,333.33	46,710,000.00		59,846,786.78		78,886,546.55	/

3. 计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	94,147,128.33	89,393,499.59
与资产相关	19,996,786.78	454,666.73
合计	114,143,915.11	89,848,166.32

其他说明：

无

十二、 与金融工具相关的风险

1. 金融工具的风险

适用 不适用

1. 金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下。

本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

由于货币资金及交易性金融资产中结构性存款的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收账款和其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面价值。

本集团在每一资产负债表日面临的信用风险敞口为向客户收取的总金额减去减值准备后的金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。本集团具有特定信用风险集中。于 2025 年 12 月 31 日，本集团应收账款的 48.62%（2024 年 12 月 31 日：31.69%）源于应收账款余额最大的客户，应收账款的 86.44%（2024 年 12 月 31 日：80.80%）源于应收账款余额前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物及其他信用增级。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、5 和 9。

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

已发生信用减值资产的定义

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团也会将其视为已发生信用减值。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

信用风险敞口

集团按照简化方法直接对应收账款以及按照通用方法对其他应收款计提未来 12 个月的预期信用损失，详见附注七、5 和 9。

于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，本集团无已逾期超过 30 天依然按照 12 个月预期信用损失对其计提减值准备的应收款项。

(2) 流动性风险

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2025年12月31日

	1年以内	1年至5年	合计
应付账款	208,233,513.35	-	208,233,513.35
其他应付款	140,489,192.45	-	140,489,192.45
一年内到期的非流动负债	14,787,099.61	-	14,787,099.61
租赁负债	-	21,458,178.67	21,458,178.67
合计	<u>363,509,805.41</u>	<u>21,458,178.67</u>	<u>384,967,984.08</u>

2024年12月31日

	1年以内	1年至5年	合计
应付账款	211,153,859.60	-	211,153,859.60
其他应付款	125,603,739.18	-	125,603,739.18
一年内到期的非流动负债	15,957,527.60	-	15,957,527.60
租赁负债	-	32,508,755.02	32,508,755.02
合计	<u>352,715,126.38</u>	<u>32,508,755.02</u>	<u>385,223,881.40</u>

(3) 市场风险

汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受汇率风险主要与美元等有关，除本公司的境内子公司昆山澜起半导体有限公司、澜起电子科技（上海）有限公司、澜起电子科技（珠海横琴）有限公司以及境外子公司主要以美元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。汇率变动可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响，并通过外汇远期合同等方式锁定汇率，控制汇率风险对本集团的影响。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益产生的影响。

2025年

	基准点 增加/（减少）%	净损益 增加/（减少）	股东权益合计 增加/（减少）
人民币对美元贬值	5.00	93,590,330.11	93,590,330.11
人民币对美元升值	(5.00)	(93,590,330.11)	(93,590,330.11)

2024年

	基准点	净损益	股东权益合计
--	-----	-----	--------

	增加/（减少）%	增加/（减少）	增加/（减少）
人民币对美元贬值	5.00	25,801,745.14	25,801,745.14
人民币对美元升值	(5.00)	(25,801,745.14)	(25,801,745.14)

2. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2025年度和2024年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指期末负债总额除以资产总额的比率。本集团于2025年12月31日的资产负债率为6%（2024年12月31日：7%），本集团管理层认为其符合本集团资本管理的要求。本集团于资产负债表日的杠杆比率如下：

	2025年	2024年
资产总额	13,748,147,352.18	12,218,911,386.38
负债总额	<u>876,991,502.11</u>	<u>822,405,821.47</u>
资产负债率	<u>6%</u>	<u>7%</u>

2. 套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3. 金融资产转移

(1). 转移方式分类

适用 不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	100,570,613.02	722,733,720.02		823,304,333.04
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	100,570,613.02	722,733,720.02		823,304,333.04
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	100,570,613.02			100,570,613.02
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款		722,733,720.02		722,733,720.02
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	27,755,580.30			27,755,580.30
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产		583,514,277.41		583,514,277.41
持续以公允价值计量的资产总额	128,326,193.32	1,306,247,997.43		1,434,574,190.75

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本集团持续第一层次公允价值计量项目主要包括非限售期内的上市的权益工具投资。以 2025 年最后一个交易日的活跃市场报价确定公允价值。

3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本集团持续第二层次公允价值计量项目主要为结构性存款及非上市权益投资。结构性存款的公允价值采用市场可获取的预期收益率预计未来现金流，并基于对预期风险水平的最佳估计所确定的利率折现确定公允价值。非上市权益投资的公允价值是参考近期融资价格或其他估值方法，如参考相同股权最近交易价格并考虑附带权利因素作为判断其公允价值的依据。

4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6. 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本报告期，本集团按公允价值计量的金融工具在各层次之间无重大转移。上年度，本集团持有的权益工具投资结束限售期，因此该权益投资的公允价值计量从第三层次转换到第一层次，合计金额约人民币 136,212,831.30 元；除该权益工具投资以外，本集团的其他金融资产的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9. 其他

适用 不适用

十四、 关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

适用 不适用

2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十

适用 不适用

3. 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳博升光电科技有限公司	联营公司

其他说明

□适用 √不适用

4. 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Intel Corporation 及其直接或间接控制的公司（以下简称“英特尔公司”）	其他
Alberti Holdings (Hong Kong) Limited	其他
Xi Yu Holdings Limited	其他

其他说明

截至 2024 年 6 月 13 日，Intel Corporation 的全资子公司 Intel Capital Corporation 持有公司股份超过 5%；自 2024 年 6 月 14 日起，Intel Capital Corporation 持有公司股份降至 5% 以下。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，自 2024 年 6 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日期间，Intel Capital Corporation 及 Intel Corporation 仍属于公司关联人；同时，公司根据实质重于形式的原则，认定在上述期间内英特尔公司均属于公司关联人。

5. 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
英特尔公司	采购商品和研发服务	69,425,229.51	300,000,000.00	否	213,677,091.46

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
英特尔公司	销售商品	-	727,836.26

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

“本期发生额”为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，公司与英特尔公司之间的交易发生额。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	35,552.91	5,849.45

本集团发生的关键管理人员薪酬包括采用货币支付的薪酬和股份支付费用等。

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6. 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	英特尔公司			86,260.80	431.30

(2). 应付项目

适用 不适用

(3). 其他项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预付款项	英特尔公司		1,327,251.80
预付款项	深圳博升光电科技有限公司	21,000,000.00	

7. 关联方承诺

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

2025 年 7 月，本公司与上海橙溪模梭企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“橙溪模梭”）共同向澜起电子科技（珠海横琴）有限公司（下称“澜起横琴”）合计增资人民币 10,050 万元，认购澜起横琴新增注册资本人民币 3,350 万元，其中：本公司出资人民币 4,020 万元，橙溪模梭出资人民币 6,030 万元。增资前，Alberti Holdings (Hong Kong) Limited 与 Xi Yu Holdings Limited 各自持有澜起横琴 6.65% 的股份，增资完成后，Alberti Holdings (Hong Kong) Limited 与 Xi Yu Holdings Limited 持有澜起横琴股份比例均变更为 4.98%。因 Alberti Holdings (Hong Kong) Limited、Xi Yu Holdings Limited 两家公司是由本公司董事、高级管理人员控制的企业，因此该交易构成 A 股上市规则认定的关联交易。

十五、 股份支付

1. 各项权益工具

(1). 明细情况

适用 不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
研发技术人员、市场销售人员、管理支持人员	908,200	23,622,282.00	1,637,248	39,295,069.48	1,658,964	39,789,421.64	1,319,909	36,844,477.69
核心高管	11,400,000	523,374,000.00						
合计	12,308,200	546,996,282.00	1,637,248	39,295,069.48	1,658,964	39,789,421.64	1,319,909	36,844,477.69

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限

研发技术人员、市场销售人员、管理支持人员	18.81-26.01	18-34 个月
核心高管	45.91	27-51 个月

其他说明
无

2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	核心高管及其他研发技术人员、市场销售人员、管理支持人员
授予日权益工具公允价值的确定方法	期权定价模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	每股普通股价值、行权价、到期年限、无风险利率、波动率、股息率
可行权权益工具数量的确定依据	分年度对公司业绩指标、个人业绩指标进行考核，以达到考核目标的激励对象所持有的数量为确定依据
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,142,304,664.39

其他说明
无

3. 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4. 本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
研发技术人员、市场销售人员、管理支持人员	110,362,992.75	
核心高管	340,026,811.93	-19,593,000.00
合计	450,389,804.68	-19,593,000.00

其他说明
无

5. 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

2025 年 12 月 26 日，本公司召开 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于公司<第三届董事会核心高管激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，并于同日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于向第三届董事会核心高管激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定将核心高管激励计划中已于 2024 年 10 月 31 日向 2 名激励对象授予的 1,140 万份股票增值权均变更为向其新增授予 1,140 万股限制性股票。因该部分激励工具变更的限制性股票授予日为 2025 年 12 月 26 日。本公司按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，共计人民币 259,619,132.00 元，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，共计人民币 359,544,000.00 元，两者之间的差额计入当期损益。

6. 其他

适用 不适用

十六、 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

	本期	上期
资本承诺	99,458,692.33	85,066,126.15
投资承诺	142,100,000.00	145,700,000.00
合计	241,558,692.33	230,766,126.15

2. 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

于资产负债表日，本集团并无须作披露的或有事项。

3. 其他

适用 不适用

十七、 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：亿元 币种：港元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	经香港联合交易所有限公司批准，本公司发行的 6,589.00 万股 H 股股票（行使超额配售权之前）于 2026 年 2 月 9 日在香港联合交易所有限公司主板挂牌并上市交易。本次全球发售的 H 股总数 6,589.00 万股（行使超额配售权之前），经扣除全球发售相关包销佣金、费用及估计开支后，在超额配售权行使之前，本公司收取的全球发售所得款项净额约为 69.05 亿港元。2026 年 2 月 10 日，本公司同意由整体协调人（代表国际包销商）悉数行使超额配售权，并于 2026 年 2 月 13 日完成 988.35 万股 H 股股份的发行。经扣除本公司就悉数行使超额配售权应付的包销佣金、费用及估计开支后，本公司收取的额外所得款项净额约为 10.43	79.48	

	亿港元。前述超额配售权悉数行使后，本次共计发行 7,577.35 万股 H 股股份。		
--	--------------------------------------------	--	--

2. 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	471,770,138.19
经审议批准宣告发放的利润或股利	471,770,138.19

3. 销售退回

适用 不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

资产负债表日后出售资产

2026 年 1 月，本公司宣布其全资子公司 Montage Technology Holdings Company Limited（以下简称“澜起开曼”）参股的 XConn Technologies Holdings, Ltd.（以下简称“XConn 公司”）收到 Marvell Technology, Inc.（以下简称“Marvell”）要约，Marvell 拟收购 XConn 公司全部股权。经 Marvell 与 XConn 公司董事会协商一致，已签署《Agreement and Plan of Reorganization》。经研究决定，本公司同意本次交易并与 Marvell 签署《Support Agreement》。XConn 公司股东享有的交易总对价以 5.4 亿美元为基准，并将按协议约定的对价调整机制进行调整。本公司对该股权的交易对价预计为 5,800 万美元-6,500 万美元。本次交易前，澜起开曼持有 XConn 公司全面摊薄后的股权比例为 13.075%；本次交易完成后，澜起开曼将不再持有 XConn 公司的股权。

十八、 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

2. 重要债务重组

适用 不适用

3. 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4. 年金计划

适用 不适用

5. 终止经营

适用 不适用

6. 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团是一家全球领先的无晶圆厂集成电路设计公司，致力于为云计算及 AI 基础设施提供创新、可靠及高能效的互连解决方案，目前主要包括两大产品线，为互连类芯片产品线以及津逮®产品线，本集团将其设为一个分部。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	614,601,810.19	222,936,138.65
合计	614,601,810.19	222,936,138.65

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	614,601,810.19	100.00			614,601,810.19	222,936,138.65	100.00			222,936,138.65
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	614,601,810.19	100.00			614,601,810.19	222,936,138.65	100.00			222,936,138.65
合计	614,601,810.19	/		/	614,601,810.19	222,936,138.65	/		/	222,936,138.65

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收合并范围内公司 款项组合	614,601,810.19		
合计	614,601,810.19		

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

本公司应收账款为应收本公司子公司款项, 预计可以收回, 因此不计提坏账准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产 期末余额	应收账款和合同资 产期末余额	占应收账款和合同 资产期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
第一名	609,610,363.87		609,610,363.87	99.19	
第二名	4,991,446.32		4,991,446.32	0.81	
合计	614,601,810.19		614,601,810.19	100.00	

其他说明

无

其他说明:

适用 不适用

2. 其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	545,205.48	
应收股利	100,000,000.00	40,000,000.00
其他应收款	1,554,661,018.52	1,247,570,989.98
合计	1,655,206,224.00	1,287,570,989.98

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
澜起电子科技（珠海横琴）有限公司	545,205.48	
合计	545,205.48	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(6). 应收股利**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
澜起电子科技（昆山）有限公司	100,000,000.00	
澜起投资有限公司		40,000,000.00
合计	100,000,000.00	40,000,000.00

(7). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(8). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(9). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(10). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(11). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	514,838,759.43	259,917,816.24
1 至 2 年	227,521,721.06	93,604,324.27
2 至 3 年	73,281,688.56	346,453,588.24
3 年以上	739,018,849.47	547,595,261.23
合计	1,554,661,018.52	1,247,570,989.98

(12). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方资金拆借	1,006,891,507.64	1,075,891,507.64
合并范围内关联方往来	547,550,963.88	171,383,958.22
押金、保证金	218,547.00	295,524.12
合计	1,554,661,018.52	1,247,570,989.98

(13). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(14). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(15). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(16). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
澜起电子科技(上海)有限公司	633,091,250.84	40.72	合并范围内关联方资金拆借及往来	1年以内-3年以上	
上海奚泰实业有限公司	567,381,507.64	36.50	合并范围内关联方资金拆借	1-3年以上	
蒙西庐实业发展(上海)有限公司	245,691,672.98	15.80	合并范围内关联方资金拆借及往来	1年以内-2年	
澜起创业投资(海南)有限公司	53,023,743.02	3.41	合并范围内关联方资金拆借及往来	1年以内-2年	
澜起电子科技(珠海横琴)有限公司	20,125,128.67	1.29	合并范围内关联方资金拆借及往来	1年以内	
合计	1,519,313,303.15	97.72	/	/	

(17). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3. 长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,147,534,636.95	10,000,000.00	3,137,534,636.95	3,085,299,188.13	10,000,000.00	3,075,299,188.13
合计	3,147,534,636.95	10,000,000.00	3,137,534,636.95	3,085,299,188.13	10,000,000.00	3,075,299,188.13

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额(账面价值)	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

Montage Technology Holdings Company Limited	1,852,719,188.13		22,035,448.82			1,874,754,636.95	
澜起电子科技（昆山）有限公司	500,000,000.00					500,000,000.00	
澜起投资有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
澜起电子科技（上海）有限公司	171,500,000.00					171,500,000.00	
澜起创业投资（海南）有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
澜起电子科技（海南）有限公司		10,000,000.00					10,000,000.00
澜起电子科技（珠海横琴）有限公司	51,080,000.00		40,200,000.00			91,280,000.00	
合计	3,075,299,188.13	10,000,000.00	62,235,448.82			3,137,534,636.95	10,000,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

4. 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	911,311,991.05	24,573,226.47	547,176,613.67	13,934,962.81
其他业务	9,158,617.12	8,966,705.99	10,189,614.40	9,038,309.40
合计	920,470,608.17	33,539,932.46	557,366,228.07	22,973,272.21

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
按经营地区分类		
境外	911,311,991.05	24,573,226.47
合同类型		
IP 授权-按计件模式	911,311,991.05	24,573,226.47
按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	911,311,991.05	24,573,226.47
合计	911,311,991.05	24,573,226.47

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

5. 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	40,000,000.00
结构性存款投资收益	10,980,575.83	25,371,397.25
合计	110,980,575.83	65,371,397.25

其他说明：

无

6. 其他

适用 不适用

二十、 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	199,825.84	第八节 七、68、75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	114,143,915.11	第八节 七、67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	112,863,009.41	第八节 七、68、70
委托他人投资或管理资产的损益	2,440,924.39	第八节 七、68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443,490.48	第八节 七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,991,325.28	主要为结构性存款收益
减：所得税影响额	30,213,409.24	
少数股东权益影响额（税后）	8,040,865.07	

合计	213,941,235.24
----	----------------

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.25	1.97	1.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.50	1.78	1.77

3. 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4. 其他

适用 不适用

董事长：杨崇和

董事会批准报送日期：2026 年 3 月 30 日

修订信息

适用 不适用

公司代码：688008

公司简称：澜起科技

澜起科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要



第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。

2. 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4. 公司全体董事出席董事会会议。

5. 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6. 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每10股派发现金红利人民币3.90元（含税）。截至2026年2月28日，公司的总股本1,222,200,021股，其中A股回购专用账户的股数为12,533,000股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为1,209,667,021股，以此计算合计拟派发现金红利471,770,138.19元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

公司2025年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。该分配方案经公司第三届董事会第十次会议审议通过，实际派发现金红利226,856,066.00元（含税）。2025年中期利润分配方案已于2025年10月实施完毕。此外，2025年度公司以现金为对价，通过集中竞价方式回购股份金额为420,723,405.89元（不含佣金、过户费等交易费用）。

综上，本年度公司现金分红（含回购）的合计为1,119,349,610.08元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为50.07%。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8. 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况**1. 公司简介****1.1 公司股票简况**

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	澜起科技	688008	/
H股	香港联合交易所主板	澜起科技	6809	/

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅晓	孔旭
联系地址	上海市徐汇区漕宝路 181 号和光天地 16 层	上海市徐汇区漕宝路 181 号和光天地 16 层
电话	021-5467 9039	021-5467 9039
传真	021-5426 3132	021-5426 3132
电子信箱	ir@montage-tech.com	ir@montage-tech.com

2. 报告期公司主要业务简介**2.1 主要业务、主要产品或服务情况**

澜起科技是一家全球领先的无晶圆厂集成电路设计公司，致力于为云计算及 AI 基础设施提供创新、可靠及高能效的互连解决方案。目前我们拥有两大产品线，互连类芯片和津逮®产品。我们的互连类芯片主要包括内存接口芯片、内存模组配套芯片、PCIe Retimer 芯片、CXL MXC 芯片及时钟芯片等。津逮®产品主要包括津逮®CPU 及数据保护和可信计算加速芯片等。下图列示我们产品的功能及主要应用。

	主要产品	功能介绍	主要应用
互连类芯片			
内存互连芯片	RCD、DB、MRCD、MDB、CKD	<ul style="list-style-type: none"> 作为服务器CPU存取内存数据的通路，提升内存数据访问的速度及可靠性 	服务器及PC内存模组
	SPD、PMIC、TS	<ul style="list-style-type: none"> 内存模组配套芯片，用于实现系统主控设备与内存模组上组件之间的通信管理、内存模组上其他芯片的电源管理、内存模组温度监控等功能 	
PCIe/CXL互连芯片	PCIe Retimer	<ul style="list-style-type: none"> 主要用于解决在高速、远距离传输场景中时序不齐、衰减、完整性差等信号问题 	服务器
	CXL MXC	<ul style="list-style-type: none"> 用于内存池化及内存扩展 	服务器
时钟芯片	时钟发生器芯片、时钟缓冲芯片、展频振荡器	<ul style="list-style-type: none"> 用于为系统中的各类设备提供精准的时钟脉冲信号，确保系统正常运行 	广泛应用于各类电子系统
津逮®产品			
津逮®产品	津逮®CPU	<ul style="list-style-type: none"> 津逮®CPU是具有PrC（预检测）或DSC（动态安全检查）功能的x86架构CPU 	服务器
	数据保护和可信计算加速芯片	<ul style="list-style-type: none"> 用于解决数据中心等高并发数据加解密运算的需求 	服务器

➤ 互连类芯片产品线

一、 内存互连芯片

(1) 内存接口芯片（RCD/DB、MRCD/MDB 及 CKD）

内存接口芯片是服务器内存模组（又称“内存条”）的核心逻辑器件，作为服务器 CPU 存取内存数据的必由通路，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。内存接口芯片需与内存厂商生产的各种内存颗粒和内存模组进行配套，并通过服务器 CPU、内存和 OEM 厂商针对其功能和性能（如稳定性、运行速度和功耗等）的全方位严格认证，才能进入大规模商用阶段。因此，研发此类产品不仅要攻克内存接口的核心技术难关，还要跨越服务器生态系统的高准入门槛。

● RCD/DB 芯片

DDR4 及 DDR5 内存接口芯片按功能可分为两类：一是寄存时钟缓冲器（RCD），用来缓冲来自内存控制器的地址、命令、时钟、控制信号；二是数据缓冲器（DB），用来缓冲来自内存控制器或内存颗粒的数据信号。RCD 与 DB 组成套片，可实现对地址、命令、时钟、控制信号和数据信号的全缓冲。仅采用了 RCD 芯片对地址、命令、时钟、控制信号进行缓冲的内存模组通常称为 RDIMM（寄存双列直插内存模组），而采用了 RCD 和 DB 套片对地址、命令、时钟、控制信号及数据信号进行缓冲的内存模组称为 LRDIMM（减载双列直插内存模组）。

澜起科技凭借其自主知识产权的高速、低功耗技术，长期致力于为新一代服务器平台提供符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案。随着 JEDEC 标准和内存技术的发展演变，我们先后推出了 DDR2-DDR5 系列内存接口芯片，可应用于各种缓冲式内存模组，包括 RDIMM 及 LRDIMM

等，满足高性能服务器对高速、大容量的内存系统的需求。我们的 DDR4 及 DDR5 内存接口芯片广泛应用于国际主流内存、服务器和云计算领域，并占据全球市场的重要份额。



图：RCD/DB 芯片及含 RCD/DB 芯片的 DDR5 LRDIMM 内存模组示意图

我们的 DDR4 内存接口芯片子代产品及其主要应用情况如下：

DDR4 内存接口芯片	主要应用
Gen1.0 DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2133
Gen1.0 DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2133
Gen1.5 DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2400
Gen1.5 DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2400
Gen2 DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2666
Gen2 DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2666
Gen2 Plus DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM、LRDIMM 和 NVDIMM，支持速率达 DDR4-3200
Gen2 Plus DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM，支持速率达 DDR4-3200

当前，DDR5 内存模组已取代 DDR4 成为市场主流产品。DDR5 是 JEDEC 标准定义的第 5 代双倍速率同步动态随机存取存储器标准。与 DDR4 相比，DDR5 采用了更低的工作电压（1.1V），同时在传输有效性和可靠性上又迈进了一步，最新推出的 DDR5 第五子代 RCD 芯片支持速率可达 8000MT/s，是 DDR4 最高速率（3200MT/s）的 2.5 倍。

我们的 DDR5 内存接口芯片子代产品及其主要应用情况如下：

DDR5 内存接口芯片	主要应用
Gen1.0 DDR5 RCD 芯片	DDR5 RDIMM 和 LRDIMM，支持速率达 DDR5-4800
Gen1.0 DDR5 DB 芯片	DDR5 LRDIMM，支持速率达 DDR5-4800
Gen2.0 DDR5 RCD 芯片	DDR5 RDIMM，支持速率达 DDR5-5600
Gen3.0 DDR5 RCD 芯片	DDR5 RDIMM，支持速率达 DDR5-6400
Gen4.0 DDR5 RCD 芯片	DDR5 RDIMM，支持速率达 DDR5-7200
Gen5.0 DDR5 RCD 芯片	DDR5 RDIMM，支持速率达 DDR5-8000

① DDR5 第一子代 RCD 芯片支持双通道内存架构，命令、地址、时钟和控制信号 1: 2 缓冲，并提供奇偶校验功能。该芯片符合 JEDEC 标准，支持 DDR5-4800 速率，采用 1.1V 工作电压，更为节能。该款芯片除了可作为中央缓冲器单独用于 RDIMM 之外，还可以与 DDR5 DB 芯片组成套片，用于 LRDIMM，以提供更高容量、更低功耗的内存解决方案。

② DDR5 第一子代 DB 芯片是一款 8 位双向数据缓冲芯片，该芯片与 DDR5 RCD 芯片一起组成套片，用于 DDR5 LRDIMM。该芯片符合 JEDEC 标准，支持 DDR5-4800 速率，采用 1.1V 工作电压。在 DDR5 LRDIMM 应用中，一颗 DDR5 RCD 芯片需搭配十颗 DDR5 DB 芯片，即每个子通道配置五颗 DB 芯片，以支持片上数据校正，并可将数据预取提升至最高 16 位，从而为高端多核服务器提供更大容量、更高带宽和更强性能的内存解决方案。

③ 2022 年 5 月，公司在业界率先试产 DDR5 第二子代 RCD 芯片。DDR5 第二子代 RCD 芯片支持双通道内存架构，命令、地址、时钟和控制信号 1: 2 缓冲，并提供奇偶校验功能。该芯片符合 JEDEC 标准，支持数据速率为 5600MT/s，采用 1.1V 工作电压，更为节能。

④ 2023 年 10 月，公司在业界率先试产 DDR5 第三子代 RCD 芯片。DDR5 第三子代 RCD 芯片支持的数据速率高达 6400MT/s，较第二子代 RCD 速率提升 14.3%，较第一子代 RCD 速率提升 33.3%。

⑤ 2024 年 1 月，公司推出 DDR5 第四子代 RCD 芯片。DDR5 第四子代 RCD 芯片支持的数据速率高达 7200MT/s，较第三子代 RCD 速率提升 12.5%，较第一子代 RCD 速率提升 50%。

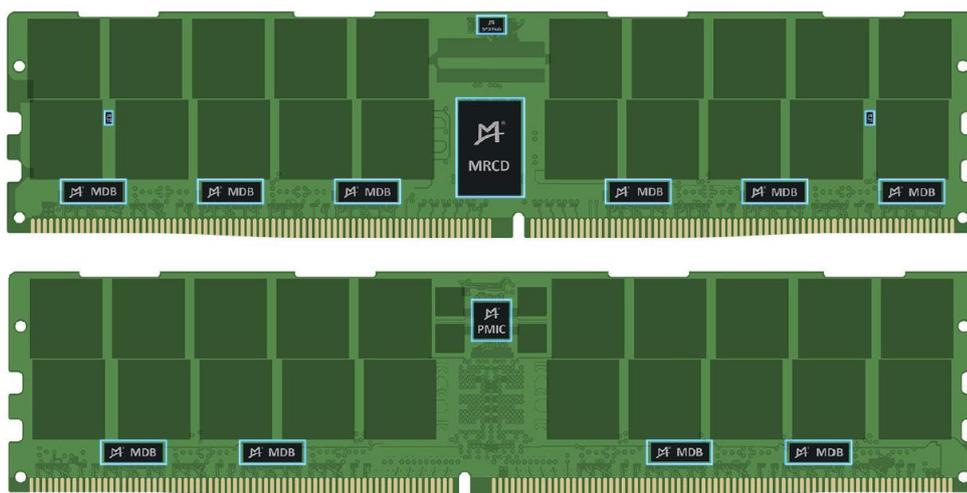
⑥ 2024 年第四季度，公司推出 DDR5 第五子代 RCD 芯片。DDR5 第五子代 RCD 芯片支持的数据速率高达 8000MT/s，较第四子代 RCD 速率提升 11.1%，较第一子代 RCD 速率提升 66.7%。

• MRCD/MDB 芯片

MRCD/MDB 芯片是服务器高带宽内存模组 MRDIMM 的核心逻辑器件。随着 AI 及大数据应用的发展以及相关技术的演进，服务器 CPU 的内核数量快速增加，对内存系统带宽的需求也日益迫切，以满足多核 CPU 中各个内核的数据吞吐要求，MRDIMM 正是基于这种应用需求而开发的。作为一种更高带宽的内存模组，第一子代 MRDIMM 支持 8800MT/s 速率，第二子代产品支持 12800MT/s 速率，每根 MRDIMM 模组均需要搭配 1 颗 MRCD、10 颗 MDB、1 颗 SPD、2 颗 TS 以及 1 颗 PMIC 芯片。

MRDIMM 的工作原理如下：MDB 芯片用来缓冲来自内存控制器或 DRAM 内存颗粒的数据信号，在标准速率下，通过 MDB 芯片可以同时访问两个 DRAM 内存阵列（而传统 RDIMM 只能访问一个阵列），从而实现双倍带宽。MRCD 则用来缓冲来自内存控制器的地址、命令、时钟、控制信号。MRDIMM 的特点和优势包括：①使用常规的 DRAM 颗粒；②与现有 DDR5 生态系统有良好的适配性；③能够大幅提升内存模组的带宽。

我们的 DDR5 第一子代 MRCD/MDB 芯片于 2024 年开始在行业规模试用。我们的第二子代 MRCD/MDB 芯片已成功向全球主要内存厂商送样，该芯片最高支持 12800MT/s 传输速率，旨在为下一代计算平台提供卓越的内存性能，满足云计算和人工智能等应用场景对内存带宽的迫切需求。



图：MRCD/MDB 芯片及含 MRCD/MDB 芯片的 MRDIMM 内存模组示意图

我们的 DDR5 高带宽内存接口芯片（MRCD/MDB）及其主要应用情况如下：

DDR5 高带宽内存接口芯片	主要应用
Gen1.0 DDR5 MRCD 芯片	DDR5 MRDIMM/MCRDIMM，支持速率达 DDR5-8800
Gen1.0 DDR5 MDB 芯片	DDR5 MRDIMM/MCRDIMM，支持速率达 DDR5-8800
Gen2.0 DDR5 MRCD 芯片	DDR5 MRDIMM，支持速率达 DDR5-12800
Gen2.0 DDR5 MDB 芯片	DDR5 MRDIMM，支持速率达 DDR5-12800

从下游应用来看，预计 MRDIMM 将在云计算、AI 等对内存带宽敏感的应用领域有较大的需求。随着 MRDIMM 未来渗透率的提升，MRCD/MDB（尤其是 MDB）芯片的需求也将大幅增长。

• CKD 芯片

在 DDR4 世代及 DDR5 世代初期，时钟驱动功能集成在 RCD 芯片中，用于服务器内存模组，尚未在 PC 端内存模组（如台式机和笔记本电脑）部署。随着 DDR5 传输速率持续提升，时钟信号频率越来越高，信号完整性问题愈发显著。根据 JEDEC 定义，当 DDR5 数据速率达到 6400MT/s 及以上时，PC 端内存模组需引入专用的时钟驱动器（CKD，即“Clock Driver”）芯片，对时钟信号进行缓冲和重新驱动，以满足高速时钟信号的完整性和可靠性要求。

我们的 DDR5 第一子代 CKD 芯片最高支持 7200MT/s 速率，旨在提高 PC 端内存模组的数据访问速度和稳定性，以匹配不断增长的 CPU 运行速度和性能需求。该芯片符合最新的 JEDEC 标准，支持双边带总线地址访问及 I²C、I³C 接口。通过配置寄存器控制字，该芯片可改变其输出信号特性以匹配不同 DIMM 的网络拓扑，并可通过禁用未使用的输出信号以降低功耗。报告期内，我们推出新一代 CKD 芯片，最高支持 9200MT/s 速率，可有效优化客户端内存子系统性能，为下一代高性能 PC、笔记本电脑及工作站提供关键技术支撑。



图：CKD 芯片及含 CKD 芯片的 CUDIMM 内存模组示意图

公司 DDR5 时钟驱动器芯片及其主要应用情况如下：

DDR5 时钟驱动器芯片	主要应用
Gen1.0 DDR5 CKD 芯片	DDR5 UDIMM/CUDIMM/CAMM，最高支持速率达 DDR5-7200
Gen1.0 Plus DDR5 CKD 芯片	DDR5 UDIMM/CUDIMM/CAMM，最高支持速率达 DDR5-9200

由于 AI PC 需要更高内存带宽以提升整体运算性能，AI PC 渗透率的提升预计将加速 DDR5 的子代迭代，并推动对更高速率 DDR5 内存的需求。因此，AI PC 应用的普及将助推 CKD 芯片的需求提升。

（2）内存模组配套芯片（SPD、TS、PMIC）

根据 JEDEC 标准，DDR5 内存模组上除了内存颗粒及内存接口芯片外，还需要三种配套芯片，分别是串行检测集线器（SPD）、温度传感器（TS）以及电源管理芯片（PMIC）。

我们的内存模组配套芯片产品及其主要应用情况如下：

内存模组配套芯片	主要应用
DDR5 SPD	DDR5 RDIMM、LRDIMM、MRDIMM/MCRDIMM、UDIMM、SODIMM、CUDIMM、CSODIMM、CAMM 和 LPCAMM
DDR5 TS	DDR5 RDIMM、LRDIMM 和 MRDIMM/MCRDIMM
DDR5 PMIC	DDR5 RDIMM 和 LRDIMM

• 串行检测集线器（SPD）

我们与合作伙伴共同研发了 DDR5 串行检测集线器（SPD），芯片内部集成了 8Kbit EEPROM、I²C/I³C 总线集线器（Hub）和温度传感器（TS），适用于 DDR5 系列内存模组（如 LRDIMM、RDIMM、MRDIMM、UDIMM、SODIMM、CUDIMM、CSODIMM、CAMM 和 LPCAMM 等），应用范围包括服务器、台式机及笔记本内存模组。SPD 是 DDR5 内存模组不可或缺的组件，也是内存管理系统的关键组成部分，其包含如下几项功能：

第一，其内置的 SPD EEPROM 是一个非易失性存储器，用于存储内存模组的相关信息以及模组上内存颗粒和相关器件的所有配置参数。根据 JEDEC 的内存规范，每个内存模组都需配置一个 SPD 器件，并按照 JEDEC 规范的数据结构编写 SPD EEPROM 的内容。主板 BIOS 在开机后会读取 SPD 内存储的信息，并根据读取到的信息来配置内存控制器和内存模组。DDR5 SPD 数据可通过 I²C/I³C 总线访问，并可按存储区块（block）进行写保护，以满足 DDR5 内存模组的高速率和安全要求。

第二，该芯片还可以作为 I²C/I³C 总线集线器，一端连接系统主控设备（如 CPU 或基板管理控制器（BMC）），另一端连接内存模组上的本地组件，包括 RCD、PMIC 和 TS，是系统主控设备与内存模组上组件之间的通信中心。在 DDR5 规范中，一个 I²C/I³C 总线上最多可连接 8 个集线器（8 个内存模组），每个集线器和该集线器管理下的每个内存模组上的本地组件都被指定了一个特定的地址代码，支持唯一地址固定寻址。

第三，该芯片还内置了温度传感器（TS），可连续监测 SPD 所在位置的温度。主控设备可通过 I²C/I³C 总线从 SPD 中的相关寄存器读取传感器检测到的温度，以便于进行内存模组的温度管理，提高系统工作的稳定性。

• 温度传感器（TS）

我们与合作伙伴共同研发了 DDR5 高精度温度传感器（TS）芯片，该芯片符合 JEDEC 规范，支持 I²C 和 I³C 串行总线，适用于 DDR5 服务器内存模组（如 RDIMM、LRDIMM 和 MRDIMM）。TS 作为 SPD 芯片的从设备，可以工作在时钟频率分别高达 1MHz I²C 和 12.5MHz I³C 总线上；CPU 可经由 SPD 芯片与之进行通讯，从而实现对内存模组的温度管理。TS 是 DDR5 服务器内存模组上重要组件，通常一条内存模组配置 2 颗 TS。

• 电源管理芯片（PMIC）

我们的 DDR5 电源管理芯片（PMIC）符合 JEDEC 规范，其作用主要是为内存模组上的其他芯片（如 DRAM、RCD、DB、SPD 和 TS 等）提供电源支持，CPU 可经由 SPD 芯片与之进行通讯，从而实现电源管理。

我们的 DDR5 SPD、TS、PMIC 芯片在内存模组中的位置示意图如下：



2. PCIe/CXL 互连芯片

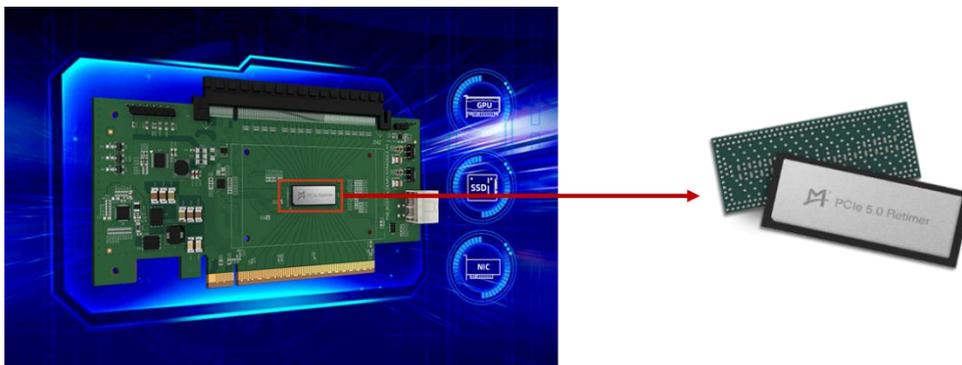
(1) PCIe Retimer 芯片

PCIe Retimer 芯片是适用于 PCIe 高速数据传输协议的超高速时序整合芯片。近年来，随着 PCIe 协议从 3.0（8 GT/s）发展至 4.0（16 GT/s）、5.0（32 GT/s），并逐步迈向 6.0（64 GT/s）和 7.0（128 GT/s），数据传输速率的不断翻倍带来了显著的信号衰减和参考时钟时序重整问题，这些问题极大地限制了 PCIe 协议在下一代计算平台的应用范围，促使行业加大对高速电路与系统互连设计的优化需求，同时也推动了在超高速传输环境下保持信号完整性的研发工作。

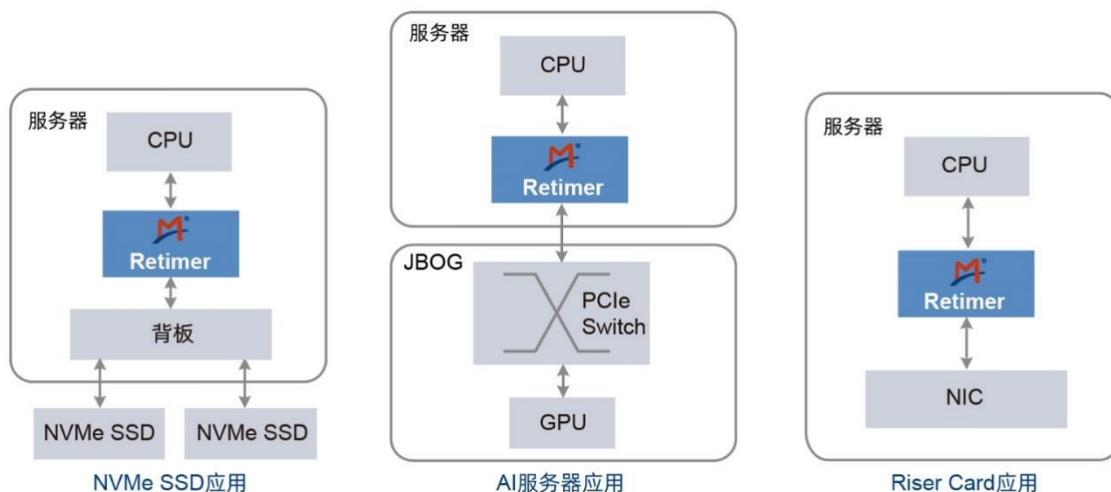
为了补偿高速信号的损耗、提升信号质量，超高速时序整合芯片（Retimer）应用而生。目前，PCIe Retimer 芯片已成为高速电路中不可或缺的重要器件，尤其在数据中心的数据高速、远距离传输场景中，可有效解决信号时序不齐、损耗严重、完整性差等问题。

PCIe Retimer 芯片采用先进的信号调理技术，能够补偿信道损耗并消除各种抖动源的影响，从而提升信号完整性，增加高速信号的有效传输距离，为服务器、存储设备及硬件加速器等应用场景提供可扩展的高性能 PCIe 互连解决方案。我们量产的 PCIe Retimer 产品组合包括 PCIe 4.0 Retimer 及 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer。其中，PCIe 4.0 Retimer 芯片符合 PCIe 4.0 基本规范，支持 16 GT/s 的传输速率，可补偿高达 28 dB 的信道损耗；PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 符合 PCIe 5.0 和 CXL 2.0 基本规范，支持 32 GT/s 的传输速率，可补偿高达 36 dB 的信道损耗，支持业界主流封装，其功耗、传输延时等关键性能指标达到国际先进水平，并已与 CPU、PCIe 交换芯片、固态硬盘、GPU 及网卡等进行了广泛的互操作测试。报告期内，我们推出了 PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer 芯片，支持 64 GT/s 的传输速率，采用 PAM4 SerDes 技术，支持高达 43 dB 的链路预算，可用于通用及 AI 服务器、有源线缆（AEC）和存储系统等典型应用场景。

我们的 PCIe Retimer 芯片及其对应板卡的示意图如下：



PCIe Retimer 芯片的典型应用场景图示如下：



我们的 PCIe Retimer 芯片及其主要应用情况如下：

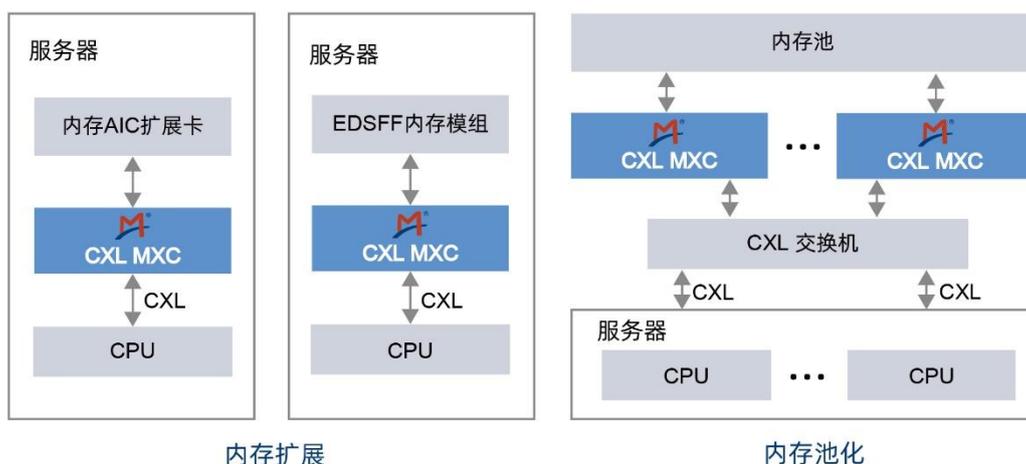
PCIe Retimer 芯片	主要应用场景
8 通道 PCIe 4.0 Retimer	服务器、存储设备和硬件加速器
16 通道 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer	服务器、存储设备和硬件加速器
16 通道 PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer	服务器、存储设备和硬件加速器

在人工智能时代，AI 服务器需求迅猛增长，PCIe Retimer 芯片的重要性日益突出。以配置 8 块 GPU 的典型 AI 服务器为例，通常需要 8 至 16 颗 PCIe Retimer 芯片；部分国产 AI 服务器为满足扩展的需求，配置了 24 颗 PCIe Retimer 芯片。随着 AI 服务器需求量持续攀升，以及 PCIe 协议传输速率不断升级，PCIe Retimer 芯片的市场空间也将进一步扩大。

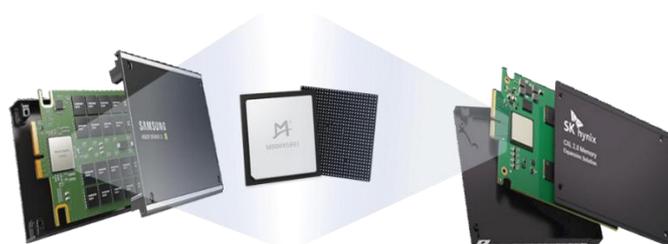
(2) CXL MXC 芯片

MXC 芯片是一款 CXL 内存扩展控制器芯片，属于 CXL 协议所定义的第三种设备类型。该芯片可为 CPU 及基于 CXL 协议的设备提供高带宽、低延迟的高速互连解决方案，实现 CPU 与各 CXL 设备间的内存共享，在大幅提升系统性能的同时，显著降低软件堆栈复杂性和数据中心总体拥有成本（TCO）。

MXC 芯片主要应用于内存扩展及内存池化领域，为内存 AIC 扩展卡、背板及 EDSFF 内存模组而设计，可大幅扩展内存容量和带宽，满足云计算、人工智能等数据密集型应用日益增长的需求，典型应用场景如下：



MXC 芯片目前的产品应用形态主要有两种：EDSFF 模组、AIC(Add In Card)连接标准 DDR5/4 内存模组。



产品应用形态一：EDSFF 模组



产品应用形态二：AIC (Add In Card) 连接标准 DDR5/4 内存模组

2022 年 5 月，我们发布了全球首款 CXL MXC 芯片，并支持三星电子、SK 海力士等内存厂商推出相关 CXL 内存产品，加速下一代存储器解决方案的商用化进程。目前，我们的 MXC 芯片已顺利通过 CXL 联盟的数十项严苛测试，列入 CXL 1.1 和 CXL 2.0 的合规供应商清单，保持在该领域的领先地位。报告期内，我们推出了 CXL 3.1 MXC 芯片，采用自研的 PCIe® 6.2 物理层接口，支持最高 64 GT/s 的传输速率 (x8 通道)，内置双通道 DDR5 内存控制器，支持速率高达 8000 MT/s。

我们与 CPU/GPU 厂商、DRAM 内存厂商、云服务提供商（CSP）、服务器 OEM/ODM 厂商等生态伙伴共同合作，以推动 CXL 技术获得更广泛的应用。

人工智能、云计算的快速发展，对突破内存瓶颈提出了迫切需求，推动业界加快部署内存扩展、内存池化等 CXL 技术的典型应用。在人工智能领域，CXL 技术通过支持 GPU 和 FPGA 等加速器与 CPU 的高效协作，可显著提升 AI 训练和推理效率，并提供低延迟、高带宽的数据传输；同时，CXL 技术支持内存扩展和内存共享，为 AI 应用提供更大容量、更灵活调配的内存资源。因此，CXL 内存将成为人工智能时代最具前景的内存解决方案之一。

3. 时钟芯片

时钟芯片是为电子系统提供其必要的时钟脉冲的芯片。在数字系统中，时钟脉冲是集成电路运转的节拍器，在电子系统中扮演着“心脏”的重要角色。时钟芯片为不同的芯片和功能模块提供统一的时序基准，确保系统各部件的协调、稳定运行。对于数据处理速率与准确度需求较高的应用场景，时钟系统通常以独立芯片或模块的形式存在。时钟芯片主要包括时钟发生器芯片、时钟缓冲芯片、去抖时钟芯片、振荡器及实时时钟芯片（RTC）等。

我们推出了时钟发生器芯片、时钟缓冲芯片和展频振荡器（即支持展频功能的差分振荡器）。其中时钟发生器产品支持最高 4 路独立差分输出，提供高精度时钟源；时钟缓冲器具备 4 至 10 路可扩展输出，实现信号无损分配；展频振荡器在提供高精度时钟源的同时，可通过展频功能有效抑制电磁干扰（EMI），提升系统稳定性。我们的时钟芯片采用先进的数模混合架构，实现业界领先的超低输出相位噪声，每个输出通道均支持独立配置 I/O 类型、驱动能力、电压值、输出频率及展频参数，可精准匹配不同接收端的需求，显著提升信号完整性，同时降低系统功耗与设计复杂度。

随着 AI 算力的迅猛增长、5G 通信的持续升级及工业自动化的不断深化，市场对时钟信号的精度与稳定性要求日益严格。我们的时钟芯片产品凭借高可靠性、低抖动和广泛适配能力，已成功通过多家头部客户的测试验证，未来将广泛应用于 AI 服务器与数据中心、通信基础设施、工业控制设备、消费电子及汽车电子等领域。



图：澜起科技时钟芯片示意图

➤ 津逮®产品线

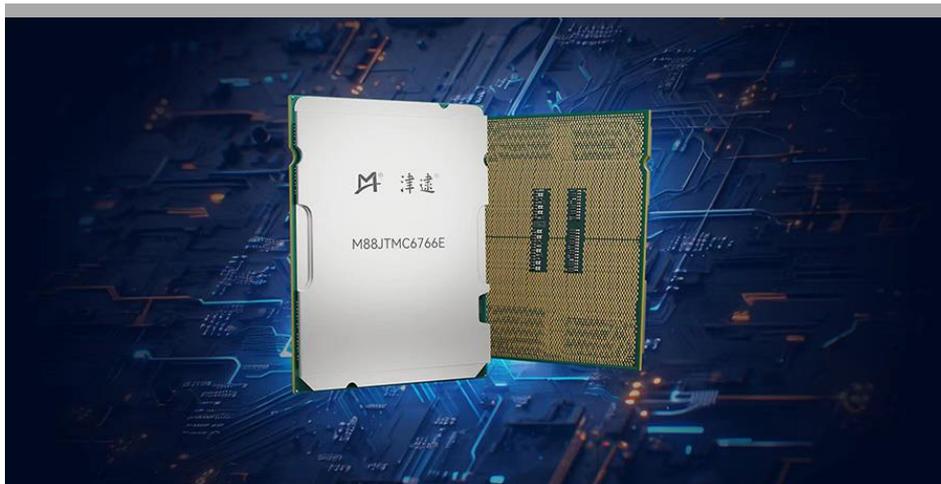
我们的津逮®产品线主要包括津逮®CPU 及数据保护和可信计算加速芯片等。该产品线具备芯片级实时安全监控功能，可在信息安全领域发挥重要作用，为云计算数据中心提供更为安全、可靠的运算平台。此外，该产品线还融合了先进的异构计算与互联技术，可为大数据及云计算时代的各种应用提供强大的综合数据处理及计算力支撑。

1. 津逮®CPU

津逮®CPU 是一系列具有预检测、动态安全监控功能的 x86 架构处理器，适用于津逮®或其他通用的服务器平台。我们先后推出了第一代至第六代津逮®CPU，以更好满足用户对安全可靠算力日益提升的需求。

2019 年 5 月，公司发布第一代津逮®CPU；2020 年 8 月，公司发布第二代津逮®CPU；2021 年 4 月，公司发布第三代津逮®CPU。2022 年 10 月，公司第三代津逮®CPU 系列产品通过了 VMware 公司的产品兼容性认证，达到 VMware ESXi 7.0 U3 虚拟化平台的通用兼容性及性能、可靠性要求，满足用户的关键应用需求。2023 年 1 月 12 日，公司发布第四代津逮®CPU。2023 年 12 月 18 日，公司发布第五代津逮®CPU。2024 年 6 月，公司发布全新第六代津逮®能效核 CPU。

2025 年 8 月，我们发布了第六代津逮®性能核 CPU，单颗 CPU 最高支持 86 个高性能核心和 172 个线程，最大三级缓存容量达 336MB，内存子系统采用 8 通道 DDR5 架构，最高支持 6400MT/s 的 RDIMM 或 8000MT/s 的 MRDIMM，显著提升内存带宽与扩展能力，在 I/O 方面，提供 88 条 PCIe® 5.0 通道，并兼容 CXL® 2.0 协议，为 GPU、FPGA 等加速器提供卓越的连接带宽。



图：第六代津速®能效核 CPU

2. 数据保护和可信计算加速芯片

我们的数据保护和可信计算加速芯片采用公司自主创新的 Mont-TSSE®可信安全系统扩展架构和技术，将硬件级数据加解密和平台可信度量两大核心功能融合于单一芯片之上。芯片内部集成了高速加解密、安全 SoC 和硬件信任根（HRoT）三个子系统。

该芯片硬件支持 SM2/3/4、SHA-256/384/512、AES、RSA、ECC 等商密算法和国际主流加解密算法加速，可广泛应用于对数据保密性、完整性要求极高的场景，如 AI 训练和推理、分布式数据存储、零信任架构等。芯片内置多个真随机数发生器(TRNG)，搭配 PCIe 5.0 ×8 高速接口，可提供高达 160Gbps 的吞吐量，多颗芯片集成可实现加密处理能力倍增，从而为数据中心提供高性能加解密算力支持，助力商密算法在数据中心落地应用。

该芯片广泛兼容多项可信计算标准，具备出色的泛在可信优势。芯片符合 TPM、TCM 和 TPCM 等可信计算标准，遵从商密 GM/T 0008-2012、GM/T 0012-2020、GM/T 0028-2014 等多项设计、测试、接口标准，并兼顾 FIPS-140 设计要求和 NIST SP 800-193 固件安全标准，支持 MCTP/SPDM 等协议。芯片可作为硬件信任根(HRoT)使用，满足可信平台 3.0 规范的需求，保障服务器、台式机、嵌入式终端、加速卡（AI 卡）等各类设备启动运行期间的平台安全。

该芯片可用于解决数据中心等高并发数据加解密运算的需求，同时因为其具有低功耗特点，也适用于端侧、边缘侧、嵌入式系统中对数据和平台安全有需求的场景。



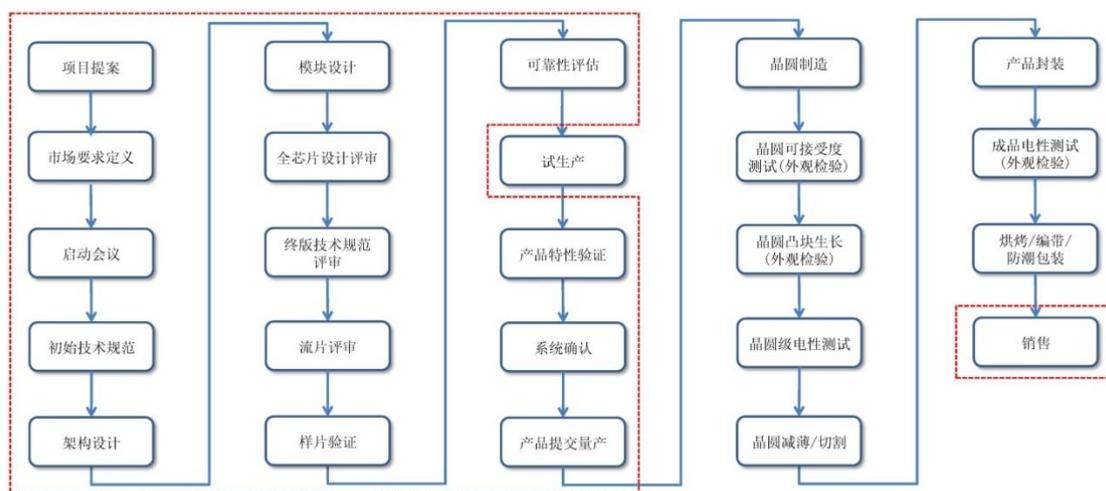
图：澜起科技数据保护和可信计算加速芯片

津逮®产品主要针对中国本土市场，截至目前，已有多家服务器厂商采用津逮®产品，开发出了系列高性能且具有独特安全功能的服务器机型。这些机型已应用到政务、交通等领域及高科技企业中，为用户实现了计算资源池的无缝升级和扩容，在保障强劲运算性能的同时，更为用户的数据、信息安全保驾护航。

2.2 主要经营模式

我们是一家集成电路设计企业，自成立以来公司经营模式均为行业里的 Fabless 模式，该模式下，我们专注于从事产业链中的集成电路设计和营销环节，其余环节委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成，由公司取得测试后芯片成品销售给客户。

在 Fabless 模式下，产品设计与研发环节属于我们经营的核心，由多个部门参与执行。芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成，因此公司需要向晶圆制造厂采购晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务。我们产品的业务流程示意图如下：



注：红色框线标注为公司自主完成，其余由委外厂商完成。

上述流程图中项目提案、市场要求定义、启动会议、初始技术规范、架构设计、模块设计、全芯片设计评审、终版技术规范审议、流片评审、样片验证、可靠性评估、产品特性验证、系统确认、产品提交量产、销售等环节主要由公司完成，其余环节主要由委外厂商完成。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

我们是一家集成电路设计企业，集成电路行业作为全球信息产业的基础，是世界电子信息技术创新的基石。集成电路行业派生出诸如 PC、互联网、智能手机、云计算、大数据、人工智能等诸多具有划时代意义的创新应用，成为现代日常生活中必不可少的组成部分。移动互联时代后，云计算、AI 计算、智能汽车等应用领域的快速发展和技术迭代，正推动集成电路产业进入新的成长周期。

我们的内存接口及模组配套芯片、PCIe Retimer 芯片、MXC 芯片、CKD 芯片等属于高速互连芯片领域。高速互连芯片是支撑数据中心、服务器及计算机实现高速数据交互的必备芯片，主要解决智能算力系统持续升级背景下各类数据传输的瓶颈。高速互连芯片适配多种标准化通信协议，通过信号处理、架构优化等方式，保障数据在各系统间高效、可靠传输。

按技术类别区分，高速互连芯片主要分为三大类：内存互连芯片、PCIe/CXL 互连芯片和以太网及光互连芯片等。其中，内存互连芯片包括内存接口及模组配套芯片，主要用于提升内存数据访问的速度及可靠性；PCIe/CXL 互连芯片包括 PCIe Retimer、PCIe Switch、CXL MXC、CXL Switch 等芯片，主要用于数据中心和服务器单机多卡连接、内存池化、内存扩展等；以太网及光互连芯片包括 Ethernet Retimer/Switch、oDSP、NIC、硅光芯片等，主要用于数据中心集群组网等长距离、高带宽的互连方案。

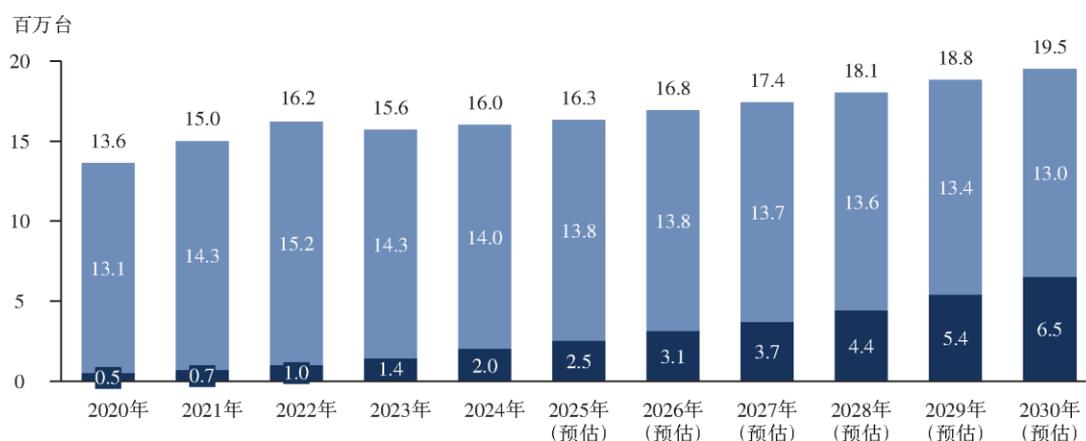
(1) 全球服务器及 PC 市场行业情况

高速互连芯片以服务器领域为主要应用场景，在 PC 领域亦有部份应用。

AI 服务器对高速互连的需求与日俱增，成为驱动高速互连芯片市场扩容的关键动力。根据行业相关数据，全球 AI 服务器出货量从 2020 年的 50 万台激增至 2024 年的 200 万台，年均复合增长率为 45.2%；展望未来，其出货量将进一步从 2025 年的 250 万台增长至 2030 年的 650 万台，年均复合增长率为 21.2%。AI 服务器需求的增长主要由大模型训练、推理等需求驱动，多芯片集群架构需高带宽、低延时互连支撑海量数据交互，直接拉动 PCIe/CXL 互连芯片、以太网及光互连芯片的需求，同时推动对更大容量及更高带宽系统主内存的需求。随着 AI 服务器向“多卡互连

+高速协议”架构升级，支持 PCIe 6.0、CXL 3.0 等新一代标准的高速互连芯片需求将持续攀升。通用服务器市场需求较为平稳，但同时也需要高速互连芯片来提升数据访问稳定性，其增速虽不及 AI 服务器，仍是相关市场的重要支撑。

复合年增长率	2020年至2024年	2025年至2030年（预估）
AI服务器	45.2%	21.2%
通用服务器	1.6%	-1.2%
总计	4.2%	3.6%



图：全球服务器出货量，按服务器类型（AI、通用）拆分

资料来源：弗若斯特沙利文¹

全球 PC 出货量总体呈平稳增长趋势，2024 年出货量为 2.59 亿台，未来预计出货量将从 2025 年的 2.63 亿台增长至 2030 年的 2.98 亿台，年均复合增长率 2.5%。

（2）内存模组行业情况

内存模组是计算机架构的核心组成部分之一，主要作为 CPU 与硬盘的数据中转站，用于临时存储数据，其存储和读取速度远高于硬盘。根据应用领域不同，内存模组可分为以下几类：①服务器内存模组，目前主要包括 RDIMM 和 LRDIMM 等类型，随着服务器数据存储和处理负载的

¹ 本年度报告引用了来自弗若斯特沙利文的多项行业数据，均来自于弗若斯特沙利文为公司发行 H 股股票并在香港联交所上市的招股章程编制的独立市场研究报告，相关详情请参阅公司于香港联交所网站披露的招股章程（链接：<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0130/2026013000007.pdf>）。相关数据仅作为行业背景参考，既不代表公司的业务预测，也不构成对业绩达成或投资回报的任何明示或暗示保证，请投资者注意识别相关风险并理性决策。

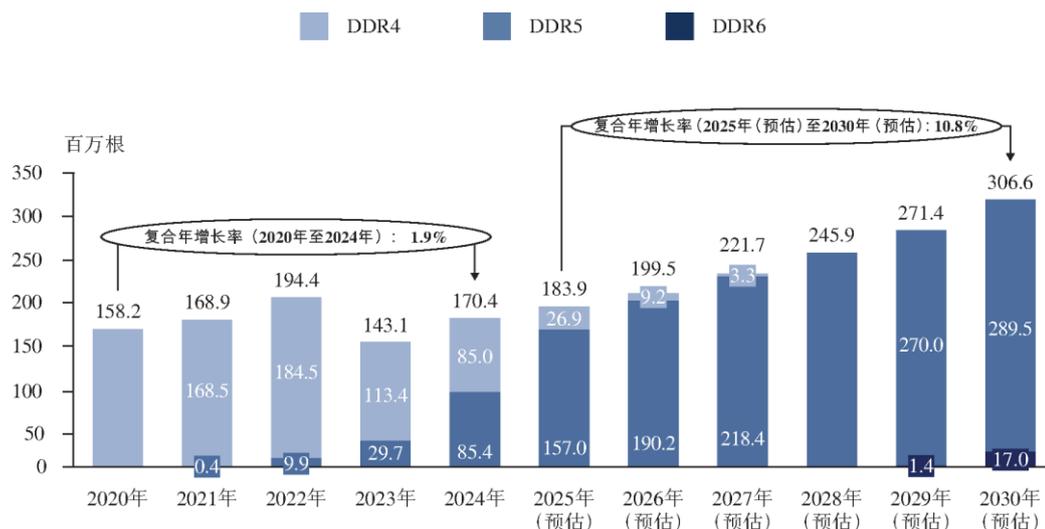
不断增加，对服务器内存模組的稳定性、纠错能力以及低功耗的要求也日益提高；②普通台式机、笔记本内存模組，主要类型为 UDIMM、SODIMM 等。全球 DRAM 市场中，90% 左右的市场份额由三星电子、海力士及美光科技占据，这三家公司也是公司内存接口芯片及内存模組配套芯片的主要下游客户。

内存模組的发展遵循清晰的技术升级路径，相关标准由 JEDEC 组织定义，涵盖内存模組的组成构件、性能指标和具体参数等。近年来，服务器内存模組行业正经历从 DDR4 世代向 DDR5 世代的切换，目前 DDR5 第一、第二、第三子代内存产品已实现量产，JEDEC 已完成 DDR5 第四、第五子代标准制定，并正在推进第六子代产品标准的制定。为满足传输速率提升及新的产业需求，JEDEC 还陆续定义了多种新型内存模組架构，例如用于服务器的 MRDIMM，以及用于台式机/笔记本电脑的 CUDIMM、CSODIMM、CAMP、LPCAMP 等。目前，JEDEC 正在开展对 DDR6 相关标准的讨论。

内存模組与 CPU 是计算机的两个核心部件，是计算机生态系统的重要组成部分。随着支持更高速率 DDR5 的 CPU 的持续迭代，DDR5 内存模組的渗透率将提升，同时其子代的更新迭代也将持续推进。

根据弗若斯特沙利文的数据，2020 年至 2024 年，服务器内存模組出货量从 1.58 亿根增长至 1.7 亿根；到 2030 年预计将攀升至 3.07 亿根，2025 年至 2030 年间的年均复合增长率约为 10.8%，呈现良好增长态势。从市场结构上看，服务器内存模組正加速向 DDR5 世代迈进：DDR5 从 2021 年开始在下游应用，到 2024 年渗透率已超过 50%，预计在 2025 年将超过 85%。同时，DDR6 内存模組有望在 2029 年前后实现商业化应用，为市场注入新的增长动力。

驱动服务器内存模組需求量增长的核心因素，在于全球服务器出货量的增长，以及单台服务器内存模組配置数量的增加。AI 服务器的崛起，进一步推动了市场需求。由于 AI 服务器对内存容量的需求显著增加，须配置更多的内存模組，通常一台典型 AI 服务器配置的内存模組数量是通用服务器的 2 倍左右，因此，随着 AI 技术在各行业的广泛应用，AI 服务器渗透率持续提升，将直接推动服务器内存模組整体需求增速高于服务器增速，进而为内存互连芯片市场带来广阔的发展空间。



图：全球服务器内存模组出货量

资料来源：弗若斯特沙利文

(3) 内存互连芯片行业情况

内存互连芯片包括内存接口芯片、内存模组配套芯片等。内存接口芯片是服务器内存模组的核心逻辑器件，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。

内存接口芯片的发展演变情况如下：

内存接口芯片世代	技术特点	主要厂商	研发时间跨度
DDR2	最低可支持 1.5V 工作电压	TI (德州仪器)、英特尔、西门子、Inphi、澜起科技、IDT 等	2004 年-2008 年
DDR3	最低可支持 1.25V 工作电压，最高可支持 1866MT/s 的运行速率	Inphi、IDT、澜起科技、Rambus、TI (德州仪器) 等	2008 年-2014 年
DDR4	最低可支持 1.2V 工作电压，最高可支持 3200MT/s 的运行速率	澜起科技、IDT、Rambus	2013 年-2017 年
DDR5	最低可支持 1.1V 工作电压，RDIMM 预计可实现 9200MT/s 的运行速率；MRDIMM 预计可实现 16000MT/s 的运行速率	澜起科技、瑞萨电子 (原 IDT)、Rambus	2017 年至今

从 2016 年开始，DDR4 技术进入成熟期并成为内存市场的主流技术。为了实现更高的传输速率和支持更大的内存容量，JEDEC 进一步完善了 DDR4 内存接口芯片的技术规格，增加了多种功能以支持更高速率和更大容量的内存。在 DDR4 世代一共有四个子代产品，每一子代内存接口芯片的最高传输速率不断提升，其中最后一个子代产品支持的最高传输速率达到 3200MT/s。随着 DDR5 内存技术的成熟和商用，DDR5 已经取代 DDR4 成为市场主流产品。相比 DDR4 最后一个子代产品，DDR5 内存接口芯片采用了更低的工作电压（1.1V），并在传输效率和可靠性上进一步提升。根据 JEDEC 公布的信息，DDR5 内存接口芯片已经规划了六个子代，前五个子代产品支持速率分别是 4800MT/s、5600MT/s、6400MT/s、7200MT/s、8000MT/s，最后一个子代支持速率预计将达到 9200MT/s。通过持续的技术创新，以实现更高的传输速率和支持更大的内存容量，将是内存接口芯片行业未来发展的趋势和动力。

在 DDR5 世代，根据 JEDEC 定义，服务器内存模组除了需要内存接口芯片之外，还需要配置三种配套芯片：一颗 SPD 芯片、一颗 PMIC 芯片和两颗 TS 芯片；普通台式机和笔记本电脑的内存模组（UDIMM、SODIMM）则需要配置两种配套芯片：一颗 SPD 芯片和一颗 PMIC 芯片。

随着技术的发展，内存互连领域衍生出新的接口芯片种类，包括用于服务器新型高带宽内存模组 MRDIMM 的 MRCD/MDB 芯片，以及用于 PC 端内存模组的 CKD 芯片：

在服务器端，随着人工智能和大数据分析等应用快速发展，处理器内核数量日益增多，对内存带宽的需求急剧增长，JEDEC 制定了新型高带宽内存模组多路复用双列直插内存模组 MRDIMM（Multiplexed Rank DIMM）的相关技术标准。根据 JEDEC 公布的信息，DDR5 MRDIMM 通过创新设计提高了数据传输速率和整体系统性能。多路复用允许将多个数据信号组合并通过单个通道传输，从而在不增加额外物理连接的情况下提升带宽，实现无缝带宽升级，使数据速率超过同期的 DDR5 RDIMM。其特性包括：①平台与 RDIMM 兼容，提供灵活的用户带宽配置；②采用标准的 DDR5 DIMM 组件(包括 DRAM、外形尺寸、引脚分布、SPD、PMIC 和 TS)，便于推广；③利用 RCD/DB 逻辑处理能力实现高效的 I/O 扩展；④借助现有的 LRDIMM 生态系统进行设计和测试。MRDIMM 未来将持续迭代升级，第一子代 MRDIMM 支持 8800MT/s 速率，第二子代 MRDIMM 支持 12800MT/s 速率，正在定义的第三子代 MRDIMM 支持的速率预计实现 16000MT/s。MRDIMM 需要搭配 1 颗 MRCD 和 10 颗 MDB 芯片，其设计复杂度和速率要求高于普通的 RCD 和 DB 芯片。

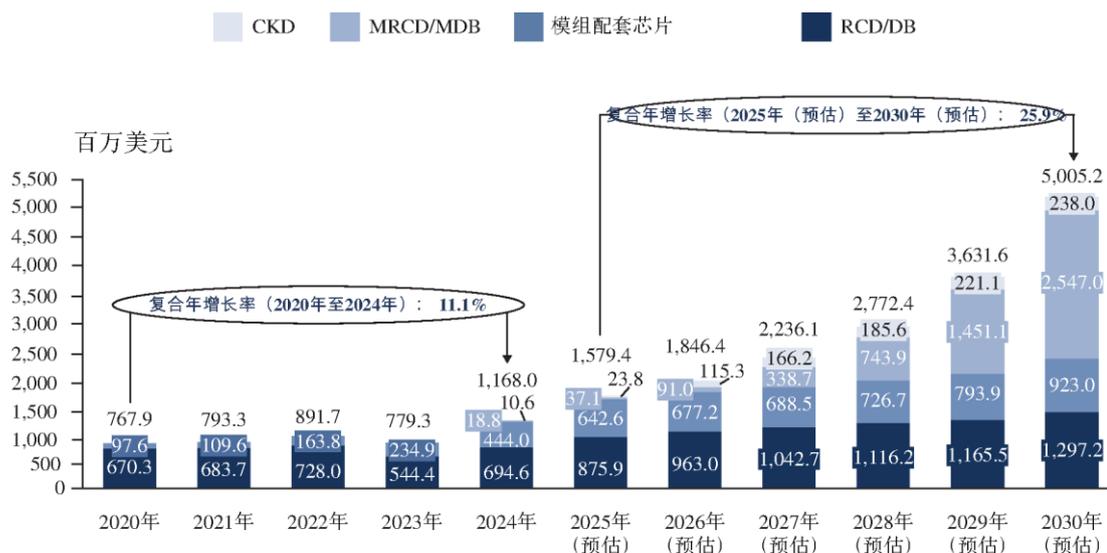
在 PC 端，随着 DDR5 传输速率持续提升，到 DDR5 中期，原本无需信号缓冲的 UDIMM、SODIMM（主要用于台式机和笔记本电脑），将需要配备一颗 CKD 芯片，对内存模组的时钟信号进行缓冲和重新驱动，从而提高时钟信号的完整性和可靠性。JEDEC 已制定了 CUDIMM 和 CSODIMM 内存模组相关标准，包括 CKD 芯片标准，将应用于支持 6400MT/s 及以上内存速率的台式机和笔记本电脑。

内存模组		RCD	DB	SPD	TS	PMIC	MRCD	MDB	CKD
服务器	RDIMM (DDR4)	1	-	1	-	-	-	-	-
	LRDIMM (DDR4)	1	9	1	-	-	-	-	-
	RDIMM (DDR5)	1	-	1	2	1	-	-	-
	LRDIMM (DDR5)	1	10	1	2	1	-	-	-
	MRDIMM (DDR5)	-	-	1	2	1	1	10	-
PC端	UDIMM/SODIMM (DDR4)	-	-	1	-	-	-	-	-
	UDIMM/SODIMM (DDR5)	-	-	1	-	1	-	-	-
	CUDIMM/CSODIMM/CAMM (DDR5)	-	-	1	-	1	-	-	1
	LPCAMM (DDR5)	-	-	1	-	1	-	-	-

图：内存互连芯片在不同类型的内存模组中的应用及配比数量

附注：(1)UDIMM(Unbuffered Dual In-line Memory Module):无缓冲双列直插内存模块；(2)CUDIMM(Clocked Unbuffered Dual In-line Memory Module):时钟无缓冲双列直插内存模块；(3)SODIMM(Small Outline Dual In-line Memory Module):小型双列直插内存模块；(4)CSODIMM(Clocked Small Outline Dual In-line Memory Module):时钟小型双列直插内存模块；(5)CAMM(Compression Attached Memory Module):压缩附加内存模块；(6)LPCAMM(Low Power Compression Attached Memory Module):低功耗压缩附加内存模块。

根据弗若斯特沙利文的数据，内存互连芯片市场规模从 2020 年的 7.68 亿美元增长至 2024 年的 11.68 亿美元，预计未来将进一步从 2025 年的 15.79 亿美元增长至 2030 年的 50.05 亿美元，期间年均复合增长率高达 25.9%。2024 年，中国占全球市场 20% 的份额，预计到 2030 年将占约 30%。



图：全球内存互连芯片市场规模

资料来源：弗若斯特沙利文

(4) PCIe 互连行业情况

PCIe 协议是一种高速串行计算机扩展总线标准，自 2003 年诞生以来，其互连技术在近几年发展迅猛，传输速率基本每 3-4 年翻倍增长，并保持良好的向后兼容特性。从 PCIe 4.0 到 PCIe 5.0，传输速率已从 16GT/s 提升至 32GT/s；到 PCIe 6.0 和 PCIe 7.0，传输速率将进一步提升至 64GT/s 和 128GT/s。凭借强大的生态系统，平台厂商、芯片厂商、终端设备厂商和测试设备厂商深度合作，PCIe 已成为主流互连接口，全面覆盖了 PC 机、服务器、存储系统等各种计算平台，广泛服务于云计算、企业级计算、人工智能和物联网等应用场景。

① PCIe Retimer 芯片

PCIe Retimer 芯片是在 PCIe 协议升级迭代背景下应运而生的，它主要解决数据中心和服务器在通过 PCIe 协议进行高速、远距离传输时，面临的信号时序不齐、损耗大、完整性差等问题。

随着应用的快速发展，PCIe 协议持续迭代更新，传输速率不断翻倍，但服务器的物理尺寸受限于工业标准，变化不大。这导致整个链路的插损预算从 PCIe 3.0 时代的 22dB 增加到 PCIe 4.0 时代的 28dB，并进一步增长到 PCIe 5.0 时代的 36dB。业界亟待解决 PCIe 信号链路的插损问题，以提高信号传输距离。

一种解决方案是选用低损 PCB，但其成本高昂且难以有效覆盖多连接器应用场景；另一种解决方案是引入链路扩展器件，如 PCIe Retimer 芯片，通过采用模拟信号和数字信号调理技术及重

定时技术，Retimer 芯片能够补偿信道损耗并消除抖动影响，从而提升 PCIe 信号的完整性，增加高速信号的有效传输距离。相较于其他技术解决方案，Retimer 芯片在性能、标准化和生态系统支持等方面具有明显优势，可用于 CPU 与高速外设（如 GPU、AI 芯片、SSD 卡及网卡等）的互连，适应多连接器应用场景，未来还可以根据系统配置灵活切换至 PCIe 或 CXL 模式，更受用户青睐。

因此，随着传输速率从 PCIe 4.0 的 16GT/s 翻倍至 PCIe 5.0 的 32GT/s，Retimer 芯片的技术优势愈发显著。根据行业发展趋势，到 PCIe 5.0 时代，PCIe Retimer 芯片已成为行业主流解决方案。近两年，随着 AI 服务器需求快速增长，PCIe Retimer 芯片已成为 AI 服务器中的关键部件，其市场规模也随之迅速扩大。

② PCIe Switch 芯片

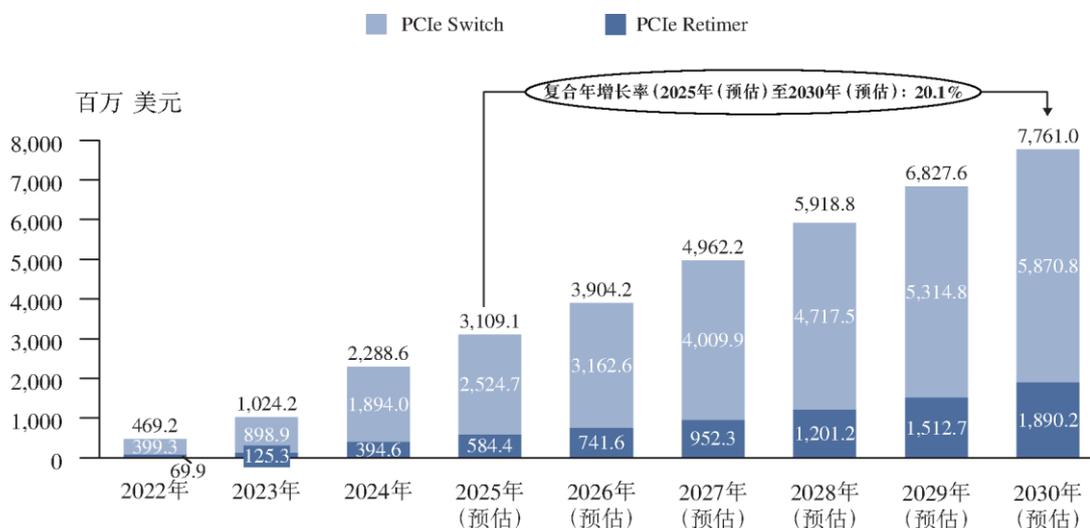
PCIe Switch 芯片是一种用于扩展和连接多个 PCIe 设备的关键组件，可以将有限的 PCIe 通道分配给更多设备，同时优化带宽分配。

PCIe Switch 芯片是用于实现高速、低延迟的设备互连的关键组件，其主要功能为：a.扩展接口：可增加 PCI Express 接口数量，让更多设备通过 PCIe 总线高速通信。如服务器中，当 CPU 的 PCIe 通道不足时，PCIe Switch 芯片可连接多个设备，例如 SSD、网卡、GPU 等；b.数据转发：在点到点（P2P）工作模式下，为连接的多个设备进行数据转发，将多个 PCIe 通道连接到芯片上，实现设备高速连接；c.实现分区功能：相当于以太网 Switch 里的虚拟局域网（Vlan），可将多台机器连接到同一片 PCIe Switch，并进行分区配置，把某些端点设备分配给特定服务器，实现统一管理和灵活分配，避免多个操作系统枚举同一堆 PCIe 总线内的角色时出现访问地址冲突；d.支持 NTB（Non-Transparent Bridge）技术：通过地址翻译实现不同分区或系统中的设备通信。例如传统存储系统中的多个控制器，可利用 NTB 技术通过 PCIe 链路直接通信，实现数据和控制信息的同步。

PCIe Switch 芯片可以突破主机有限 PCIe 接口的制约，实现更多设备的高密度 PCIe 互连，显著提升系统扩展性和资源利用率，在数据中心、云计算、存储系统、网络设备中有广泛的应用，尤其适用于对带宽和延迟敏感的场景。比如在数据中心和云计算中，PCIe Switch 芯片可以连接多块 GPU/AI 加速卡进行并行计算，也可以构建 GPU/AI 加速卡集群进行超大规模计算；在存储系统中，PCIe Switch 芯片可以连接大量 NVMe SSD，构建高速存储池；在网络设备中，PCIe Switch 芯片可以连接多块 100G/400G 网卡，管理高速端口的数据转发。

AI 服务器的快速增长显著拉动了 PCIe Retimer 芯片和 PCIe Switch 芯片的需求。以配置 8 块 GPU 的典型 AI 服务器为例，通常需配备 2 至 4 个 PCIe Switch 实现拓扑扩展，同时需要 8 至 16 个 Retimer，以延长 CPU 与外设间的有效传输距离。目前，根据部分国内 8 卡 GPU 服务器的方案，需要 24 个 Retimer 芯片。因此，PCIe 互连芯片已成为 AI 服务器中不可或缺的核心器件，其需求量与 AI 服务器出货量呈正相关。

根据弗若斯特沙利文的数据，PCIe 互连芯片市场规模从 2022 年的 4.69 亿美元快速增长至 2024 年的 22.89 亿美元。行业预测显示，未来该市场将持续高速增长，预计 2030 年市场规模将达到 77.61 亿美元，2025 至 2030 年间的年复合增长率高达 20.1%。2024 年，中国占全球市场 25% 以上的份额，预计到 2030 年将占 30% 以上。



图：全球 PCIe 互连芯片市场规模

资料来源：弗若斯特沙利文

(5) CXL 互连行业情况

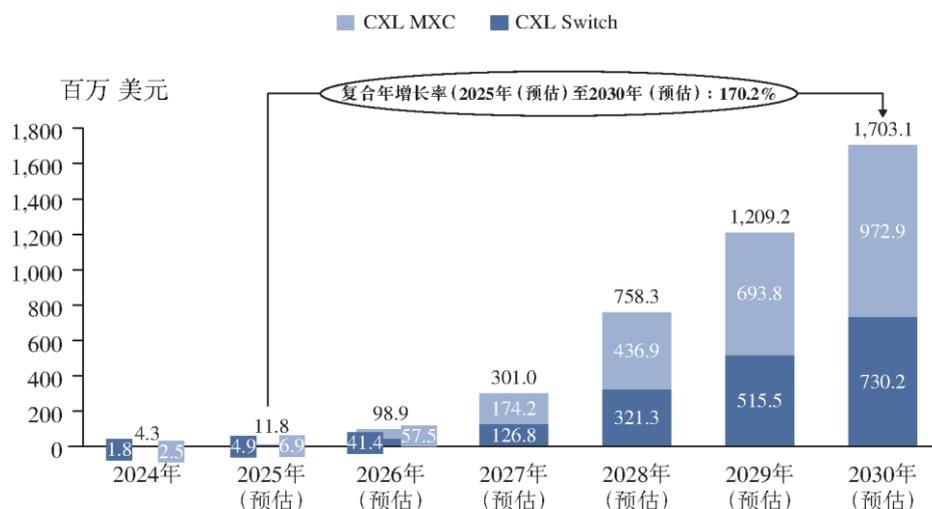
作为一种新兴的高速互连技术，CXL 自推出以来就备受业界关注。随着人工智能、云计算等领域的高速发展，内存扩展、内存池化等 CXL 技术的典型应用正在受到越来越多厂商的积极部署，以打破内存瓶颈。

近年来，CXL 技术在数据中心和人工智能领域展现出巨大的应用潜力。在数据中心领域，CXL 技术通过高带宽、低延迟的特性，将不同的计算和存储资源进行互连，形成庞大的资源池，可以显著提升数据处理和分析效率，满足现代数据中心对大规模数据处理和分析的需求。在人工智能领域，CXL 技术通过支持 GPU 和 FPGA 等加速器与主处理器的高效协作，可显著提升 AI 模型训练和推理的速度，实现低延迟、高速的数据传输，从而大幅提高计算效率；同时 CXL 技术支持内

存扩展和内存共享，为 AI 应用提供更大的内存空间和更灵活的资源分配方式。根据相关服务器厂商测评，CXL 内存池化方案在 AI 推理、向量数据库和内存数据库三个最重要的大内存应用场景中，均有卓越性能表现；CXL 内存池化方案为运行更大参数 AI 模型提供了更高容量和性能的内存支持。

CXL 协会 2024 年发布了 CXL3.2 标准，2025 年又继续推出了 CXL4.0 标准，CXL 技术的相关生态也在不断完善：（I）从主流 CPU 厂商来看，英特尔发布了两款支持 CXL 2.0 协议的 CPU（Granite Rapids 和 Sierra Forest），AMD 发布了支持 CXL 2.0 协议的第五代 EPYC 处理器，上述 CPU 平台能支持更多的 CXL 设备类型，提供更好的安全性和可靠性，适配更多的应用场景；2025 年主流 CPU 厂商也继续推进 CXL3.0 新平台的内部验证，未来几年数据中心支持 CXL 技术的服务器平台比例将进一步提升。（II）从内存模组厂商来看，SK 海力士和三星电子正在积极研发并量产 CXL 兼容的内存模块，如三星电子展示了 CMM-D 2.0 模组，并于联想一起完成了 128GB CMM-D CXL 内存模块的验证，而且计划在 2026 年推出 CMM-D 3.0 模组。（III）从服务器平台来看，CXL Switch 也开始应用于服务器平台，支持 CXL 协议的数据传输，可以实现多个节点间的内存和其他设备资源的共享。未来，越来越多的服务器 CPU 和 GPU 都将支持 CXL 接口，这一趋势将显著推动 CXL 市场的发展，尤其是在数据中心、人工智能和云计算等领域的广泛应用。

根据弗若斯特沙利文的数据，2024 年 CXL 互连芯片市场尚处于商业化初期，市场规模约为 430 万美元，行业预测未来几年该市场将迎来爆发式增长，预计至 2030 年市场规模将达到 17.03 亿美元，2025 至 2030 年期间的年均复合增长率高达 170.2%。2024 年，中国占全球市场 25% 以上的份额，预计到 2030 年将占 30% 以上。



图：全球 CXL 互连芯片市场规模

资料来源：弗若斯特沙利文

（6）时钟芯片行业情况

时钟芯片是为电子系统提供其必要的时钟脉冲的芯片。在数字系统中，时钟脉冲是集成电路运转的节拍器，在电子系统中扮演着“心脏”的重要角色。高频/高性能数字模块的正确运行需要时钟芯片提供精准的时钟脉冲（节拍）来同步运算操作和数据传输交互。时钟脉冲的性能决定了系统是否能运行到目标速度，时钟芯片不达标有可能导致模块或设备无法运作。因此，时钟芯片提供的输出时钟需要具备极高的可靠性、宽广的输出频率范围、优良的抖动特性以及扩频功能。

目前，时钟芯片主要包括时钟发生器、去抖时钟芯片、时钟缓冲芯片和展频振荡器等产品子类。时钟发生器是根据参考时钟来合成多个不同频率时钟的芯片，它是时钟芯片的一个重要类别，是数据中心、工业控制、新能源汽车等领域的基础芯片；去抖时钟芯片是为其他芯片提供低抖动低噪声的参考时钟的芯片；时钟缓冲芯片是用于时钟脉冲复制、格式转换、电平转化等功能的芯片；展频振荡器是基于扩展频谱技术的晶体振荡器，通过调制原始时钟信号的频率分布，将能量分散到更宽的频带内，从而降低电磁干扰（EMI）峰值并提升系统稳定性。

从市场规模来看，时钟芯片是一个相对成熟、空间较大的市场。根据弗若斯特沙利文的数据，全球时钟芯片市场已进入稳定增长阶段，市场规模从 2020 年的 17 亿美元增长至 2024 年的 22 亿美元，期间年均复合增长率为 5.7%。展望未来，随着 AI 服务器、高速通信、智能驾驶与工业边缘计算等对高精度时钟的需求持续增长，时钟芯片在系统架构中的价值量将稳步提升。预计至 2030 年，全球时钟芯片市场规模预计将扩大至 30 亿美元，2025 至 2030 年间年均复合增长率为 5.3%。根据 Market Data Forecast 的数据，2022 年全球时钟芯片的市场规模合计为 20.3 亿美元，预计到 2027 年可达到 30.2 亿美元。

目前，高性能时钟芯片国产化程度较低，主要市场份额被少数几家海外厂商占据，国产替代空间广阔。比如单台服务器内一般需要 10 颗左右的时钟芯片，平均每台中高端仪器仪表使用约 4 颗时钟芯片。

AI 已成为服务器技术升级的核心驱动力：一方面，推动互连标准向 PCIe 5.0 及 112G 切换；另一方面，AEC/AOC 等技术的应用也对时钟芯片性能提出了新要求。这两大趋势，共同构成了对高性能时钟芯片的强劲需求。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1) 内存互连芯片

内存接口芯片和内存模组配套芯片是 JEDEC 固态技术协会定义的行业标准产品。我们在该领域深耕二十年,拥有自主知识产权的高速、低功耗技术,可为新一代服务器平台提供符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案,是全球可提供从 DDR2 到 DDR5 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一,产品获得市场和用户的广泛认可。

在产品标准制定方面,我们是全球微电子行业标准制定机构 JEDEC 固态技术协会的董事会成员之一,在 JEDEC 下属的若干个委员会及分会中安排员工担任主席或副主席职位,深度参与 JEDEC 相关产品的标准制定,在该领域拥有重要话语权。我们牵头制定 DDR5 RCD、MDB 及 CKD 芯片的国际标准,并积极参与 DDR5 内存模组配套芯片的标准制定。

在技术实力方面,我们处于国际领先水平。我们发明的 DDR4 全缓冲“1+9”架构被 JEDEC 国际标准采纳,并在 DDR5 世代演化为“1+10”框架,继续作为 LRDIMM 的国际标准,同时衍生出 MRDIMM 国际标准。在 DDR5 世代,我们进一步巩固了技术领先优势。2025 年 1 月,我们推出 DDR5 第二子代 MRCD/MDB 芯片,支持速率为 12800MT/s; 2025 年 10 月,我们的 DDR5 第四子代 RCD 芯片成功量产,支持速率为 7200MT/s; 2025 年 11 月,我们推出新一代用于客户端的 DDR5 CKD 芯片,支持速率为 9200MT/s。

在市场份额方面,我们在 DDR4 世代逐步确立了行业领先地位,是全球可提供 DDR4 内存接口芯片的三家主要厂商之一,占据全球市场的重要份额。在 DDR5 世代,我们牵头制定相关产品国际标准,并提供完整的内存接口及模组配套芯片解决方案,继续保持行业领先地位。根据弗若斯特沙利文的数据,2024 年内存互连市场整体呈现高度集中的市场格局,前三家企业合计占据 93.4% 的市场份额:其中,我们以 36.8% 的市场份额,排名全球第一。

(2) PCIe Retimer 芯片

PCIe Retimer 芯片是适用于 PCIe 协议的超高速时序整合芯片,其技术实现和协议交互均需符合 PCI-SIG 联盟制定的标准体系。

在 PCIe 4.0 时代,我们是全球量产 PCIe 4.0 Retimer 芯片的三家厂商之一;进入 PCIe5.0 时代,我们成为全球主要供货 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片的两家厂商之一。2025 年 1 月,我们推出了 PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer 芯片并向客户送样,并于 2026 年 1 月发布 PCIe 6.x/CXL 3.x AEC 解决方案,同时正在积极推进 PCIe 7.0 Retimer 芯片的研发。

作为全球领先的 PCIe Retimer 芯片供应商之一，我们自研的 PCIe SerDes IP 已成功应用于 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 和 PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer 芯片中。自研 IP 带来了良好的整合性，使公司的产品在信道适应能力、传输时延等关键性能指标上处于行业领先水平，此外，我们的 PCIe Retimer 芯片还提供全方位的遥测功能，能够实现更全面的链路监控和故障诊断，为高可靠性的 AI 集群应用提供了坚实保障。

基于领先的技术实力及优异的产品性能，我们的 PCIe Retimer 芯片从 2024 年开始出货快速增长，呈现良好成长态势。根据弗若斯特沙利文的数据，2024 年全球 PCIe Retimer 芯片市场呈现出极高的市场集中度，前两家企业合计占据 96.9% 的市场份额：其中，我们作为市场的新进入者，以 10.9% 的市场份额，排名全球第二。

(3) CXL MXC 芯片

CXL MXC 芯片是遵循 CXL 行业标准规范的产品，其设计、功能及互操作性均需通过 CXL 联盟的严格认证，属于 CXL 协议所定义的第三种设备类型，主要用于内存扩展和内存池化。

2022 年 5 月，我们全球首发 MXC 芯片，并与多家全球顶级云计算厂商及内存龙头企业开展合作；同年，全球领先内存厂商三星电子及 SK 海力士先后推出其最新的 CXL 内存产品，均采用了我们的 MXC 芯片。2023 年 8 月，我们的 MXC 芯片顺利通过了 CXL 联盟的数十项严苛测试，成为全球首家通过 CXL1.1 测试的内存扩展控制器产品，与国际知名 CPU 和存储器厂商的产品在 CXL 官网并列展示，彰显了我们的技术实力。2025 年 1 月，我们的 MXC 芯片入选 CXL 联盟公布的首批 CXL 2.0 合规供应商清单，同期入选还包括三星电子和 SK 海力士，其受测产品均采用了我们的 MXC 芯片。2025 年 9 月，我们推出基于 CXL[®]3.1 标准的 MXC 芯片，并已开始向主要客户送样测试。

我们将继续深化与 CPU/GPU 厂商、DRAM 内存厂商、云服务提供商(CSP)、服务器 OEM/ODM 厂商等生态伙伴的交流与合作，紧跟技术前沿，不断推进产品更新迭代，致力于推动 CXL 生态的成熟完善和 CXL 技术的广泛应用，并保持公司在的行业领先地位。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 报告期内与公司及行业相关的新政策

2025 年 8 月，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，以科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等领域为重点，深入实施“人工智能+”行动，涌现一批新基础设施、新技术体系、新产业生态、新就业岗位等，加快培育发展新质生产力。

2025 年 9 月，工业和信息化部、市场监督管理总局发布《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》，方案明确，电子信息制造业 2025 至 2026 年主要预期目标包括，规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速在 7% 左右，到 2026 年，预期实现营收规模和出口比例在 41 个工业大类中保持首位，5 个省份的电子信息制造业营收过万亿，服务器产业规模超过 4000 亿元。

(2) 报告期内行业的新技术及未来发展趋势

➤ 内存互连技术

内存互连技术主要跟随主流 CPU 及内存模组生态系统的发展而演进。报告期内，DDR5 内存模组已取代 DDR4 成为市场主流产品，其内部子代持续迭代升级，同时，行业正在开展对 DDR6 内存互连技术相关标准的讨论和制定。

① 服务器内存互连技术

服务器内存互连技术的演进路径及发展趋势如下：

在传统内存模组 RDIMM 方面，内存互连技术遵循 JEDEC 标准持续演进，各子代产品支持的数据速率在持续提升。例如，DDR5 第一子代内存接口芯片支持速率为 4800MT/s，到了 DDR5 第五子代产品，支持速率提升至 8000MT/s，而 DDR5 第六子代产品将达到 9200MT/s 的速率。

在新型高带宽内存模组 MRDIMM 方面，基于 CPU 多核化的技术演进，以及 AI 和高性能计算应用对内存带宽日益增长的迫切需求，高带宽内存互连技术也在迭代升级，新一子代产品支持的数据速率提升显著。其中，第一子代 MRDIMM 最高支持 8800MT/s 速率，第二子代产品最高支持 12800MT/s 速率，预计第三子代产品支持速率将达到 16000MT/s。MRDIMM 采用 LRDIMM“1+10”的基础架构，需要搭配 1 颗 MRCD 芯片和 10 颗 MDB 芯片，这些新型高带宽内存接口芯片与 CPU 的数据连接仍为单组内存信号，但是通过采用双倍数据传输速率和时分数据复用技术，能够将两个标准速率的内存数据通道合并后进行倍频传输，其与 DRAM 的数据连接则扩展为两组独立内

存信号，可以在标准速率下对 MRDIMM 上面两个内存阵列同时操作，实现双倍速率读写。因此，与普通的 RCD/DB 芯片相比，MRCD/MDR 芯片设计难度更高，构造也更为复杂。随着 MRDIMM 技术逐步成熟以及相关生态日益完善，未来将有更多的服务器 CPU 支持第二子代 MRDIMM，其将为下游应用提供更具性价比的高带宽内存解决方案。

② 客户端内存互连技术

在 DDR4 世代及 DDR5 初期，内存接口芯片只用于服务器内存模组，其核心功能是缓冲来自内存控制器的地址、命令及控制信号，从而提升内存数据访问的速度及稳定性，以满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。由于台式机和笔记本电脑 CPU 及内存模组之间数据传输量相对较小，因此在这类设备中尚未需要对信号进行缓冲。

然而，随着 DDR5 传输速率持续提升，时钟信号频率越来越高，信号完整性面临瓶颈。当 DDR5 数据速率达到 6400MT/s 及以上时，原本无需信号缓冲的 UDIMM、SODIMM（主要用于台式机和笔记本电脑），也需要引入时钟驱动器（CKD），对内存模组的时钟信号进行缓冲和重新驱动，以提高信号完整性和可靠性。DDR5 第一子代 CKD 芯片已于 2024 年开始在行业规模试用，支持速率可达 7200MT/s，主流 CPU 厂商也发布了支持该产品的客户端 CPU。目前，JEDEC 已经制定了新一代 CKD 芯片（支持速率为 9200MT/S）的标准，同时积极推动配备该 CKD 芯片的 CUDIMM 和 CSODIMM 标准的进程。

此外，JEDEC 还制定了尺寸更加紧凑的 CAMM 和 LPCAMM 内存模组的相关标准，以满足笔记本电脑等设备的需求。其中 CAMM 内存模组采用 DDR5 DRAM 颗粒，需配合 CKD、SPD 和 PMIC 芯片使用；而 LPCAMM 内存模组采用 LPDDR5 DRAM 颗粒，需配合 SPD 和 PMIC 芯片使用。

目前，DDR5 相关技术已日臻成熟，相关产品已实现规模商用。为了应对服务器和客户端等应用对高速、大容量、低功耗内存子系统的持续需求，JEDEC 组织已经开始对 DDR6 内存互连技术进行技术讨论和标准制定。公司正深度参与相关技术标准的讨论和制定，并为 DDR6 内存接口芯片和相关模组配套芯片的研发做好准备。行业预计，DDR6 内存模组有望在 2029 年前后开始规模商用。

► PCIe 互连技术

PCIe 作为业界广泛采用的高速串行点对点互连标准，已成为 CPU、GPU、FPGA 和 SSD 等关键计算设备之间不可或缺的连接桥梁。PCI-SIG 持续推动 PCIe 标准的演进，以满足不断增长的互连需求。

AI 服务器的快速发展带动 PCIe Retimer 拓展至高速铜缆领域。高速铜缆主要用于数据中心内部服务器与交换机之间、交换机与交换机之间等短距离互联传输场景，铜缆方案不仅有助于提升数据传输速度和可靠性，还在散热效率、信号传输及成本方面有显著的优势。高速铜缆可以分为无源铜缆（DAC）、有源铜缆（ACC）与有源线缆（AEC）三大类，其中 AEC 通过在线缆两端加入 Retimer 芯片实现对信号的放大和再生，相比传统的无源直连铜缆 DAC 的传输距离更长，同时大幅优化了信号质量。据行业分析，AEC 领域既有以太网 Retimer，也有 PCIe Retimer，目前的应用是以太网 Retimer 为主。相比以太网 Retimer，PCIe Retimer 带宽相对较低，但时延相对较小，在推理服务器上可能具备一定优势。

PCIe 6.0 协议将数据传输速率提高了一倍，达到 64GT/s，以支持人工智能和机器学习等计算密集型应用，同时保持了向后兼容性。行业预计 PCIe 6.0 在 GPU、SSD、CXL 领域的应用将快速增长，并进一步扩展到以太网、工业智能化、无人驾驶汽车和物联网(IoT)等新兴领域。

2025 年，PCI-SIG 发布 PCIe 7.0 规范最终版本，新规范将传输速率提升至 128GT/s，其主要特点包括：1.通过 x16 配置可实现高达 512GB/s 的双向带宽；2.采用 PAM4 信号和基于 Flit 的编码技术；3.提高了能效比；4.保持向后兼容性。PCIe 7.0 标准为下一代 AI、机器学习、800 以太网、云计算和量子计算等数据驱动型应用提供了强大的支持。

►CXL 互连技术

CXL 互连技术可以提升系统间各模块的数据交换效率，解决缓存一致性问题，显著改善多路 CPU、CPU 与加速器之间的通信能力，降低延迟，实现数据中心 CPU 和加速器芯片之间的超高速互连，从而提高数据密集型应用程序的性能。

作为当前数据中心领域重要标准之一，CXL 互连技术其有望催生诸多创新应用，改变现有数据中心的基本架构，从而提升其运行效率并降低运行成本。CXL 标准使用 PCIe 协议作为物理接口，增强了兼容性，通过三种基础协议（CXL.io、CXL cache 和 CXL.memory）支持具体应用。在 CXL 1.1 规范的初期，有三种应用模式：其一，调用 CXL.io 和 CXL cache，可以使得一些内存不足的智能设备（比如智能网卡）与 CPU 内存进行交互；其二，调用 CXL.io、CXL cache 和

CXL.memory, 可以实现 CPU、GPU、ASIC 和 FPGA 等设备间内存的共享, 同时解决缓存一致性问题; 其三, 调用 CXL.io 和 CXL.memory 协议, 可实现内存扩展及内存池化。

2023 年 11 月, CXL 联盟发布了 CXL3.1 规范。该规范对横向扩展 CXL 进行了结构优化, 新增了可信执行环境功能, 并改进了内存扩展器。CXL 3.1 的一项新功能是支持使用全局集成内存 (GIM) 通过 CXL 结构进行主机之间的通信, 提升系统性能, 通过 CXL 对内存访问直接点对点支持, 提高 GPU 内存使用效率, 有利于处理大规模数据集和 AI 工作负载。此外, CXL 3.1 还定义了基于端口的路由 CXL 交换机 Fabric Manager API, 使结构管理器成为 CXL 生态系统的关键, 同时, 其可信安全协议 (TSP) 对云服务提供商的多租户虚拟机环境的安全性至关重要。随着 CXL 技术的发展, 未来数据中心的计算节点和内存节点将实现更加快速、高效和灵活的互连。

2025 年 11 月, CXL 联盟推出了最新的 CXL 4.0 规范。该规范在 CXL 3.x 的基础上将传输速度翻倍, 达到 PCIe 7.0 的 128GT/s; 同时扩展了连接距离, 能够最多支持 4 级 Retimer 芯片来显著增强信号传输, 支持跨机架部署; 通过引入捆绑端口的概念允许将多个物理 CXL 端口聚合成一个逻辑实体, 提升总带宽。针对当前 AI/HPC 工作负载的极端带宽需求, 跨机架远距离传输的痛点, 以及不断提升的 CXL 内存 RAS 的要求, CXL 4.0 都提供了相应的解决方案, 成为未来数据中心互连技术的重要选择之一。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	13,748,147,352.18	12,218,911,386.38	12.52	10,697,540,981.27
归属于上市公司股东的净资产	12,923,722,372.46	11,403,438,067.08	13.33	10,191,406,155.95
营业收入	5,456,316,783.63	3,638,911,068.29	49.94	2,285,738,498.23
利润总额	2,320,568,053.46	1,412,617,850.07	64.27	472,218,810.54
归属于上市公司股东的净利润	2,235,569,970.18	1,411,778,923.59	58.35	450,909,813.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,021,628,734.94	1,248,290,398.82	61.95	369,932,113.14
经营活动产生的现金流量净额	2,022,020,556.92	1,691,321,506.14	19.55	731,249,699.11
加权平均净资产收益率 (%)	18.25	13.41	增加4.84个百分点	4.44

基本每股收益（元/股）	1.97	1.25	57.60	0.40
稀释每股收益（元/股）	1.96	1.25	56.80	0.40
研发投入占营业收入的比例（%）	16.77	20.98	减少4.21个百分点	29.83

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,222,209,473.93	1,411,247,007.15	1,424,232,009.73	1,398,628,292.82
归属于上市公司股东的净利润	525,326,047.97	633,744,331.75	473,213,606.21	603,285,984.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	502,602,549.26	588,783,209.44	376,038,130.77	554,204,845.47
经营活动产生的现金流量净额	188,245,990.36	870,443,028.97	541,982,422.33	421,349,115.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4. 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							106,174
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							115,748
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）							0
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
香港中央结算有限公司	78,515,472	151,412,538	13.21	0	无	0	境外法人

中国电子投资控股有限公司	- 17,117,936	48,045,935	4.19	0	无	0	国有法人
WLT Partners,L.P.	0	45,012,524	3.93	0	无	0	其他
上海融迎企业管理合伙企业（有限合伙）	- 22,899,251	37,905,987	3.31	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	- 16,308,124	37,238,787	3.25	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	- 13,177,598	34,640,959	3.02	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	1,429,028	26,026,042	2.27	0	无	0	其他
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	21,212,320	21,212,320	1.85	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	-639,666	18,881,970	1.65	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	-4,690,957	13,752,675	1.20	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. WLT Partners,L.P.的控制人在上海融迎投资合伙企业（有限合伙）享有重要财产权益； 2. 未知上述其余股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注：年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 115,748 户，其中：A 股 115,743 户，H 股登记股东 5 户。

存托凭证持有人情况适用 不适用**截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**适用 不适用**4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况**适用 不适用**5. 公司债券情况**适用 不适用

第三节 重要事项

一、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025 年，受益于 AI 产业趋势，行业需求旺盛，公司互连类芯片出货量显著增加，推动公司 2025 年度经营业绩较上年同期实现大幅增长。因此，报告期内公司实现营业收入 54.56 亿元，较上年度增长 49.94%；实现归属于母公司所有者的净利润 22.36 亿元，较上年度增长 58.35%。

二、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用